



珠海越亚封装基板技术股份有限公司

Zhuhai Advanced Chip Carriers & Electronic Substrate Solutions

Technologies Co., Ltd.

珠海市斗门区珠峰大道北 3209 号 FPC 厂房

首次公开发行 A 股股票招股说明书

（申报稿）

保荐人（主承销商）



招商证券股份有限公司

China Merchants Securities CO., LTD.

深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38—45 楼

声明

本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说明书（申报稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书全文作为作出投资决定的依据。

本次发行概况

发行股票类型	人民币普通股（A股）		
发行股数	本次公开发行A股股票总数不超过20,170.8023万股，其中公司公开发行新股数量上限为20,170.8023万股，公司股东公开发售股份数量上限为5,000万股且不超过自愿设定12个月及以上限售期的投资者获得配售股份的数量。发行后的流通股股份占公司股份总数的比例不低于25.00%。根据本次发行询价结果，若新股发行募集资金净额超过募投项目所需资金总额的，则公司将相应减少新股发行数量，同时进行老股转让，老股转让所得资金不归公司所有。		
每股面值	1.00元	预计发行日期	【】年【】月【】日
拟上市证券交易所	上海证券交易所	发行后总股本	不超过806,832,090股
每股发行价格	【】		
股份限制流通及自愿锁定承诺	公司并列第一大股东之一方正信产承诺：1.如果珠海越亚本次股票上市成功，本公司承诺自珠海越亚股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本公司直接或者间接持有的珠海越亚首次公开发行股票前已发行股份，也不由珠海越亚回购本公司直接或者间接持有的前述股份。2.珠海越亚股票上市后六个月内如其股票连续二十个交易日的收盘价（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，按有关规定进行相应调整，下同）均低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，本公司持有发行人股票的锁定期限自动延长至少六个月。3.本公司所持珠海越亚股票在上述锁定期满后两年内减持的，减持价格（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，按有关规定进行相应调整）不低于发行价。 方正信产的实际控制人北京大学承诺：如果珠海越亚本次股票上市成功，本单位承诺自珠海越亚股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本单位直接或者间接持有的珠海越亚首次公开发行股票前已发行股份，也不由珠海越亚回购本单位直接或者间接持有的前述股份。 公司并列第一大股东之一AMITEC公司承诺：1.如果珠海越亚本次股票上市成功，本公司承诺自珠海越亚股票上市之日起三十六个月内（“锁定期”），不转让或者委托他人管理本公司直接或者间接持有的		

	珠海越亚首次公开发行股票前已发行的股份，也不由珠海越亚回购本公司直接或者间接持有的前述股份。2.本公司承诺，(1) 如珠海越亚股票上市后六个月内（“额外期限”）如其股票连续二十个交易日的收盘价（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，按有关规定进行相应调整，下同）均低于发行价，或者 (2) 额外期限的期末收盘价低于发行价，上述适用于本公司的锁定期自动延长六个月（“延长的锁定期”）。3.本公司所持珠海越亚股票在上述锁定期（或延长的锁定期，如适用）届满后两年内减持的，减持价格（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，按有关规定进行相应调整）不低于发行价。如适用的法律法规对上述承诺有新的或修改的其他强制性规定，则适用该等规定且承诺的内容相应修改。 AMITEC 公司的控股股东 Priortech 承诺：如果珠海越亚本次股票上市成功，本公司承诺自珠海越亚股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本公司直接或者间接持有的珠海越亚首次公开发行股票前已发行股份，也不由珠海越亚回购本公司直接或者间接持有的前述股份。 AMITEC 公司的实际控制人 Yotam Stern 及 Rafi Amit 均承诺：如果珠海越亚本次股票上市成功且本人为 AMITEC 的实际控制人期间，本人承诺自珠海越亚股票上市之日起三十六个月内，行使本人作为 AMITEC 实际控制人的权力及授权，确保不转让或者委托他人管理本人直接或者间接持有的珠海越亚首次公开发行股票前已发行股份，也不由珠海越亚回购本人直接或者间接持有的前述股份。 本公司股东香港睿祺及珠海睿祺均承诺：1.如果珠海越亚股票上市成功，本公司/本企业承诺自珠海越亚股票上市之日起二十四个月内，不转让或者委托他人管理本公司/本企业持有的珠海越亚首次公开发行股票前已发行的股份，也不由珠海越亚回购本公司/本企业持有的前述股份；2.珠海越亚股票上市后六个月内如其股票连续二十个交易日的收盘价（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，按有关规定进行相应调整，下同）均低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，本公司/本企业持有珠海越亚股票的锁定期自动延长至少六个月。3.本公司/本企业所持珠海越亚股票在上述锁定期满后两年内减持的，减持价格（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，按有关规定进行相应调整）不低于发行价。 本公司股东珠海睿鑫承诺：如果珠海越亚本次股票上市成功，本企业承诺自本企业增资成为珠海越亚股东的工商变更登记完成之日（即 2012 年 9 月 28 日）起三十六个月内，以及自珠海越亚股票上市之日起二十四个月内，不转让或者委托他人管理本企业直接或者间接持有的珠海

	越亚公开发行股票前已发行的股份，也不由珠海越亚回购本企业直接或者间接持有的前述股份。 本公司股东东方富海、东方富海二号、皖江物流、上海开物、宁波科发及开铂银科均承诺：如果珠海越亚本次股票上市成功，本企业承诺自珠海越亚股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本企业直接或者间接持有的珠海越亚公开发行股票前已发行股份，也不由珠海越亚回购本企业直接或者间接持有的前述股份。 担任本公司董事的 Yotam Stern 及 Rafi Amit 均承诺：1.如果珠海越亚股票上市成功，本人承诺自珠海越亚股票上市之日起十二个月内（“锁定期”），不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的该等珠海越亚首次公开发行股票前已发行的股份（统称“该等股份”），也不由珠海越亚回购该等股份。2.如果：(a) 珠海越亚股票上市后六个月内（“额外期限”），其股票连续二十个交易日的收盘价（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，按有关规定进行相应调整，下同）均低于发行价，或者 (b) 额外期限的期末收盘价低于发行价，则该等股份的锁定期自动延长六个月（“延长的锁定期”）。3.上述锁定期（或延长的锁定期，如适用）届满后，本人在担任珠海越亚董事、监事或高级管理人员期间每年转让的股份不超过本人持有的越亚股份总数的 25%。本人若从珠海越亚离职，离职后半年内不转让该等股份；4.该等股份在上述锁定期（或延长的锁定期，如适用）届满后两年内减持的，减持价格（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，按有关规定进行相应调整）不低于发行价。5.本人不会因职务变更、离职等原因而拒绝履行上述承诺。如适用的法律法规对上述承诺有新的或修改的其他强制性规定，则适用该等规定且承诺的内容相应修改。 担任本公司董事的方中华及梅健均承诺：1.如果珠海越亚股票上市成功，承诺人承诺自珠海越亚股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理承诺人直接或间接持有的珠海越亚首次公开发行股票前已发行的股份，也不由珠海越亚回购承诺人直接或间接持有的前述股份。2.珠海越亚股票上市后六个月内如其股票连续二十个交易日的收盘价（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，按有关规定进行相应调整，下同）均低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，承诺人直接或通过承诺人能够实际控制的单位间接持有的珠海越亚股份的锁定期自动延长至少六个月。3.上述锁定期届满后，承诺人在担任珠海越亚董事、监事或高级管理人员期间每年转让的股份不超过承诺人直接或间接持有的珠海越亚股份总数的 25%，承诺人若从珠海越亚离职，离职后半年内不转让承诺人直接或间接持有的珠海越亚股份。4.承诺人直接或通过承诺人能够实际控制的单位间接持有的珠海越亚股票在上述锁定期满后两年内减持的，减持价格（如果因

	派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，按有关规定进行相应调整）不低于发行价。5.承诺人不会因职务变更、离职等原因而拒绝履行上述承诺。 担任本公司高级管理人员的 Dror Hurvits、陈先明、陈春灵、向文胜及黄士辅均承诺：1.如果珠海越亚股票上市成功，承诺人承诺自珠海越亚股票上市之日起二十四个月内，不转让或者委托他人管理承诺人直接或间接持有的珠海越亚公开发行股票前已发行的股份，也不由珠海越亚回购承诺人直接或间接持有的前述股份。2.珠海越亚股票上市后六个月内如其股票连续二十个交易日的收盘价（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，按有关规定进行相应调整，下同）均低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，承诺人直接或通过承诺人能够实际控制的单位间接持有的珠海越亚股份的锁定期自动延长至少六个月。3.上述锁定期届满后，承诺人在担任珠海越亚董事、监事或高级管理人员期间每年转让的股份不超过承诺人直接或间接持有的珠海越亚股份总数的 25%，承诺人若从珠海越亚离职，离职后半年内不转让承诺人直接或间接持有的珠海越亚股份。4.承诺人直接或通过承诺人能够实际控制的单位间接持有的珠海越亚股票在上述锁定期满后两年内减持的，减持价格（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，按有关规定进行相应调整）不低于发行价。5.承诺人不会因职务变更、离职等原因而拒绝履行上述承诺。 担任本公司监事的刘兰兰及谢凤霞均承诺：1.如果珠海越亚股票上市成功，本人承诺自珠海睿鑫增资成为珠海越亚股东的工商变更登记完成之日（即 2012 年 9 月 28 日）起三十六个月内，以及珠海越亚股票上市之日起二十四个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的珠海越亚公开发行股票前已发行的股份，也不由珠海越亚回购本人直接或间接持有的珠海越亚公开发行股票前已发行的股份。2.本人在珠海越亚担任董事/监事/高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人直接或间接所持有的珠海越亚股份总数的 25%，本人若从珠海越亚离职，离职后半年内不转让本人直接或间接所持有的珠海越亚股份。 担任本公司监事的王秋虎承诺：1.如果珠海越亚股票上市成功，本人承诺自珠海越亚股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的珠海越亚首次公开发行股票前已发行的股份，也不由珠海越亚回购本人直接或间接持有的珠海越亚首次公开发行股票前已发行的股份。2.本人在任职期间每年转让的股份不超过本人直接或间接所持有的珠海越亚股份总数的 25%，本人若从珠海越亚离职，离职后半年内不转让本人直接或间接所持有的珠海越亚股份。 根据财政部于 2013 年 5 月 21 日下发的《财政部关于批复教育部珠海

	越亚封装基板技术股份有限公司部分国有股权转由全国社会保障基金理事会持有的函》(财教函[2013]67号)，发行人在境内发行A股并上市后，方正信产应按照《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》的有关规定履行国有股转持义务，将其持有的发行人14,119,562股（以实际发行股份数及根据有关规定的计算结果为准）划转给全国社会保障基金理事会持有。全国社会保障基金理事会将承继方正信产的禁售期义务。
保荐人（主承销商）	招商证券股份有限公司
招股说明书签署日期	2014年6月23日

发行人声明

发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。

中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。

重大事项提示

本公司特别提醒投资者特别关注本公司及本次发行的以下事项和风险：

一、股份限制流通及自愿锁定承诺

公司并列第一大股东之一方正信产承诺：1.如果珠海越亚本次股票上市成功，本公司承诺自珠海越亚股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本公司直接或者间接持有的珠海越亚首次公开发行股票前已发行股份，也不由珠海越亚回购本公司直接或者间接持有的前述股份。2.珠海越亚股票上市后六个月内如其股票连续二十个交易日的收盘价（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，按有关规定进行相应调整，下同）均低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，本公司持有发行人股票的锁定期自动延长至少六个月。3.本公司所持珠海越亚股票在上述锁定期满后两年内减持的，减持价格（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，按有关规定进行相应调整）不低于发行价。

方正信产的实际控制人北京大学承诺：如果珠海越亚本次股票上市成功，本单位承诺自珠海越亚股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本单位直接或者间接持有的珠海越亚首次公开发行股票前已发行股份，也不由珠海越亚回购本单位直接或者间接持有的前述股份。

公司并列第一大股东之一 AMITEC 公司承诺：1.如果珠海越亚本次股票上市成功，本公司承诺自珠海越亚股票上市之日起三十六个月内（“锁定期”），不转让或者委托他人管理本公司直接或者间接持有的珠海越亚首次公开发行股票前已发行的股份，也不由珠海越亚回购本公司直接或者间接持有的前述股份。2. 本公司承诺，(1) 如珠海越亚股票上市后六个月内（“额外期限”）如其股票连续二十个交易日的收盘价（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，按有关规定进行相应调整，下同）均低于发行价，或者(2) 额外期限的期末收盘价低于发行价，上述适用于本公司的锁定期自动延长六个月（“延长的锁定期”）。3.本公司所持珠海越亚股票在上述锁定期（或延长的锁定期，如适用）届满后两年内减持的，减持价格（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，按有关规定进行相应调整）不低于发行价。如适用的法律法规对上述承诺有新的或修改的其他强制性规定，则适用该等规定且承诺的内容相应修改。

AMITEC 公司的控股股东 Priortech 承诺：如果珠海越亚本次股票上市成功，本公司承诺自珠海越亚股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本公司直接或者间接持有的珠海越亚首次公开发行股票前已发行股份，也不由珠海越亚回购本公司直接或者间接持有的前述股份。

AMITEC 公司的实际控制人 Yotam Stern 及 Rafi Amit 均承诺：如果珠海越亚本次股票上市成功且本人为 AMITEC 的实际控制人期间，本人承诺自珠海越亚股票上市之日起三十六个月内，行使本人作为 AMITEC 实际控制人的权力及授权，确保不转让或者委托他人管理本人直接或者间接持有的珠海越亚首次公开发行股票前已发行股份，也不由珠海越亚回购本人直接或者间接持有的前述股份。

本公司股东香港睿祺及珠海睿祺均承诺：1.如果珠海越亚股票上市成功，本公司/本企业承诺自珠海越亚股票上市之日起二十四个月内，不转让或者委托他人管理本公司/本企业持有的珠海越亚首次公开发行股票前已发行的股份，也不由珠海越亚回购本公司/本企业持有的前述股份；2.珠海越亚股票上市后六个月内如其股票连续二十个交易日的收盘价（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，按有关规定进行相应调整，下同）均低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，本公司/本企业持有珠海越亚股票的锁定期自动延长至少六个月。3.本公司/本企业所持珠海越亚股票在上述锁定期满后两年内减持的，减持价格（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，按有关规定进行相应调整）不低于发行价。

本公司股东珠海睿鑫承诺：如果珠海越亚本次股票上市成功，本企业承诺自本企业增资成为珠海越亚股东的工商变更登记完成之日（即 2012 年 9 月 28 日）起三十六个月内，以及自珠海越亚股票上市之日起二十四个月内，不转让或者委托他人管理本企业直接或者间接持有的珠海越亚公开发行股票前已发行的股份，也不由珠海越亚回购本企业直接或者间接持有的前述股份。

本公司股东东方富海、东方富海二号、皖江物流、上海开物、宁波科发及开铂银科均承诺：如果珠海越亚本次股票上市成功，本企业承诺自珠海越亚股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本企业直接或者间接持有的珠海越亚公开发行股票前已发行股份，也不由珠海越亚回购本企业直接或者间接持有的前述股份。

担任本公司董事的 Yotam Stern 及 Rafi Amit 均承诺：1.如果珠海越亚股票上市成功，本人承诺自珠海越亚股票上市之日起十二个月内（“锁定期”），不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的该等珠海越亚首次公开发行股票前已

发行的股份（统称“该等股份”），也不由珠海越亚回购该等股份。2.如果：(a) 珠海越亚股票上市后六个月内（“额外期限”），其股票连续二十个交易日的收盘价（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，按有关规定进行相应调整，下同）均低于发行价，或者 (b) 额外期限的期末收盘价低于发行价，则该等股份的锁定期自动延长六个月（“延长的锁定期”）。3.上述锁定期（或延长的锁定期，如适用）届满后，本人在担任珠海越亚董事、监事或高级管理人员期间每年转让的股份不超过本人持有的越亚股份总数的 25%。本人若从珠海越亚离职，离职后半年内不转让该等股份；4.该等股份在上述锁定期（或延长的锁定期，如适用）届满后两年内减持的，减持价格（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，按有关规定进行相应调整）不低于发行价。5.本人不会因职务变更、离职等原因而拒绝履行上述承诺。如适用的法律法规对上述承诺有新的或修改的其他强制性规定，则适用该等规定且承诺的内容相应修改。

担任本公司董事的方中华及梅健均承诺：1.如果珠海越亚股票上市成功，承诺人承诺自珠海越亚股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理承诺人直接或间接持有的珠海越亚首次公开发行股票前已发行的股份，也不由珠海越亚回购承诺人直接或间接持有的前述股份。2.珠海越亚股票上市后六个月内如其股票连续二十个交易日的收盘价（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，按有关规定进行相应调整，下同）均低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，承诺人直接或通过承诺人能够实际控制的单位间接持有的珠海越亚股份的锁定期自动延长至少六个月。3.上述锁定期届满后，承诺人在担任珠海越亚董事、监事或高级管理人员期间每年转让的股份不超过承诺人直接或间接持有的珠海越亚股份总数的 25%，承诺人若从珠海越亚离职，离职后半年内不转让承诺人直接或间接持有的珠海越亚股份。4.承诺人直接或通过承诺人能够实际控制的单位间接持有的珠海越亚股票在上述锁定期满后两年内减持的，减持价格（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，按有关规定进行相应调整）不低于发行价。5.承诺人不会因职务变更、离职等原因而拒绝履行上述承诺。

担任本公司高级管理人员的 Dror Hurvits、陈先明、陈春灵、向文胜及黄士辅均承诺：1.如果珠海越亚股票上市成功，承诺人承诺自珠海越亚股票上市之日起二十四个月内，不转让或者委托他人管理承诺人直接或间接持有的珠海越亚公开发行股票前已发行的股份，也不由珠海越亚回购承诺人直接或间接持有的前述股份。2.珠海越亚股票上市后六个月内如其股票连续二十个交易日的收盘价（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，按有关规定进行相应调整，下同）均低于发行价，或者上市后六个月期末收

盘价低于发行价，承诺人直接或通过承诺人能够实际控制的单位间接持有的珠海越亚股份的锁定期自动延长至少六个月。3.上述锁定期届满后，承诺人在担任珠海越亚董事、监事或高级管理人员期间每年转让的股份不超过承诺人直接或间接持有的珠海越亚股份总数的 25%，承诺人若从珠海越亚离职，离职后半年内不转让承诺人直接或间接持有的珠海越亚股份。4.承诺人直接或通过承诺人能够实际控制的单位间接持有的珠海越亚股票在上述锁定期满后两年内减持的，减持价格（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，按有关规定进行相应调整）不低于发行价。5.承诺人不会因职务变更、离职等原因而拒绝履行上述承诺。

担任本公司监事的刘兰兰及谢凤霞均承诺：1.如果珠海越亚股票上市成功，本人承诺自珠海睿鑫增资成为珠海越亚股东的工商变更登记完成之日（即 2012 年 9 月 28 日）起三十六个月内，以及珠海越亚股票上市之日起二十四个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的珠海越亚公开发行股票前已发行的股份，也不由珠海越亚回购本人直接或间接持有的珠海越亚公开发行股票前已发行的股份。2.本人在珠海越亚担任董事/监事/高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人直接或间接所持有的珠海越亚股份总数的 25%，本人若从珠海越亚离职，离职后半年内不转让本人直接或间接所持有的珠海越亚股份。

担任本公司监事的王秋虎承诺：1.如果珠海越亚股票上市成功，本人承诺自珠海越亚股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的珠海越亚首次公开发行股票前已发行的股份，也不由珠海越亚回购本人直接或间接持有的珠海越亚首次公开发行股票前已发行的股份。2.本人在任职期间每年转让的股份不超过本人直接或间接所持有的珠海越亚股份总数的 25%，本人若从珠海越亚离职，离职后半年内不转让本人直接或间接所持有的珠海越亚股份。

根据财政部于 2013 年 5 月 21 日下发的《财政部关于批复教育部珠海越亚封装基板技术股份有限公司部分国有股权转由全国社会保障基金理事会持有的函》（财教函[2013]67 号），发行人在境内发行 A 股并上市后，方正信产应按照《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》的有关规定履行国有股转持义务，将其持有的发行人 14,119,562 股（以实际发行股份数及根据有关规定的计算结果为准）划转给全国社会保障基金理事会持有。全国社会保障基金理事会将承继方正信产的禁售期义务。

二、上市后稳定股价的措施

公司第一届董事会第十五次会议及 2013 年年度股东大会审议通过了《公司关于首次公开发行股票并上市后三年内稳定公司股价的预案》。预案的主要内容如下：

为强化股东、管理层诚信义务，进一步保护珠海越亚上市后投资者的权益，现根据相关监管要求，方正信产、AMITEC 公司、珠海越亚及其非独立董事和高级管理人员特制定如下股价稳定措施。

（一）启动股价稳定措施的具体条件

自珠海越亚上市之日起三年内，如珠海越亚股票连续 20 个交易日的股票交易均价（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照上海证券交易所的有关规定作复权处理，下同）低于最近一期经审计的每股净资产，且公司情况同时满足证券监管机构关于回购、增持等股本变动行为的规定，则触发方正信产、AMITEC、珠海越亚非独立董事及高级管理人员的增持义务及珠海越亚的回购义务。

（二）稳定股价的具体措施

稳定股价的具体措施包括：

1、方正信产及 AMITEC 在触发增持义务后的 20 个交易日内，应公告增持珠海越亚股票的具体计划，披露拟增持的数量范围、价格区间、完成时间等信息，且该次增持计划中，方正信产及 AMITEC 各自为增持所支付的金额不得低于上一年度各自从公司获得的现金分红金额的 30%，但当方正信产或 AMITEC 持有公司的股份达到公司总股本的 29.99%时，达到上述比例的该方可以不再进一步增持。

2、如方正信产及 AMITEC 履行上述增持义务后仍未达到稳定公司股价的目的，则公司非独立董事和高级管理人员应在方正信产及 AMITEC 完成增持计划之日起 30 个交易日（如期间存在 N 个交易日限制董事、高级管理人员买卖股票，则董事、高级管理人员应在首次满足上述条件后的 30+N 个交易日内）增持珠海越亚股票，并且各自累计增持金额不低于其上年度从珠海越亚领取的税后薪酬总额的 20%。

3、如公司非独立董事和高级管理人员履行上述增持义务后仍未达到稳定公司股价的目的，则公司董事会应在公司董事和高级管理人员完成增持计划之日起 10 个交易日内公告具体股份回购计划，披露拟回购股份的数量范围、价格区间、完成时间等信息，且该次计划回购总金额不得低于 1,000 万元。该股份回购计划

须由出席股东大会的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上同意通过，方正信产及 AMITEC 承诺在股东大会就前述回购事项进行表决时投赞成票，回购的股份将被依法注销并及时办理公司减资程序。

在履行完毕前述三项股价稳定措施后的 6 个月内，方正信产、AMITEC、珠海越亚及其非独立董事和高级管理人员的增持或回购义务自动解除。从履行完毕前述三项股价稳定措施后的 6 个月届满后，如珠海越亚股票价格连续 20 个交易日的股票交易均价仍低于最近一期经审计的每股净资产，则方正信产、AMITEC、珠海越亚及其非独立董事和高级管理人员的股价稳定义务将按照前述顺序自动产生。

方正信产、AMITEC、珠海越亚及其非独立董事和高级管理人员在履行其增持或回购义务时，应按照公司股票上市地上市规则及其他适用的监管要求履行相应的信息披露义务。

（三）其他稳定股价的措施

单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以向董事会提交公司股份回购计划的议案，并交由公司股东大会审议。

（四）约束措施

1、如果方正信产或 AMITEC 未按照上述规定履行增持义务，则珠海越亚应当以其未履行的增持金额为限截留对未履行增持义务股东的现金分红，用于珠海越亚实施股份回购计划，未履行增持义务股东丧失对相应金额现金分红的追索权。如果方正信产或 AMITEC 对公司董事会提出的股份回购计划投弃权票或反对票，则公司应将与方正信产或 AMITEC 履行其增持义务相等金额的应付现金分红予以截留用于下次股份回购计划，方正信产或 AMITEC 丧失对相应金额现金分红的追索权。

2、珠海越亚非独立董事和高级管理人员应主动履行其增持义务，如相关人员未能按上述规定履行其增持义务，则珠海越亚应将其履行增持义务相等金额的工资薪酬予以截留并用于下次股份回购计划。如相关人员在任职期间连续三次未能主动履行其增持义务，由方正信产、AMITEC 或珠海越亚董事会提请股东大会更换相关董事，由珠海越亚董事会提请解聘相关高级管理人员。

3、如因珠海越亚股票上市地上市规则及其他适用的监管要求对于社会公众股东最低持股比例的规定导致方正信产、AMITEC、珠海越亚及其非独立董事和高级管理人员在一定时期内无法履行其增持或回购义务的，相关责任主体可免于前述约束，但亦应积极采取其他措施稳定股价。

（五）其他事项

在本措施有效期内，珠海越亚新聘任的董事、高级管理人员应履行本预案规定的董事、高级管理人员义务。对于珠海越亚拟聘任的董事、高级管理人员，应在获得提名前书面同意履行前述义务。

三、关于信息披露的承诺

（一）发行人关于信息披露的承诺

发行人承诺：

1、本公司首次公开发行股票招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；

2、若证券监管部门依法认定本公司首次公开发行股票招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断其是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本公司将依法回购首次公开发行的全部新股；

3、在证券监管部门认定本公司招股说明书存在对判断本公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏之情形或对前述事实作出处罚决定之日起 20 个交易日内，公司董事会应制定并公告回购计划，包括回购股份数量、回购价格、完成时间等信息，股份回购计划经董事会审议通过后提交公司股东大会审议。回购价格不低于二级市场价格和首次公开发行股票的发价价格，期间若本公司股票已发生派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，回购数量及价格相应调整；

4、本公司首次公开发行股票招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本公司将依法赔偿投资者损失；

5、上述承诺为本公司真实意思表示，本公司自愿接受监管机构、自律组织及社会公众的监督，若违反上述承诺本公司将依法承担相应责任。

（二）方正信产关于信息披露的承诺

方正信产承诺：

1、发行人首次公开发行股票招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；

2、若证券监管部门依法认定发行人首次公开发行股票招股说明书（以下简称“发行人招股说明书”）有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断其是否

符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本公司将依法回购首次公开发行时本公司公开发售的股份（如有，下同）；

3、在证券监管部门认定发行人招股说明书存在对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏之情形或对前述事实作出处罚决定之日起 20 个交易日内，本公司将制定回购计划，并提请发行人予以公告；回购价格不低于二级市场价格和首次公开发行的发行价格，期间若发行人股票已发生派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，回购数量及价格相应调整。同时，本公司将积极督促发行人依法回购首次公开发行的全部新股；

4、若发行人招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本公司将依法赔偿投资者损失；

5、上述承诺为本公司真实意思表示，本公司自愿接受监管机构、自律组织及社会公众的监督，若违反上述承诺本公司将依法承担相应责任。

（三）AMITEC 公司关于信息披露的承诺

AMITEC 公司承诺：

1.发行人首次公开发行招股说明书（以下简称“发行人招股说明书”）不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；

2.若证券监管部门依法认定发行人招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断其是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本公司将依法回购首次公开发行时本公司公开发售的股份（如有）；

3.在证券监管部门认定发行人招股说明书存在对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏之情形或对前述事实作出处罚决定之日起 20 个交易日内，本公司将制定回购首次公开发行时本公司公开发售的股份（如有）的计划，并提请发行人予以公告；回购价格不低于二级市场价格和首次公开发行的发行价格，期间若本公司股票已发生派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，回购数量和回购金额相应调整。同时，本公司将积极督促发行人依法回购首次公开发行的全部新股；

4.若发行人招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本公司将依法赔偿投资者损失；

5.上述承诺为本公司真实意思表示，本公司自愿接受监管机构、自律组织

及社会公众的监督，若违反上述承诺本公司将依法承担相应责任。

如适用的法律法规对本函规定的上述承诺有新的或修改的其他强制性规定，则适用该等规定且本函的内容应相应修改。

（四）北京大学关于信息披露的承诺

北京大学承诺：

1、发行人首次公开发行招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；

2、若发行人首次公开发行招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本单位将依法赔偿投资者损失；

3、上述承诺为本单位真实意思表示，本单位自愿接受监管机构、自律组织及社会公众的监督，若违反上述承诺本单位将依法承担相应责任。

（五）Yotam Stern 和 Rafi Amit 关于信息披露的承诺

Yotam Stern 和 Rafi Amit 承诺：

1、发行人首次公开发行招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任；

2、若发行人首次公开发行招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将依法赔偿投资者损失；

3、上述承诺为本人真实意思表示，本人自愿接受监管机构、自律组织及社会公众的监督，若违反上述承诺本人将依法承担相应责任。

如适用的法律法规对本函规定的上述承诺有新的或修改的其他强制性规定，则适用该等规定且本函的内容应相应修改。

（六）董事、监事及高级管理人员关于信息披露的承诺

方中华、刘欲晓、梅健、Yoon Sung Yong、赵晋琳、赵大利、郭国庆、刘兰兰、谢凤霞、王秋虎、Dror Hurvits、陈先明、陈春灵、向文胜及黄士辅承诺：

1、发行人首次公开发行招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任；

2、若发行人首次公开发行招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将依法赔偿投资者损失；

3、上述承诺为本人真实意思表示，本人自愿接受监管机构、自律组织及社会公众的监督，若违反上述承诺本人将依法承担相应责任。

（七）中介机构关于信息披露的承诺

本次发行的保荐机构、律师事务所、审计机构、资产评估机构、验资机构、验资复核机构等中介机构分别作出了如下承诺。

招商证券股份有限公司（保荐机构）承诺：若因招商证券未能依照适用的法律法规、规范性文件及行业准则的要求勤勉尽责地履行法定职责而导致招商证券为珠海越亚封装基板技术股份有限公司首次公开发行制作、出具的发行保荐书及发行保荐工作报告有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失，但招商证券能够证明自己没有过错的除外。

北京市君合律师事务所（律师事务所）承诺：若因本所未能依照适用的法律法规、规范性文件及行业准则的要求勤勉尽责地履行法定职责而导致本所为珠海越亚封装基板技术股份有限公司首次公开发行制作、出具的法律意见书及律师工作报告有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，导致珠海越亚不符合法律法规、规范性文件规定的首次公开发行条件，给投资者造成损失的，在该等违法事实经司法机关生效判决认定后，将依法赔偿投资者的直接损失，但本所能够证明自己没有过错的除外。

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）（审计机构及验资复核机构）承诺：若因本所未能依照适用的法律法规、规范性文件及行业准则的要求勤勉尽责地履行法定职责而导致本所为珠海越亚封装基板技术股份有限公司首次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失，但本所能够证明自己没有过错的除外。

广东中广信资产评估有限公司（资产评估机构）承诺：若因本公司未能依照适用的法律法规、规范性文件及行业准则的要求勤勉尽责地履行法定职责而导致本公司为珠海越亚封装基板技术股份有限公司首次公开发行制作、出具的资产评估报告有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失，但本公司能够证明自己没有过错的除外。

利安达会计师事务所有限责任公司（验资机构）承诺：若因本公司未能依照适用的法律法规、规范性文件及行业准则的要求勤勉尽责地履行法定职责而导致本公司为珠海越亚封装基板技术股份有限公司首次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失，但本公司能够证明自己没有过错的除外。

四、持股 5%以上股东的持股意向及减持意向

持股 5%以上的股东包括方正信产、AMITEC 及东方富海，分别持有公司首次公开发行前股份总额的 38.3575%、38.3575%及 7.6853%。上述股东分别出具了持股意向及减持意向承诺。

（一）方正信产及 AMITEC 承诺的主要内容

方正信产及 AMITEC 分别承诺：

1、本公司作为发行人的并列第一大股东之一，严格按照法律、法规、规范性文件规定及监管要求关于股份锁定的规定，持有发行人的股份，遵守本公司所承诺的股份锁定期限；在承诺的锁定期届满后，本公司减持所持有的发行人股份应符合相关法律、法规、规范性文件及证券交易所规则关于股份锁定义务的要求。

2、减持方式。承诺的锁定期届满后，本公司可通过包括但不限于二级市场集中竞价交易、大宗交易、协议转让等方式减持所持有的发行人股份。

3、减持价格。本公司减持所持有的发行人股份的价格参照当时的二级市场价格确定，并应符合相关法律法规及证券交易所规则要求；本公司在发行人首次公开发行前所持有的发行人股份在锁定期满后两年内减持的，减持价格（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，按照有关规定进行相应调整，下同）不低于首次公开发行股票的发行人价格。

4、减持期限与减持数量。在锁定期届满后的 12 个月内，本公司减持发行人股份数量不超过本公司于发行人首次公开发行时持有发行人股份总数（股份总数以送股、转增股本或增发股份后的股本数量计算，下同）的 20 %；在锁定期满后的 24 个月内，本公司减持所持有的发行人股份数量不超过本公司于发行人首次公开发行时持有发行人股份总数的 30%。

5、本公司在减持所持有的发行人股份前，应提前 3 个交易日予以公告，并按照证券交易所规则及时、准确、完整地履行信息披露义务。

6、本公司将严格履行上述承诺事项，并承诺将遵守下列约束措施：

（1）如果未履行上述承诺事项，本公司将在发行人的股东大会及中国证券监督管理委员会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因并向发行人的其他股东和社会公众投资者道歉；

（2）如果未履行上述承诺事项，本公司持有的发行人股票在自未履行承诺

事件发生时起 3 个月内不得减持。

(3) 如果未履行上述承诺事项，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本公司将依法赔偿投资者损失。

(4) 若其因未履行上述承诺而获得收入的，所得收入归发行人所有，将在获得收入的 5 日内将前述收入支付给发行人指定账户。

如适用的法律法规对本函规定的上述承诺有新的或修改的其他强制性规定，则适用该等规定且本函的内容应相应修改。

(二) 东方富海承诺的主要内容

东方富海承诺：

1、本企业严格按照法律、法规、规范性文件规定及监管要求，持有发行人的股份，遵守股份锁定期限；锁定期届满后，本企业减持所持有的发行人股份应符合相关法律、法规、规范性文件及证券交易所规则要求。

2、减持方式。锁定期届满后，本企业拟通过包括但不限于二级市场集中竞价交易、大宗交易、协议转让等方式减持所持有的发行人股份。

3、减持价格。本企业减持所持有的发行人股份的价格（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，按照有关规定进行相应调整，下同）根据当时的二级市场价格确定。

4、减持期限与减持数量。在锁定期满后的 24 个月内，本企业拟减持所持有的发行人的全部股份。

5、本企业在减持所持有的发行人股份前，应提前 3 个交易日予以公告，并按照证券交易所规则及时、准确、完整地履行信息披露义务，但是减持时持有发行人的股票比例低于 5%时除外。

6、本企业将严格履行上述承诺事项，并承诺将遵守下列约束措施：

(1) 如果未履行上述承诺事项，本企业将在发行人的股东大会及中国证券监督管理委员会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因并向发行人的其他股东和社会公众投资者道歉；

(2) 如果未履行上述承诺事项，本企业持有的发行人股票在 3 个月内不得减持。

五、公司股东公开发售股份的方案

（一）公开发行新股与公司股东公开发售股份数量及调整机制

本次公开发行A股股票总数不超过20,170.8023万股，其中公司公开发行新股数量上限为20,170.8023万股，公司股东公开发售股份数量上限为5,000万股且不超过自愿设定12个月及以上限售期的投资者获得配售股份的数量。发行后的流通股股份占公司股份总数的比例不低于25.00%。根据本次发行询价结果，若新股发行募集资金净额超过募投项目所需资金总额的，则公司将相应减少新股发行数量，同时进行老股转让，老股转让所得资金不归公司所有。

若本次发行进行老股转让，老股转让数量将不超过5,000万股，由公司股东方正信产和Amitec公司转让；双方各自的老股转让数量在发行前由公司、方正信产和Amitec公司与保荐机构（主承销商）根据本次发行定价情况及中国证监会的相关规定和要求进行协商确定，确保在新股发行、老股转让、北大方正信息产业集团有限公司向社保基金转持股份后，公司的股权结构不会发生重大变化。

公司股东东方富海、东方富海二号、皖江物流、上海开物、宁波科发、开铂银科、香港睿祺、珠海睿祺及珠海睿鑫不参与老股转让。

新股发行的具体数量由公司与保荐机构（主承销商）根据本次发行定价情况及中国证监会的相关规定和要求，在上述发行数量上限内协商确定。

公司董事会与保荐机构（主承销商）参考向符合资格的询价对象询价情况或初步询价情况，并综合考虑本次发行募集资金计划、公司业绩及市场情况等因素确定发行价格，或采用中国证监会认可的其他方式确定发行价格。老股转让应当符合《证券发行与承销管理办法》、《首次公开发行股票时公司股东公开发售股份暂行规定》等相关规定，老股转让价格与新股发行价格相同。

（二）本次发行费用分摊原则

本次发行的承销费用由公司与进行老股转让的股东按照新股发行数量及老股转让数量占本次发行数量的比例分摊。保荐费、审计费、律师费、信息披露费、发行手续费等其他费用由公司承担。

（三）股东公开发售股份事项的影响

股东公开发售股份事项不会对公司的控制权、治理结构及生产经营等产生重大影响。

六、发行人及其主要股东、董事、监事、高级管理人员等关于失信补救措施的承诺

为强化对发行人及其主要股东、董事、监事、高级管理人员等单位或个人的约束，前述单位或个人分别作出了失信补救措施的承诺。

（一）发行人关于失信补救措施的承诺

发行人承诺：

1、及时、充分披露本公司承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因；

2、向本公司的投资者提出补充承诺或替代承诺（相关承诺需按法律、法规、本公司公司章程的规定履行相关审批程序），以尽可能保护投资者的权益；

3、若未能履行上述承诺及在本公司招股说明书中披露的其他公开承诺，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本公司将按有关法律、法规的规定和监管部门的要求赔偿投资者损失。

如因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等本公司无法控制的客观原因导致本公司承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的，本公司将采取以下措施：

1、及时、充分披露本公司承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因；

2、向本公司的投资者提出补充承诺或替代承诺（相关承诺需按法律、法规、本公司公司章程的规定履行相关审批程序），以尽可能保护投资者的权益。

（二）发行人全体董事、监事和高级管理人员，发行人并列第一大股东及其实际控制人等关于失信补救措施的承诺

发行人全体董事、监事和高级管理人员，发行人主要股东方正信产及 AMITEC 公司以及方正信产的实际控制人北京大学和 AMITEC 公司的实际控制人 Yotam Stern 及 Rafi Amit 均出具了《关于失信补救措施的承诺函》。

方正信产、北京大学、方中华、刘欲晓、梅健、Yoon Sung Yong、赵晋琳、赵大利、郭国庆、刘兰兰、谢凤霞、王秋虎、Dror Hurvits、陈先明、陈春灵、向文胜及黄士辅等单位或个人承诺的主要内容包括：

保证将严格履行发行人首次公开发行股票并上市招股说明书披露的承诺事项，如承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的（相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等无法控制的客观原因导致的除外），承诺严格遵守下列约束措施：

1、通过发行人及时、充分披露承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因；

2、向发行人及其投资者提出补充承诺或替代承诺（相关承诺需按法律、法规、承诺人自身章程或制度（如有）及发行人公司章程的规定履行相关审批程序），以尽可能保护投资者的权益；

3、若未能履行上述承诺及在发行人招股说明书中披露的其他公开承诺，致使发行人或投资者在证券交易中遭受损失的，将按有关法律、法规的规定和监管部门的要求赔偿发行人或投资者损失。

如因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等无法控制的客观原因导致承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的，将采取以下措施：

（1）通过发行人及时、充分披露承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因；

（2）向发行人及其投资者提出补充承诺或替代承诺（相关承诺需按法律、法规、承诺人自身章程或制度（如有）及发行人公司章程的规定履行相关审批程序），以尽可能保护投资者的权益。

AMITEC 公司承诺的主要内容包括：

本公司作为发行人的并列第一大股东，保证将严格履行发行人首次公开发行股票并上市招股说明书披露的本公司承诺事项，如本公司承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的（相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等本公司无法控制的客观原因导致的除外），承诺严格遵守下列约束措施：

1、通过发行人及时、充分披露本公司承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因；

2、向发行人及其投资者提出补充承诺或替代承诺（相关承诺需按法律、法规、本公司及发行人公司章程的规定履行相关审批程序），以尽可能保护投资者的权益；

3、若未能履行发行人招股说明书中披露的本公司承诺及本承诺函中的承诺，致使发行人或投资者在证券交易中遭受损失的，本公司将按有关法律、法规的规

定和监管部门的要求赔偿发行人或投资者损失。

如因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等本公司无法控制的客观原因导致本公司承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的，本公司将采取以下措施：

（1）通过发行人及时、充分披露本公司承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因；

（2）向发行人及其投资者提出补充承诺或替代承诺（相关承诺需按法律、法规、本公司及发行人公司章程的规定履行相关审批程序），以尽可能保护投资者的权益。

如适用的法律法规对本函规定的上述承诺有新的或修改的其他强制性规定，则适用该等规定且本函的内容应相应修改。

Yotam Stern 和 Rafi Amit 承诺的主要内容包括：

作为发行人第一大股东 Amitec-Advanced Multilayer Interconnect Technologies Ltd.的实际控制人之一和发行人副董事长/董事，保证将严格履行发行人首次公开发行股票并上市招股说明书披露的本人承诺事项，如本人承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的（相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等本人无法控制的客观原因导致的除外），承诺严格遵守下列约束措施：

1、通过发行人及时、充分披露本人承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因；

2、向发行人及其投资者提出补充承诺或替代承诺（相关承诺需按法律、法规、发行人公司章程的规定履行相关审批程序），以尽可能保护投资者的权益；

3、若未能履行发行人招股说明书中披露的本人承诺及本函中载明的本人承诺，致使发行人或投资者在证券交易中遭受损失的，本人将按有关法律、法规的规定和监管部门的要求赔偿发行人或投资者损失。

如因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等本人无法控制的客观原因导致本人承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的，本人将采取以下措施：

（1）通过发行人及时、充分披露本人承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因；

（2）向发行人及其投资者提出补充承诺或替代承诺（相关承诺需按法律、法

规、发行人公司章程的规定履行相关审批程序），以尽可能保护投资者的权益。

如适用的法律法规对本函规定的上述承诺有新的或修改的其他强制性规定，则适用该等规定且本函的内容应相应修改。

七、发行上市后的利润分配政策

公司 2013 年度股东大会审议通过了《修改<公司上市当年及此后两个年度利润分配规划的议案>的议案》和《关于修改<公司章程（草案）>，并于上市之日起生效实施的议案》，明确规定了积极的股利分配政策，注重保护投资者的合法权益。具体规定如下：

（一）利润分配原则

公司实行积极、持续、稳定的利润分配政策，公司利润分配应重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司当年的实际经营情况和可持续发展；公司董事会、监事会和股东大会对利润分配政策的决策和论证应当充分考虑独立董事、监事和公众投资者的意见。

（二）利润分配的形式

公司可以采取现金或者股票或者现金与股票相结合的方式分配股利，且优先采取现金方式分配股利。公司的利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。

（三）利润分配的条件

1、现金分红的具体条件和比例

现金分红比例：在满足本公司章程规定的公司现金分红条件的情形下，公司每年以现金方式分配的利润应不少于当年实现的可供分配利润的 15%，保持利润分配政策的连续性和稳定性；且任意三个连续会计年度内，公司以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的 30%。

公司董事会应综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照本章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：

（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；

（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现

金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；

（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%；

（4）公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%。

公司现金分红条件是指公司拟实施现金分红时应同时满足如下条件：

（1）公司该年度盈利且实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值，实施现金分红不会影响公司后续持续经营；

（2）审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；

（3）公司资产负债率情况良好，未来十二个月内无重大投资计划或重大现金支出等事项发生(募集资金项目除外)。

重大投资计划或重大现金支出是指以下情形之一：（1）公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的 50%，且超过 3,000 万元；（2）公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的 30%。

2、发放股票股利的条件

根据累计可供分配利润、公积金及现金流状况等情况，在确保足额现金红利分配的前提下，可以采取股票股利的方式进行利润分配，但应当考虑公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。

（四）公司的利润分配的期间间隔

1、在公司该年度盈利且实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值的情形下，公司原则上每年度进行一次分红；

2、公司董事会可以根据当期的盈利规模、现金流状况、发展阶段及资金需求状况，提议公司进行中期分红。

（五）公司的利润分配方案的论证程序和决策机制

1、公司董事会应当根据当期的经营情况和项目投资的资金需求计划，在充分考虑股东利益的基础上正确处理公司的短期利益及长远发展的关系，确定合理的利润分配方案；

2、利润分配方案由公司董事会制定，公司董事会应根据公司的财务经营状

况，提出可行的利润分配提案，并经全体董事过半数通过并决议形成利润分配方案；

3、独立董事在召开利润分配的董事会前，应当就利润分配的提案提出明确意见，同意利润分配提案的，应经全体独立董事过半数通过，如不同意利润分配提案的，独立董事应提出不同意的的事实、理由，要求董事会重新制定利润分配提案，必要时，可提请召开股东大会；独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。

4、监事会应当就利润分配提案提出明确意见，同时充分考虑外部监事的意见（如有），同意利润分配提案的，应经全体监事过半数通过，如不同意利润分配提案的，监事会应提出不同意的的事实、理由，并建议董事会重新制定利润分配提案，必要时，可提请召开股东大会；

5、利润分配方案经上述程序后同意实施的，由董事会提议召开股东大会，并提交股东大会批准。利润分配方案应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上通过；但如股东大会审议发放股票股利或以公积金转增股本的方案，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。同时，就该等议案公司必须根据证券交易所的有关规定提供网络或其他方式为公众投资者参加股东大会提供便利。

公司当年盈利，公司董事会未做出年度现金利润分配预案的，应当在定期报告中披露原因、公司留存资金的使用计划和安排。

存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。

（六）利润分配政策调整

公司利润分配政策不得随意调整而降低对股东的合理回报。因公司外部环境或者自身经营状况发生较大变化而需要调整利润分配政策的，公司可对利润分配政策进行调整，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定。

1、由公司董事会制定利润分配政策调整方案，充分论证调整利润分配政策的必要性，并说明利润留存的用途，由公司董事会根据实际情况，在公司盈利转强时实施公司对过往年度现金分红弥补方案，确保公司股东能够持续获得现金分红。

2、公司独立董事对利润分配政策调整方案发表明确意见，并应经全体独立董事过半数通过；如不同意，独立董事应提出不同意的的事实、理由，要求董事会

重新制定利润分配政策调整方案，必要时，可提请召开股东大会。

3、监事会应当对利润分配政策调整方案提出明确意见，同意利润分配政策调整方案的，应形成决议；如不同意，监事会应提出不同意的的事实、理由，并建议董事会重新制定利润分配调整方案，必要时，可提请召开股东大会。

4、利润分配政策调整方案应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 $\frac{2}{3}$ 以上通过。在发布召开股东大会的通知时，须公告独立董事和监事会意见。股东大会审议利润分配政策调整方案时，公司应根据证券交易所的有关规定提供网络或其他方式为公众投资者参加股东大会提供便利。

为免疑义，上述“公司外部经营环境或自身经营状况发生较大变化”系指下列情形之一：

（1）国家制定的法律法规、行业政策及经济环境发生重大变化，非因公司自身原因导致公司经营亏损；

（2）出现地震、台风、水灾、战争等不能预见、不能避免并不能克服的不可抗力因素，对公司生产经营造成重大不利影响导致公司经营亏损；

（3）公司法定公积金弥补以前年度亏损后，公司当年实现净利润仍不足以弥补以前年度亏损；

（4）公司的主营业务发生重大变化或实施重大资产重组，公司还处于业务调整期的；

（5）中国证监会和证券交易所规定的其他事项。

（七）公众投资者保护

1、在有关利润分配方案的决策和论证过程中，董事会可以通过电话、传真、信函、电子邮件、公司网站上的投资者关系互动平台等方式，与独立董事、中小股东进行沟通和交流，充分听取独立董事和中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。在股东大会对利润分配方案进行审议前，公司应当通过多种渠道（包括但不限于电话、传真、邮箱、互动平台等）主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。

2、存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。

八、本次发行前未分配利润的处理

截至 2013 年 12 月 31 日，公司滚存的合并报表归属于母公司股东的未分配利润为 5,589.69 万元。根据公司 2013 年 2 月 19 日召开的 2013 年第二次临时股东大会决议，公司本次向社会首次公开发行股票前形成的累计未分配利润，归本次发行上市后登记在册的新老股东共享。

九、本公司特别提醒投资者注意以下风险因素

（一）下游大客户集中的风险

全球芯片市场主要由欧美大型企业主导，市场集中度较高。报告期内，公司的主导产品主要应用于无线射频模块芯片，主要包括功率放大器、收发器和前端接收模块芯片；公司主要面对的芯片厂商为美国的威讯联合半导体（RFMD）和安华高科技（Avago）。

公司与芯片厂商确定产品方案后，芯片厂商会通过两种方式采购发行人的产品：一是由芯片厂商（含其下属公司）直接向公司采购，二是由芯片厂商向其合作封装测试厂商指定公司的产品，由封装测试公司向公司采购。

2013 年、2012 年及 2011 年，将来自安华高科技（Avago）合作封装测试厂商的销售收入与来自安华高科技（Avago）（含其下属公司）的销售收入合并后，来自安华高科技（Avago）相关客户的收入与来自威讯联合半导体（RFMD）（含其下属公司）的收入合计占公司营业收入的比重见下表：

单位：万元

项目	客户名称	销售收入	占营业收入比例
2013 年度	安华高科技（Avago）相关	22,432.00	60.88%
	威讯联合半导体（RFMD）	12,231.09	33.19%
	合计	34,663.09	94.07%
2012 年度	安华高科技（Avago）相关	35,766.20	72.05%
	威讯联合半导体（RFMD）	12,266.61	24.71%
	合计	48,032.81	96.76%
2011 年度	安华高科技（Avago）相关	31,449.63	71.84%
	威讯联合半导体（RFMD）	10,450.45	23.87%
	合计	41,900.08	95.72%

公司销售收入存在大客户集中的特点。同时，若客户发现其某项采购较依赖于单个供应商时，也会利用“第二货源(Second Source)”策略，适当降低对该供应商的采购。因此大客户集中使得公司存在较大的经营风险。若大客户需求

和订单发生不利变化，公司营业收入将面临大幅下滑的风险；若大客户信用发生不利变化，公司应收账款将可能不会按期收回甚至无法收回；若大客户终止与公司合作，或发生其他情况导致其对公司产品的需求量大幅降低，则将不可避免地对公司销售造成不利影响，甚至可能出现公司上市当年营业利润比上年下滑 50% 以上或上市当年即亏损的情形。

2013 年，公司大客户安华高科技（Avago）新产品的技术方案发生了变化，减少了对公司的采购量；同时，公司获取新客户认证的进度未达到预期，获得的新客户订单未能充分弥补安华高科技（Avago）减少的订货量，导致公司当年营业收入较上年下降。但由于公司已准备了新的产能，2013 年折旧费用有所增加。上述因素共同导致公司 2013 年产能利用率下滑较多，营业利润较 2012 年下滑超过 50%。

2014 年，公司积极接洽新客户、拓展新市场，并逐步获得了中普微电子、国民技术等新客户的量产订单，进一步改善了客户结构；但前期购买的部分设备也将逐步转入固定资产，折旧费用将进一步增加。如果安华高科技（Avago）等老客户的采购量进一步下滑，新客户订单未能填补缺口，公司 2014 年经营业绩可能相对 2013 年进一步下滑，甚至在 2014 年上半年出现亏损的情况。

（二）客户认证的风险

公司处于半导体产业链上，面对的客户为芯片厂商及其合作封装测试厂，且目前主要为国际客户。这些客户均实行严格的供应商认证体制，包括对封装基板企业技术、设备、产能、产品等方面的认证程序，一般需要一年或更长的时间，而且客户认证通过后，也会不断追踪考核公司及产品的资质。

公司基于自身发明专利生产无芯封装基板，已逐步得到了市场认可。目前，在无线射频模块市场，公司已经通过了威讯联合半导体（RFMD）和安华高科技（Avago）的认证，并处于国内多个芯片企业的认证过程中；在数字芯片市场，公司正处于业内知名芯片厂商的认证过程中；未来公司推出的新产品、新技术，都需通过客户的认证。若因各种原因使得上述认证时间过长或者认证失败，公司将在短时间内无法取得这些客户的量产订单，公司未来的增长将存在较大的不确定性；另外，为应对客户认证，公司必须提前预备产能，若客户认证时间过长或认证失败，公司新增产能将得不到有效利用，新增折旧反而会使得公司盈利下滑。因此公司面临客户认证时间过长或认证失败的风险。

（三）产能与生产订单不能及时匹配和季节性波动的风险

受下游消费电子产品需求的影响，公司所处 IC 封装基板市场存在季节性波动的特点。一般说来，每年的第一、第二季度是行业淡季，第三、第四季度受到国内外传统节日影响，消费需求增长，进而拉动封装基板行业进入需求旺季。但公司设备特别是进口设备需提前投资，一旦投资完成形成产能，则不能轻易变动。当行业处于淡季时，订单较少，部分设备将可能利用率不高；当行业处于旺季时，产能利用率将大幅提高，甚至可能因为部分工序形成瓶颈而无法及时满足客户的需求。因此，尽管客户会向公司提供订单预测，但公司无论淡旺季都无法使得产能利用和生产订单及时匹配。产能利用率不高时，相对较高的固定费用将使得公司盈利减少，产能不足时，将无法满足客户需求而丢失订单，因此公司生产经营存在产能与生产订单不能及时匹配和季节性波动的风险。

（四）公司无实际控制人的风险

本公司无控股股东和实际控制人。截至本招股说明书签署之日，公司共有 11 名股东，股权结构较为分散，并列第一大股东方正信产和 AMITEC 公司分别持有公司 38.3575% 的股权，无任何股东直接持股比例高于 50%。单一股东在公司董事会所占席位均未过半，无单一股东对董事会有实质影响，单一股东对公司董事会均不构成实际控制。公司前两大股东于 2013 年 5 月 1 日签署了《无控制确认协议》，进一步确认自越亚有限成立以来双方均对珠海越亚无实质控制，并对非独立董事的选举进行了一定的措施安排。

本公司无实际控制人的状况表明公司股权一定程度的分散与制衡，虽然有利于提高决策的科学性，但也可能造成公司在进行重大生产经营和投资等决策时，因决策效率降低而贻误业务发展机遇，造成公司生产经营和经营业绩的波动。即使各股东均对其持股锁定进行了承诺，但上市公司的持股结构将仍可能发生变化，进而影响公司经营政策的稳定性、连续性。同时，公司无实际控制人的状况也可能使得管理层容易形成内部人控制的局面，从而对股东利益最大化的目标造成负面影响。因此，公司无实际控制人的状况对公司治理结构存在潜在不利影响。

（五）募集资金投资项目的技术和市场风险

公司本次发行股票募集资金投资项目为公司的改扩建项目，即通过进一步研发和生产模拟芯片封装基板产品和数字芯片封装基板产品，扩展公司在模拟芯片市场和数字芯片市场的业务。尽管公司董事会在确定上述投资项目之前已经对其技术先进性和成熟性进行了论证，其中模拟芯片封装基板产品已具备量产经验、数字芯片封装基板产品已为客户成功生产样板，但在实施过程中仍有

可能出现一些目前尚未知晓或不能及时解决的技术问题而使该项目存在一定的技术风险。

同时，在确定投资上述项目前，公司已分别对其市场及前景进行了充分研究和调查，论证了产品的市场需求，确信该项目在未来一定时期内具有良好的市场及前景。尽管如此，由于国家政策及市场本身具有的不确定性，以及客户认证存在的不确定性，包括已通过的模拟芯片封装基板产品客户认证不能持续保持、数字芯片封装基板产品无法获得客户认证或量产订单不足，都将可能使得募集资金项目新增产能无法被新增订单消化，从而使得实施该项目仍具有一定的市场风险。

目录

本次发行概况	2
发行人声明	7
重大事项提示	8
一、股份限制流通及自愿锁定承诺	8
二、上市后稳定股价的措施	12
三、关于信息披露的承诺	14
四、持股 5%以上股东的持股意向及减持意向	18
五、公司股东公开发售股份的方案	20
六、发行人及其主要股东、董事、监事、高级管理人员等关于失信补救措施的承诺	21
七、发行上市后的利润分配政策	24
八、本次发行前未分配利润的处理	28
九、本公司特别提醒投资者注意以下风险因素	28
目录	32
释义	36
第一章 概览	42
一、发行人概况	42
二、发行人控股股东及实际控制人	43
三、发行人主要财务数据	43
四、本次发行情况	45
五、募集资金用途	45
第二章 本次发行概况	47
一、本次发行的基本情况及发行费用	47
二、本次发行有关机构	48
三、发行人与本次发行有关当事人之间的关系	49
四、与本次发行上市有关的重要日期	49
第三章 风险因素	51
一、宏观经济及半导体产业周期波动的风险	51
二、下游大客户集中的风险	51
三、市场竞争激烈的风险	53
四、公司产品最终主要应用于消费电子产品而需面对的风险	53
五、客户认证的风险	54
六、产品研发不能迅速满足客户需求的风险	54
七、产能与生产订单不能及时匹配和季节性波动的风险	55
八、公司无实际控制人的风险	55
九、人才流失和短缺的风险	55
十、技术市场化及技术更新换代的风险	56
十一、技术流失和专利保护的风险	56
十二、原材料及能源采购的风险	57
十三、资本支出、无形资产金额较大带来的折旧、摊销和减值风险	57
十四、募集资金投资项目的技术和市场风险	58

十五、公司净资产收益率下降的风险.....	58
十六、税收政策变化的风险.....	59
十七、国际贸易和汇率相关的风险.....	59
十八、资产及经营规模大幅增长带来的管理风险.....	60
十九、环境保护相关的风险.....	60
二十、股价波动的风险.....	61
二十一、信息技术系统失灵或出现安全漏洞的风险.....	61
第四章 发行人基本情况	62
一、发行人的基本资料.....	62
二、发行人改制重组情况.....	62
三、发行人独立运行情况.....	64
四、发行人设立以来的股本形成及变化和重大资产重组情况.....	66
五、发行人历次验资情况.....	79
六、发行人的组织结构.....	82
七、发行人股权投资情况.....	89
八、发行人股东基本情况.....	90
九、发行人股本情况.....	102
十、发行人员工及其社会保障情况.....	104
十一、主要股东及作为股东的董事、监事及高管人员的重要承诺.....	106
第五章 业务和技术	108
一、发行人主营业务及其变化情况.....	108
二、发行人所处行业的基本情况.....	109
三、发行人在行业中的竞争地位.....	133
四、发行人的主营业务情况.....	140
五、环境保护及安全生产.....	151
六、发行人主要业务相关的固定资产和无形资产.....	151
七、发行人的技术水平与研发.....	155
八、境外经营情况.....	161
九、主要产品或服务的质量控制情况.....	161
十、产品质量纠纷情况.....	163
第六章 同业竞争与关联交易	164
一、同业竞争.....	164
二、关联方与关联关系.....	176
三、关联交易事项.....	178
四、规范关联交易的主要制度安排.....	190
五、发行人报告期内关联交易的执行情况及独立董事意见.....	192
六、公司减少关联交易的措施.....	192
第七章 董事、监事、高级管理人员和核心技术人员	195
一、董事、监事、高级管理人员和核心技术人员简介.....	195
二、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属直接或间接持有本公司股权情况.....	199
三、董事、监事、高级管理人员和核心技术人员的其他对外投资情况.....	200

四、董事、监事、高级管理人员和核心技术人员薪酬情况.....	201
五、董事、监事、高级管理人员和核心技术人员相互之间的关系及兼职情况.....	202
六、董事、监事、高级管理人员和核心技术人员有关协议.....	207
七、董事、监事、高级管理人员的任职资格.....	207
八、董事、监事、高级管理人员报告期内的变动情况.....	208
第八章 公司治理结构.....	210
一、发行人股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的建立健全及运行情况.....	210
二、报告期内发行人的违法违规情况.....	218
三、近三年发行人资金占用和对外担保的情况.....	218
四、发行人内部控制制度.....	219
五、基于股权结构、行业特点等保证其内控制度完整合理有效、公司治理完善的具体措施.....	219
第九章 财务会计信息.....	221
一、发行人财务报表.....	221
二、注册会计师审计意见类型.....	228
三、财务报表编制基础及合并财务报表范围.....	228
四、报告期内的主要会计政策和会计估计.....	229
五、报告期内重大会计政策、会计估计变更及差错更正.....	247
六、税项.....	248
七、主营业务分部报告信息.....	249
八、非经常性损益.....	250
九、主要资产情况.....	250
十、主要债务情况.....	251
十一、所有者权益变动情况.....	253
十二、现金流量情况.....	253
十三、资产负债表日后事项、或有事项及其他重要事项.....	254
十四、最近三年主要财务指标.....	254
十五、发行人设立时及报告期内的资产评估情况.....	257
十六、发行人历次验资情况.....	258
第十章 管理层讨论与分析.....	259
一、发行人财务状况分析.....	259
二、盈利能力分析.....	280
三、发行人资本性支出分析.....	292
四、股利分配情况.....	293
五、未来盈利能力及经营前景分析.....	293
第十一章 业务发展目标.....	295
一、发行人当前及未来两年的发展规划及发展目标.....	295
二、实现规划和目标所依据的假设条件.....	299
三、本公司实施上述计划将面临的主要困难.....	299
四、业务发展规划和目标与现有经营业务之间的关系.....	300

第十二章 募集资金运用	301
一、本次发行募集资金数额及依据	301
二、募集资金投资项目的必要性和市场前景	301
三、募集资金投资项目简介	306
四、募集资金运用对公司经营成果和财务状况的影响	311
第十三章 股利分配政策	312
一、发行人最近 3 年的股利分配政策	312
二、最近 3 年公司股利分配情况	313
三、本次发行后的股利分配政策	313
四、本次发行完成前滚存利润的分配政策	313
五、上市当年及此后两个年度利润分配规划	313
第十四章 其他重要事项	319
一、信息披露制度相关情况	319
二、重要合同	319
三、对外担保情况	326
四、重大诉讼或仲裁事项	326
五、其他重要事项	327
第十五章 董事、监事、高级管理人员 及有关中介机构声明	328
一、发行人全体董事、监事、高级管理人员声明	328
二、保荐人（主承销商）声明	329
三、发行人律师声明	330
四、审计机构声明	331
五、资产评估机构声明	332
六、验资机构声明	333
七、验资复核机构声明	334
第十六章 备查文件	335

释义

在本招股说明书中，除非文义另有所指，下列词语或简称具有如下含义：

第一部分：常用词语		
发行人、公司、本公司、股份公司、珠海越亚	指	珠海越亚封装基板技术股份有限公司
越亚有限	指	珠海越亚封装基板技术有限公司，系本公司前身
AMITEC 公司、AMITEC	指	Amitec-Advanced Multilayer Interconnect Technologies Ltd.，系公司并列第一大股东
AMITEC 香港公司	指	Amitec-Advanced Multilayer Interconnect Technologies HK Limited，系 AMITEC 公司的全资子公司
Prioritech、Prioritech 公司	指	Prioritech Ltd.，系 AMITEC 公司的控股股东
珠海多层	指	珠海方正科技多层电路板有限公司，系公司原股东
珠海发展	指	珠海方正印刷电路板发展有限公司
珠海高密	指	珠海方正科技高密电子有限公司
方正科技	指	方正科技集团股份有限公司，上海证券交易所上市公司（股票代码为 600601.SH）
国开行	指	国家开发银行股份有限公司
深圳数码	指	深圳市北大方正数码科技有限公司，系公司原股东
方正信产	指	原名方正信息产业控股有限公司，于 2014 年 2 月更名为北大方正信息产业集团有限公司，系公司并列第一大股东。
方正集团	指	北大方正集团有限公司，系方正信产控股股东
北大资产	指	北大资产经营有限公司，系方正集团控股股东
北京大学	指	系北大资产唯一出资人，方正信产实际控制人
方正财务公司	指	北大方正集团财务有限公司
东方富海	指	东方富海（芜湖）股权投资基金（有限合伙），系公司主要股东
东方富海二号	指	东方富海（芜湖）二号股权投资基金（有限合伙）
皖江物流	指	皖江（芜湖）物流产业投资基金（有限合伙）
上海开物	指	上海开物投资合伙企业（有限合伙）
宁波科发	指	宁波市科发股权投资基金合伙企业（有限合伙）
开铂银科	指	开铂银科（成都）创业投资企业
香港睿祺	指	香港睿祺投资有限公司
珠海睿祺	指	珠海睿祺投资合伙企业（有限合伙）
珠海睿鑫	指	珠海睿鑫投资合伙企业（有限合伙）

本次发行	指	本次公开发行 A 股股票总数不超过 20,170.8023 万股，其中公司公开发行新股数量上限为 20,170.8023 万股，公司股东公开发售股份数量上限为 5,000 万股且不超过自愿设定 12 个月及以上限售期的投资者获得配售股份的数量。发行后的流通股股份占公司股份总数的比例不低于 25.00% 的行为。
A 股	指	人民币普通股
元、万元	指	人民币元、万元
新谢克尔	指	以色列货币
发起人	指	方正信产、AMITEC 公司、东方富海、开铂银科、皖江物流、上海开物、宁波科发、东方富海二号等珠海越亚的股东
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
财政部	指	中华人民共和国财政部
商务部	指	中华人民共和国商务部
上交所	指	上海证券交易所
股东大会	指	珠海越亚封装基板技术股份有限公司股东大会
董事会	指	珠海越亚封装基板技术股份有限公司董事会
监事会	指	珠海越亚封装基板技术股份有限公司监事会
《发起人协议》	指	《珠海越亚封装基板技术股份有限公司发起人协议》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《管理办法》	指	《首次公开发行股票并上市管理办法》
《公司章程》	指	《珠海越亚封装基板技术股份有限公司章程》
保荐人、主承销商、招商证券	指	招商证券股份有限公司
利安达	指	利安达会计师事务所有限公司
君合律师	指	发行人律师，北京市君合律师事务所
国富浩华	指	发行人会计师，国富浩华会计师事务所(特殊普通合伙)，已于 2013 年 5 月更名为瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)
瑞华	指	发行人会计师，瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)，原为国富浩华会计师事务所(特殊普通合伙)，已于 2013 年 5 月更名为瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)
岳华安地	指	珠海岳华安地联合会计师事务所
和通泰	指	珠海和通泰会计师事务所
国睿衡赋	指	珠海国睿衡赋会计师事务所
浙大科发	指	浙江浙大科发股权投资管理有限公司
深圳东方富海	指	深圳市东方富海投资管理有限公司
皖江基金	指	皖江(芜湖)物流产业投资基金管理企业(有限合伙)
天津富海	指	天津富海股权投资基金管理中心

富海基金	指	东方富海（芜湖）股权投资基金管理企业（有限合伙）
珠海市工商局	指	珠海市工商行政管理局
广东省环保厅	指	广东省环境保护厅
越亚香港	指	珠海越亚封装基板技术（香港）股份有限公司，2014 年更名为越亚封装基板（香港）有限公司
越亚美国	指	ACCESS Technologies USA
Cupertino 公司	指	American Exec Cupertino, Inc., dba Pacific Business Centers
P.C.B 公司	指	P.C.B Technologies Ltd.
建设银行	指	中国建设银行股份有限公司珠海市分行
招商银行	指	招商银行股份有限公司珠海分行
南洋银行	指	南洋商业银行（中国）有限公司深圳分行
光大银行	指	中国光大银行股份有限公司珠海分行
中国银行	指	中国银行股份有限公司珠海分行
汇丰银行	指	汇丰银行（中国）有限公司
工商银行	指	中国工商银行股份有限公司珠海斗门支行
农业银行	指	中国农业银行股份有限公司珠海朝阳支行
平安银行	指	平安银行股份有限公司珠海分行
Prismark	指	Prismark Partners LLC，美国一家电子行业资讯机构
Gartner	指	Gartner, Inc.，美国一家从事信息技术研究和咨询的公司
IDC	指	International Data Corporation，一家从事信息技术、电信行业和消费科技市场咨询、顾问和活动服务的公司
IHS	指	Information Handling Services，美国一家资讯公司
μm	指	微米，1 微米=0.001 毫米
报告期、最近 3 年	指	包括 2013 年度、2012 年度、2011 年度
OHSAS18000	指	Occupational Health and Safety Assessment Series 18000，职业健康与安全管理体系
安华高科技（Avago）	指	Avago Technologies
威讯联合半导体（RFMD）	指	RF Micro Devices
Inari	指	Inari Technology Sdn Bhd
日月光、ASE	指	日月光半导体制造股份有限公司
ASE Korea	指	ASE Korea Inc. 日月光半导体制造股份有限公司的韩国附属企业
Shunsin	指	ShunSin Technology Holdings Limited
国碁电子、Ambit	指	Ambit microsystems corporation
制造 BU	指	从制造部、工艺部、品质部分别抽取核心技术人员组成的小组，对制造流程中工艺和品质的难题进行研究讨论，有效减少产品的报废，提高产品的良率
第二部分：专用术语		

IC、芯片	指	为 Integrated Circuit 的缩写，即集成电路，是一种微型电子器件或部件。采用一定的工艺，把一个电路中所需要的晶体管、二极管、电阻、电容和电感等元件及布线互连一起，制作在一小块或几小块半导体晶片或介质基片上，然后封装在一个管壳内，成为具有所需电路功能的微型结构。
IC 封装基板	指	对芯片起支持，保护，连接功能的载板
有机 IC 封装基板	指	采用有机绝缘材料制作的 IC 封装基板
无机 IC 封装基板	指	采用无机绝缘材料制作的 IC 封装基板
柔性有机 IC 封装基板	指	采用柔性材料制作的有机 IC 封装基板
刚性有机 IC 封装基板	指	采用刚性材料制作的有机 IC 封装基板；如无特别说明，本招股说明书中提及的 IC 封装基板主要指刚性有机 IC 封装基板。
IC 设计	指	为 Integrated Circuit Design 的缩写，即集成电路设计，运用专业的逻辑和电路设计技术设计集成电路。
晶圆	指	多指单晶硅圆片，由普通硅沙拉制提炼而成，是最常用的半导体材料，按其直径分为 4 英寸、5 英寸、6 英寸、8 英寸等规格，近来发展出 12 英寸甚至更大规格，目前以 8 英寸为主流。
IDM	指	为 Integrated Device Manufacturer 的缩写，表示集芯片设计、芯片制造、封装测试及产品销售于一体的集成器件制造商。
RF	指	为 Radio Frequency 的缩写，无线射频，它是一种高频交流变化电磁波的简称。
RF Module	指	为 Radio Frequency Module 的缩写，指无线射频模块，一种高频交流变化电磁波所作用的模组元件，一般用于通讯行业的信号滤波或者转换。
RF Module 封装基板、无线射频模块封装基板	指	应用于无线射频模块封装的 IC 封装基板
FCCSP	指	为 Flip Chip-Chip Scale Package 的缩写，倒装芯片级封装，区别于普通打线接合的倒装方式，FCCSP 由凸点焊球（Bump）连接基板与晶圆，为目前具良好电气特性、高 I/O 接点密度，且能缩小 IC 尺寸的一种封装形式。
FC	指	为 Flip Chip 的缩写，倒装封装形式，是将晶片正面翻覆，以凸块直接连接封装基板。
WB		为 Wire Bonding 的缩写，打线封装形式，利用金线或铜线连接芯片上的电性接点和封装基板上的输入电路接点。
FCBGA	指	为 Flip Chip-Ball Grid Array 的缩写，倒装芯片球栅格阵列，此封装形式使用小球代替原先采用的针来连接处理器。
WBBGA	指	为 Wire Bonding-Ball Grid Array 的缩写，打线球栅阵列封装。

WBCSP	指	为 Wire Bonding-Chip Scale Package 的缩写，打线芯片级封装基板。
FCPGA	指	为 Flip Chip-Pin Grid Array 的缩写，倒装针栅格阵列封装，插装型封装之一，其底面的垂直引脚呈阵列状排列。
FCLGA	指	为 Flip Chip-Land Grid Array 的缩写，触点栅格阵列封装，即在底面制作有阵列状电极触点的封装。
ABF	指	为 Ajinomoto Build-up Film 的缩写，一种无玻纤成分的树脂材料，ABF 材料是由 Intel 所主导的材料，主要用于 Flip Chip 等高阶基板。
PP	指	为 Pre-pregnant（或 Prepreg）的缩写，半固化片，是树脂与载体合成的一种片状粘结材料。
CMP	指	为 Chemical Mechanical Polishing 的缩写，化学机械研磨，CMP 工艺为半导体行业晶圆表面抛光技术。
OSP	指	为 Organic Solderability Preservatives 的缩写，有机抗氧化保护，OSP 指在洁净的裸铜表面上，以化学的方法长出一层有机皮膜。
Sputtering/Sputter	指	真空溅镀膜，是在相对稳定真空状态下，阴阳极间产生辉光放电，极间气体分子或原子被离子化而产生带电电荷，其中正离子受阴极之负电位加速运动而撞击阴极上之靶材，将其原子等粒子溅出，此溅出之原子则沉积于阳极之基板上而形成薄膜的技术。
LDI	指	为 Laser Direct Imaging 的缩写，激光直接成像技术，用于 PCB 及封装基板制造工艺中的曝光工序，区别于传统的底片接触曝光方法。
AOI	指	为 Automatic Optic Inspection 的缩写，自动光学检测，是基于光学原理来对焊接生产中遇到的常见缺陷进行检测的设备。
FQC	指	为 Final Quality Control 的缩写，最终品质控制。
铜柱法	指	自孔底向上电镀铜柱制作导通孔的方法。
绝缘层	指	封装基板内上下两层金属线路图形间用以隔绝的非导电层。
导电层	指	封装基板内平面方向的金属组成的线路图形层，一般为铜。
芯板层	指	有芯封装基板内最中间的绝缘层和两面的导电层及连通两面的导电层的导通孔层。
堆积层	指	相对芯板层后面流程增加的层，也称增层。
导通孔层	指	线路图形层之间，在上下垂直方向连通线路图形层的孔层。
种子层	指	珠海越亚无芯板封装基板流程中，通过化学或物理方式，在绝缘材料上增加一个很薄的金属层，用来作为后续电镀线路图形的基础。

连续铜层	指	厚度一致的整板连续的铜层。

第一章 概览

重要提示

本概览仅对招股说明书全文做扼要提示。投资者作出投资决策前，应认真阅读招股说明书全文。

一、发行人概况

（一）发行人基本情况

发行人名称	珠海越亚封装基板技术股份有限公司
英文名称	Zhuhai Advanced Chip Carriers & Electronic Substrate Solutions Technologies Co.,Ltd
发行人住所	珠海市斗门区珠峰大道北 3209 号 FPC 厂房
发行人主要办公地点	珠海市斗门区珠峰大道北 3209 号 FPC 厂房
法定代表人	方中华
注册资本	605,124,067 元
有限公司成立日期	2006 年 4 月 26 日
股份公司成立日期	2012 年 7 月 31 日
经营范围	生产和销售自产的封装基板，从事封装基板相关技术的研发、及自主研发技术成果的转让。

（二）主营业务及产品概述

本公司最早由中国、以色列两国企业合资组建，主要从事具有自主知识产权的刚性有机 IC 无芯封装基板的研发、生产和销售，始终致力于成为国际领先的创新型的半导体封装基板解决方案提供商。自 2006 年成立以来，公司以“新型集成电路支撑结构及其制作方法”等为核心进行高新技术成果转化，并通过多年的自主研发和技术积累，将实验室技术转化为量产技术，成为世界上首家采用“铜柱法”生产无芯封装基板并实现量产的高科技企业。公司无芯封装基板技术产业化的成功，打破境外企业垄断市场的局面。

公司在技术创新上取得了较多成果，目前拥有五大无芯封装基板量产技术：无芯板（Coreless）技术、铜柱（Copper Pillar）技术、采用半固化片在铜柱上层压的技术、化学机械抛光（CMP）磨板技术和真空喷溅（Sputtering）技术。截至本招股说明书签署日，公司拥有 13 项发明专利，全部知识产权属于无芯封装基板制造技术领域，技术达到国际先进水平。

公司为客户提供封装基板解决方案以及定制化的高密度有机无芯 IC 封装基板，产品经过封装测试厂的封测后，最终运用于手机、平板电脑、游戏机等便

携式终端消费电子产品。公司产品具备良好的导电性、散热性、耐热冲击性等特点，能够较好地满足当今先进封装设计对高密度、高效低能耗、高速度的需求。目前公司主要研发生产应用于模拟芯片封装领域的无线射频模块（RF Module）封装基板，此类产品已处于量产阶段，已通过国际芯片企业威讯联合半导体（RFMD）、安华高科技（Avago）等客户认证并获得其量产订单，该等客户已进入 iPhone、三星 Galaxy 系列等智能手机以及 iPad、Galaxy Tab 等平板电脑的供应链。

公司为国家高新技术企业、珠海市知识产权优势企业、中小企业创新产业化示范基地、广东省战略性新兴产业培育企业、广东省创新型试点企业、广东省第二批重点创新帮扶高成长性中小企业，并设有珠海市级重点企业技术中心及广东省工程技术研究中心。2012 年 12 月，公司“高可靠 RF Module 系统级封装基板制造技术”获得珠海市科技进步一等奖，并于 2014 年 4 月获得广东省科学技术奖二等奖。

（三）经营业绩

2011 年、2012 年和 2013 年，公司分别实现销售收入 43,774.74 万元、49,641.70 万元和 36,847.10 万元；2011 年、2012 年和 2013 年，归属于母公司股东的净利润分别为 4,541.85 万元、8,270.97 万元和 1,995.24 万元。

二、发行人控股股东及实际控制人

本公司无实际控制人，并列第一大股东为方正信产和 AMITEC 公司，截至本招股说明书签署日，方正信产和 AMITEC 公司各自持有公司 38.3575%的股份。

方正信产是方正集团的全资子公司，北京大学是方正信产的实际控制人。方正信产所持公司股份性质为国有法人股。

AMITEC 公司是以色列上市公司 Priortech 公司的控股子公司。以色列籍 Yotam Stern 先生和 Rafi Amit 先生是 AMITEC 公司的实际控制人。AMITEC 公司所持本公司股份性质为外资股。

有关两家公司的情况详见“第四章 发行人基本情况”之“八、发行人股东基本情况”。

三、发行人主要财务数据

根据瑞华出具的瑞华审字[2014]40030105 号标准无保留意见的《审计报告》，本公司最近 3 年合并报表主要财务数据如下：

（一）资产负债表主要数据

单位：万元

项目	2013 年 12 月 31 日	2012 年 12 月 31 日	2011 年 12 月 31 日
资产总计	113,115.51	117,277.13	96,953.10
负债总计	28,206.61	34,372.70	51,274.89
所有者权益	84,908.90	82,904.43	45,678.21
归属于母公司普通股股东权益	84,908.90	82,904.43	45,678.21

（二）利润表主要数据

单位：万元

项目	2013 年度	2012 年度	2011 年度
营业收入	36,847.10	49,641.70	43,774.74
营业利润	1,658.11	8,863.66	4,519.31
利润总额	2,282.10	9,048.90	4,540.62
归属于母公司所有者的净利润	1,995.24	8,270.97	4,541.85
净利润	1,995.24	8,270.97	4,541.85

（三）现金流量表主要数据

单位：万元

项目	2013 年度	2012 年度	2011 年度
经营活动产生的现金流量净额	13,735.84	16,656.20	7,606.82
投资活动产生的现金流量净额	-13,989.03	-37,518.55	-28,301.64
筹资活动产生的现金流量净额	-1,283.56	13,955.77	23,888.02
现金及现金等价物净增加额	-1,292.44	-6,863.15	3,155.83

（四）主要财务指标

项目	2013 年	2012 年	2011 年
流动比率（倍）	1.19	1.13	0.65
速动比率（倍）	0.83	0.87	0.53
资产负债率（母公司）	24.82%	29.20%	52.89%
无形资产（扣除土地使用权）占净资产的比例	10.68%	10.66%	20.88%
应收账款周转率（次/年）	4.40	5.26	6.98
存货周转率（次/年）	5.83	6.09	7.72
息税折旧摊销前利润（万元）	10,962.67	15,648.70	9,253.93
利息保障倍数（倍）	3.41	14.54	3.36
归属于本公司股东的净利润（万元）	1,995.24	8,270.97	4,541.85
归属于本公司股东扣除非经常性损益后的净利润（万元）	1,464.85	8,108.89	4,520.55
归属于本公司股东的每股净资产（元/股）	1.40	1.37	—

项目	2013 年	2012 年	2011 年
每股经营活动产生的现金流量（元/股）	0.23	0.28	—
每股净现金流量（元/股）	-0.02	-0.11	—
加权平均净资产收益率（扣除非经常性损益后归属普通股股东的净利润）	1.75%	11.05%	19.30%

四、本次发行情况

股票种类	人民币普通股（A 股）
每股面值	1.00 元
发行股数及占发行后总股本的比例	本次公开发行 A 股股票总数不超过 20,170.8023 万股，其中公司公开发行新股数量上限为 20,170.8023 万股，公司股东公开发售股份数量上限为 5,000 万股且不超过自愿设定 12 个月及以上限售期的投资者获得配售股份的数量。发行后的流通股股份占公司股份总数的比例不低于 25.00%。根据本次发行询价结果，若新股发行募集资金净额超过募投项目所需资金总额的，则公司将相应减少新股发行数量，同时进行老股转让，老股转让所得资金不归公司所有。
发行方式	采用网下向询价对象配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，或采用中国证监会核准的其他方式
发行对象	符合资格的询价对象和在上海证券交易所开设 A 股股东账户的境内自然人、法人和其他机构投资者（国家法律、行政法规、其它规范性文件及本公司须遵守的其它监管要求所禁止者除外）或中国证监会规定的其它对象
上市地点	上海证券交易所
承销方式	余额包销

五、募集资金用途

若本次股票发行成功，募集资金净额将用于投资以下项目：

单位：万元

项目名称	总投资	募集资金投资额
珠海越亚封装基板技术股份有限公司改扩建项目	62,000.00	52,000.00

珠海越亚封装基板技术股份有限公司改扩建项目总投资 62,000 万元，其中 52,000 万元通过上市募集资金解决，剩余 10,000 万元主要通过自筹资金解决。项目募集资金使用金额与公司本次发行实际募集资金相比，如本次募集资金不能满足拟投资项目的资金需求，公司将自筹资金方式解决资金缺口。如本次公开发行募集资金到位时间与项目资金需求的时间要求不一致，公司可根据实际情

况以自筹资金先期投入，募集资金到位后予以置换。具体内容详见本招股说明书“第十二章 募集资金运用”有关内容。

第二章 本次发行概况

一、本次发行的基本情况及发行费用

（一）本次发行基本情况

序号	项目	基本情况
1	股票种类	人民币普通股（A股）
2	每股面值	1.00 元
3	发行股数	本次公开发行 A 股股票总数不超过 20,170.8023 万股，其中公司公开发行新股数量上限为 20,170.8023 万股，公司股东公开发售股份数量上限为 5,000 万股且不超过自愿设定 12 个月及以上限售期的投资者获得配售股份的数量。发行后的流通股股份占公司股份总数的比例不低于 25.00%。根据本次发行询价结果，若新股发行募集资金净额超过募投项目所需资金总额的，则公司将相应减少新股发行数量，同时进行老股转让，老股转让所得资金不归公司所有。
4	每股发行价格	人民币【】元/股，根据向询价对象询价结果确定
5	发行市盈率	【】倍（每股收益按照【】年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）
6	发行前每股净资产	【】元/股
7	预计发行后每股净资产	【】元/股（按照【】年【】月【】日经审计的净资产加上本次发行筹资净额之和除以本次发行后总股本计算）
8	预计发行市净率	【】倍（按照发行价格除以发行后每股净资产计算）
9	发行方式	采用网下向询价对象配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式或中国证监会核准的其他方式
10	发行对象	符合资格的询价对象和在上海证券交易所开设 A 股股东账户的中国境内自然人、法人和其他投资者（中国法律、行政法规、其他规范性文件及本公司须遵守的其他监管要求所禁止者除外）或中国证监会规定的其他对象
11	承销方式	余额包销
12	募集资金总额	本次发行募集资金总额为【】万元
13	募集资金净额	扣除发行费用后，本次发行募集资金净额为【】万元

（二）发行费用概算

序号	项目	费用
1	保荐费用	【】万元
2	承销费用	【】万元
3	审计及验资费用	【】万元

4	评估费用	【】万元
5	律师费用	【】万元
6	信息披露及上网发行手续费等	【】万元
合计		【】万元

注：上述列表中费用以实际支出为准

二、本次发行有关机构

1	发行人：珠海越亚封装基板技术股份有限公司 住所：珠海市斗门区珠峰大道北 3209 号 FPC 厂房 法定代表人：方中华 联系人：陈春灵 电话：0756-5656005 传真：0756-5656510
2	保荐人（主承销商）：招商证券股份有限公司 住所：深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38—45 楼 法定代表人：宫少林 保荐代表人：徐国振、张迎 项目协办人：王森鹤 项目经办人：韩汾泉、李恺、罗天羽、李锐、王吉祥、于明礼 电话：0755—82943666 传真：0755—82943121
3	副主承销商：（待定）
4	分销商：（待定）
5	发行人律师：北京市君合律师事务所 住所：北京市建国门北大街 8 号华润大厦 22 层 负责人：刘大力 经办律师：胡义锦、令狐铭、王志雄 电话：021-22086299 传真：021-52985492

6	会计师事务所及验资机构：瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 住所：北京市海淀区西四环中路 16 号院 2 号楼 法定代表人：杨剑涛 经办会计师：王淑燕、张芳 电话：010-88219191 传真：010-88210558
7	资产评估机构：广东中广信资产评估有限公司 住所：广州市越秀区东风中路 300 号之金安商务大厦 17 楼 L、K 位 法定代表人：汤锦东 经办评估师：汤锦东、周丽 电话：0756-3228771 传真：0756-3228717
8	股票登记机构：中国证券中央登记结算有限责任公司上海分公司 住所：上海市浦东新区陆家嘴东路 166 号中国保险大厦 36 楼 电话：021—58708888 传真：021—58899400
9	拟上市证券交易所：上海证券交易所 住所：上海市浦东新区浦东南路 528 号上海证券大厦 电话：021—68808888 传真：021—68804868
10	保荐人（主承销商）收款银行：招商银行深圳分行深纺大厦支行 住所：深圳市华强北路 3 号深纺大厦 B 座 1 楼 户名：招商证券股份有限公司 账号：819589015710001

三、发行人与本次发行有关当事人之间的关系

发行人与本次发行有关的中介机构及其负责人、高级管理人员及经办人员之间不存在任何直接或间接的股权关系或其他权益关系。

四、与本次发行上市有关的重要日期

序号	项目	时间
1	刊登发行公告的日期	【】年【】月【】日
2	开始询价推介的日期	【】年【】月【】日

3	刊登定价公告的日期	【】年【】月【】日
4	申购日期和缴款日期	【】年【】月【】日
5	预计股票上市日期	【】年【】月【】日

请投资者关注发行人与保荐人（主承销商）于相关媒体披露的公告。

第三章 风险因素

投资者在评价发行人本次发行的股票时，除本招股说明书提供的其他各项资料以外，应特别认真地考虑下述各项风险因素。下述风险是根据重要性原则或可能影响投资者决策的程度大小排序，但该排序并不表示风险因素会依次发生。

一、宏观经济及半导体产业周期波动的风险

近几年来，随着次贷危机、欧债危机等事件的发生，全球宏观经济波动性加大，全球经济增长前景存在较大不确定性。半导体产业与全球宏观经济关联度较高，具有明显的周期性。根据 Prismark 的研究，2002 年到 2004 年，全球半导体产业处于高速增长阶段；2005 年出现周期性回落，随后两年增速一直保持较低的水平；2008 年和 2009 年受金融危机的影响，甚至出现了负增长；2010 年国际市场环境逐渐好转使得半导体行业又步入了较快发展阶段，然而 2011 年至 2012 年，宏观经济下行又制约了行业的发展。据 Gartner 统计，2013 年全球半导体市场规模较上年增长 5.03%，相对 2012 年有所好转。

本公司属于 IC 封装基板行业，即向芯片厂商及其合作封装测试厂商提供封装基板技术解决方案及产品。IC 封装基板行业属于半导体集成电路产业链，其景气程度直接受到半导体集成电路产业的影响。因此若未来全球经济波动继续加大，或半导体产业周期性变化，芯片厂商及其合作封装测试厂商对公司产品的需求将可能大幅波动，将使得公司面临宏观经济及半导体产业周期波动的风险。

二、下游大客户集中的风险

全球芯片市场主要由欧美大型企业主导，市场集中度较高。报告期内，公司的主导产品主要应用于无线射频模块芯片，主要包括功率放大器、收发器和前端接收模块芯片；公司主要面对的芯片厂商为美国的威讯联合半导体（RFMD）和安华高科技（Avago）。

公司与芯片厂商确定产品方案后，芯片厂商会通过两种方式采购发行人的产品：一是由芯片厂商（含其下属公司）直接向公司采购，二是由芯片厂商向其合作封装测试厂商指定公司的产品，由封装测试公司向公司采购。

2013 年、2012 年及 2011 年，将来自安华高科技（Avago）合作封装测试厂商的销售收入与来自安华高科技（Avago）（含其下属公司）的销售收入合并后，来

自安华高科技（Avago）相关客户的收入与来自威讯联合半导体（RFMD）（含其下属公司）的收入合计占公司营业收入的比重见下表：

单位：万元

项目	客户名称	销售收入	占营业收入比例
2013 年度	安华高科技（Avago）相关	22,432.00	60.88%
	威讯联合半导体（RFMD）	12,231.09	33.19%
	合计	34,663.09	94.07%
2012 年度	安华高科技（Avago）相关	35,766.20	72.05%
	威讯联合半导体（RFMD）	12,266.61	24.71%
	合计	48,032.81	96.76%
2011 年度	安华高科技（Avago）相关	31,449.63	71.84%
	威讯联合半导体（RFMD）	10,450.45	23.87%
	合计	41,900.08	95.72%

公司销售收入存在大客户集中的特点。同时，若客户发现其某项采购较依赖于单个供应商时，也会利用“第二货源(Second Source)”策略，适当降低对该供应商的采购。因此大客户集中使得公司存在较大的经营风险。若大客户需求发生不利变化，公司营业收入将面临大幅下滑的风险；若大客户信用发生不利变化，公司应收账款将可能不会按期收回甚至无法收回；若大客户终止与公司合作，或发生其他情况导致其对公司产品的需求量大幅降低，则将不可避免地对公司销售造成不利影响，甚至可能出现公司上市当年营业利润比上年下滑 50% 以上或上市当年即亏损的情形。

2013 年，公司大客户安华高科技（Avago）新产品的技术方案发生了变化，减少了对公司的采购量；同时，公司获取新客户认证的进度未达到预期，获得的新客户订单未能充分弥补安华高科技（Avago）减少的订货量，导致公司当年营业收入较上年下降。但由于公司已准备了新的产能，2013 年折旧费用有所增加。上述因素共同导致公司 2013 年产能利用率下滑较多，营业利润较 2012 年下滑超过 50%。

2014 年，公司积极接洽新客户、拓展新市场，并逐步获得了中普微电子、国民技术等新客户的量产订单，进一步改善了客户结构；但前期购买的部分设备也将逐步转入固定资产，折旧费用将进一步增加。如果安华高科技（Avago）等老客户的采购量进一步下滑，新客户订单未能填补缺口，公司 2014 年经营业绩可能相对 2013 年进一步下滑，甚至在 2014 年上半年出现亏损的情况。

三、市场竞争激烈的风险

公司是世界上首家采用“铜柱法”生产无芯封装基板并实现量产的高科技企业，其产品具备高集成度、更薄、良好的散热性等特征。凭借专利优势、技术优势和差异化的产品优势，公司通过了无线射频模块芯片厂商威讯联合半导体（RFMD）、安华高科技（Avago）的正式认证，并实现了较高的销售规模。尽管如此，公司仍面临着激烈的市场竞争。

首先，IC 封装基板行业市场集中度较高，且主要集中在日本、韩国和中国台湾。2012 年前十名企业封装基板收入占整个行业收入的比例超过 80%。这些企业均在行业经营多年，拥有各自的核心技术与产品，且与现有芯片厂商有较长的合作关系。如果这些企业针对本公司实施竞争性策略，公司无论在无线射频模块芯片市场还是倒装芯片市场等细分市场都将面临较大的市场竞争。

其次，我国大陆封装基板企业较少，但随着行业和市场的发展，从事封装基板研发和生产的企業将逐步增加。同时，外资企业和台资企业向大陆转移生产和研发的趋势也可能进一步增大，国内企业间的市场竞争将越来越激烈。

第三，公司“铜柱法”无芯封装基板目前具有一定的差异化优势，但若其他市场参与者利用传统技术生产的产品性能和成本变得更好，或利用其他方式实现了更好的无芯封装基板产品，或研发出了更新的技术，公司产品的差异化优势将可能迅速丧失，公司面临的市场竞争将大大增加。

市场竞争的日趋激烈，将可能影响公司的盈利能力，加大公司的经营风险。

四、公司产品最终主要应用于消费电子产品而需面对的风险

公司产品为 IC 无芯封装基板，目前最终主要应用于手机、平板电脑等消费电子产品。消费电子产品市场竞争激烈，消费者偏好变化快，产品生命周期越来越短，且销售价格普遍呈逐渐下降的趋势。为此，公司采用按照客户需求定制化生产的模式，以增加与下游客户的合作粘性，降低经营风险。但公司需同时面对不同客户、不同订单、不同类型、不同需求的样板订单、量产板订单，这对公司的生产管理提出了较高的要求。若公司不能及时处理好各类生产计划，不能较好的控制各生产工序，可能会影响公司产品的良率、降低公司的毛利率，甚至可能影响到公司与客户的合作关系，进而影响公司未来的盈利能力。

同时，消费电子产品生命周期变短的特点可能会使得公司相应产品的生命周期变短、价格下降较快。公司需不断保持研发创新能力，应对这种不利变化。若公司不能及时开发出满足市场需求的新产品，或者不能及时采取措施应对终端产品价格出现的不利变动，公司的盈利情况将可能受到不利影响。

五、客户认证的风险

公司处于半导体产业链上，面对的客户为芯片厂商及其合作封装测试厂，且目前主要为国际客户。这些客户均实行严格的供应商认证体制，包括对封装基板企业技术、设备、产能、产品等方面的认证程序，一般需要一年或更长的时间，而且客户认证通过后，也会不断追踪考核公司及产品的资质。

公司基于自身发明专利生产无芯封装基板，已逐步得到了市场认可。目前，在无线射频模块市场，公司已经通过了威讯联合半导体（RFMD）和安华高科技（Avago）的认证，并处于国内多个芯片企业的认证过程中；在数字芯片市场，公司正处于业内知名芯片厂商的认证过程中；未来公司推出的新产品、新技术，都需通过客户的认证。若因各种原因使得上述认证时间过长或者认证失败，公司将在短时间内无法取得这些客户的量产订单，公司未来的增长将存在较大的不确定性；另外，为应对客户认证，公司必须提前预备产能，若客户认证时间过长或认证失败，公司新增产能将得不到有效利用，新增折旧反而会使公司盈利下滑。因此公司面临客户认证时间过长或认证失败的风险。

六、产品研发不能迅速满足客户需求的风险

公司下游客户面向的消费电子产品市场更新换代日益加快，产品推陈出新的周期日益缩短，因此公司客户芯片设计厂商需快速响应终端产品更新对芯片提出的新需求。公司作为封装基板产品及解决方案提供商，依托具有自主知识产权的核心技术，力求迅速为客户提供针对性、个性化的定制开发服务。然而，如果客户所要求的产品与公司目前能够实现的量产产品存在一定差异，公司需运用新技术、改进生产工艺及购买相关设备才能配合新产品研发与生产。新产品需投入较大人力、物力，且从研发到量产需要较长时间，并存在因未能及时满足客户需求，从而无法进入量产阶段，导致公司的前期投入无法收回，新产品拓展失败的风险。这将对公司的盈利能力造成不利影响。

七、产能与生产订单不能及时匹配和季节性波动的风险

受下游消费电子产品需求的影响，公司所处 IC 封装基板市场存在季节性波动的特点。一般说来，每年的第一、第二季度是行业淡季，第三、第四季度受到国内外传统节日影响，消费需求增长，进而拉动封装基板行业进入需求旺季。但公司设备特别是进口设备需提前投资，一旦投资完成形成产能，则不能轻易变动。当行业处于淡季时，订单较少，部分设备将可能利用率不高；当行业处于旺季时，产能利用率将大幅提高，甚至可能因为部分工序形成瓶颈而无法及时满足客户的需求。因此，尽管客户会向公司提供订单预测，但公司无论淡旺季都无法使得产能利用和生产订单及时匹配。产能利用率不高时，相对较高的固定费用将使得公司盈利减少，产能不足时，将无法满足客户需求而丢失订单，因此公司生产经营存在产能与生产订单不能及时匹配和季节性波动的风险。

八、公司无实际控制人的风险

本公司无控股股东和实际控制人。截至本招股说明书签署之日，公司共有 11 名股东，股权结构较为分散，并列第一大股东方正信产和 AMITEC 公司分别持有公司 38.3575% 的股权，无任何股东直接持股比例高于 50%。单一股东在公司董事会所占席位均未过半，单一股东对公司董事会均不构成实际控制。方正信产和 AMITEC 公司于 2013 年 5 月 1 日签署了《无控制确认协议》，进一步确认自越亚有限成立以来双方均对珠海越亚无实质控制，并对非独立董事的选举进行了一定的措施安排。

本公司无实际控制人的状况表明公司股权一定程度的分散与制衡，虽然有利于提高决策的科学性，但也可能造成公司在进行重大生产经营和投资等决策时，因决策效率降低而贻误业务发展机遇，造成公司生产经营和经营业绩的波动。即使各股东均对其持股锁定进行了承诺，但上市公司的持股结构将仍可能发生变化，进而影响公司经营政策的稳定性、连续性。同时，公司无实际控制人的状况也可能使得管理层容易形成内部人控制的局面，从而对股东利益最大化的目标造成负面影响。因此，公司无实际控制人的状况对公司治理结构存在潜在不利影响。

九、人才流失和短缺的风险

公司自设立以来即致力于将无芯封装基板制造的实验室技术转化为量产技术，并最终取得了成功，目前公司已在在无线射频模块芯片市场取得了较好的

市场份额。公司技术驱动的发展路径离不开核心人员，包括 Dror Hurvits、陈先明、黄士辅、向文胜、姜俊文、郭进良、许元鸿、王建皓、Nicholas Stukan 等，这些人员对公司专利研发、技术创新、生产管理、工艺实现、工艺控制、国际市场开拓等都非常重要。若这些人才发生流失、且在短期内没有合适的人员可以替代，将在一定程度上影响公司相应方面的日常经营，进而可能对公司的经营业绩造成不利影响。

公司产品面向芯片厂商，精密度和技术要求较高；公司在生产过程中需要培养大量的熟练工人和技术工人。随着我国城市化进程的发展，人员成本总体上逐年上涨，技术工人的流动将可能增加。若该等熟练工人和技术工人出现大批流失，可能会对公司的生产经营造成不利影响。

同时，随着公司生产经营规模的扩大以及募集资金投资项目的实施，公司对各类人才的需求量还将大幅增加。而且，随着行业竞争的日趋激烈，行业内竞争对手对上述人才的争夺也将加剧，公司可能面临人才短缺的风险。

十、技术市场化及技术更新换代的风险

截至目前，封装基板生产制造的主要技术包括有芯半固化片积层法、树脂积层法以及无芯封装基板制造技术。公司自设立以来即致力于将无芯封装基板制造的核心专利产业化，目前已拥有“无芯板(Coreless)技术”、“铜柱(Copper Pillar)技术”、“采用半固化片在铜柱上层压的技术”、“化学机械抛光(CMP)磨板技术”、“真空喷溅(Sputtering)技术”等五大核心技术以及多项专有技术。但公司仍需进一步积累量产经验，继续开展研发创新和技术创新，以保持产品和技术的差异化优势。但不排除公司产品可能存在潜在、不可预知的缺陷或漏洞等的风险，亦可能存在由于投资不足、决策失误等因素导致不能及时跟进技术进步和客户需求的可能，这将可能对发行人的竞争力和财务表现产生不利影响。

芯片厂商和封装基板厂商都在尝试新的技术，如果行业内出现优于本公司无芯封装基板技术的新技术且实现市场化，或者传统技术得到大幅改进使得公司产品优势丧失，甚至芯片厂商可以接受并运用无需封装基板即可实施的封测技术等，均会使得公司面临丧失技术优势而竞争力下降的风险。

十一、技术流失和专利保护的风险

发行人注重在技术开发方面的持续投入，经过多年的生产经验积累，公司在封装基板行业内掌握了国际先进的核心技术、生产工艺和非专利技术，并具

有完全自主知识产权。这些核心技术、生产工艺、非专利技术是公司封装基板产品及技术解决方案能够取得业界先进水平的重要基础。公司依靠专利法、保密协议和其他合同条款，采取“专利群”策略对公司的核心技术进行保护。目前市场上尚未发现竞争对手试图模仿公司的生产技术；但若上述技术和工艺出现意外泄露，则公司可能丧失在产品性能、品质等方面的技术优势。另外，公司仍在不断研发新技术并对其申请专利保护，然而若发行人无法及时获取专利授权，或发行人部分专利申请已公示却未能获得授权，则他人可能无偿使用公司的技术，削弱公司的竞争地位。

同时，公司目前已经在中国、美国、以色列、韩国、日本、中国台湾等国家或地区拥有 13 项专利和超过 70 项的专利申请。这些国家或地区专利法律的变化可能削弱公司保护知识产权的能力，或者增加公司进行专利保护的的成本，从而削弱公司的核心竞争力，甚至影响公司的持续盈利能力。

十二、原材料及能源采购的风险

公司生产所需的原材料包括金盐、铜箔、半固化片、干膜等。报告期内，公司金盐、铜箔、半固化片占直接材料的比例约为 50%，且金盐的供应需要有严格的资质限制，其采购需要履行一定的备案手续。公司与珠海市剧毒物品专卖有限公司、深圳市柳鑫实业有限公司等签订了原材料采购协议。若上述原材料的采购不能及时满足公司需求，或者金盐、铜箔等价格受大宗商品市场的影响出现大幅波动，将对公司的盈利状况产生一定的影响。

公司所需的能源包括水、电、气等，且由于电镀工序等原因，水和电对公司的生产作用较大。停水、停电以及水电价格波动都会对公司经营及盈利造成一定的不利影响。因此，公司生产经营存在原材料及能源采购的风险。

十三、资本支出、无形资产金额较大带来的折旧、摊销和减值风险

报告期内，公司为扩大产能进行了较大规模的设备及其他固定资产投资，并导致非流动资产金额及其占总资产的比例迅速增加。2013 年、2012 年及 2011 年公司投资活动现金流出分别为 13,989.03 万元、37,518.74 万元和 28,301.64 万元，截至 2013 年末，公司固定资产及在建工程账面价值合计为 88,084.08 万元，占资产总额比例达到了 77.87%。同时，公司预计募投资金项目投资总额为 6.2 亿元，随着募集资金项目的实施，公司设备投资将进一步增长，账面固定资产、在建工程期末余额将继续增加。

若公司无法保持正常的业务增长，或募集资金项目未能如期产生效益，以消化新增的折旧，将可能使得公司利润下滑；另外，由于公司的主要机器设备专业化程度高，价值量大，如果未来封装基板制造技术出现重大变化或定制设备在使用过程无法实现预设效果，公司将会面临一定的资产减值的风险。

此外，公司无形资产账面价值较大。截至 2013 年末，公司无形资产账面价值为 9,065.61 万元，主要为股东投入的技术资产组合。一方面，该类资产每年摊销金额较大，2013 年公司无形资产摊销金额为 741.58 万元；另一方面，如果未来公司经营业绩持续低于预期，该资产存在减值风险。

十四、募集资金投资项目的技术和市场风险

公司本次发行股票募集资金投资项目为公司的改扩建项目，即通过进一步研发和生产模拟芯片封装基板产品和数字芯片封装基板产品，扩展公司在模拟芯片市场和数字芯片市场的业务。尽管公司董事会在确定上述投资项目之前已经对其技术先进性和成熟性进行了论证，其中模拟芯片封装基板产品已具备量产经验、数字芯片封装基板产品已为客户成功生产样板，但在实施过程中仍有可能出现一些目前尚未知晓或不能及时解决的技术问题而使该项目存在一定的技术风险。

同时，在确定投资上述项目前，公司已分别对其市场及前景进行了充分研究和调查，论证了产品的市场需求，确信该项目在未来一定时期内具有良好的市场及前景。尽管如此，由于国家政策及市场本身具有的不确定性，以及客户认证存在的不确定性，包括已通过的模拟芯片封装基板产品客户认证不能持续保持、数字芯片封装基板产品无法获得客户认证或量产订单不足，都将可能使得募集资金项目新增产能无法被新增订单消化，从而使得实施该项目仍具有一定的市场风险。

十五、公司净资产收益率下降的风险

报告期内，受净资产规模持续增长的影响，公司净资产收益率下降明显，2013 年、2012 年及 2011 年，公司按扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润计算的加权平均净资产收益率分别为 1.75%、11.05%及 19.30%。由于募集资金的到位与拟投资项目的建成达产之间存在一定的时间差，在拟投资项目达到预定收益目标前，公司存在净资产收益率继续下降的风险。

十六、税收政策变化的风险

报告期内，本公司享受的主要税收优惠政策及面临的风险如下：

（一）企业所得税税率变化的风险

根据广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国家税务局、广东省地方税务局联合下发的《关于公布广东省 2011 年第二批高新技术企业名单的通知》（粤科高字〔2012〕47 号），本公司于 2011 年 11 月 17 日被认定为高新技术企业，。因此，公司在 2013 年度按 15% 的税率缴纳企业所得税。

公司被认定为高新技术企业的有效期限为 3 年，若 2014 年公司高新技术企业资格未能通过重新认定，则将需要按 25% 的税率缴纳企业所得税，公司的利润将受到一定程度的影响。

（二）出口退税政策变化的风险

报告期内，公司出口销售收入占全部销售收入的比例较高，出口产品享受增值税“免、抵、退”优惠政策，出口产品退税率为 17%。出口退税率降低将导致公司营业成本的增加，若未来国家出口退税政策发生较大不利变化，将对公司的经营业绩造成一定影响。

以报告期为例，不考虑其他因素的影响，如果出口退税率下降至 15% 或 13%，报告期内公司的营业利润变化情况如下：

单位：万元

出口退税税率	17%	15%		13%	
	营业利润	营业利润	降幅	营业利润	降幅
2013 年	1,658.11	1,183.14	28.65%	708.16	57.29%
2012 年	8,863.66	8,127.51	8.31%	7,391.37	16.61%
2011 年	4,519.31	3,878.33	14.18%	3,237.34	28.37%
均值	5,013.69	4,396.33	17.05%	3,778.96	34.09%

十七、国际贸易和汇率相关的风险

公司的产品主要出口至美国、韩国和东南亚，部分生产设备直接或间接进口自日本、欧洲等多个国家或地区。公司业务受到国际贸易环境变化的影响，例如国际政治形势的波动、国际贸易政策的变化等因素。若市场上出现针对公司所处细分行业的技术性贸易壁垒、关税壁垒，或其他不可预见的贸易环境变化，公司的生产经营将会受到重大不利影响。

公司的产品出口以及原材料、机器设备进口均会涉及外币结算，结算货币包括美元、港币、欧元等。公司产品在国际市场中主要以美元计价，在售价不变的情况下，人民币升值将造成公司利润空间收窄；提高售价则会影响产品的市场竞争力，造成销量萎缩。近几年随着中国的经济发展，人民币呈现升值趋势。这种变动将会在短期内影响公司的资产、负债的账面价值，从而影响经营业绩。同时，从长远来看，人民币升值会在一定程度上降低公司产品在国际市场的竞争力。

为避免人民币升值带来的汇兑损失，锁定美元兑人民币的汇率。公司参与了远期外汇合约，截至 2013 年 12 月 31 日，根据公司向中国建设银行股份有限公司珠海市分行提交的结售汇交易申请书的履行情况，尚有 1,210.02 万美元的远期结汇合约待履行。

2014 年初以来，人民币呈现贬值趋势，若 2014 年人民币继续贬值，发行人与银行签署的远期汇率协议将遭受一定汇兑损失。

十八、资产及经营规模大幅增长带来的管理风险

未来随着募集资金投资项目的实施，公司资产及经营规模还将继续增长，这将对公司的经营管理水平提出更高的要求。如果公司的管理水平不能适应资产及经营规模的变化，其持续发展及盈利能力将可能受到一定影响。

十九、环境保护相关的风险

IC 封装基板生产过程中不可避免会产生废水、废气及固体废物等，特别是本公司生产环节包含电镀工序。为降低公司生产经营活动对环境可能造成的不利影响，公司自成立以来便逐步制定了各项有关环境保护的制度，重视生产经营过程中的环境保护工作，对各类污染物分别采取了有效的治理措施。

尽管公司严格执行环保法规及政策、加强环保管理，但不排除公司未来在环保方面出现意外情况的可能性，如出现对环境造成污染的意外事件等，一旦发生意外情况，将会对公司的声誉和日常生产经营造成不利影响。

另一方面，我国对环境保护日趋重视，如果国家在未来进一步制定并实施更为严格的环境保护法规，则本公司可能需要进一步加大在环境保护方面的投入，这将增加本公司的成本，从而一定程度上影响本公司的盈利水平。与此同时，本公司的产品大多销往海外，而欧美国家环保意识较我国强，且正逐步立法以提高对电子零部件的环保要求。若欧美国家对电子零部件的环保要求进一步严格，将可能提高公司的经营成本，对公司产生不利影响。

二十、股价波动的风险

若公司本次发行成功，公司股票将在证券交易所挂牌上市。股票市场价格波动除受公司自身经营状况变化的影响外，还受到诸多不可预见因素的影响，如国内外政治经济形势、国家金融政策、股票供求关系、投资者心理等。因此即使在本公司经营状况稳定的情况下，股票价格仍可能因上述因素波动，可能出现低于发行价甚至股票面值的风险，直接或间接对投资者造成损失，投资者对此应有充分的认识。

二十一、信息技术系统失灵或出现安全漏洞的风险

为保证生产经营的准确性及商业信息的机密性，公司启用了严密的信息技术系统，并在网络系统中安排了安全措施，但信息技术系统仍存在因电脑病毒入侵、自然灾害、恐怖袭击以及通信失灵等出现安全漏洞的可能性。公司的生产制造自动化程度高，且在公司内部及与供应商、客户往来过程中，电子邮件等网络通讯都是极为重要的手段，因此信息技术系统的失灵会妨碍公司的经营运作。同时安全漏洞也有可能泄露公司专有信息和商业机密，导致公司承担相应责任或支付额外支出。

第四章 发行人基本情况

一、发行人的基本资料

- 1、注册中文名称：珠海越亚封装基板技术股份有限公司
- 2、注册英文名称：Zhuhai Advanced Chip Carriers & Electronic Substrate Solutions Technologies Co., Ltd.
- 3、注册资本：605,124,067 元
- 4、法定代表人：方中华
- 5、成立日期：2006 年 4 月 26 日（有限公司）
2012 年 7 月 31 日（股份公司）
- 6、公司住所：珠海市斗门区珠峰大道北 3209 号 FPC 厂房
- 7、邮政编码：519175
- 8、电话号码：0756-5656005
- 9、传真号码：0756-5656510
- 10、电子邮箱：zhuhai-access@access-substrates.com

二、发行人改制重组情况

（一）公司设立

本公司系由珠海越亚封装基板技术有限公司依法整体变更设立的外商投资股份有限公司。越亚有限系由珠海多层和 AMITEC 公司于 2006 年 4 月 26 日以货币方式共同出资设立的中外合资经营企业，设立时注册资本为 200 万美元。

2012 年 5 月 15 日，越亚有限董事会一致同意将越亚有限整体变更为股份公司。同日，越亚有限全体股东签署《发起人协议》，同意以越亚有限 2012 年 4 月 30 日为基准日的经审计净资产折为 596,000,000 股，每股面值人民币 1 元，其余计入股份公司资本公积金，将珠海越亚有限整体变更为股份公司。

对于越亚有限本次整体变更行为，广东省对外贸易经济合作厅出具了《关于合资企业珠海越亚封装基板技术有限公司转制为外商投资股份有限公司的批复》（粤外经贸资字[2012]288 号），同意越亚有限整体变更改制为外商投资股份有限公司；北京大学出具了《北京大学关于同意珠海越亚封装基板技术有限公司整体

变更设立股份公司的批复》（校发[2012]78号），批准越亚有限整体变更为股份有限公司。

2012年6月26日，广东省人民政府向公司核发了《中华人民共和国外商投资企业批准证书》（批准号：商外资粤股份证字[2012]0008号），批准了公司上述经济行为。

2012年7月19日，利安达对上述注册资本的实收情况进行了验证，并出具了利安达验字[2012]第1041号《验资报告》。

2012年7月31日，公司就整体变更事宜在珠海市工商局履行了工商变更登记手续，并领取了注册号为440400400018926的《企业法人营业执照》。

（二）发起人

公司由其前身越亚有限整体变更设立，原越亚有限的股东即为公司的发起人，股份公司设立时各发起人持股情况如下：

序号	发起人名称	持股数量/股	持股比例（%）
1	北大方正信息产业集团有限公司	232,110,412	38.9447
2	AMITEC-Advance Multilayer Interconnect Technologies Ltd.	232,110,412	38.9447
3	东方富海（芜湖）股权投资基金（有限合伙）	46,505,880	7.8030
4	开铂银科（成都）创业投资企业	23,959,796	4.0201
5	皖江（芜湖）物流产业投资基金（有限合伙）	19,167,956	3.2161
6	上海开物投资合伙企业（有限合伙）	17,969,996	3.0151
7	宁波市科发股权投资基金合伙企业（有限合伙）	14,975,096	2.5126
8	东方富海（芜湖）二号股权投资基金（有限合伙）	9,200,452	1.5437
合计		596,000,000	100.0000

（三）发行人设立前后主要发起人拥有的主要资产和实际从事的主要业务

本公司主要发起人为方正信产、AMITEC公司及东方富海，于股份公司成立时分别持有公司38.9447%、38.9447%及7.8030%的股份。整体变更为股份公司时，方正信产持有的主要资产为对下属企业的投资；AMITEC公司除持有部分专利、珠海越亚及AMITEC香港公司的股权等资产外，不从事任何其他业务；东方富海为股权投资企业，主要业务为利用自有资金对外进行股权投资，其拥有的主要资产为货币资金及所投资企业的股权。

发行人改制设立前后，主要发起人的资产状况和实际从事的主要业务均未发生重大变化。

（四）发行人成立时拥有的资产和实际从事的主要业务

本公司系由越亚有限整体变更设立，承继了越亚有限的全部资产及业务。拥有的主要资产包括现金、应收账款、存货等流动资产，以及与生产经营相关的机器设备、运输设备、电子及办公设备等固定资产及无形资产。

发行人设立前后业务流程没有发生变化。具体业务流程详见本招股说明书“第五章 业务和技术”之“四、发行人的主营业务情况”之“（三）主要业务模式”。

（五）发行人成立以来在生产经营方面与主要发起人的关联关系及演变情况

发行人前身越亚有限设立时为中外合资经营企业，根据公司设立时签订的《合资经营合同》及其修正案，外方股东负责提供核心技术授权支持，中方股东负责提供经营所需的厂房、公用设施和资金支持。

在公司整体变更为股份公司前后，外方股东 AMITEC 公司通过出资方式将原对公司授权许可的专利技术组合转让给公司；中方股东关联方将公司生产所占用的土地和厂房等资产转让至公司名下。同时，部分园区设施及服务仍由中方股东关联方提供。发行人与主要发起人之间的具体关联交易情况详见“第六章 同业竞争与关联交易”之“三、关联交易事项”。

（六）发行人出资资产的产权变更

公司系依据《公司法》及有关法律法规的规定由越亚有限整体变更设立。公司承继了原有限公司所有的资产、负债及权益，资产权属及负债的变更均已履行了必要的法律手续。本公司已合法拥有商标、专利、专有技术、机器设备、土地、厂房等相关权利。

三、发行人独立运行情况

本公司成立以来，严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求规范运作，在资产、人员、财务、机构、业务等方面与现有股东独立，具有完整的业务经营体系和直接面向市场独立经营的能力。

（一）业务独立

发行人的主营业务为刚性有机 IC 无芯封装基板的研发、生产和销售，公司已建立了较为完整的职能部门架构，拥有独立的采购、生产、销售和研发系统，在业务上不存在与主要股东及其关联方的依赖关系，能够独立开展业务。发行人在主营业务方面与股东之间不存在竞争关系或显失公平的关联交易。

（二）资产完整

发行人系整体变更设立的股份有限公司，承继了原有限公司所有的资产、负债及权益。发行人合法拥有完整的、独立于股东及其他关联方的、用于 IC 无芯封装基板的研究、开发、生产、销售及技术服务所需的各项资产，包括土地、厂房、机器设备、商标、专利等资产，相关资产的权属均登记在公司名下。

（三）机构独立

发行人拥有独立的生产经营和办公场所，不存在与股东单位及其他关联方混合经营、合署办公的情形。公司依照《公司法》和《公司章程》设置了股东大会、董事会、监事会等决策监督机构，并制定了相应的议事规则，建立了完整、独立的法人治理结构，各机构均独立于股东，并依照《公司法》、《公司章程》等规定规范运行，在各自职责范围内独立决策。公司建立了符合自身经营特点、独立完整的组织结构，独立开展生产经营活动。

（四）人员独立

发行人拥有独立的人事、工资、福利制度及管理体系，拥有 IC 无芯封装基板研究、开发、生产、销售和技术服务等所需的管理、研究、开发、生产和销售等相关人员。

公司董事、监事及高级管理人员严格按照《公司法》、《公司章程》的有关规定产生。公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员均专职在公司工作并领取薪酬。公司的财务人员没有在公司主要股东及其控制的其他企业中兼职，不存在影响人员独立的情形。

（五）财务独立

公司设立后，已按照中华人民共和国《会计法》、《企业会计准则》的要求建立了一套独立、完整、规范的财务会计核算体系和财务管理制度，并实施严格的财务监督管理。公司设立了独立的财务部门，配备了专职财务人员；公司在银行单独开立账户，拥有独立的银行账号；公司作为独立的纳税人，依法独立纳税；公司独立做出财务决策，独立对外签订合同，不受股东或其他单位干预或控制。

截至本招股说明书签署日，本公司没有为股东提供担保或将以本公司名义的借款转借给股东使用，也不存在资产、资金被股东占用而损害公司利益的情况。

四、发行人设立以来的股本形成及变化和重大资产重组情况

（一）发行人前身越亚有限的股本形成过程

1. 越亚有限设立

发行人的前身系珠海越亚封装基板技术有限公司，由珠海多层与以色列 AMITEC 公司以货币方式共同出资设立，注册资金 200 万美元。珠海多层于越亚有限成立之时，为方正科技（股票代码为 600601.SH）的控股子公司，方正科技为北京大学控制的公司。

2006 年 4 月 18 日，珠海市香洲区对外贸易经济合作局向越亚有限下发了《关于合资经营珠海越亚封装基板技术有限公司合同书及公司章程的批复》（珠香贸外资字[2006]022 号），同意珠海多层和 AMITEC 公司合资设立越亚有限。

2006 年 4 月 19 日，珠海市人民政府向越亚有限核发了《中华人民共和国外商投资企业批准证书》（商外资粤珠合资证字[2006]0024 号），批准珠海多层和 AMITEC 公司合资设立越亚有限。

2006 年 4 月 26 日，越亚有限在珠海市工商局完成注册登记，取得注册号为企合粤珠总字第 007506 号的《企业法人营业执照》，注册资本为 200 万美元，企业类型为中外合资企业，法定代表人为方中华，住所为珠海市香洲区前山白石路 107 号六层厂房六楼，经营范围为研发、生产和销售自产的封装基板。

越亚有限设立时，各股东出资情况如下：

序号	股东名称	出资额（万美元）	出资比例（%）	出资方式
1	珠海多层	100.00	50.00	货币
2	AMITEC	100.00	50.00	货币
合计		200.00	100.00	

珠海岳华安地联合会计师事务所分别于 2006 年 5 月 15 日和 2006 年 5 月 25 日出具了岳华安地验字第（2006-02-0032）号《验资报告》和岳华安地验字第（2006-02-0035）号《验资报告》，验证上述股东出资缴足。

2006 年 12 月 18 日，越亚有限取得了换发的营业执照，公司注册资本 200 万美元，实收资本 200 万美元。

2. 越亚有限第一次增资及第一次出资转让

2007 年 1 月 18 日，经越亚有限董事会决议，公司注册资本由 200 万美元增至 1,100 万美元，投资总额由 285 万美元增至 2,535 万美元，此次新增注册资本由

中外双方股东各按 50.00%比例以现金认缴，其中珠海多层增资 450 万美元，AMITEC 公司增资 450 万美元。此次增资分三期进行，其中第一期出资 225 万美元，第二期出资 300 万美元，第三期出资 375 万美元。

2007 年 2 月 2 日，珠海市对外贸易经济合作局向越亚有限下发了《关于合营企业珠海越亚封装基板技术有限公司重新修订合同、章程的批复》（珠外经贸资[2007]83 号），同意上述变更。

2007 年 2 月 2 日，珠海市人民政府向越亚有限核发了《中华人民共和国外商投资企业批准证书》（商外资粤珠合资证字[2006]0024 号），批准上述增资。

2007 年 2 月 9 日，珠海市工商局就此次变更事宜向越亚有限换发了《企业法人营业执照》（注册号：企合粤珠总字第 007506 号），注册资本 1100 万美元，实收资本 200 万美元。

此次变更完成后，越亚有限的股东、出资额、出资比例及实收资本如下：

序号	股东名称	认缴出资		实缴出资	
		金额（万美元）	比例（%）	金额（万美元）	比例（%）
1	珠海多层	550	50.00	100	9.0909
2	AMITEC 公司	550	50.00	100	9.0909
合计		1,100	100.00	200	18.1818

（1）2007 年 3 月第一期出资

2007 年 3 月，珠海多层以人民币折合 112.50 万美元缴纳出资，AMITEC 公司以 112.50 万美元缴纳出资，上述出资全部计入公司实收资本。

珠海和通泰会计师事务所对珠海多层和 AMITEC 公司的本次出资进行审验，并于 2007 年 3 月 12 日出具了和通泰验字第（2007-02-0004）号《验资报告》，验证截至 2007 年 3 月 12 日公司累计实缴注册资本 425 万美元，占已登记注册资本总额的 38.6364%。

2007 年 3 月 26 日，珠海市工商局就此次变更事宜向越亚有限换发了《企业法人营业执照》（注册号：企合粤珠总字第 007506 号）。

本次出资完成后，越亚有限的股东、注册资本、实收资本及出资比例情况如下：

序号	股东名称	认缴出资		实缴出资	
		金额（万美元）	比例（%）	金额（万美元）	比例（%）
1	珠海多层	550	50.00	212.50	19.3182
2	AMITEC 公司	550	50.00	212.50	19.3182

序号	股东名称	认缴出资		实缴出资	
		金额（万美元）	比例（%）	金额（万美元）	比例（%）
	合计	1,100	100.00	425.00	38.6364

（2）2008 年 6 月第二期出资

2008 年 6 月，珠海多层以人民币折合 150 万美元缴纳出资，AMITEC 公司以 150 万美元缴纳出资，上述出资全部计入公司实收资本。

珠海和通泰会计师事务所对珠海多层和 AMITEC 公司的本次出资进行审验，并于 2008 年 6 月 3 日出具了和通泰验字第（2008-02-0016）号《验资报告》，验证截至 2008 年 6 月 2 日公司累计实缴注册资本 725 万美元，占已登记注册资本总额的 65.9091%。

2008 年 6 月 23 日，珠海市工商局就此次变更事宜向越亚有限换发了《企业法人营业执照》（注册号：440400400018926）。本次出资完成后，越亚有限的股东、注册资本、实收资本及出资比例情况如下：

序号	股东名称	认缴出资		实缴出资	
		金额（万美元）	比例（%）	金额（万美元）	比例（%）
1	珠海多层	550	50.00	362.50	32.9545
2	AMITEC 公司	550	50.00	362.50	32.9545
	合计	1,100	100.00	725.00	65.9091

（3）2008 年 11 月，第一次出资转让

2008 年 9 月 22 日，经越亚有限董事会决议，同意珠海多层将其所持有越亚有限 50.00% 的出资（包括 17.05% 的注册资金认缴权）以 1,543 万元的价格转让给深圳数码。深圳数码与珠海多层同为北京大学控制的企业。同日，珠海多层、深圳数码签订了《珠海越亚封装基板技术有限公司注册资本金认缴权及股权转让协议书》。

2008 年 10 月 30 日，越亚有限取得珠海市对外贸易经济合作局《关于合资企业珠海越亚封装基板技术有限公司补充合同之二及章程修改之二的批复》（珠外经贸资[2008]955 号），同意上述出资转让。

2008 年 11 月 3 日，珠海市人民政府对越亚有限核发了《中华人民共和国外商投资企业批准证书》（商外资粤珠合资证字[2006]0024 号），批准了前述出资转让。

2008 年 11 月 26 日，越亚有限取得珠海市工商局就此次出资转让向越亚有限换发的《企业法人营业执照》（注册号 440400400018926）。

本次转让完成后，越亚有限的股东、注册资本、实收资本及出资比例情况如下：

序号	股东名称	认缴出资		实缴出资	
		金额（万美元）	比例（%）	金额（万美元）	比例（%）
1	深圳数码	550	50.00	362.50	32.9545
2	AMITEC 公司	550	50.00	362.50	32.9545
合计		1,100.00	100.00	725.00	65.9091

（4）2009 年 12 月第三期出资

2009 年 12 月，深圳数码以人民币折合 187.50 万美元缴纳出资，AMITEC 公司以 187.50 万美元缴纳出资，上述出资全部计入公司实收资本。

珠海和通泰会计师事务所对深圳数码和 AMITEC 公司的本次出资进行审验，并于 2009 年 12 月 24 日出具了和通泰验字第（2009-02-0038）号《验资报告》，验证了截至 2009 年 12 月 23 日珠海越亚注册资本为 1,100 万美元，累计实收资本为 1,100 万美元，占已登记注册资本总额的 100.00%。

2009 年 12 月 29 日，珠海市工商局就此次变更事宜向越亚有限换发了《企业法人营业执照》（注册号：440400400018926）。

本次出资完成后，越亚有限的股东、注册资本、实收资本及出资比例情况如下：

序号	股东名称	认缴出资		实缴出资	
		金额（万美元）	比例（%）	金额（万美元）	比例（%）
1	深圳数码	550	50.00	550	50.00
2	AMITEC 公司	550	50.00	550	50.00
合计		1,100	100.00	1,100	100.00

3. 第二次增资，公司注册资本增至 4,100 万美元

2010 年 11 月 29 日，经公司董事会决议，越亚有限注册资本由 1,100 万美元增至 4,100 万美元，投资总额由 2,535 万美元增至 6,535 万美元，深圳数码和 AMITEC 公司各认缴新增注册资本 1,500 万美元。

2010 年 12 月 1 日，珠海市科技工贸和信息化局向越亚有限下发了《关于合资企业珠海越亚封装基板技术有限公司补充合同之三及章程修改之三的批复》（珠科工贸信资[2010]988 号），同意上述增资。

同日，珠海市人民政府向越亚有限核发了《中华人民共和国外商投资企业批准证书》（商外资粤珠合资证字[2006]0024 号），批准上述增资。

(1) 2010 年 12 月第一期出资

2010 年 12 月，深圳数码以人民币折合 500 万美元缴纳出资，AMITEC 公司以 500 万美元缴纳出资，上述出资全部计入公司实收资本。

2010 年 12 月 20 日珠海和通泰会计师事务所出具和通泰验字第(2010-02-0036)号《验资报告》对深圳数码和 AMITEC 公司本次出资进行了验证，验证截至 2010 年 12 月 17 日，越亚有限已收到股东以货币缴纳的新增注册资本合计 1,000 万美元；越亚有限累计实缴注册资本 2,100 万美元，占已登记注册资本总额的 51.2195%。

2010 年 12 月 28 日，珠海市工商局就此次变更事宜向越亚有限换发了《企业法人营业执照》（注册号：440400400018926）。

本次出资完成后，越亚有限的股东、注册资本、实收资本及出资比例情况如下：

序号	股东名称	认缴出资		实缴出资	
		金额（万美元）	比例（%）	金额（万美元）	比例（%）
1	深圳数码	2,050	50.00	1,050	25.6098
2	AMITEC 公司	2,050	50.00	1,050	25.6098
合计		4,100	100.00	2,100	51.2195

(2) 2011 年 4 月第二期出资

2011 年 4 月，AMITEC 公司以 699.9962 万美元缴纳出资，全部计入公司实收资本。珠海和通泰会计师事务所对新增注册资本缴纳情况进行了审验，并于 2011 年 4 月 15 日出具了和通泰验字第（2011-02-0012）号《验资报告》。

2011 年 4 月 25 日，珠海市工商局就此次变更事宜向越亚有限换发了《企业法人营业执照》（注册号：440400400018926）。

本次出资完成后，越亚有限的股东、注册资本、实收资本及出资比例情况如下：

序号	股东名称	认缴出资		实缴出资	
		金额（万美元）	比例（%）	金额（万美元）	比例（%）
1	深圳数码	2,050	50.00	1,050	25.6098
2	AMITEC 公司	2,050	50.00	1,749.9962	42.6828
合计		4,100	100.00	2,799.9962	68.2926%

(3) 2011 年 5 月第三期出资

2011年5月，深圳数码以人民币折合1,000万美元缴纳出资，全部计入实收资本。珠海和通泰会计师事务所对新增注册资本缴纳情况进行了审验，并于2011年4月29日出具了《验资报告》（和通泰验字2011-02-0013号），验证出资到位。

2011年5月11日，珠海市工商局就此次变更事宜向越亚有限换发了《企业法人营业执照》（注册号：440400400018926）。本次出资完成后，越亚有限的股东、注册资本、实收资本及出资比例情况如下：

序号	股东名称	认缴出资		实缴出资	
		金额（万美元）	比例（%）	金额（万美元）	比例（%）
1	深圳数码	2,050	50.00	2,050	50.00
2	AMITEC 公司	2,050	50.00	1,749.9962	42.6828
合计		4,100	100.00	3,799.9962	92.6828

（4）2011年7月第四期出资

AMITEC 公司以 300.0038 万美元缴纳对公司的出资，全部计入实收资本。珠海国睿衡赋会计师事务所有限公司对新增注册资本缴纳情况进行了审验，并于2011年7月20日出具了《验资报告》（珠海国赋外验字（2011）Y020号）验证截至2011年7月8日，越亚有限已收到股东 AMITEC 公司以货币缴纳的新增注册资本 300.0038 万美元；越亚有限累计实缴注册资本 4,100 万美元。

2011年7月28日，珠海市工商局就本次增资事宜连同第三次增资第一期出资，向公司换发了《企业法人营业执照》（注册号 440400400018926）。

4. 第三次增资，公司注册资本增至 7,100 万美元

2011年7月8日，越亚有限董事会作出决议，同意将越亚有限投资总额增加至 11,000 万美元，注册资本增加至 7,100 万美元，其中深圳数码以现金形式认缴 1,500 万美元，AMITEC 公司以其持有的无形资产（即“设计、制造、测试以顺序叠加的介质层、线路层、铜柱层以及可移除载板层的内部互连等特征形成的无芯封装基板结构的技术”）形式认缴 1,500 万美元。

2011年7月11日，越亚有限与 AMITEC 公司就此签署了《无形资产转让协议》，并界定了用以出资的无形资产范围。

2011年7月19日，珠海市科技工贸和信息化局向越亚有限下发了《关于合资企业珠海越亚封装基板技术有限公司补充合同之四及章程修改之四的批复》（珠科工贸信资[2011]528号），同意上述增资。

2011年7月20日，珠海市人民政府向越亚有限核发了《中华人民共和国外商投资企业批准证书》（商外资粤珠合资证字[2006]0024号），批准了上述增资。

对于越亚有限的第三次增资，各股东实缴出资的具体情况如下：

（1）2011年7月第一期出资

2011年7月，深圳数码以人民币折合1,500万美元，缴纳对公司的出资，全部计入公司实收资本。

2011年7月21日，珠海和通泰会计师事务所出具《验资报告》（和通泰验字2011-02-0021号），确认截至2011年7月19日，越亚有限已收到股东深圳数码以货币缴纳的新增注册资本1,500万美元，越亚有限累计实缴注册资本5,600万美元，占已登记注册资本总额的78.8732%。

2011年7月28日，珠海市工商局就公司第三次增资第一期出资事宜连同越亚有限第二次增资第四期出资事宜，向越亚有限换发了《企业法人营业执照》（注册号440400400018926）。

截至2011年7月28日，越亚有限的股东、注册资本、实收资本和出资比例情况如下：

序号	股东名称	认缴出资		实缴出资	
		金额（万美元）	比例（%）	金额（万美元）	比例（%）
1	深圳数码	3,550	50.00	3,550	50.00
2	AMITEC 公司	3,550	50.00	2,050	28.8732
合计		7,100	100.00	5,600	78.8732

（2）2011年12月第二期出资

广东中广信资产评估有限公司对AMITEC公司拟用于本次增资的技术组合采用收益法进行了评估，并于2011年7月10日出具了中广信评报字[2011]第304号《资产评估报告书》，经评估，该技术组合至评估基准日2011年5月31日市场价值为10,035.35万元。

截至评估基准日，AMITEC公司已就该技术组合以不同的名称分别在中国、美国、以色列、日本、韩国和中国台湾等六个国家或地区申请专利保护共13项。包括7项已获授权的专利和6项专利申请，如下表所示：

序号	名称	专利/专利申请号	专利/专利申请所有权转移至越亚时间
1	Integrated Circuit Support Structure and their Fabrication 集成电路支撑结构及其制作方法	US7635641	2011/8/4

序号	名称	专利/专利申请号	专利/专利申请 所有权转移至 越亚时间
2	Novel Integrated Support Structure and the Fabrication thereof 新型集成电路支撑结构及其制作方法	KR 10-2008-7010687 KR 10-0983320	2011/8/26
3	Novel Integrated Support Structure and the Fabrication thereof 新型集成电路支撑结构及其制作方法	CN11496227A ZL200680046501.7	2011/8/10
4	Novel Integrated Support Structure and the Fabrication thereof 新型集成电路支撑结构及其制作方法	IL171378	2011/10/11
5	Advanced Multilayer Coreless Support Structures and Method for their Fabrication 新型多层无芯支撑结构及其制作方法	US7682972	2011/8/4
6	Advanced Multilayer Coreless Support Structures and their Fabrication 新型多层无芯支撑结构及其制作方法	KR 10-2007-0021036 KR 10-0915145	2011/8/26
7	Advanced Multilayered Coreless Support Structures and their Fabrication Method 新型多层无芯支撑结构及其制作方法	CN200710105226.8 ZL200710105226.8	2011/8/8
8	Coreless Cavity Substrates for Chip Packaging and their Fabrication 芯片封装用无芯空腔基板的制造	US7669320	2011/8/4
9	Novel Integrated Support Structure and the Fabrication thereof 新型集成电路支撑结构及其制作方法	JP2008-535188	2011/8/13
10	Advanced Multilayer Coreless Support Structures and their Fabrication 新型多层无芯支撑结构及其制作方法	JP2007-050798	2011/8/13
11	Advanced Coreless support structures and their fabrication 新型多层无芯支撑结构的制作方法	TW096120277	2011/12/16
12	Coreless Cavity Substrates for Chip Packaging and their Fabrication 芯片封装用无芯空腔基板的制造	IL175011	2011/10/11
13	Coreless Cavity Substrates for Chip Packaging and their Fabrication 芯片封装用无芯空腔基板的制造	IL213301	2011/10/11

2011年7月11日，越亚有限就本次出资事宜，与AMITEC公司签订《无形资产转让协议》，确定了AMITEC公司和越亚有限之间就作为AMITEC公司对其认购的越亚有限增资而拟由AMITEC公司转让给越亚有限的无形资产的权利和义务。上述技术资产组合中包含的授权专利及专利申请均已于2011年12月16日前完成了由AMITEC公司过户给珠海越亚的变更手续，各国或地区专利局均颁发了变更通知书。

2011年12月20日，珠海和通泰会计师事务所出具《验资报告》（和通泰验字2011-02-0042号），验证截至2011年12月20日，越亚有限已收到股东AMITEC公司以无形资产缴纳的新增注册资本1,500万美元，越亚有限累计实缴注册资本

7,100 万美元，占已登记注册资本总额的 100.00%；其中货币出资 5,600 万美元，占注册资本总额的 78.8732%。

2011 年 12 月 23 日，珠海市工商局就此次变更事宜向越亚有限换发了《企业法人营业执照》（注册号：440400400018926）。

本次变更完成后，越亚有限的股东、注册资本、实收资本及持股比例情况如下：

序号	股东名称	认缴出资		实缴出资	
		金额（万美元）	比例（%）	金额（万美元）	比例（%）
1	深圳数码	3,550	50.00	3,550	50.00
2	AMITEC 公司	3,550	50.00	3,550	50.00
合计		7,100	100.00	7,100	100.00

5. 第四次增资，注册资本增至 8,474.1935 万美元

为了满足公司快速发展的需求，进一步扩大公司的资产规模同时完善法人治理结构，越亚有限拟引入财务投资者东方富海、东方富海二号、皖江物流及上海开物作为公司新股东。公司就增资事宜，委托北京龙源智博资产评估有限责任公司以 2011 年 11 月 30 日为评估基准日，对越亚有限全部权益进行评估。

2011 年 12 月 18 日，北京龙源智博资产评估有限责任公司出具了《珠海越亚封装基板技术有限公司拟增资扩股而涉及的该公司股东全部权益价值项目评估报告书》（龙源智博评报字（2011）第 B-126 号），经评估，截至评估基准日，越亚有限股东全部权益（净资产）的市场价值为 37,513.91 万元。

2012 年 1 月 5 日，经公司董事会决议，公司注册资本增加由 7,100 万美元至 8,474.1935 万美元。其中，东方富海以人民币折合 1,452.8 万美元溢价认缴 665.4761 万美元出资额，占增资后注册资本的 7.8530%；东方富海二号以人民币折合 307.20 万美元溢价认缴 140.7174 万美元出资额，占本次增资后公司注册资本的 1.6605%；皖江物流以人民币折合 640 万美元溢价认缴 293.1613 万美元出资额，占本次增资后公司注册资本的 3.4595%；上海开物以人民币折合 600 万美元溢价认缴 274.8387 万美元出资额，占本次增资后公司注册资本的 3.2432%。

2012 年 1 月 5 日，越亚有限与 AMITEC 公司、深圳数码、东方富海、东方富海二号、皖江物流及上海开物就增资事宜签署了《珠海越亚封装基板技术有限公司增资协议》。

2012年1月9日，珠海市科技工贸和信息化局下发了《关于合资企业珠海越亚封装基板技术有限公司重新修订合同及章程的批复》（珠科工贸信资[2012]7号），同意上述增资。

同日，珠海市人民政府核发了《中华人民共和国外商投资企业批准证书》（商外资粤珠合资证字[2006]0024号），批准了上述增资。

2012年1月11日，珠海和通泰会计师事务所出具《验资报告》（和通泰验字第2012-02-0001号），验证出资到位。

2012年1月19日，珠海市工商局就此次变更事宜向越亚有限换发了《企业法人营业执照》（注册号：440400400018926）。

本次增资完成后，公司的股东、注册资本、实收资本及持股比例情况如下：

序号	股东名称	认缴出资		实缴出资	
		金额（万美元）	比例（%）	金额（万美元）	比例（%）
1	深圳数码	3,550	41.8919	3,550	41.8919
2	AMITEC 公司	3,550	41.8919	3,550	41.8919
3	东方富海	665.4761	7.8530	665.4761	7.8530
4	皖江物流	293.1613	3.4595	293.1613	3.4595
5	上海开物	274.8387	3.2432	274.8387	3.2432
6	东方富海二号	140.7174	1.6605	140.7174	1.6605
合计		8,474.1935	100.00	8,474.1935	100.00

6. 第二次股权转让与第五次增资，注册资本增加至 9,115.4839 万美元

为了进一步增加公司注册资本金，并调整公司股权，公司决定第二次股权转让并再一次引入财务投资者。龙源智博于2012年3月12日出具了《深圳市北大方正数码科技有限公司拟转让持有的珠海越亚封装基板技术有限公司股权而涉及的该公司股东全部权益价值项目评估报告书》（龙源智博评报字（2012）第1006号），确认以2012年2月29日为评估基准日，越亚有限股东全部权益（净资产）的市场价值为68,274.12万元。

2012年3月19日，越亚有限董事会作出决议同意越亚有限注册资本增加至9,115.4839万美元，其中原股东东方富海以人民币折合100.00万美元溢价认缴45.8065万美元出资额，越亚有限新引入股东开铂银科以人民币折合800万美元溢价认缴366.4516万美元出资额；越亚有限新引入股东宁波科发以人民币折合500万美元溢价认缴229.0323万美元出资额；同意深圳数码将其持有的越亚有限

41.8919%的出资以 28,425.43 万元的价格转让给方正信产，方正信产与深圳数码同为北京大学控制的企业。

2012 年 3 月 19 日，越亚有限与 AMITEC 公司、深圳数码、东方富海、东方富海二号、皖江物流、上海开物、开铂银科和宁波科发就此次增资事宜签署了《珠海越亚封装基板技术有限公司增资协议》。同日，深圳数码与方正信产就该次出资转让事宜签署了《股权转让协议》。

2012 年 3 月 29 日，珠海市科技工贸和信息化局向越亚有限下发了《关于合资企业珠海越亚封装基板技术有限公司重新修订合同及章程的批复》（珠科工贸信资[2012]160 号），同意上述增资及出资转让事宜。

同日，珠海市人民政府核发了《中华人民共和国外商投资企业批准证书》（商外资粤珠合资证字[2006]0024 号），批准了上述增资及出资转让事宜。

2012 年 4 月 18 日，利安达珠海分所出具了利安达验字[2012]第 B-2007 号《验资报告》，验证截至 2012 年 4 月 13 日，越亚有限收到股东以货币缴纳的新增注册资本合计 641.2904 万美元，越亚有限累计实缴注册资本 9,115.4839 万美元。

2012 年 4 月 20 日，珠海市工商局就此次变更事宜向越亚有限换发了《企业法人营业执照》（注册号：440400400018926）。

本次出资转让及增资完成后，越亚有限的股东、注册资本、实收资本及出资比例情况如下：

序号	股东名称	认缴出资		实缴出资	
		金额（万美元）	比例（%）	金额（万美元）	比例（%）
1	方正信产	3,550	38.9447	3,550	38.9447
2	AMITEC 公司	3,550	38.9447	3,550	38.9447
3	东方富海	711.2826	7.8030	711.2826	7.8030
4	开铂银科	366.4516	4.0201	366.4516	4.0201
5	皖江物流	293.1613	3.2161	293.1613	3.2161
6	上海开物	274.8387	3.0151	274.8387	3.0151
7	宁波科发	229.0323	2.5126	229.0323	2.5126
8	东方富海二号	140.7174	1.5437	140.7174	1.5437
合计		9,115.4839	100.00	9,115.4839	100.00

7. 有权机关对过往经济行为的确认

2012 年 7 月 16 日，北京大学出具《北京大学关于确认珠海越亚封装基板有限公司过往经济行为的批复》（校发[2012]77 号），确认越亚有限上述设立、增

资、转让股权等过往经济行为的决策和批准程序合法有效，该等经济行为中不存在国有资产流失等损害国有资产及损害国有上市公司利益的情形。

根据《国务院办公厅关于北京大学清华大学规范校办企业管理体制试点问题的通知》（国办函[2001]58号），北京大学依据有关法规，对经营性国有资产具有占有、使用、一定的处置和收益分配的权利；北京大学对所管理的国有资产承担资产保值责任，并对经营性国有资产行使出资人权力。

（二）股份公司设立及股本变化

1. 股份公司设立

2012年5月15日，越亚有限董事会通过决议，同意以公司截至2012年4月30日经审计的净资产折股，整体变更为股份有限公司；同日，有限公司的全体股东作为拟整体变更设立的股份有限公司发起人，共同签署《发起人协议》，以2012年4月30日经审计的净资产折合成股份总额59,600万股，整体变更设立股份有限公司。

广东中广信资产评估有限公司对公司股东全部权益价值进行了评估，于2012年5月15日出具了中广信珠评报字[2012]第012号《评估报告书》，经评估，截至评估基准日2012年4月30日，越亚有限股东全部权益价值的评估价值为77,449.89万元。该评估结果在教育部进行了备案。

北京大学于2012年7月16日出具了《北京大学关于同意珠海越亚封装基板技术有限公司整体变更设立股份公司的批复》（校发[2012]78号），同意公司上述整体变更事宜。

2012年7月19日，利安达出具了利安达验字[2012]第1041号《验资报告》，对越亚有限整体变更为股份公司的注册资本变更及实收情况进行审验。

2012年7月31日，公司取得了珠海市工商行政管理局颁发的《企业法人营业执照》（注册号为440400400018926）。整体变更为股份公司后，发行人总股本59,600万股，各股东持股比例保持不变，具体情况如下：

序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例（%）
1	方正信产	232,110,412	38.9447
2	AMITEC 公司	232,110,412	38.9447
3	东方富海	46,505,880	7.8030
4	开铂银科	23,959,796	4.0201
5	皖江物流	19,167,956	3.2161
6	上海开物	17,969,996	3.0151
7	宁波科发	14,975,096	2.5126

8	东方富海二号	9,200,452	1.5437
合计		596,000,000	100.00

2. 股份公司增资

为增强发行人团队稳定性，提高员工工作积极性，发行人通过增资入股方式引入员工持股企业香港睿祺、珠海睿祺、珠海睿鑫。

广东中广信资产评估有限公司对发行人股东全部权益价值进行评估，于2012年8月17日出具了中广信珠评报字[2012]第018号《关于珠海越亚封装基板技术股份有限公司拟进行增资所涉及该公司股东全部权益价值项目资产评估报告》，经评估，截至评估基准日2012年7月31日，公司股东全部权益价值为79,309.57万元。该评估结果在教育部进行了备案。

2012年8月24日，公司股东大会决议通过，股本总额增加至60,512.4067万股，其中，香港睿祺以人民币556.1525万元认购公司新增注册资本418.1598万股；珠海睿祺以人民币315.8150万元认购公司新增注册资本237.4549万股；珠海睿鑫以人民币341.5334万元认购公司新增注册资本256.7920万股，增资价格为1.33元/股；出资额与新增股本之间的差额计入公司资本公积。

2012年9月12日，北京大学出具了《北京大学关于同意北大方正集团有限公司下属珠海越亚封装基板技术股份有限公司增资扩股的批复》（校发[2012]100号），同意公司上述增资扩股事宜。

2012年9月17日，广东省对外贸易经济合作厅出具的《广东省外经贸厅关于外商投资股份制企业珠海越亚封装基板技术股份有限公司增资扩股的批复》（粤外经贸资字[2012]462号），同意公司上述增资扩股事宜。

2012年9月18日，广东省人民政府核发的《中华人民共和国外商投资企业批准证书》（批准号：商外资粤股份证字[2012]0008号），批准公司上述增资扩股事宜。

2012年9月25日，利安达珠海分所出具《验资报告》（利安达验字[2012]第B-2013号），验证截至2012年9月25日，公司收到股东以货币缴纳的新增注册资本合计912.4067万元，公司变更后累计实缴注册资本及股本为60,512.4067万元。

2012年9月28日，珠海市工商局就此次变更事宜向发行人换发了《企业法人营业执照》（注册号：440400400018926）。

本次增资完成后，公司股东、股本及持股比例等情况如下：

序号	股东	持股数量（股）	持股比例（%）
1	方正信产	232,110,412	38.3575
2	AMITEC 公司	232,110,412	38.3575
3	东方富海	46,505,880	7.6853
4	开铂银科	23,959,796	3.9595
5	皖江物流	19,167,956	3.1676
6	上海开物	17,969,996	2.9696
7	宁波科发	14,975,096	2.4747
8	东方富海二号	9,200,452	1.5204
9	香港睿祺	4,181,598	0.6910
10	珠海睿鑫	2,567,920	0.4244
11	珠海睿祺	2,374,549	0.3924
合计		605,124,067	100.00

（三）发行人重大资产重组

报告期内，本公司未发生重大资产重组情况。

五、发行人历次验资情况

（一）越亚有限设立时注册资本验资情况

2006 年 5 月 15 日，珠海多层出资 100 万美元，珠海岳华安地联合会计师事务所对本次出资进行了审验，并出具岳华安地验字第（2006-02-0032）号《验资报告》。2006 年 5 月 23 日，AMITEC 公司出资 100 万美元，由珠海岳华安地联合会计师事务所进行审验，并于 2006 年 5 月 25 日出具岳华安地验字第（2006-02-0035）号《验资报告》。截至 2006 年 5 月 23 日，越亚有限已收到全体股东缴纳的注册资本合计 200 万美元。

（二）越亚有限第一次增资时的验资情况

1. 第一期出资

2007 年 3 月 12 日，珠海和通泰会计师事务所出具《验资报告》（和通泰验字 2007-02-0004 号），验证截至 2007 年 3 月 12 日，越亚有限已收到股东以货币缴纳的新增注册资本合计 225 万美元，公司累计实缴注册资本 425 万美元，占已登记注册资本总额的 38.6364%。

2. 第二期出资

2008 年 6 月 3 日，珠海和通泰会计师事务所出具《验资报告》（和通泰验字 2008-02-0016 号），验证截至 2008 年 6 月 2 日，越亚有限已收到股东以货币缴纳

的新增注册资本合计 300 万美元，公司累计实缴注册资本 725 万美元，占已登记注册资本总额的 65.9091%。

3. 第三期出资

2009 年 12 月 24 日，珠海和通泰会计师事务所出具《验资报告》（和通泰验字 2009-02-0038 号），验证截至 2009 年 12 月 23 日，越亚有限已收到股东以货币缴纳的新增注册资本 375 万美元，越亚有限累计实缴注册资本 1,100 万美元，占已登记注册资本总额的 100.00%。至此，越亚有限第一次增资的注册资本已全部缴足。

（三）越亚有限第二次增资时的验资情况

1. 第一期出资

2010 年 12 月 20 日，珠海和通泰会计师事务所出具《验资报告》（和通泰验字 2010-02-0036 号），验证截至 2010 年 12 月 17 日，越亚有限已收到股东以货币缴纳的新增注册资本合计 1,000 万美元；越亚有限累计实缴注册资本 2,100 万美元，占已登记注册资本总额的 51.2195%。

2. 第二期出资

2011 年 4 月 15 日，珠海和通泰会计师事务所出具《验资报告》（和通泰验字 2011-02-0012 号），验证截至 2011 年 4 月 11 日，越亚有限已收到股东以货币缴纳的新增注册资本 699.9962 万美元，越亚有限累计实缴注册资本 2,799.9962 万美元，占已登记注册资本总额的 68.2926%。

3. 第三期出资

2011 年 4 月 29 日，珠海和通泰会计师事务所出具《验资报告》（和通泰验字 2011-02-0013 号），验证截至 2011 年 4 月 28 日，越亚有限已收到股东以货币缴纳的新增注册资本 1,000 万美元，越亚有限累计实缴注册资本 3,799.9962 万美元，占已登记注册资本总额的 92.6828%。

4. 第四期出资

2011 年 7 月 20 日，珠海国睿衡赋会计师事务所有限公司出具《验资报告》（珠海国赋外验字（2011）Y020 号），验证截至 2011 年 7 月 8 日，越亚有限已收到股东 AMITEC 公司以货币缴纳的新增注册资本 300.0038 万美元；越亚有限累计实缴注册资本 4,100 万美元，占已登记注册资本总额的 100.00%。至此，越亚有限第二次增资的注册资本已全部缴足。

（四）越亚有限第三次增资时的验资情况

1. 第一期出资

2011年7月21日，珠海和通泰会计师事务所出具《验资报告》（和通泰验字2011-02-0021号），确认截至2011年7月19日，越亚有限已收到股东深圳数码以货币缴纳的新增注册资本1,500万美元，越亚有限累计实缴注册资本5,600万美元，占已登记注册资本总额的78.8732%。

2. 第二期出资

2011年12月20日，珠海和通泰会计师事务所出具《验资报告》（和通泰验字2011-02-0042号），验证截至2011年12月20日，越亚有限已收到股东AMITEC公司以无形资产缴纳的新增注册资本1,500万美元，越亚有限累计实缴注册资本7,100万美元，占已登记注册资本总额的100.00%；其中货币出资5,600万美元，占注册资本总额的78.8732%。

（五）越亚有限第四次增资时的验资情况

2012年1月11日，珠海和通泰会计师事务所出具《验资报告》（和通泰验字第2012-02-0001号），验证截至2012年1月11日，越亚有限已收到股东以货币缴纳的新增注册资本合计1,374.1935万美元，越亚有限累计实缴注册资本8,474.1935万美元。

（六）越亚有限第五次增资时的验资情况

2012年4月18日，利安达珠海分所出具《验资报告》（利安达验字[2012]第B-2007号），验证截至2012年4月13日，越亚有限收到股东以货币缴纳的新增注册资本合计641.2904万美元，越亚有限累计实缴注册资本9,115.4839万美元。

（七）股份公司设立时的验资情况

2012年7月19日，利安达对越亚有限整体变更为股份公司的注册资本变更及实收情况进行审验，并出具了利安达验字[2012]第1041号《验资报告》，确认公司已将截至2012年4月30日经审计的净资产人民币77,233.8652万元折合股份59,600万股，其中人民币59,600万元作为注册资本，其余部分作为资本公积（股本溢价），每股面值人民币壹元。

（八）股份公司设立后的验资情况

2012年9月25日，经利安达珠海分所出具的利安达验字[2012]第B-2013号《验资报告》审验，截至2012年9月25日，公司已收到香港睿祺以货币资金缴纳的注册资本418.1598万元人民币、珠海睿祺以货币资金缴纳的注册资本237.4549

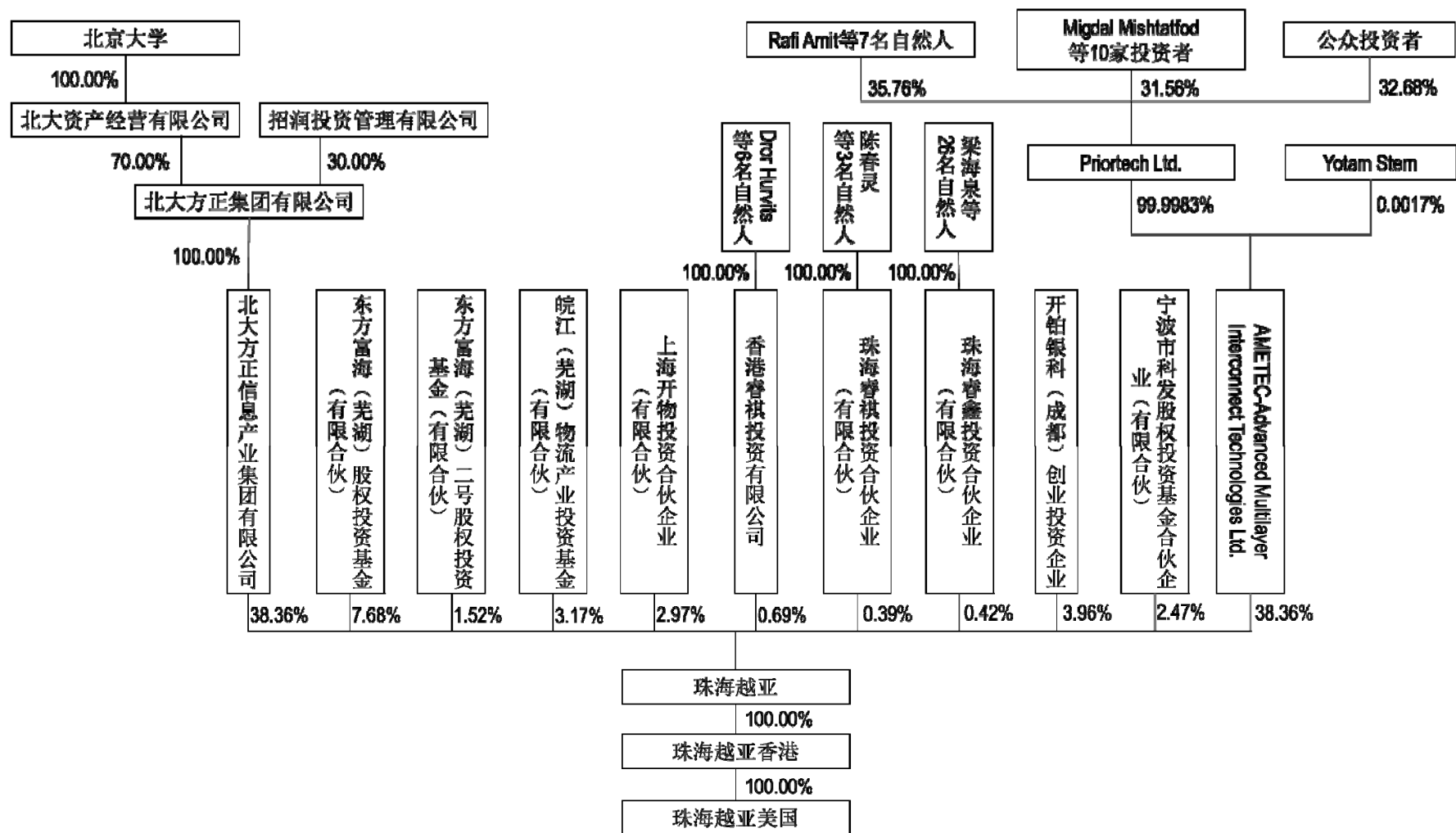
万元人民币、珠海睿鑫以货币缴纳注册资本 256.7920 万元人民币。珠海越亚累计实收资本 60,521.4067 万元人民币。

（九）验资复核的情况

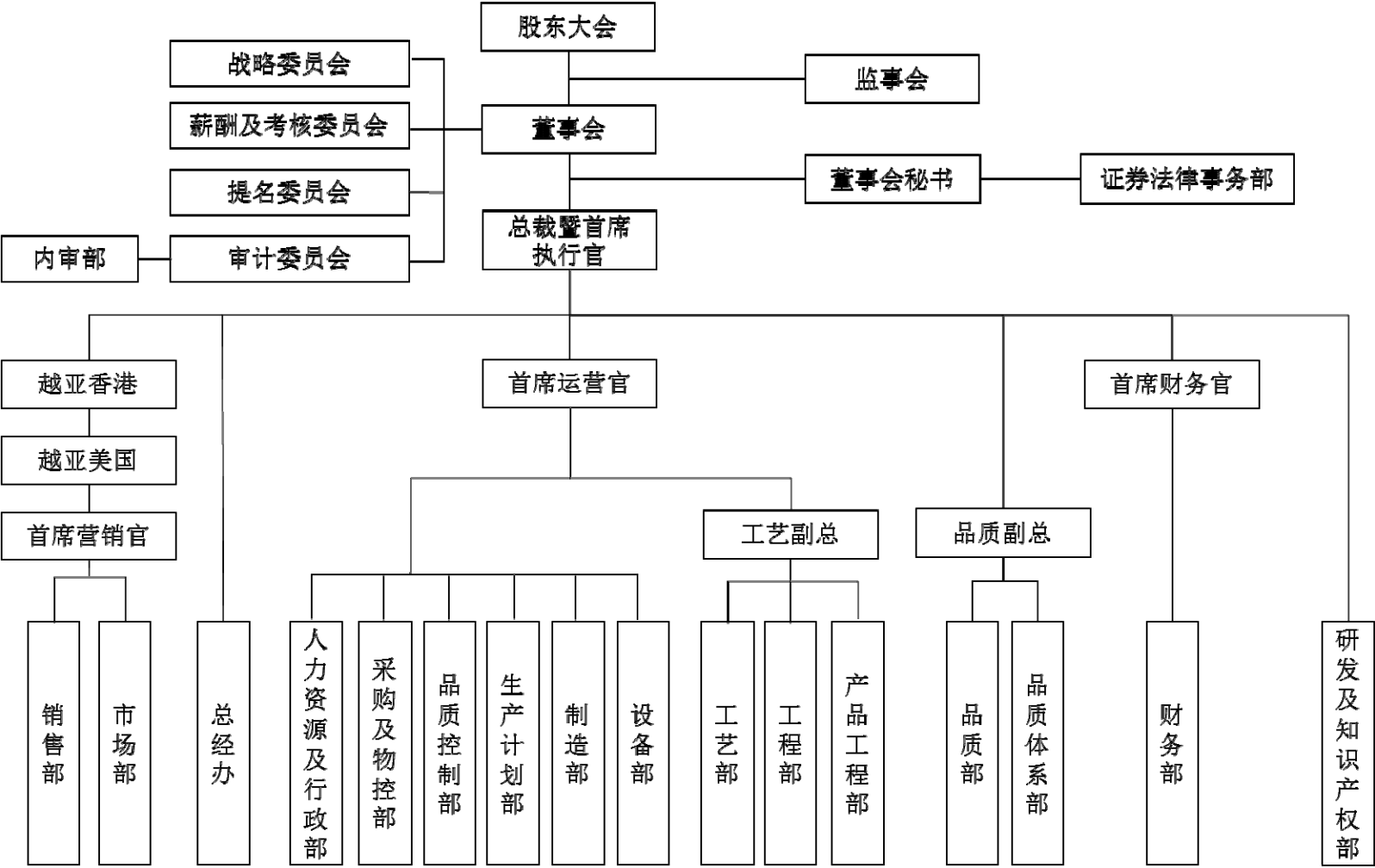
2013 年 4 月 29 日，国富浩华会计师事务所出具了国浩核字[2013]838A0027 号《验资复核报告》，验证截至 2012 年 12 月 31 日，珠海越亚公司自设立以来的注册资本已全部到位。

六、发行人的组织结构

（一）发行人股东结构及控股、参股公司图



(二) 发行人内部组织机构图



公司各主要职能部门的主要职能是：

1. 内审部

负责公司审计制度的拟定和执行；实施内部审计；配合外部审计部门和审计机构的审计工作；对公司各部门和人员的经济问题进行财务检查和监督，并提出检查报告书和处理意见；宣传审计法规；其它相关职责。部门内环境因素/风险的识别、评价与控制管理；本部门环境因素适用法规的学习、宣导与遵守。

2. 证券法律事务部

拟定公司各项证券管理制度，制定投资者关系管理制度、计划和目标，经批准后实施；投资者关系分析与研究工作；协助筹备股东大会、临时股东大会、董事会会议，并准备会议材料；协助公司做好年度报告、半年度报告、季度报告的编制、设计、印刷、报送、披露工作，以及其他临时性公告的披露；与投资者沟通、接待投资者；建立并维护与监管部门、行业协会、证券交易所、证券登记结算公司等良好的公共关系；维护本公司网站中投资者关系管理专栏，参与更新网上本公司信息，方便投资者查询；对公司重大合同及重大项目进行法律审查；其它相关职责。部门内环境因素/风险的识别、评价与控制管理；本部门环境因素适用法规的学习、宣导与遵守。

3. 研发及知识产权部

建立健全并不断更新完善现有研发项目管理体系；依据所获得的最新行业技术和产品市场发展信息，结合企业现有研发技术资源基础，评估制定企业中长期研发战略目标规划和年度研发项目目标规划；统筹规划并合理利用现有研发技术资源，组织相关研发项目负责人员充分评估制定企业年度各研发项目的具体实施计划；跟进执行并及时监督反馈年度各研发项目的具体实施进度情况；对取得的各项研发技术成果及时进行评估总结和归档，并对那些具有创新性的技术成果及时实施知识产权保护策略；实时跟踪研判行业最新技术和产品市场发展动态和趋势，为企业制定和调整未来研发技术战略目标规划提供必要的技术信息资源支持。部门内环境因素/风险的识别、评价与控制管理；本部门环境因素适用法规的学习、宣导与遵守。

4. 采购及物控部

负责物料及其他辅料的采购；负责设备采购的组织与商务洽谈；负责合格供应商开发、评审工作；负责公司采购成本控制；负责公司进出口报关工作；部门内环境因素/风险的识别、评价与控制管理；本部门环境因素适用法规的学习、宣导与遵守。负责公司整体物流、订单交期评审、产品生产的计划与控制

工作；负责制定各类物料的采购计划；跟进物料到货进度及异常情况的协调解决；负责统计分析各类物料消耗情况，跟进差异原因分析，严格控制物料的使用；部门内环境因素/风险的识别、评价与控制管理；本部门环境因素适用法规的学习、宣导与遵守。

5. 市场部

负责制定公司年度销售指标并推动达成；负责外部竞争环境分析，确定目标市场及策略客户，寻找新的客户资源,并对客户进行信用评估及开发维护;负责寻找新订单资源,了解每个新产品从打样到量产的产品生命周期，并以此获取长期合作的预测规划；主导新产品的评估认证,确保公司营运永续稳定;负责维系长期客户关系及客户满意度，并及时了解客户需求及同业、行业竞争力信息，同时转换为对厂内的要求，推动公司竞争力的提升；推动客户端销售回款的及时达成；管理、监督和控制公司市场预算费用使用情况。部门内环境因素/风险的识别、评价与控制管理；本部门环境因素适用法规的学习、宣导与遵守。

6. 销售部

参与制定中短期营销战略规划，为重大营销决策提供建议和信息支持，并确保中短期销售目标的达成；负责制定和实施销售管理制度，规范销售流程和销售渠道；负责组织对外报价、投标、合同谈判、合同评审、签订、履行等管理；负责与客户之间的日常经营活动信息交流及收集客户要求并予以满足，确保接单、订单排程、准时交付、账款回收的及时达成；了解样板及量产在客户端的进展状况，负责组织对产品销售状况进行评估、跟踪和管理，推动客户需求持续稳定；负责公司销售队伍的建设，人员选拔和调配、销售培训等；组织并督促部门人员，全面完成公司规定的各项工作；负责控制销售费用；部门内环境因素/风险的识别、评价与控制管理；本部门环境因素适用法规的学习、宣导与遵守。

7. 品质部

监督生产工艺和工序控制，使其按批准的作业指导书作业；负责质量统计和废品隔离；收集产品质量信息，进行数据统计和分析。会审新工艺开发的有关文件；负责计量管理和计量器具档案的建立；负责制定产品检验规范。对不合格品的判定、处置和分析，对纠正和预防措施的监督验证提高全员质量意识，促进质量管理方法的应用和实施。部门内环境因素/风险的识别、评价与控制管理；部门环境因素适用法规的学习、宣导与遵守。

8. 品质体系部

负责原材料检验，确保原材料和产品质量符合规定标准；参与对供应商质量环境管理体系的评审；处理客户投诉；对工程资料的正确性予以审查；认真组织所有体系文件的编制、修改工作，负责组织日常检查和内部审核工作，有计划、全面、系统地监督各部门质量环境体系是否贯彻执行；配合认证机构定期复审，跟踪不合格项，及时报告实施情况，监督在限定时间内完成全部纠正措施并予以验证；负责质量环境体系文件、客户资料文件以及内部文件的控制；负责统计过程控制的监控。部门内环境因素/风险的识别、评价与控制管理；部门环境因素适用法规的学习、宣导与遵守。

9. 品质控制部

组织生产检验工作，配合生产计划部门确保订单准时交货；反馈产品质量信息；发送不合格品报告，责成相关部门进行分析改善；成本的节约控制；落实作业现场管理，做好安全生产工作；协同相关部门处理客户投诉；部门内环境因素/风险的识别、评价与控制管理；部门环境因素适用法规的学习、宣导与遵守。

10. 制造部

组织制造部下属各工序，配合生产计划部门确保订单准时交货；确保产品质量；生产成本的节约控制；落实作业现场管理，做好环境安全生产工作；负责订单交期评审、计划排产工作；根据订单、物料、库存、生产等各个环节的变化因素，及时调整计划并进行有效的控制；部门内环境因素/风险的识别、评价与控制管理本部门环境因素适用法规的学习、宣导与遵守。

11. 生产计划部

负责公司生产计划的排产工作，并根据订单、物料、库存、生产等各个环节的变化因素，及时调整计划并进行有效的控制，保证客户交期；负责对采购到厂的各类物料验收入库数量、储存与管理并按标准发放；产成品入库数量验收、储存并严格按照要求办理出、入库；负责公司化学品、有价值固体废弃物、边角余料的管理；部门内环境因素/风险的识别、评价与控制管理；本部门环境因素适用法规的学习、宣导与遵守。

12. 设备部

管理全厂设备、设施；维护全厂设备、设施运作；参与设备采购过程；参与安全生产管理及系统维护；参与品质环境系统改善；负责协助产业园公用设施部对公司废水、废气、噪声进行管理和委外监测，负责相关环境目标指标的监测；部门内环境因素/风险的识别、评价与控制管理；本部门环境因素适用法规的学习、宣导与遵守。

13. 工艺部

负责现有生产工艺和设备的改良及更换物料的评估，适应公司对质量提升和环境改善及降低成本的要求；负责工艺问题的解决，保障生产顺利进行；负责工艺文件、参与操作文件的制订与落实负责各种技术能力和生产能力的统计、分析与评估。部门内环境因素/风险的识别、评价与控制管理；本部门环境因素适用法规的学习、宣导与遵守。

14. 工程部

客户资料审查，根据公司的生产能力及现状与市场部或客户澄清不明确的要求，并对超出能力的要求提出建议，与客户技术方面沟通，最终与客户达成一致的意见；组织订单技术评审，对超出公司能力的要求及尚未明确的生产方式提交横向职能小组讨论解决；根据生产要求编写和制作符合客户要求并适应生产的生产指示和工具，确保生产顺畅。同时，对生产成本负责，保证生产设计的高质量和低成本；制作图形资料、钻铣带、针床资料等生产工具，不断改善工具使之更好的提高生产质量合格率。部门内环境因素/风险的识别、评价与控制管理；本部门环境因素适用法规的学习、宣导与遵守。

15. 产品工程部

负责新客户、新产品的导入；负责对认证板、重点单进行全程跟进实施和总结，提供量产启动的改善建议和措施，为市场开拓方向提供依据；为客户提供技术支持和接口沟通，解决客户对于无芯封装基板技术的疑问及产品制作过程中出现的问题；参与和协助处理客户品质投诉。部门内环境因素/风险的识别、评价与控制管理；本部门环境因素适用法规的学习、宣导与遵守。

16. 财务部

实施财务管理功能、保障财务正常运转；在公司生产、经营及资金运转的全过程中，发挥预算、核算、分析控制、监督等功能；负责公司的会计核算和账务管理、成本管理，进行企业经济核算和分析工作，并反映其成效；严格执行国家财会法规和公司各项规章制度、加强财务管理，维护公司资产安全；根据公司经营预算来组织编制公司财务预算，并加强责任管理，促进各项经济指标实现；为公司质量环境体系有效运行提供财力支持。部门内环境因素/风险的识别、评价与控制管理；本部门环境因素适用法规的学习、宣导与遵守。

17. 人力资源及行政部

人力资源部编写并组织实施公司的人力资源规划，制定公司的人力资源管理制度；合理配置公司的人力资源，对现有人力资源进行有效开发；负责公司企业文化建设的规划及实施和与员工之间的信息交流；组织与实施员工的绩效

考核与管理；负责组织员工的招聘和培训工作；负责拟订公司的岗位设置、人员编制及工资分配方案；负责员工的岗位培训实施与组织；负责公司员工的工资发放、社会保险的缴费、劳动合同的签续订和人事档案的管理工作。

行政部协助公司的主管领导对日常行政事务的管理。

18. 总经办

贯彻公司经营理念，主导企业文化建设方向，提升企业战斗力；负责企业各类政府项目的申报及复审；负责协调企业与政府部门的各项关系；负责收集及分析经济情报、及时掌握商情，分析行业动态及走势和投资规划。

七、发行人股权投资情况

截至本招股说明书签署日，发行人共有一家全资子公司越亚香港，越亚香港拥有一家全资子公司越亚美国。除此以外，发行人无其他控股、参股子公司。越亚香港和越亚美国的具体情况如下：

（一）越亚香港

为便利公司接受海外客户订单，2012年8月10日，珠海越亚2012年第一次临时股东大会作出决议，同意设立珠海越亚封装基板技术（香港）股份有限公司，注册资本为100,000元港币。

2012年9月3日，商务部对珠海越亚颁发了商境外投资证第4400201200276号《企业境外投资证书》，准许珠海越亚在香港独资设立越亚香港，注册资本为1.5189万美元，经营年限为20年，经营范围为封装基板的进出口业务。

2012年9月17日，越亚香港于香港注册成立，商业登记证号码为60367101-000。

2014年2月28日，通过股东特别决议批准越亚香港更名为越亚封装基板（香港）有限公司，香港公司注册处处长于2014年3月12日发出公司更改名称证明书。越亚香港于2014年4月28日取得了商务部换发的商境外投资证第4400201400161号《企业境外投资证书》。

经瑞华会计师事务所审计，截至2013年12月31日，越亚香港的总资产为102.07万元，净资产为-477.42万元，2013年度净利润为-362.59万元。

（二）越亚美国

为进一步开拓美国市场，2013年2月19日，珠海越亚2013年第二次临时股东大会作出决议，同意由越亚香港设立美国子公司 ACCESS Technologies USA，注册资本为10.00万美元。

越亚美国于2013年2月22日在美国加州合法成立，注册号为C3536948，注册地址为19925 Stevens Creek, Boulevard, Suite 100, Cupertino, California 95014-2358。其成立时股份数为100,000股，全部为普通股，以每股1.00美元的价格发行给越亚香港。

经瑞华会计师事务所审计，截至2013年12月31日，越亚美国的总资产为5.69万美元，净资产为3.14万美元，2013年度净利润为-6.86万美元。

八、发行人股东基本情况

（一）发起人基本情况

1. 方正信产

方正信产为发行人并列第一大股东，持有发行人232,110,412股股份，占发行人本次发行前总股本的38.3575%。所持发行人股份性质为国有法人股。

方正信产成立于2010年11月8日，住所为北京市海淀区成府路298号方正大厦6层，法定代表人为张兆东，注册资本100,000.00万元，企业法人营业执照注册号为110000013359469。方正信产的经营范围为：项目投资；投资管理；资产管理；经济信息咨询（不含中介）；开发、销售计算机软件及硬件产品；计算机系统集成；技术服务（股权出资70,000.00万元）。

（1）方正信产的股东及实际控制人情况

方正信产目前为方正集团的全资子公司。方正集团成立于1992年12月12日，住所为北京市海淀区成府路298号，注册资本为101,428.57万元。经营范围：许可经营项目：房地产开发；物业管理。一般经营项目：制造方正电子出版系统、方正-SUPPER 汉卡、计算机软硬件及相关设备、通讯设备、仪器仪表、办公自动化设备；技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术推广；投资管理；财务咨询（不得开展审计、验资、查账、评估、会计咨询、代理记账等需经专项审批的业务，不得出具相应的审计报告、验资报告、查账报告、评估报告等文字材料）；销售电子产品、自行开发的产品、计算机、软件及辅助设备、仪器仪表、机械设备、非金属矿石、金属矿石、金属材料、建筑材料、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）；货物进出口、代理进出口、技术进出口；装卸服务；仓储服务；包装服务。（未取得行政许可的项目除外）

①方正集团股东及实际控制人

截至目前，方正集团的股东情况如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
1	北大资产	71,000.00	70.00
2	北京招润投资管理有限公司	30,428.57	30.00
合计		101,428.57	100.00

北大资产持有方正集团 70.00% 的股份，是方正集团控股股东。根据《国务院办公厅关于北京大学清华大学规范校办企业管理体制试点问题的通知》（国办函[2001]58 号），北大资产于 2002 年设立，系北京大学下属的经营性国有资产管理平台。北京大学为方正信产、方正集团的实际控制人。

北京招润投资管理有限公司是一家自然人控股的以股权投资为主营业务的投资公司，具体股权结构如下：

序号	股东姓名	认缴注册资本（万元）	出资比例（%）
1	李 友	329.8	32.98
2	方中华	268.9	26.89
3	余 丽	233.2	23.32
4	冯七评	64.8	6.48
5	张兆东	55.5	5.55
6	魏 新	47.8	4.78
-	合计	1,000	100.00

②方正信产报告期内股权变动情况

方正信产于 2010 年 11 月 8 日经北京市工商行政管理局核准设立，其设立之初股权结构如下：

序号	股东名称	认缴注册资本（万元）	出资比例（%）
1	方正集团	80,000	80.00
2	方正产业控股有限公司	15,000	15.00
3	北大方正投资有限公司	5,000	5.00
合计		100,000	100.00

2012 年 2 月，股东方正集团、北大方正投资有限公司和方正产业控股有限公司之间完成了第一次股权转让。转让完成后，方正信产的出资结构如下：

序号	股东名称	认缴注册资本（万元）	出资比例（%）
1	方正集团	74,000	74.00
2	方正产业控股有限公司	23,120	23.12
3	北大方正投资有限公司	2,880	2.88

序号	股东名称	认缴注册资本（万元）	出资比例（%）
	合计	100,000	100.00

2012 年 9 月，北大方正投资有限公司和方正产业控股有限公司将其所持股权全部转让给方正集团。转让完成后，方正信产成为方正集团的全资子公司。

（2）方正信产直接控制的其他企业情况

方正信产直接控制的其他企业情况，详见本招股说明书“第六章 同业竞争与关联交易”之“一、同业竞争”。

（3）方正信产的财务情况

经北京亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2013 年 12 月 31 日，方正信产的总资产为 1,093,030.21 万元，归属于母公司的所有者权益为 50,877 万元，2013 年度归属于母公司所有者的净利润为-15,932.13 万元。

2. AMITEC 公司

AMITEC 公司成立于 1997 年 12 月 9 日，为一家根据以色列法律合法成立、有效存续的非公众有限责任公司，其注册号为 512560319，联络地址为 POB 631, Migdal Ha'emek, Southern Industry Zone 10556, Israel，法定代表人为 Yotam Stern。

AMITEC 公司已登记的股本总额为 200,000 新谢克尔，分为 20,000,000 股普通股，每股面值 0.01 新谢克尔；AMITEC 公司已发行股本总额为 57,500 新谢克尔，均已有效发行并由股东足额认缴。

AMITEC 公司持有发行人 232,110,412 股股份，占发行人本次发行前总股本的 38.3575%，为发行人并列第一大股东。所持本公司股份性质为外资股。

（1）AMITEC 公司的股东及实际控制人情况

自 2010 年 1 月 1 日以来，AMITEC 公司股东持股比例未发生变化，截至本招股说明书签署日，AMITEC 公司股权情况如下：

序号	股东名称	持股数量（股）	出资比例（%）
1	Priortech Ltd.	5,749,900	99.9983
2	Yotam Stern	100	0.0017
	合计	5,750,000	100.0000

Priortech Ltd.持有 AMITEC 公司 99.9983%的股权，为其控股股东。Priortech 公司成立于 1980 年 9 月 8 日，系以色列上市公司，其已登记的股本总额为 14,000,000 新谢克尔，分为 14,000,000 股普通股，每股面值 1 新谢克尔；Priortech 公司已发行股本总额为 11,702,506 新谢克尔，截至 2014 年 5 月 30 日，其股权结构如下：

序号	股东名称/姓名	持股数量（股）	持股比例（%）
1	Rafi Amit	1,114,798	10.25
2	Yotam Stern	1,010,664	9.29
3	Excellence Nessuah	855,349	7.87
4	Migdal Insurance & Financial Holdings Ltd	819,671	7.54
5	David Kishon	681,999	6.27
6	Haim Langmans 的继承人	501,589	4.61
7	Yalin Lapidot Holdings management Ltd Trust Fund	436,483	4.01
8	Yalin Lapidot Holdings management Ltd	351,723	3.23
9	Meitav Dv investments Ltd-Trust Fund	264,552	2.43
10	Hanoch Feldstein	250,221	2.30
11	Meitav Dv investments Ltd ETF	209,386	1.93
12	Meitav Dv investments Ltd Pension fund	186,519	1.72
13	Yitzhak Krell 的继承人	168,304	1.55
14	Zahava Weinberg	161,501	1.49
15	Migdal Insurance & Financial Holdings Ltd Pension Funds	73,888	0.68
16	Mordechai Keret	5,400	0.05
17	Meitav Dv investments Ltd	228,160	2.10
18	公众持股		32.68
19	Priortech 公司	828,036 （隐名股）	---
合计		14,000,000 （含未发行股份）	---

自 2010 年 1 月 1 日以来，由 Rafi Amit, Yotam Stern, David Kishon, Haim Langmas（及其继承人），Hanoch Feldstein, Yitzhak Krell（及其继承人）及 Zahava Weinberg 七人构成的 Priortech 公司的控股组合没有发生变化；根据该七人于 1992 年 3 月 29 日签署的表决协议以及 Yotam Stern, Rafi Amit 和 Yitzhak Krell 于 1993 年 9 月 27 日签署的表决协议，Rafi Amit 和 Yotam Stern 在上述控股组合中共同持有大部分有表决权的股权；Rafi Amit 和 Yotam Stern 为 Priortech 公司的实际控制人。

（2）AMITEC 公司直接控制的其他企业情况

除了持有发行人股份，AMITEC 公司只持有 AMITEC 香港公司的股份。AMITEC 香港公司是 AMITEC 公司全资子公司，注册地址为：Unit 4404, 44/F., Hopewell Centre, 183 Queen's Road East, Wanchai, Hong Kong。AMITEC 香港公司注册资本港币 10,000 元。

（3）AMITEC 公司的财务情况

经 Raveh Ravid（以色列特拉维夫）会计师审计，截至 2013 年 12 月 31 日，AMITEC 公司的总资产为 173,406,000 新谢克尔，总负债为 228,022,000 新谢克尔，2013 年度净利润为 1,982,000 新谢克尔。

3. 东方富海（芜湖）股权投资基金（有限合伙）

东方富海于 2010 年 12 月 22 日取得了由芜湖市工商行政管理局颁发的注册号为 340202000004502 的营业执照，认缴出资额为 167,900.00 万元，是一家由东方富海（芜湖）股权投资基金管理企业（有限合伙）为执行事务合伙人管理的以股权投资为主营业务的有限合伙企业。本次发行前，持有发行人 46,505,880 股股份，占发行人本次公开发行前总股本的 7.6853%。

截至本招股说明书签署日，东方富海的出资情况如下：

序号	股东名称	认缴出资额 (万元)	出资比例 (%)
1	芜湖创宇富股权投资基金合伙企业（有限合伙）	13200.00	7.8618
2	亨特（深圳）股权投资企业（有限合伙）	10000.00	5.9559
3	三胞集团南京投资管理有限公司	10000.00	5.9559
4	彭 浩	10000.00	5.9559
5	冯章茂	7000.00	4.1691
6	西安开元控股集团股份有限公司	6000.00	3.5736
7	甘肃省信托有限责任公司	5000.00	2.978
8	深圳市腾益股权投资基金企业（有限合伙）	5000.00	2.978
9	寿稚岗	5000.00	2.978
10	勇晓京	5000.00	2.978
11	杨乔宇	5000.00	2.978
12	浙江城海股权投资合伙企业（有限合伙）	4300.00	2.561
13	东方富海（芜湖）股权投资基金管理企业（有限合伙）	4000.00	2.3824
14	苏州海汇投资有限公司	4000.00	2.3824
15	赵海奇	4000.00	2.3824
16	上海厚石股权投资管理有限公司	3000.00	1.7868
17	上海正西商贸服务中心	3000.00	1.7868
18	李清江	3000.00	1.7868
19	李咸刚	3000.00	1.7868
20	上海易泓鑫投资中心（有限合伙）	2700.00	1.6081
21	程小兵	2500.00	1.489
22	宁波坤鼎股权投资合伙企业（有限合伙）	2400.00	1.4294
23	方明东	2400.00	1.4294
24	陈明静	2200.00	1.3103
25	尚亿文	2200.00	1.3103
26	江苏五岳置业投资发展有限公司	2000.00	1.1912
27	浙江贝瑞实业投资有限公司	2000.00	1.1912
28	吴朝成	2000.00	1.1912
29	厦门市思明区汇朋富投资合伙企业（有限合伙）	2000.00	1.1912
30	陈军云	2000.00	1.1912
31	孟 波	2000.00	1.1912
32	楼今女	2000.00	1.1912

序号	股东名称	认缴出资额 (万元)	出资比例 (%)
33	章子玺	2000.00	1.1912
34	鲍嘉龙	2000.00	1.1912
35	胡丽娟	2000.00	1.1912
36	胡志滨	2000.00	1.1912
37	张 明	2000.00	1.1912
38	袁 丽	2000.00	1.1912
39	杨宇鹏	2000.00	1.1912
40	古少明	2000.00	1.1912
41	林桂香	2000.00	1.1912
42	柴树风	2000.00	1.1912
43	邓诗维	2000.00	1.1912
44	陈少忠	2000.00	1.1912
45	黄 勇	2000.00	1.1912
46	王政翔	2000.00	1.1912
47	王 强	2000.00	1.1912
合计		167900.00	100.0000

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所审计，截至 2013 年 12 月 31 日，东方富海的总资产为 163,416.22 万元，所有者权益为 152,816.88 万元，2013 年实现的净利润为-3,219.67 万元。

4. 东方富海（芜湖）二号股权投资基金（有限合伙）

东方富海二号是一家以东方富海（芜湖）股权投资基金管理企业（有限合伙）为普通合伙人（执行事务合伙人）的非法人股权投资企业。2010 年 12 月 30 日芜湖市工商行政管理局对其颁发了注册号为 340202000004535 的营业执照，认缴出资额为 78,500.00 万元，住所为安徽省芜湖市渡春路 33 号房屋-4，经营范围为股权投资、创业投资及股权投资、创业投资咨询服务（国家法律、法规规定需前置许可的项目除外）。本次发行前，持有发行人 9,200,452 股股份，占发行人本次公开发行前总股本的 1.5204%。

截至本招股说明书签署日，东方富海二号的出资情况如下：

序号	股东名称	认缴出资额 (万元)	出资比例 (%)
1	宜兴市新芳铜厂有限公司	6,000.00	7.6433
2	上海榕愉投资中心（有限合伙）	4,800.00	6.1146
3	胡宏	3,000.00	3.8217
4	詹忆源	3,000.00	3.8217
5	柳青	3,000.00	3.8217
6	钱玉兰	3,000.00	3.8217

序号	股东名称	认缴出资额 (万元)	出资比例 (%)
7	武汉市恒燊投资咨询有限公司	3,000.00	3.8217
8	南京泉峰国际贸易有限公司	3,000.00	3.8217
9	崔其峰	2,500.00	3.1847
10	张培贵	2,400.00	3.0573
11	姜言礼	2,300.00	2.9299
12	陈志坚	2,300.00	2.9299
13	徐祥荣	2,300.00	2.9299
14	孙国兴	2,200.00	2.8025
15	徐泉根	2,100.00	2.6752
16	江苏海达电缆有限公司	2,100.00	2.6752
17	梁宝川	2,000.00	2.5478
18	高思诗	2,000.00	2.5478
19	金建华	2,000.00	2.5478
20	严明硕	2,000.00	2.5478
21	何宜祥	2,000.00	2.5478
22	史建生	2,000.00	2.5478
23	陈起	2,000.00	2.5478
24	王余美	2,000.00	2.5478
25	赵彩华	2,000.00	2.5478
26	殷菊芳	2,000.00	2.5478
27	陶丽妹	2,000.00	2.5478
28	王一英	2,000.00	2.5478
29	王金玲	2,000.00	2.5478
30	浙江省兴合集团公司	2,000.00	2.5478
31	马海明	1,500.00	1.9108
32	陈静	1,000.00	1.2739
33	东方富海（芜湖）股权投资基金管理企业（有限合伙）	1,000.00	1.2739
合计		78,500.00	100.0000

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所审计，截至 2013 年 12 月 31 日，东方富海二号的总资产为 92,558.61 万元，所有者权益为 84,430.46 万元，2013 年实现的净利润为-1,025.35 万元。

5. 皖江（芜湖）物流产业投资基金（有限合伙）

皖江（芜湖）物流产业投资基金（有限合伙）于 2010 年 12 月 23 日取得了芜湖市工商行政管理局颁发的注册号为 340202000004527 的营业执照。皖江物流的执行事务合伙人为皖江（芜湖）物流产业投资基金管理企业（有限合伙），认缴出资额为 300,000.00 万元，住所为安徽省芜湖市渡春路 33 号房屋-3，经营范围为物流产业投资、股权投资、投融资管理及相关资讯服务（国家法律、法规规定

需前置许可的项目除外)。本次发行前,持有发行人 19,167,956 股股份,占发行人本次公开发行前总股本的 3.1676%。

截至本招股说明书签署日,皖江物流的出资情况如下:

序号	股东名称	认缴出资额 (万元)	出资比例 (%)
1	东方富海芜湖股权投资基金管理企业(有限合伙)	87,000.00	29.00
2	南翔万商(安徽)物流产业股份有限公司	75,000.00	25.00
3	芜湖市建设投资有限公司	60,000.00	20.00
4	淮南矿业(集团)有限责任公司	45,000.00	15.00
5	奇瑞控股有限公司	30,000.00	10.00
6	皖江(芜湖)物流产业投资基金管理企业(有限合伙)	3,000.00	1.00
合计		300,000.00	100.0000

经安徽新中天会计师事务所审计,截至 2013 年 12 月 31 日,皖江物流的资产总额为 84,305.49 万元,资产净额为 81,304.96 万元,2013 年度实现的净利润为 755.06 万元。

6. 上海开物投资合伙企业(有限合伙)

上海开物投资合伙企业(有限合伙)是一家以上海开物股权投资管理有限公司为普通合伙人(执行事务合伙人)的有限合伙企业。2010 年 12 月 7 日上海市工商行政管理局对其颁发了注册号为 310104000477078 的营业执照,认缴出资额为 45,153.80 万元,住所为淮海中路 1408 号 401 室,经营范围为实业投资,投资咨询。本次发行前,持有发行人 17,969,996 股股份,占发行人本次公开发行前总股本的 2.9696%。

截至本招股说明书签署日,上海开物的出资情况如下:

序号	股东名称	认缴出资额 (万元)	出资比例 (%)
1	沈黎明	5,000.00	11.0733
2	天津歌斐基金股权投资基金合伙企业(有限合伙)	4,000.00	8.8586
3	上海徐汇科技创业投资有限公司	3,000.00	6.644
4	天津歌斐兴业股权投资基金合伙企业(有限合伙)	2,000.00	4.4293
5	张超	1,500.00	3.322
6	汤仲飞	1,400.00	3.1005
7	赵亮	1,200.00	2.6576
8	马刚	1,100.00	2.4361
9	范县金属回收加工有限公司	1,000.00	2.2147
10	胡铁安	1,000.00	2.2147
11	李荧	1,000.00	2.2147

序号	股东名称	认缴出资额 (万元)	出资比例 (%)
12	刘翠萍	1,000.00	2.2147
13	陆华超	1,000.00	2.2147
14	上海浩金投资管理有限公司	1,000.00	2.2147
15	施皓天	1,000.00	2.2147
16	王继红	1,000.00	2.2147
17	王蕴	1,000.00	2.2147
18	王增冰	1,000.00	2.2147
19	赵雷	1,000.00	2.2147
20	干银达	1,000.00	2.2147
21	李燕娟	1,000.00	2.2147
22	王则湘	1,000.00	2.2147
23	裘索	1,000.00	2.2147
24	陈菊平	600.00	1.3288
25	周建华	600.00	1.3288
26	程颖	600.00	1.3288
27	杜会云	600.00	1.3288
28	吴旗	600.00	1.3288
29	崔柳英	500.00	1.1073
30	高广峰	500.00	1.1073
31	姜松湖	500.00	1.1073
32	李雪	500.00	1.1073
33	余景文	500.00	1.1073
34	曾毅	500.00	1.1073
35	胡升光	500.00	1.1073
36	黄南哲	500.00	1.1073
37	李静	500.00	1.1073
38	林静	500.00	1.1073
39	刘宏柱	500.00	1.1073
40	孙新	500.00	1.1073
41	唐继跃	500.00	1.1073
42	王君炎	500.00	1.1073
43	袁国栋	500.00	1.1073
44	上海开物股权投资管理有限公司	453.80	1.0050
合计		45,153.80	100.0000

截至 2013 年 12 月 31 日，上海开物的资产总额为 39,454.16 万元，资产净额为 39,436.16 万元，2013 年度实现的净利润为 3,891.69 万元（未审计）。

7. 宁波市科发股权投资基金合伙企业（有限合伙）

宁波市科发股权投资基金合伙企业（有限合伙）2012 年 3 月 1 日取得宁波市工商行政管理局对其颁发的注册号为 330200000080798 的营业执照，认缴出资额

为 12,125.00 万元，住所为宁波市江北区慈城镇走马街广场 26 号 021 幢 308 室，经营范围为股权投资及其咨询服务（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目）。本次发行前，持有发行人 14,975,096 股股份，占发行人本次公开发行前总股本的 2.4747%。

截至本招股说明书签署日，宁波科发的出资情况如下：

序号	股东名称	认缴出资额（万元）	出资比例（%）
1	罗承	3,360.00	27.7134
2	恒生电子股份有限公司	2,000.00	16.4948
3	徐建初	2,000.00	16.4948
4	陈炳贤	3040.00	25.0722
5	孙银海	800.00	6.5979
6	杨天遥	800.00	6.5979
7	浙江浙大科发股权投资管理有限公司	125.00	1.0309
合计		12,125.00	100.0000

经杭州萧然会计师事务所有限公司审计，截至 2013 年 12 月 31 日，宁波科发的资产总额为 7,805.28 万元，资产净额为 7,800.39 万元，2013 年度实现的净利润为-282.92 万元。

8. 开铂银科（成都）创业投资企业

开铂银科（成都）创业投资企业于 2010 年 12 月 6 日取得了成都市工商行政管理局颁发的注册号为 510100500030503 的营业执照。开铂银科的负责人为 Yoon Sung Yong，认缴出资额为 50,000.00 万元，住所为成都市高新区天府大道北段 1480 号拉德方斯西楼 3 楼 305 号，经营范围为股权投资，即主要向未上市企业进行股权投资或以其他法律法规允许的方式进行投资，并为之提供管理咨询服务（公司须在中国法律法规和公司章程规定的经营范围内从事生产经营活动）。本次发行前，持有发行人 23,959,796 股股份，占发行人本次公开发行前总股本的 3.9595%。

截至本招股说明书签署日，开铂银科的出资情况如下：

序号	股东名称	认缴出资额（万元）	出资比例（%）
1	KK Platinum Investment Limited	35,000.00	70.00
2	成都银科创业投资有限公司	15,000.00	30.00
合计		50,000.00	100.00

经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）成都分所审计，截至 2013 年 12 月 31 日，开铂银科的资产总额为 20,115.63 万元，资产净额为 19,533.18 万元，2013 年度实现的净利润为-1,077.35 万元。

（二）发起人以外的其他股东基本情况

1. 香港睿祺

香港睿祺是于 2012 年 8 月 24 日在香港依《香港公司条例》注册成立的员工持股公司，英文名称为 Hong Kong Smart Investment Limited，商业登记证号码为 60268765-000，住所为中国香港湾仔骆克道 212-220 号洛洋阁商业大厦 18 楼 B 室。

香港睿祺持有发行人 4,181,598 股股份，占发行人本次发行前总股本的 0.6910%。

截至本招股说明书签署日，香港睿祺股权结构及其股东在发行人任职情况如下：

序号	股东名称	国籍/地区	护照号码	持股数量 (股)	持股比例 (%)	目前在发行人处 任职
1	Dror Hurvits	以色列国	2062 XXXX	717,173	79.8515	总经理暨 首席执行官
2	Nicholas Stukan	美国	45520 XXXX	150,395	16.7453	越亚美国首席营 销官
3	黄士辅	中国台湾	30843 XXXX	14,074	1.5670	副总经理
4	Teo Chee Khye	马来西亚	A2750 XXXX	6,443	0.7174	生产计划部经理
5	许元鸿	中国台湾	21211 XXXX	5,024	0.5594	工艺部和研发及 知识产权部资深 经理
6	王建皓	中国台湾	30010 XXXX	5,024	0.5594	工程部资深经理
合计				898,133	100.0000	

2. 珠海睿祺

珠海睿祺是于 2012 年 8 月 23 日在珠海市注册的有限合伙企业（营业执照注册号为 440400000353175），执行事务合伙人为陈春灵，认缴出资总额为 322.9386 万元，住所为珠海市珠峰大道北 3209 号 1 栋方正 PCB 产业园研发楼四楼东侧办公室。珠海睿祺是发行人员工持股企业，持有发行人 2,374,549 股股份，占发行人本次发行前总股本的 0.3924%。

截至本招股说明书签署日，珠海睿祺的出资结构及其出资人在发行人任职情况如下：

序号	合伙人 姓名	身份证号	认缴出资 额(万元)	出资比例 (%)	目前在发行人处任职
1	陈先明	51050219751115XXXX	166.7649	51.6398	副总经理暨首席运营官
2	向文胜	43010519671004XXXX	80.5854	24.9538	副总经理
3	陈春灵	R511XXX(X)	75.5883	23.4064	首席财务官暨董事会秘书

序号	合伙人姓名	身份证号	认缴出资额(万元)	出资比例(%)	目前在发行人处任职
合计			322.9386	100.0000	

3. 珠海睿鑫

珠海睿鑫是发行人员工持股企业，持有发行人 2,567,920 股股份，占发行人本次发行前总股本的 0.4244%。

珠海睿鑫于 2012 年 8 月 23 日取得珠海市工商行政管理局颁发的注册号为 440400000353167 的营业执照，执行事务合伙人为梁海泉，认缴出资总额为 349.2368 万元，住所为珠海市珠峰大道北 3209 号 1 栋方正 PCB 产业园研发楼二楼东侧办公室。

截至本招股说明书签署日，珠海睿鑫的出资结构及其出资人在发行人任职情况如下：

序号	合伙人姓名	身份证号	认缴出资额(元)	出资比例(%)	目前在发行人处任职
1	罗明	42011119730119XXXX	600,000	17.1803	品质部资深经理
2	曾琼生	44522219720318XXXX	504,349	14.4415	制造部资深经理
3	姜俊文	43030319681010XXXX	399,668	11.444	工程部经理
4	谢凤霞	36220419800901XXXX	406,042	11.6266	采购及物控部经理
5	劳锐新	44072419690129XXXX	234,834	6.7241	设备部经理
6	宝玥	21130219781204XXXX	150,000	4.2951	工艺部高级工程师
7	黄本霞	42012419830608XXXX	150,000	4.2951	品质体系部经理
8	张伟	41282219751222XXXX	147,251	4.2164	市场部经理
9	郭进良	41022119790325XXXX	113,500	3.2499	产品工程部经理
10	梁海泉	44040219740416XXXX	84,834	2.4291	财务部经理
11	邓小峰	42900619790923XXXX	80,000	2.2907	制造部高级工程师
12	张丽娜	61012519800521XXXX	76,663	2.1952	市场部副经理
13	曹先贵	34082219760318XXXX	63,625	1.8218	工艺部高级工程师
14	杨洋	43100319840612XXXX	62,417	1.7872	制造部高级主管
15	胡柳意	45272419831005XXXX	50,000	1.4317	品质部主管
16	刘兰兰	42118119841021XXXX	50,000	1.4317	法务专员/监事会主席
17	吴德和	32088119790608XXXX	50,000	1.4317	设备部高级工程师
18	朱学见	34242519720320XXXX	42,417	1.2146	品质部高级主管
19	李高林	50022319850326XXXX	42,417	1.2146	工艺部高级工程师
20	杨云珠	36222319721016XXXX	40,000	1.1454	制造部副主管
21	池伟相	36068119831016XXXX	31,813	0.9109	品质部高级主管
22	谌龙彪	43092319860803XXXX	31,813	0.9109	制造部高级主管
23	管金良	12022319850929XXXX	23,625	0.6765	工程部主管
24	冯磊	42060219840821XXXX	23,500	0.6729	产品工程部高级工程师

序号	合伙人姓名	身份证号	认缴出资额 (元)	出资比例 (%)	目前在发行人处任职
25	王金辉	51138119861210XXXX	20,000	0.5727	制造部高级主管
26	彭建	43030219800923XXXX	13,600	0.3894	工艺部高级工程师
合计			3,492,368	100.0000	

(三) 公司实际控制人情况

本公司无实际控制人。截至招股说明书签署之日，公司共有 11 名股东，股权结构较为分散，并列第一大股东方正信产和 AMITEC 公司分别持有公司 38.3575%的股权，无任何股东直接持股比例高于 50%。单一股东在公司董事会所占席位均未过半，单一股东对公司董事会均不构成实际控制。

同时，方正信产与 AMITEC 公司签署《无控制确认协议》，同意在适用法律、法规及珠海越亚章程允许的范围内充分利用其届时因持有珠海越亚股份而享有的表决权以确保任何一方提名的两名代表当选为董事，并确保珠海越亚的所有其他非独立董事均为由双方共同同意提名的人员获得当选；双方在协议中明确，该协议的任何条款均不应理解为双方之间就任何董事会决议或股东大会除协议所述事项外的任何其他决议构成任何性质的一致行动协议。

(四) 股票质押及其他争议情况

截至本招股说明书签署日，本公司股东持有发行人的股份无质押或其他争议情况。

九、发行人股本情况

(一) 本次发行前后的股本情况

公司本次发行前总股本为 605,124,067 股。本次公开发行 A 股股票总数不超过 20,170.8023 万股，其中公司公开发行新股数量上限为 20,170.8023 万股，公司股东公开发售股份数量上限为 5,000 万股且不超过自愿设定 12 个月及以上限售期的投资者获得配售股份的数量。发行后的流通股股份占公司股份总数的比例不低于 25.00%。

假设公司发行 201,708,023 股新股，同时无老股转让的情况下，发行前后各股东所持股份及其比例变化如下表所示：

股东名称	发行前		发行后	
	持股数（股）	持股比例（%）	持股数（股）	持股比例（%）
方正信产	232,110,412	38.3575	232,110,412	28.7681
AMITEC公司	232,110,412	38.3575	232,110,412	28.7681

股东名称	发行前		发行后	
	持股数（股）	持股比例（%）	持股数（股）	持股比例（%）
东方富海	46,505,880	7.6853	46,505,880	5.7640
东方富海二号	9,200,452	1.5204	9,200,452	1.1403
皖江物流	19,167,956	3.1676	19,167,956	2.3757
上海开物	17,969,996	2.9696	17,969,996	2.2272
宁波科发	14,975,096	2.4747	14,975,096	1.8560
开铂银科	23,959,796	3.9595	23,959,796	2.9696
香港睿祺	4,181,598	0.6910	4,181,598	0.5183
珠海睿祺	2,374,549	0.3924	2,374,549	0.2943
珠海睿鑫	2,567,920	0.4244	2,567,920	0.3183
本次发行的新股			201,708,023	25.0000
合计	605,124,067	100.0000	806,832,090	100.0000

如果发生老股转让，发行后上述股东持股数量将相应调整。

根据财政部于 2013 年 5 月 21 日下发的《财政部关于批复教育部珠海越亚封装基板技术股份有限公司部分国有股权转由全国社会保障基金理事会持有的函》（财教函[2013]67 号），发行人在境内发行 A 股并上市后，方正信产应按照《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》的有关规定履行国有股转持义务，将其持有的发行人 14,119,562 股（以实际发行股份数及根据有关规定的计算结果为准）划转给全国社会保障基金理事会持有。

（二）前十名股东

截至本招股说明书签署日，公司无自然人股东，前十名股东的持股情况如下：

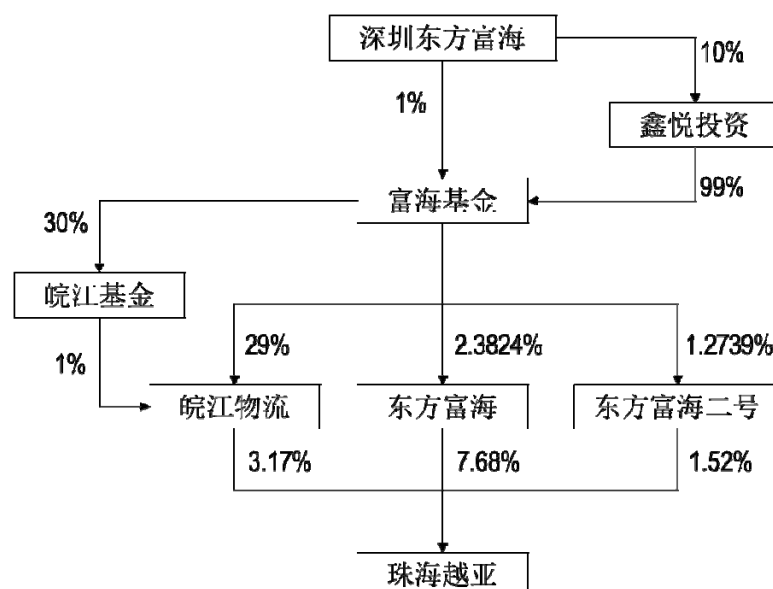
序号	股东名称	持股数量/股	持股比例（%）	股份性质
1	方正信产	232,110,412	38.3575	国有法人股
2	AMITEC 公司	232,110,412	38.3575	外资法人股
3	东方富海	46,505,880	7.6853	境内非法人股
4	开铂银科	23,959,796	3.9595	外资非法人股
5	皖江物流	19,167,956	3.1676	境内非法人股
6	上海开物	17,969,996	2.9697	境内非法人股
7	宁波科发	14,975,096	2.4747	境内非法人股
8	东方富海二号	9,200,452	1.5204	境内非法人股
9	香港睿祺	4,181,598	0.6910	外资法人股
10	珠海睿鑫	2,567,920	0.4244	境内非法人股
合计		602,749,518	99.6076	

（三）股东中的战略投资者持股及其简况

发行人不存在战略投资者持股情形。

（四）本次发行前各股东间的关联关系及关联股东的各自持股比例

梅健是本公司董事，其持有深圳市东方富海投资管理有限公司 8.00% 的出资，深圳东方富海通过多层结构持有本公司股份。截至本招股说明书签署日，本公司具有关联关系的股东——东方富海、东方富海二号、皖江物流合计持有本公司 12.37% 的股份，具体关联关系如下图所示：



除上图所示关联关系外，报告期内深圳东方富海曾持有浙大科发 30% 的股份，浙大科发是发行人股东宁波科发的普通合伙人，持有宁波科发 1.03% 的合伙份额。2013 年 7 月 31 日，深圳东方富海将浙大科发 30% 的股份转让给宁波市丰海投资有限公司。截至本招股说明书签署日，宁波科发与发行人其他股东不存在关联关系。

公司股东珠海睿祺的执行事务合伙人陈春灵先生同时担任公司股东香港睿祺的董事。

除上述关联关系外，发行人各股东之间无其他关联关系。

（五）本次发行前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺

本次发行前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺详见本招股说明书“重大事项提示”之“一、股份限制流通及自愿锁定承诺”。

十、发行人员工及其社会保障情况

（一）员工人数及变化情况

2011 年末、2012 年末及 2013 年末，本公司员工人数分别为 1,275 人、981 人及 763 人。截至 2013 年 12 月 31 日，本公司员工基本构成如下：

1. 员工专业结构

专业	人数	比例
生产人员	498	65.27%
销售人员	8	1.05%
研发技术人员	215	28.18%
管理人员	42	5.50%
合计	763	100.00%

2. 员工受教育程度

教育程度	人数	比例
大专及以上	236	30.93%
中专及高中	522	68.41%
高中以下	5	0.66%
合计	763	100.00%

3. 员工年龄分布

年龄	人数	比例
30 岁以下	621	81.39%
30-40 岁	117	15.33%
40-50 岁	24	3.15%
50 岁以上	1	0.13%
合计	763	100.00%

（二）员工社会保障情况

发行人已依照《中华人民共和国劳动法》与全体在册员工签订《劳动合同》。员工按照《劳动合同》承担义务和享受权利，发行人根据劳动合同的约定履行用人单位的各项义务，充分保障员工的合法利益。

发行人按国家有关法律法规和政策并按照当地政府关于建立、完善社会保障制度等配套文件的要求为发行人员工提供必要的社会保障，包括基本养老保险、医疗保险、工伤保险、生育保险、失业保险等保险。

珠海市斗门区劳动监察大队对发行人工资支付、社保缴纳情况出具证明，发行人没有因违反社会保险费征缴等相关法律法规而受到处罚的情况。

珠海市住房公积金管理中心出具证明，发行人依法建立了住房公积金账户，未受过相关行政处罚。

珠海市社会保险基金管理中心出具证明，发行人已办理了单位社会保险等级，并依照各险种法定的缴费比例缴纳社会保险费。

十一、主要股东及作为股东的董事、监事及高管人员的重要承诺

（一）关于避免同业竞争的承诺

公司并列第一大股东方正信产及其实际控制人北京大学分别向本公司出具了《关于避免同业竞争的声明与承诺函》，具体情况详见本招股说明书“第六章 同业竞争与关联交易”之“一、同业竞争”之“（二）避免同业竞争的承诺”。

公司并列第一大股东 AMITEC 公司、AMITEC 公司的控股股东 Priortech 及实际控制人 Rafi Amit 和 Yotam Stern 分别向本公司出具了《关于避免同业竞争的声明与承诺函》，具体情况请见本招股说明书“第六章 同业竞争与关联交易”之“一、同业竞争”之“（二）避免同业竞争的承诺”。

（二）关于减少和规范关联交易的承诺

持有公司股份 5%以上的股东（方正信产、AMITEC 公司和东方富海）及其关联机构或个人（方正集团、北大资产、北京大学、Priortech、Yotam Stern 和 Rafi Amit）向本公司出具了《关于减少和规范关联交易的承诺函》，具体内容详见本招股说明书“第六章 同业竞争与关联交易”之“六、公司减少关联交易的措施”。

（三）关于股份锁定的承诺

发行人主要股东就持有发行人股份的锁定期作出承诺，具体情况详见本招股说明书“重大事项提示”之“一、股份限制流通及自愿锁定承诺”。

（四）关于上市后稳定股价的措施

方正信产、AMITEC、发行人及其董事和高级管理人员关于上市后稳定股价措施详见本招股说明书“重大事项提示”之“二、上市后稳定股价的措施”。

（五）关于持股意向及减持意向的承诺

方正信产、AMITEC 及东方富海分别出具了持股意向及减持意向承诺，详见本招股说明书“重大事项提示”之“四、持股 5%以上股东的持股意向及减持意向”。

（六）关于招股说明书信息披露的承诺

公司并列第一大股东方正信产及 AMITEC 和各自的实际控制人，公司董事、监事和高级管理人员关于招股说明书信息披露的承诺详见本招股说明书“重大事

项提示”之“三、关于信息披露的承诺”。

（七）关于失信补救措施的承诺

公司并列第一大股东方正信产及 AMITEC 和各自的实际控制人，公司董事、监事和高级管理人员关于失信补救措施的承诺详见本招股说明书“重大事项提示”之“六、发行人及其主要股东、董事、监事、高级管理人员等关于失信补救措施的承诺”。

（八）关于社保及住房公积金的承诺

公司并列第一大股东方正信产及 AMITEC 就珠海越亚(包括其前身越亚有限)因其报告期内为员工缴纳社会保险和住房公积金的实际情况(以下简称“社保实际缴纳情况”)而可能承担的责任无条件承诺如下:

如珠海越亚因社保实际缴纳情况而被任何政府主管部门要求补缴社会保险或住房公积金,或被任何政府主管部门处以行政处罚,或被任何政府主管部门、法院或仲裁机构决定、判决或裁定向任何员工或其他方支付补偿或赔偿,本公司将以本公司除直接或间接持有的珠海越亚股份以外的其他个人财产与 Amitec-Advanced Multilayer Interconnect Technologies Ltd./方正信产无条件连带全额承担,并连带承担与此相关的一切费用。

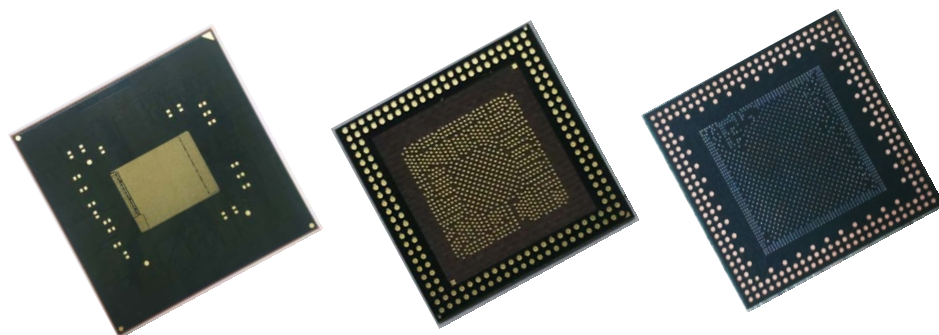
第五章 业务和技术

一、发行人主营业务及其变化情况

（一）主营业务及产品

本公司最早由中国、以色列两国企业合资组建，主要从事具有自主知识产权的刚性有机无芯 IC 封装基板的研发、生产和销售，始终致力于成为国际领先的创新型的半导体封装基板解决方案提供商。自 2006 年成立以来，公司以“新型集成电路支撑结构及其制作方法”等技术为核心进行高新技术成果转化，并通过多年的自主研发和技术积累，将实验室技术转化为量产技术，成为世界上首家采用“铜柱法”生产无芯封装基板并实现量产的高科技企业。公司无芯封装基板技术产业化的成功，打破了境外企业对半导体封装基板市场的垄断。

公司为客户提供封装基板解决方案以及定制化的高密度刚性有机无芯 IC 封装基板，产品经过封装测试厂的封测后，最终运用于手机、平板电脑、游戏机等便携式终端消费电子产品。公司产品具备良好的导电性、散热性、耐热冲击性等特点，能够较好地满足当前先进封装设计对高密度、高效、高速度和低能耗的需求。目前公司主要研发生产应用于模拟芯片封装领域的无线射频模块(RF Module)封装基板，此类产品已处于量产阶段，已通过国际知名芯片设计企业威讯联合半导体(RFMD)、安华高科技(Avago)等客户认证并获得其量产订单，该等客户已进入 iPhone、三星 Galaxy 系列等智能手机，以及 iPad、Galaxy Tab 等平板电脑的供应链。



刚性有机无芯 IC 封装基板产品图例

公司在技术创新和产品开发上取得了多项成果，已拥有五大封装基板量产技术：无芯板(Coreless)技术、铜柱(Copper Pillar)技术、采用半固化片在铜柱上层压的技术、化学机械抛光(CMP)磨板技术和真空喷溅(Sputtering)技术。截至本招股说明书签署之日，公司在中国、美国、韩国、以色列、日本、中国台湾等国家或地区拥有 13 项发明专利，全部知识产权属于无芯封装基板制造技

术领域，技术达到国际先进水平。同时公司尚有超过 70 项专利在上述各个国家或地区申请。

公司为国家高新技术企业、珠海市知识产权优势企业、中小企业创新产业化示范基地、广东省战略性新兴产业培育企业、广东省创新型试点企业、广东省第二批重点创新帮扶高成长性中小企业，并设有珠海市级重点企业技术中心及广东省工程技术研究中心。2012 年 12 月，公司“高可靠 RF Module 系统级封装基板制造技术”获得珠海市科技进步一等奖，并于 2014 年 4 月获得广东省科学技术奖二等奖。

（二）发行人设立以来主营业务的变化情况

发行人自设立以来，始终从事 IC 封装基板的研发、生产和销售，主营业务未发生变化。

二、发行人所处行业的基本情况

（一）IC 封装基板行业的概述

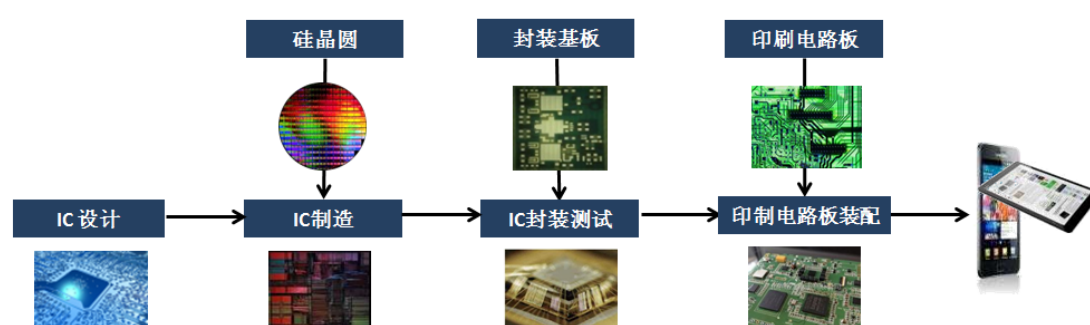
1. IC 封装基板概述

集成电路产业是国民经济和社会发展的战略性、基础性产业，是各国电子信息产业发展的核心与基础。完整的集成电路由裸芯片（晶圆片）与封装体（封装基板及固封材料、引线等）组合而成。封装作为集成电路制造的重要环节，为芯片提供信号和电源互连、机械支撑和散热通路，以及环境保护等。早期 IC 封装主要使用引线框架作为导通 IC 与支撑 IC 的载体。20 世纪 90 年代，封装基板作为一种新的载体出现，在高阶封装领域取代了传统引线框架，并迅速推动了 IC 封装与互连技术的发展，已成为芯片封装中不可缺少的一部分。

IC 封装基板是承载芯片的载体，能够保护、固定、支撑芯片，增强芯片导热（散热）性能，保证信号的完整性。整个 IC 封装基板的上层与芯片相连，下层和印刷电路板相连，以实现电气和物理连接、功率分配、信号分配，以及沟通芯片内部与外部电路等功能。随着科学技术的进步和电子产品轻、薄、短、小的需求驱动，集成电路呈现出向小型化、高度集成化、多功能化的发展趋势。高性能的封装成为保证集成电路功能充分发挥的关键。

IC 封装基板由导电层和绝缘层组成，导电层之间通过绝缘层隔开，绝缘材料包括有机（刚性封装基板和柔性封装基板）和无机（陶瓷封装基板）两大类。这两类封装基板的应用领域有所不同：有机封装基板多用于消费电子产品领域，无机封装基板则广泛应用于对可靠性要求较高的领域，如军工产业。2008

年全球有机封装基板的产值约占整个 IC 封装基板总产值的 95%。有机封装基板因其运用的材料不同，可分为刚性和柔性两种，刚性封装基板采用 BT 树脂基板材料、环氧树脂等刚性材料，柔性封装基板采用柔性材料。刚性封装基板主要运用于基带芯片、应用处理器芯片、功率放大器芯片、数字模块芯片等领域。柔性封装基板主要运用于晶体管液晶显示器芯片等领域。刚性有机 IC 封装基板与芯片制造、消费电子产品生产过程的关系如下：



2. IC 封装基板的制造与刚性有机 IC 无芯封装基板的发展

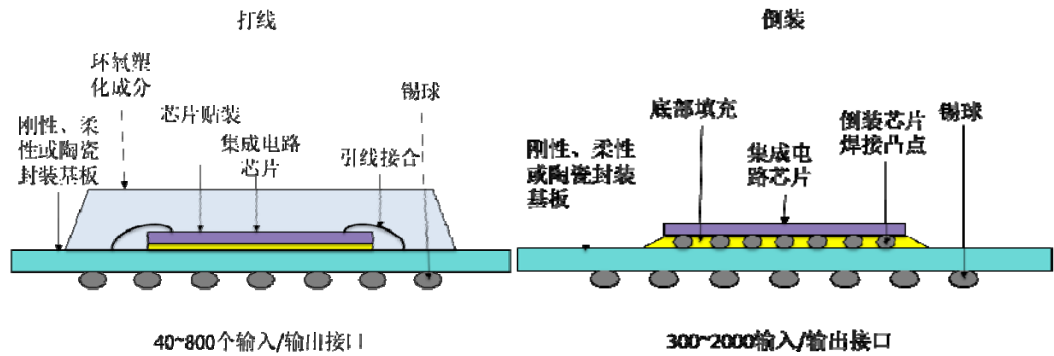
IC 封装基板的制造工艺最早源于微型化、高等级的印刷电路板的制造，随着技术创新带来的电子电路集成度的提高，IC 封装基板制造工艺的发展已经开始接近芯片制造工艺，投资门槛和技术壁垒越来越高。根据 Prismark 的研究报告，全球目前仅有十几家企业生产和制造刚性有机 IC 封装基板，主要分布于日本、韩国和中国台湾。这些企业使用传统的积层法制造封装基板，即以树脂或半固化片为基础，通过在芯板层双侧增层的方式实现多层堆积，并通过钻孔、电镀填铜的方式制作层间导通孔提供电子通路，进而生产出不同层数的封装基板。

随着消费电子产品朝着功能融合性和体积微小型发展，芯片在技术和功能上不断更新和升级，芯片尺寸不断缩小，即功耗持续降低的同时要求性能进一步提高。更高集成度的芯片需要高密度的封装，并对其稳定性、电气性能和电路运行效率提出更严格的要求。封装基板作为重要的封装材料，其大小与性能直接影响封装体的尺寸以及芯片性能的发挥，因此主流厂商不断改善芯板层和堆积层的设计，将芯板层变得越来越薄，直至出现了无芯封装基板的设计方案。

无芯封装基板的出现缩小了产品的封装体积并提升了芯片的性能。本公司是无芯封装基板制造的典型代表。基于铜柱法等五大无芯封装基板量产技术，公司可实现小尺寸、高性能的无芯封装基板。

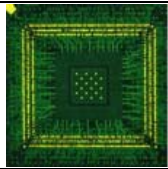
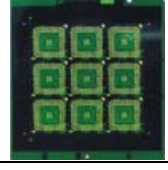
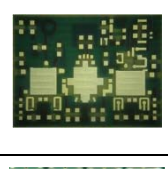
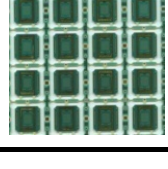
3. 刚性有机 IC 封装基板的具体分类

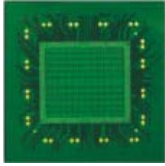
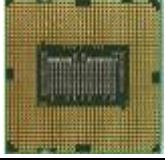
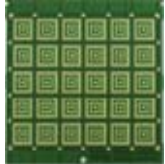
刚性有机 IC 封装基板有多种分类方式。根据导电层的数量可以分为不同层数的封装基板；按照和芯片的连接方式，封装基板可以分为倒装（Flip Chip，FC）和打线（Wire Bonding，WB）两大类。倒装是将晶片正面翻覆，以凸块直接连接封装基板以实现互联。打线则是利用金线或铜线连接芯片上的电性接点和封装基板上的输入电路接点。



资料来源：Prismark

基于不同的封装方式，打线和倒装类型的封装基板有多种多样的产品类型。行业内主流封装基板的具体分类、示例及应用领域如下：

芯片与基板的连接方式	类型	简称	示例	产品应用领域	终端产品
打线	球栅阵列	WB BGA		微处理器，南桥芯片，网络芯片	电脑、平板电脑、手机、游戏机等
	芯片级封装	WB CSP		电脑内存，手机，快闪内存卡	电脑、手机、照相机、摄像机、便携式游戏机、MP3
	射频模块	RF Module		无线射频功率放大器，收发器，前端接收模块	手机、平板电脑、游戏机、电脑等
	数字模块	Digital Module		数码相机内存卡	数码相机

倒装	球栅阵列	FC BGA		微处理器，图形处理器，基带芯片，应用处理器，游戏机处理器	电脑、平板电脑、游戏机等
	针栅格阵列	FC PGA		微处理器	电脑、平板电脑、游戏机等
	触点栅格阵列	FC LGA		微处理器	电脑、平板电脑、游戏机等
	芯片级封装	FC CSP		应用处理器，基带芯片，智能手机加速处理器，电源管理/电力线收发器	手机、平板电脑、照相机、摄像机、数字电视等

资料来源：Prismark、公司自行整理

上述产品按其运用领域又可分为两类：一类是运用于模拟芯片的封装基板，模拟芯片运用于模拟集成电路，模拟集成电路是指由晶体管、电容、电阻等组成的模拟电路集成在一起用来处理模拟信号或实现电源转换的集成电路。无线射频模块芯片是典型的模拟芯片，而运用于这些芯片的封装基板即为无线射频模块封装基板。另一类是运用于数字芯片的封装基板，数字芯片运用于数字集成电路，数字集成电路是指将元器件和连线集成于同一半导体芯片上而制成的数字逻辑电路或系统。典型的芯片类型有基带芯片、应用处理器芯片、内存卡芯片等。用于承载这些芯片的封装基板包括 WBBGA、WBCSP、FCBGA、FCCSP 等。

（二）行业管理体系及主要法律法规政策

1. 行业管理体制

按照中国证监会颁布并实施的《上市公司行业分类指引》，公司产品作为电子元件，属于制造业中的计算机、通信和其他电子设备制造业（行业代码：C39），国家工业与信息化部是计算机、通信和其他电子设备制造业的行政主管部门，主要负责制定实施我国半导体行业发展战略、方针政策和总体规划，并对行业的发展方向进行宏观调控；指导拟定行业技术法规和行业标准；监测半导体行业内企业的日常运行。（来源：国家工业和信息化部网站）

2. 主要法律法规及政策

国家出台了若干产业政策，鼓励、扶持行业的发展，相关产业主要政策包括：

主要政策	颁布部门	颁布日期	政策典型内容
《国家重点支持的高新技术领域》、《高新技术企业认定管理办法》	科技部、财政部、国家税务总局	2008年4月	电子信息技术等8个领域为国家重点支持的高新技术领域；重点发展新型的集成电路封装技术，“包括采用薄型载带封装、塑料针栅阵列（PGA）、球栅阵列（PBGA）、多芯片组装（MCM）、芯片倒装焊（Flip Chip）、WLP（Wafer Level Package），CSMP（Chip Size Module Package），3D（3 Dimension）等封装工艺技术”。
《电子信息产业技术进步和技术改造投资方向》	国家发展改革委员会、科技部、工信部、商务部、知识产权局	2009年9月	半导体集成电路、电子基础产品等7个领域是电子信息产业技术进步和技术改造投资的主要方向，其中重点支持高密度互联多层印制电路板、多层挠性板、刚挠印制电路板、IC封装基板、特种印制电路板；以及栅阵列封装（BGA）、系统级封装（SIP）、芯片级封装（CSP）、方型扁平无引脚封装（QFN）、倒扣封装（Flip Chip）、多芯片组装（MCM）等集成电路新型封装测试。
《国务院关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》	国务院	2011年2月	为进一步优化软件产业和集成电路产业发展环境，提高产业发展质量和水平，该通知制定一系列政策促进软件产业和集成电路产业发展。在税收上规定为完善集成电路产业链，对符合条件的集成电路封装、测试、关键专用材料企业以及集成电路专用设备相关企业给予企业所得税优惠。明确表示重点支持基础软件、面向新一代信息网络的高端软件、工业软件、数字内容相关软件、高端芯片、集成电路装备和工艺技术、集成电路关键材料、关键应用系统的研发以及重要技术标准的制订。
《国家“十二五”科学和技术发展规划》	科技部	2011年3月	加强设计技术、可靠性技术、制造工艺、基础零部件和电子元器件、大型铸锻件、仪器仪表、计量测试设备等方面基础性、共性技术研发，同时将

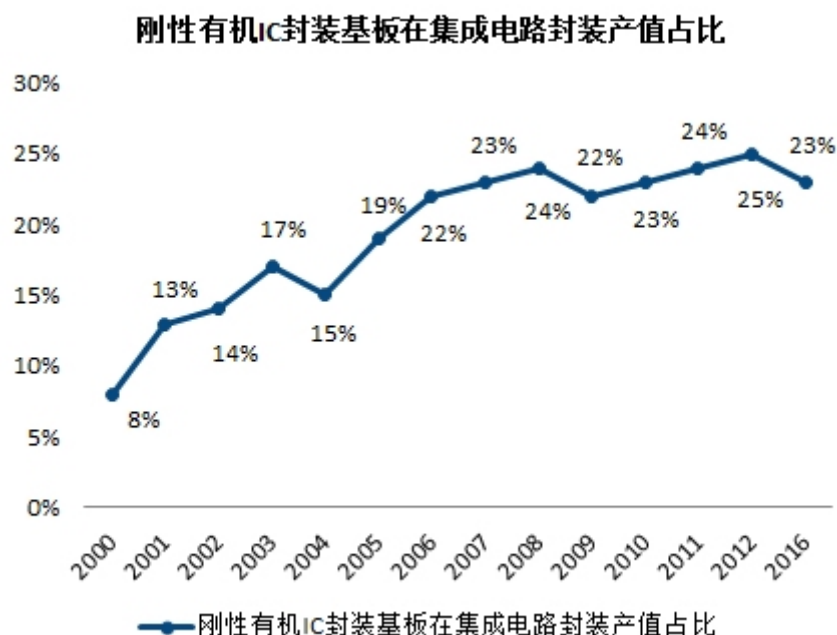
主要政策	颁布部门	颁布日期	政策典型内容
			“集成电路及关键元器件”作为关键技术、重点产业。
《当前优先发展的高技术产业化重点领域指南（2011年度）》	国家发展和改革委员会、科技部、工信部、商务部、知识产权局	2011年6月	《指南》确定了当前优先发展的信息、生物、航空航天、新材料、先进能源、现代农业、先进制造、节能环保和资源综合利用、海洋、高技术服务业十大产业中的 137 项高技术产业化重点领域，其中，线宽65纳米以下的纳米级集成电路芯片封装和测试被归入当前优先发展的高技术产业化重点领域。
《广东省高端新型电子信息产业发展“十二五”规划》	广东省经济和信息化委员会	2011年7月	《规划》强调重点发展球栅阵列、系统级、芯片级、方型扁平无引脚、倒扣封装等集成电路新型封装技术。重点支持集成电路公共服务平台建设，推动广州、深圳、珠海和中山集成电路设计服务中心支撑平台完善和升级。
《“十二五”产业技术创新规划》	工信部	2011年11月	提出对计算机产品工业设计、主板制造、轻薄便携、低功耗、触控技术；BGA、CSP、MCM、WLP、3D、TSV等先进封装和测试技术；集成电路关键设备和后封装设备关键技术等进行重点开发。
《电子信息制造业“十二五”发展规划》	工信部	2011年12月	规划中明确提出电子信息制造业“十二五”的发展着重于计算机、集成电路、关键电子元器件等11个领域，同时顺应集成电路产品向功能多样化的重要发展方向，大力发展先进封装和测试技术，推进高密度堆叠型三维封装产品的进程，支持封装工艺技术升级和产能扩充。
《国务院关于印发工业转型升级规划（2011—2015年）的通知》	国务院	2011年12月	提出着力发展集成电路设计业，持续提升先进和特色集成电路芯片生产技术和能力，发展先进封装工艺，进一步提高测试水平，攻克关键设备、仪器、材料和电子设计自动化（EDA）工具技术工艺，实现重大产品、重大工艺和新兴领域的突破。 LED方面，重点突破外延生长和芯片制造关键技术，提高外延片和高端芯片的国内保障水平。增强功率型LED器件封装能力，加大对封装结构设计、新型封装材料及新工艺的研究与开发。

主要政策	颁布部门	颁布日期	政策典型内容
《集成电路产业“十二五”发展规划》	工信部	2011年12月	到“十二五”末，集成电路产业规模再翻一番以上，关键核心技术和产品取得突破性进展，结构调整取得明显成效，产业链进一步完善，形成一批具有国际竞争力的企业，基本建立以企业为主体的产学研用相结合的技术创新体系。顺应集成电路产品向功能多样化的重要发展方向，大力发展先进封装和测试技术，推进高密度堆叠型三维封装产品的进程，支持封装工艺技术升级和产能扩充。
《“十二五”国家战略性新兴产业发展规划》	国务院	2012年7月	提出包括新一代信息技术产业、节能环保产业等7个重点发展方向和主要任务。新一代信息技术产业中的“电子核心基础产业”发展强调“围绕重点整机和战略领域需求，大力提升高性能集成电路产品自主开发能力，突破先进和特色芯片制造工艺技术，先进封装、测试技术以及关键设备、仪器、材料核心技术，加强新一代半导体材料和器件工艺技术研发，培育集成电路产业竞争新优势”。
《信息化发展规划》	工信部	2013年9月	提出到2015年，信息化和工业化深度融合取得显著进展，在集成电路、新型显示器件、系统软件、关键元器件等领域取得一批重大创新成果，集成电路芯片规模生产工艺达到32/28纳米。

（三）行业市场情况

1. 行业的竞争格局和市场化程度

过去十余年，全球 IC 产业快速发展，带动了 IC 封装市场及 IC 封装基板市场的成长。根据 Prismark 的统计，全球刚性有机 IC 封装基板市场容量从 2000 年的 19.8 亿美元增加到 2012 年的 83.13 亿美元，刚性有机 IC 封装基板在集成电路封装产值中的比重由 2000 年 8% 增加到 2012 年的 25%。以封装基板为基础的封装方式成为集成电路封装的主流。



资料来源：Prismark

目前全球半导体产业链可分为：垂直整合模式下的集成设备制造商(IDM)，垂直分工模式下的芯片设计商(Fabless)、晶圆制造商(Foundries)、封装测试商(Assembly&Test)；以及半导体设备和原料供应商(Semi Equipment & Materials)、外协厂商等，其中，IDM 厂商的经营范围涵盖了 IC 设计、IC 制造、封装测试等各环节，甚至延伸至下游电子终端。产业链上 IC 设计、晶圆制造、封装测试各个环节的难度不断加大，技术门槛和资本投入需求也越来越高，整个产业向专业化、精细分工方向不断发展。根据 Gartner 的研究报告，2013 年全球半导体营业收入总计 3,150 亿美元，前 20 名半导体企业中，IDM 厂商仍处于主要位置，如英特尔(Intel)、三星(Samsung)、德州仪器(Texas Instruments)、东芝(Toshiba)、意法半导体(ST Microelectronics)等；同时，垂直分工模式下的一些芯片设计商(Fabless)也已进入前 20 名，如高通(Qualcomm)、博通(Broadcom)、联发科(MediaTek)等。从国家、地区产业格局来看，发达国家产业基础雄厚，综合实力全球领先，因此芯片的设计和高端芯片制造仍由美国、欧洲、日本、韩国厂商主导。而封装测试、中低端芯片制造等环节则从美、欧、日、韩向亚洲其他地区转移。

作为集成设备制造商(IDM)和芯片设计商(Fabless)及其封装厂的上游供应商，刚性有机 IC 封装基板的生产制造具有明显的技术密集和资金密集特征。目前，全球 90%的刚性有机 IC 封装基板由十几家企业生产和制造，这些企业主要分布于日本、韩国和中国台湾。2011 年，日本、韩国和中国台湾实现封装基

板销售收入分别为 34.90 亿美元、16.15 亿美元和 25.90 亿美元，共占全球刚性有机 IC 封装基板市场份额的 89.10%。

上世纪 90 年代开始，日本就走在了世界刚性有机 IC 封装基板开发、应用的前列。日本生产刚性有机封装基板的厂家主要包括揖斐电（Ibiden）、新光电气工业（Shinko）、京瓷化学（Kyocera）等公司。中国台湾封装基板行业的投资，主要来自封装制造厂和印刷电路板厂。他们通过从美国、日本等引进技术进入该领域，并逐步拥有自主创新开发能力，目前主要生产企业包括日月光材料（ASE Material）、欣兴电子（Unimicron）、南亚电路板（NanYa PCB）、景硕科技（Kinsus）等。韩国企业也是从 20 世纪末期开始生产制造封装基板，目前主要生产厂家有：三星电机（Semco）、伊诺特（LG Innotek）、大德电子（Daeduck Electronics）、信泰电子（Simmtech）等。

中国大陆刚性有机 IC 封装基板厂商主要为日本、韩国、中国台湾公司在中国大陆设立的生产基地，如日月光材料（ASE Material）、景硕科技（Kinsus）、健鼎（Tripod）、美维电子等公司，在大陆设立了生产厂，但这些公司的研发力量主要集中在境外。同时，有少数本土厂商通过引进国外技术、自主研发等途径进入刚性有机 IC 封装基板领域。根据 Prismark 的报告，2011 年，中国大陆刚性有机 IC 封装基板市场容量为 5.50 亿美元，仅占全球市场份额的 6.37%。我国刚性有机 IC 封装基板行业存在巨大的成长潜力。根据 Prismark 的预测，2016 年中国大陆刚性有机 IC 封装基板销售收入将达到 10.00 亿美元，2011 至 2016 年复合增长率为 13%。

2. 行业内的主要参与者

与 IC 产业竞争格局类似，刚性有机 IC 封装基板行业的市场集中度较高，且主要市场格局变化不大。根据 Prismark 的报告，2012 年前十名企业合计销售规模为 69.85 亿美元，占总体市场容量的比例为 84.03%。这十家企业情况如下：

排名	厂商名称	所在地	2012 年总收入（亿美元）	市场份额
1	揖斐电（Ibiden）	日本	16.50	19.85%
2	三星电机（SEMCO）	韩国	12.30	14.80%
3	欣兴电子（Unimicron）	中国台湾	9.25	11.13%
4	新光电气工业（Shinko）	日本	8.70	10.47%
5	南亚电路板（NanYa PCB）	中国台湾	6.45	7.76%
6	景硕科技（Kinsus）	中国台湾	5.94	7.15%
7	信泰电子（Simmtech）	韩国	3.36	4.04%
8	京瓷集团（Kyocera）	日本	2.86	3.44%
9	大德电子（Daeduck Electronics）	韩国	2.75	3.31%

排名	厂商名称	所在地	2012 年总收入（亿美元）	市场份额
10	日月光材料（ASE Material）	中国台湾	1.74	2.09%
小计			69.85	84.03%
封装基板市场总销售额			83.13	100.00%

来源：Prismark

本公司是刚性有机 IC 封装基板市场的新兴企业，其研发生产的无芯封装基板在技术路线和产品设计上与上述企业存在差异化竞争优势。公司主要从 RF Module 封装基板这一细分市场进入该行业，基于自主知识产权生产的刚性有机无芯 IC 封装基板，能够顺应终端产品向轻薄短小、高集成度发展过程中对封装基板提出的更高要求。

3. 市场供求状况及其变动原因

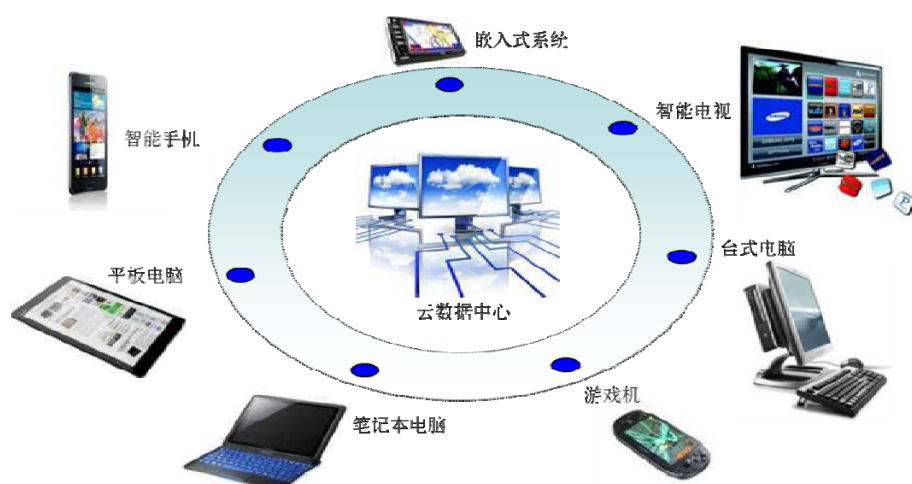
（1）市场需求变化及原因

从产业链看，刚性有机 IC 封装基板的市场需求直接取决于下游芯片的出货量，而二者的需求变化趋势与终端消费电子产品市场变化直接相关。根据 Prismark 的预计，全球刚性有机 IC 封装基板的市场容量于 2017 将达到 92.30 亿美元，较 2012 年增长 11.03%，不同的细分产品将呈现出不同的增长趋势。具体需求变化及原因如下：

①终端电子消费品市场的快速发展使得整个供应链受益

随着社会信息化水平的提高及数字生活、移动互联的发展，包括智能手机、平板电脑、游戏机、电视机、数码相机等在内的终端电子消费品正在发生深刻变化。

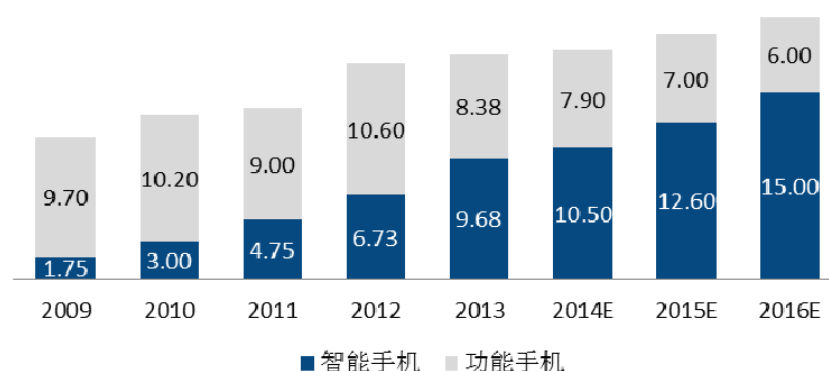
首先，集多种功能于一体的智能电子产品迎来了普及浪潮，市场规模迅速扩大。其次，电子产品越来越广泛的移动性能，使人们随时随地享受终端产品带来的方便和乐趣。新产品和新技术为人们生活带来了便利和乐趣，激发了人们对电子类消费品的消费热情，推动电子类消费品出货量的攀升。



根据美国消费电子协会数据，金融危机之后，全球消费电子行业销售额呈现稳步增长。从 2009 年的 6,810 亿美元，增长至 2013 年 1.07 万亿美元，创历史新高。近年来以中国为主的亚洲发展中国家取代北美，成为全球最大消费电子市场。全球消费电子行业仍将继续向前发展，预计销售额继续增长。

电子消费品市场中，智能手机和平板电脑因其智能化、社交化、融合化、便携化等特点已成为增长速度最快的产品之一。根据 Gartner 的统计，2013 年智能手机占全球手机市场份额的 53.60%，出货量由 2009 年的 1.75 亿台增长至 2013 年的 9.68 亿台，年复合增长率高达 53.36%。随着低价智能手机在新兴市场国家的普及，功能手机市场份额进一步萎缩。2013 年智能手机出货量首次超过功能手机。

全球手机出货量（亿台）



资料来源：Prismark、Gartner

在市场分布方面，新兴市场成为推动智能手机市场快速增长的主要动力来源。根据 IDC 的统计，2013 年智能手机在亚太、拉美、中东和非洲地区的出货量达到 6.77 亿台，占全球智能手机出货量比例超过 60%。且 IDC 预测，2013-2017

年亚太地区智能手机出货量年复合增长率将达到 23.2%，拉美地区达到 23.7%，中东和非洲地区达到 18.5%，远高于美国和欧洲市场。新兴市场的迅速崛起，为上游封装基板生产厂商提供了更为广阔的增长空间。

在智能手机市场，苹果和三星表现突出，中国本土厂商增长显著。Gartner 对 2013 年的数据分析显示，三星在 2013 年全球智能手机市场中排名第一位，智能手机出货量为 2.99 亿台；苹果排名第二，智能手机出货量为 1.51 亿台。同时，随着智能手机在新兴市场的渗透，以华为、联想为代表的本土手机厂商在 2013 年也进入了全球智能手机出货量的前五位。这些厂商在终端市场强劲的销售增长，能够为其供应链上的封装基板厂商提供生存、发展的动力。

主要手机厂商智能手机出货量

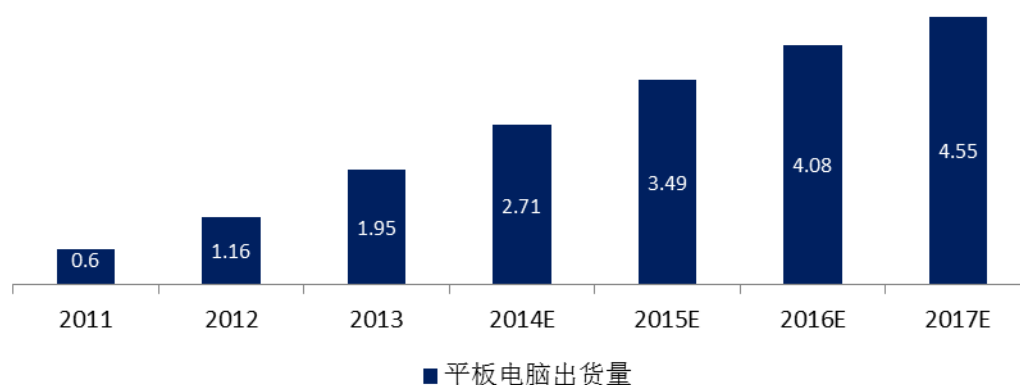
单位：亿台

品牌	2013 年	2012 年
三星	2.99	2.06
苹果	1.51	1.30
华为	0.47	0.27
LG	0.46	0.26
联想	0.44	0.22

资料来源：Gartner

平板电脑市场是高速发展的新兴市场。自从 2010 年 6 月份苹果率先发布 iPad 之后，这种在形式上兼顾了笔记本性能和手机便携的新型电脑就迅速在世界范围内流行。随后，包括惠普、戴尔、三星、联想等国内外厂商纷纷跟进。2011 年、2012 年和 2013 年全球平板电脑出货量为 6,000 万台、1.16 亿台和 1.95 亿台。2013 年苹果平板电脑出货量为 7,040.02 万台，位居第一；三星平板电脑出货量为 3,741.19 万台，位居第二。

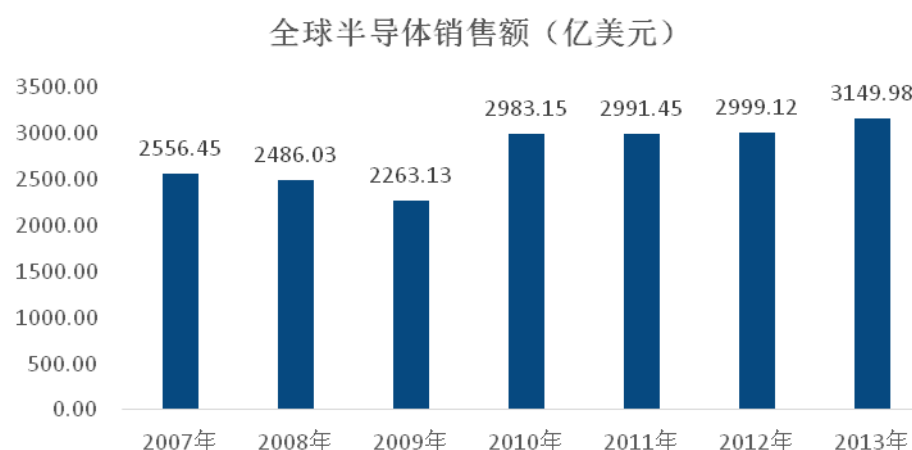
平板电脑出货量（亿台）



资料来源：Gartner、IDC

②IC 厂商的发展直接促进行业需求增长

首先，终端产品市场的蓬勃发展，增加了其产业链上芯片厂商的出货量。同时，随着电子产品功能的不断拓展与融合，单位产品对部分 IC 的需求量相应增加。以功率放大器为例，高阶智能手机从 2G 向 3G 和 4G 转换，需要额外的功率放大器和接收器来支持新的频段。一支手机从只需要 1 个功率放大器芯片发展为需要多个独立的功率放大器芯片来支持不同代(2G、3G 或 4G)的通讯系统，使得无线射频模块市场空间迅速增大。以高通 (Qualcomm) 为例，它作为有线和无线通讯领域的半导体方案供应商，2013 年实现销售收入 248.7 亿美元，2007 年至 2013 年销售收入年均复合增长率达到 18.75%。



资料来源：Gartner

其次，芯片市场已形成寡头垄断的竞争结构，每个芯片厂商对上游供应商而言都意味着较大的市场需求。根据 IHS 对 2012 年全球半导体厂商的销售收入排名，前二十大半导体厂商共占 64.77% 的市场份额。英特尔 (Intel)、三星电子 (Samsung Electronics)、高通 (Qualcomm)、德州仪器 (Texas Instruments)、东芝 (Toshiba) 是这个细分行业中前五大供应商。

在公司目前主要下游客户所在的无线射频模块芯片领域，根据 Gartner 发布的 2011 年手机无线射频模块芯片供应商销售收入排名，思佳讯 (Skyworks)、威讯联合半导体 (RFMD)、高通 (Qualcomm)、三胞半导体 (TriQuint Semiconductor)、意法半导体 (ST Microelectronics)、英特尔 (Intel) 和安华高科技 (Avago) 是这个细分行业中的前七大供应商，其市场份额合计超过 70%。

电子产品朝便携式和小型化、网络化和多媒体化转换，促使模拟集成电路朝高精度、低功耗、小封装方向发展，数字集成电路向更快、更复杂、更高集成度的方向演变，推动封装基板朝着具备更小的线宽线距、更密集的导通孔、

更具有弹性的产品设计和更高的性能发展。为了满足终端电子消费品对集成电路更高性能、更小尺寸的要求，IDM 厂商和 IC 设计厂商与封装基板厂商相互之间的配合越来越密切，协同度也越来越高。它们利用新兴封装基板供应商的技术优势和研发实力，突破传统封装基板工艺瓶颈给芯片设计方案造成的种种限制，共同开发出新的解决方案，协助改善集成电路设计方案，优化产品性能。

（2）市场供给变化及其原因

Prismark 的报告显示，2012 年全球刚性有机 IC 封装基板出货量为 **392.98** 亿颗，实现销售收入 83.13 亿美元。Prismark 预测 2017 年全球刚性有机 IC 封装基板出货量为 530.42 亿颗，销售收入达 92.30 亿美元。

从单个产品的市场供给来看，在过去的六年间，在模拟芯片封装基板领域，RF Module 封装基板增长速度最快，2012 年出货量和销售收入分别为 39.60 亿颗和 3.25 亿美元，2006 至 2012 年间销售收入年复合增长率为 6.43%。预计 2017 年出货量将达到 62.90 亿颗。数字芯片封装基板领域，FCCSP 因主要用于高阶智能手机的基带及应用处理器芯片而增长较快。2012 年 FCCSP 的出货量和销售收入分别为 25.14 亿颗和 13.79 亿美元，2006 至 2012 年销售收入年复合增长率为 22.67%。预计 2017 年出货量和销售收入将分别达到 62.83 亿颗和 21.99 亿美元。

全球刚性有机 IC 封装基板出货量

单位：亿颗

时间	FCBGA/LGA/ PGA	WBBGA	WBCSP	FCCSP	RF Module	其他
2012 年	12.42	10.45	142.42	25.14	39.60	162.93
2017 年（E）	15.03	8.65	202.56	62.83	62.90	178.45
预计年复合增长率（2012-2017）	3.89%	-3.71%	7.30%	20.10%	9.70%	1.84%

资料来源：Prismark

未来封装基板市场供给变化及其原因如下：

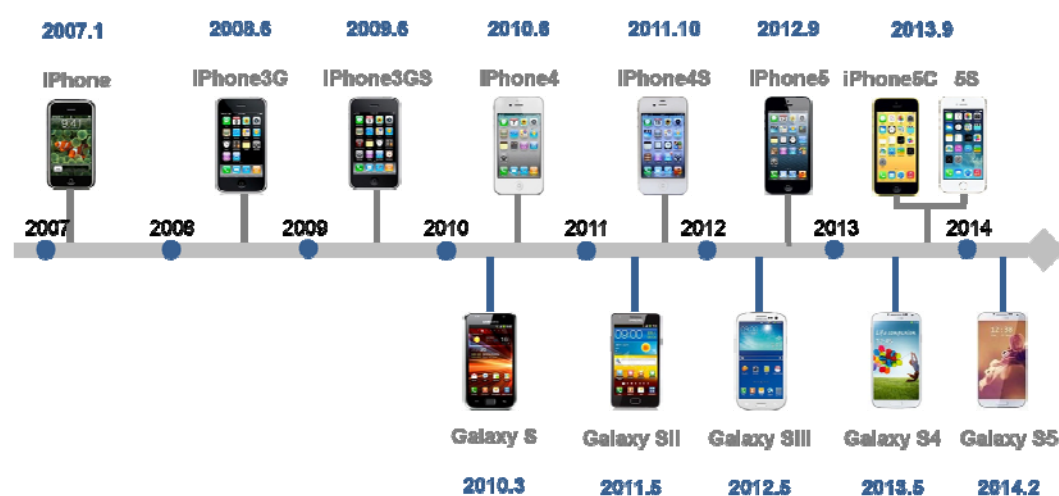
①满足终端产品对刚性有机 IC 封装基板尺寸和性能提出的新需求

为实现电子产品的小型轻便化和功能集成化，封装基板需要向高密度、高脚位、薄型化和低成本转变。一方面，行业内的厂商将通过革新技术、使用新材料的方式实现基板性能的提高和尺寸减小。无芯封装基板应用是其中一种解决方案，但目前只有少数厂商掌握了此种生产技术并实现量产，尚未完全满足市场需求。

另一方面，为了适应终端产品价格下行的趋势，封装基板厂商通过提高劳动力效率和自动化程度两种方式降低生产成本。由于生产线设计的差异，劳动力驱动型厂商通过向劳动力成本低廉的国家设厂转移产能，增强对员工的培训以提高工作效率，降低生产成本；自动化程度较高的厂商则通过提高自动化水平、优化生产流程、减少人工操作的生产环节从而实现雇佣工人人数最小化来降低成本。随着发展中国家人力成本的提高，逐步提高自动化程度已成为各企业新建产能时的重要选择。

②满足不断缩短的产品生命周期对刚性有机 IC 封装基板持续创新的需求

终端电子消费产品生命周期短，更新速度快。以智能手机为例，苹果约每 12 个月就会推出新一代的 iPhone 手机，三星高端智能手机 Galaxy 系列约每 12 个月会有新一代产品问世，每 2 至 3 个月则会推出升级的新产品，这便需要产业链上的供应商及时提供新产品来支持终端产品的更新换代。为了顺应市场变化趋势，获得更多的订单，封装基板厂商需要较强的市场前瞻和研发创新能力，加快产品设计、不断推出符合市场需求的新产品。因而终端产品更迭迅速的行业特点对封装基板厂商的研发和生产提出了更高的要求。



资料来源：苹果、三星公开信息

4. 行业利润水平的变动趋势及变动原因

对于封装基板厂商，利润水平取决于产品价格的变动和生产成本的控制。一般而言，终端电子消费品厂商在一个产品接近生命周期尾声时，往往采取降价策略，并压低对供货商的采购价格，因此，封装基板厂商在产品推出后往往面临价格持续下降的趋势。同时，保持较高且稳定的产品良率是封装基板厂商成本控制的主要手段之一。较低的良率会增加产品的生产成本，从而降低企业利润率。

持续创新并不断推出能够响应市场的新产品是行业内厂商维持高毛利率的关键。终端消费电子产品的升级或新品问世，将对包括封装基板厂商在内的供应链提出新的需求。封装基板厂商通过持续研究开发和技术创新，生产出与芯片设计方案相契合的新产品，快速实现量产，并以较高的价格销售，才能获取更高的利润。因而掌握核心技术、不断研发创新、市场反应迅速的厂商有望将毛利率保持在较高水平。

5. 行业进入的主要障碍

（1）技术壁垒

首先，刚性有机 IC 封装基板行业属于资金和技术密集型行业，其产品生产需要先进的技术、复杂的制程和精密的生产工艺，目前，封装基板已成为芯片设计中不可缺少的一部分，行业内厂商需在生产过程中与客户密切合作，运用自身的技术实力向客户提供与其设计方案契合度最高的封装解决方案及产品。其次，封装基板直接与芯片相连，产品尺寸较小、精密度较高，生产过程和品质控制较为严格，产品量产过程中包含企业丰富的技术诀窍。最后，封装基板行业终端产品更新换代周期缩短，产品功能日益复杂，对封装基板的技术升级水平和速度提出了更高的要求。

（2）人才壁垒

首先，行业的技术不断创新，需要大量优秀的研发和技术人才，以保持企业的持续研发能力和自主创新能力；其次，该行业面对的市场变化快，产品不断更新换代，需要反应敏锐的销售人员和管理人员；同时产品的生产制造还需要大批经验丰富的熟练工人。这些人才的培养和积累需要一定的时间，因此本行业对于新进入者，具有一定的人才壁垒。

（3）资金壁垒

封装基板生产制造需要大量的设备投资，且关键环节的设备金额较大，大多需要从发达国家进口，资金需求量高。下游客户在对封装基板厂商进行认证时，产能是其考核供应商的重要指标。如果产能增加与销售增长、回笼资金不能实现较好的匹配，将会给厂商带来较大的资金压力。因此，设备上的高投资门槛将对新进入者构成一定的障碍。

（4）市场壁垒

封装基板产品具有典型的多品种、多批次、非标准化等特点，往往需要配合下游客户的设计方案进行产品调整，因此下游客户对供应商会严格筛选和认证，时间往往长达 1 年甚至以上。若封装基板厂商提供的产品能持续达到其技

术、良率、交货期等要求，下游客户倾向于与其达成长期稳定的合作关系，不会轻易更换供应商。因此对于新进入本行业的竞争对手而言，很难快速打开市场，面临一定的市场壁垒。

（四）影响行业发展的有利因素和不利因素

1. 有利因素

（1）国家产业政策大力支持

IC 封装基板是 IC 封装测试的关键材料，属于国家行业政策鼓励和支持发展的领域。我国集成电路产业销售收入从 2001 年的 199 亿元，提高到 2012 年的 2,158.50 亿元，2001 年至 2012 年销售收入年复合增长率为 24.20%，已成为全球集成电路产业增长最快的地区之一。但我国集成电路产业对外依存度较高，自主供应能力不足，持续创新能力亟待加强。

我国目前刚性有机 IC 封装基板企业主要为外资在国内投资设立的工厂。早在 2005 年，我国已将 IC 封装基板的研究列入 863 计划。国家发改委颁布的《电子信息产业技术进步和技术改造投资方向》进一步载明，电子基础产品等 7 个领域是电子信息产业技术进步和技术改造投资的主要方向，其中重点支持高密度互联多层印制电路板、多层挠性板、刚挠印制电路板、IC 封装基板、特种印制电路板等材料的发展。国家出台了《国家“十二五”科学和技术发展规划》、《“十二五”国家战略性新兴产业发展规划》等推动集成电路及其相关产业发展的政策。预期未来国家还将出台更多针对集成电路产业的优惠政策，这将会为我国集成电路的快速增长提供更好的外部环境。

（2）下游需求和市场空间广阔

全球正处于一个新技术、新产业加快孕育、融合的时代。以物联网、云计算、移动互联网为主要标志的新一代信息技术风起云涌，推动了全球消费电子产业的快速发展。2013 年全球消费电子市场规模已达 1.1 万亿美元，其中智能手机和平板电脑是增长速度最快的产品之一。手机、电脑、电视、数码相机、游戏机等消费电子产品不断推陈出新，为封装基板等电子元器件的快速增长提供了广阔的市场空间。下游市场需求量的不断增长以及单位产品对电子元器件需求量的提高，推动着封装基板行业的发展。能够紧跟市场步伐进行技术革新并快速实现新品量产的厂商，有望在市场需求发生变化时抓住新的市场机遇，实现更好的发展。

（3）电子产品功能融合和微型化发展给高端封装基板带来机遇

多领域的消费电子产品融合为一或某一类产品的跨界发展日趋明显。以手机为例，它在取代 PDA 掌上电脑的同时又在不断融合数码相机、GPS、MP3 播放器等产品的功能，逐步形成了“掌上智能终端”。消费类电子产品的跨界融合依托于半导体产业的基础设计和制造工艺水平，需要其内部芯片的多功能化和高集成度，进而对封装工艺和封装材料提出更高要求。同时，体积微型化已成为消费电子产品的发展趋势。更轻、更薄、更加小巧的电子产品工业设计需求要求电子元器件在设计制造过程中都应做出相应贡献。随着封装技术的发展，封装体的尺寸在不断缩小、封装密度在不断提高，不断向微型化和更高性能化发展，从而对高端封装基板提出越来越高的要求。在成本可控的范围内，高端封装基板厂商将面临消费电子产品微型化发展带来的市场机遇。

（4）产业转移和产业升级

全球 IC 产业已具有较为完整的国际分工体系。封装测试是全球半导体企业最早向中国转移的一环，近几年来快速成长，已成为中国半导体产业的主体，占据我国集成电路产业总产值的 70%。随着中国封装测试行业的蓬勃发展，全球封装基板产能逐步向中国转移，中国封装基板企业开始起步，面临着良好的发展机遇。

2. 不利因素

（1）全球经济增速放缓

在经历金融危机和欧债危机的影响之后，美国经济处于恢复后的缓慢增长期，欧元区经济体依然难以摆脱萧条，亚洲发展中国家经济增速开始低于过去几年的高速增长率并逐渐趋缓，全球经济 2013 年增速开始降低。根据国际货币基金组织 IMF 的数据显示，2013 年全球 GDP 增速为 2.39%，美国 GDP 增速为 2.78%，欧元区 GDP 下降 0.46%，亚洲发展中国家 GDP 增速为 6.51%。欧美市场不再延续之前的高消费的状态，亚洲市场的需求成为世界关注的焦点。据 Gartner 统计，2013 年全球半导体市场规模较上年增长 5.03%，相对 2012 年有所好转。

（2）下游厂商压低价格，上游原材料成本波动

本行业的终端产品是平板电脑、手机、数码相机等消费电子类产品。压低销售价格以抢夺市场份额已成为消费电子终端企业常规的竞争策略之一。下游终端产品的降价压力会向供应链传导，对封装基板厂商的毛利率有不利影响。

另一方面，上游原材料的价格波动也影响封装基板行业的成本。如金盐占本行业原材料成本比例较高，其价格的波动性较大，目前没有合适的替代品，因此金盐等原材料价格波动对行业存在一定的不利影响。

（3）人力资源短缺

封装基板的研发、生产和管理中涉及多种技术的综合应用，要求一批具有丰富工作经验和专业技能的专业技术人员，他们在产品制造和客户服务过程中承担着至关重要的作用。同时，随着我国制造业的深入发展和社会的全面进步，人力成本进一步提高，制造业工人逐步进入了短缺的状态。人力资源的结构性短缺和周期性短缺对行业内企业发展形成一定的制约因素。

（五）行业的主要特征

1. 行业的技术水平及发展方向

封装基板技术的演变主要随着封装技术的发展而发展，并与终端电子消费品的技术革新密切相关。消费电子产品朝便携式和小型化、网络化和多媒体化的发展趋势推动封装基板一方面向高密度、薄型化、低成本化逐渐发展，一方面向更高电热性能转变。

（1）行业的技术水平

刚性有机 IC 封装基板的结构日益复杂和精密是行业技术水平不断发展的体现，主要表现在层数、线宽/线距、孔直径等多个方面。以 RF Module 封装基板和 FCCSP 封装基板的相应指标为例，具体如下：

①RF Module 封装基板产品的技术发展

RF Module 的产品结构已从有芯封装基板为主导地位，发展到无芯封装基板市场份额持续提高，层数由之前的 4 层及以下，发展到 7 层甚至更高层数。体现设计复杂程度的线路图形密度目前已发展到 30/30 μm 线宽/线距的量产化水平，预计将进一步向精细化发展。孔尺寸也在近几年从 100 μm 以上发展到目前 70 μm ，预计将进一步缩小到 50 μm 。

RF Module 封装基板技术发展历程					
项目	2010 年 及以前	2011 年	2012 年	2013 年	2014 年
结构	有芯板占主导地位，个别无芯板技术厂家投入大批量生产	有芯板主导地位，有芯板厂商开拓无芯板产品	有芯板占主导地位，无芯板技术进一步发展	有芯板存在，无芯板技术进一步发展	有芯板存在，无芯板技术进一步发展
堆积层线宽线距 (μm)	>50/50	50/50	40/40	30/30	20/20

堆积层孔直径 (μm)	>100	100	80	70	50

资料来源：公司自行整理

②FCCSP 产品的技术发展

倒装封装基板的产品结构更加丰富，出现了高达 18 层的无芯封装基板，堆积层和芯板层的线宽线距及孔直径都不断缩小。目前，FCCSP 封装基板的堆积层线宽线距为 15 - 20 μm 、孔直径为 50 - 60 μm ，芯板层的线宽线距和孔直径相对于堆积层会受到更多限制。预计未来堆积层的线宽线距和孔直径还会进一步缩小，而芯板层的线宽线距和孔直径则将通过无芯封装基板技术获得改善。

FCCSP 封装基板技术发展历程					
项目	2010 年 及以前	2011 年	2012 年	2013 年	2014 年
结构	有芯板占主导地位，无芯板技术开发	有芯板占主导地位，无芯板技术开始开发	有芯板主导，无芯板技术个别厂家开始试产	有芯板存在，无芯板技术进一步发展	有芯板存在，无芯板技术进一步发展
堆积层线宽线距 (μm)	>30/30	25/25	20/20	20/20	12/12
堆积层孔直径 (μm)	>70	70	60	60	50

资料来源：公司自行整理

(2) 行业的技术实现方式及技术发展方向

①无芯封装基板制造法、有芯半固化片积层法及树脂积层法的比较

目前刚性有机 IC 封装基板主要制造技术可分为三种：有芯半固化片积层法（Prepreg Type Build-Up Substrate）、树脂积层法（ABF Type Build-Up Substrate）和无芯封装基板制造方法。有芯半固化片积层法和树脂积层法作为传统封装基板技术，采用芯板作为起始层，叠加树脂（ABF）或半固化片进行增层，这种方式能够通过厚芯板获得较好的机械支撑性能，但所产封装基板相对较厚，很难实现奇数层结构，同时在实现更小线宽线距、更灵活的线路设计等方面存在瓶颈。

随着市场对封装基板的物理性能、热性能和电气性能不断提出更高的要求，封装基板制造商不断寻求更好的封装基板解决方案，无芯封装基板技术成为了其研究方向之一。无芯封装基板没有芯板层，每一层均采用含纤维树脂布作为绝缘材料，既能制作精细线路，又具有良好的机械性能。封装基板厂商很

早就开始了无芯封装基板技术的研究，但仅少数厂商实现了量产。目前，行业内厂商继续推动对无芯封装基板的产业化进程。

以下表格为三种技术特点的对比：

项目	树脂积层法	有芯半固化片积层法	无芯封装基板制造法
图例			
层数	2, 4, 6 等偶数层	2, 4, 6 等偶数层	奇/偶任意层数，如 1,2,3,4,5,6,7 层
板厚度	较厚的芯板层，总体封装基板较厚	较薄的芯板层，总体封装基板较厚	无芯板层，能实现总厚度更薄封装基板
线宽/线距设计	芯板层需要设计更宽的线宽，限制了线路图形精细化，限制了封装基板尺寸的微型化	芯板层需要设计更宽的线宽，限制了线路图形精细化，限制了封装基板尺寸的微型化	因为没有芯板层，每层线路都可以设计为精细线路，可实现微型化的封装基板
孔尺寸设计	芯板层需要设计更大的机械/激光钻孔，限制了钻孔层精细化，限制了封装基板尺寸的微型化	芯板层需要设计更大的机械/激光钻孔，限制了钻孔层精细化，限制了封装基板尺寸的微型化	因为没有芯板层，每层孔都可以设计成微小孔，可实现微型化的封装基板
成本	因为芯板层的存在，限制了产品尺寸微型化，从而限制了单位面积的成本的下降空间。	因为芯板层的存在，限制了产品尺寸微型化，从而限制了单位面积的成本的下降空间	通过每层都采用相同的设计准则（线宽/孔尺寸），可减低封装基板尺寸或层数，在同等面积的材料下制作更多的单个产品

资料来源：公司自行整理

② “铜柱法”技术与“激光/机械钻孔”技术的比较

目前，行业中制作封装基板导通孔的方式可分为“铜柱法”和“激光/机械钻孔”两种方法。“激光/机械钻孔”方式需钻孔后再对所钻孔进行金属化的方式形成导通孔。这种方式一方面由于需要“逐孔制作”，耗费时间和成本，一方面由于孔直径较大而限制了布线空间，另外，因为孔壁粗糙，高频信号容易衰减。因此行业内的企业不断研发新技术、改善制作工艺，出现了例如“铜柱法”的新兴技术，铜柱技术可以推动孔尺寸进一步缩小，孔的尺寸和形状也不受限制，并可通过一次曝光及电镀形成所有的孔，在未来封装基板孔数更多的情况下获得成本优势。封装基板工艺技术不断推陈出新，使导通孔微小化、导线精细化，性能更为理想的封装基板产品逐渐发展和成熟。

目前，部分厂商通过“激光/机械钻孔”方式实现无芯封装基板，但在孔直径大小和制作成本等方面较“铜柱法”制造无芯封装基板存在限制。

参数	铜柱法	激光/机械钻孔
孔制作	铜柱法	激光/机械钻孔技术
孔直径	实现最小 50 μ m 孔量产,已开发进一步减小到 40 μ m	>50 μ m
孔数与成本	孔数增加单位成本不变	孔数增加成本上升
孔形状	任意形状	只是圆形
孔堆叠	多种直径/形状孔堆叠	孔堆叠

资料来源：公司自行整理

2. 行业特有的经营模式

集成电路产业链分工严密、细致，并逐步向高度专业化转化。随着高科技电子产品的发展和芯片厂商不断提出的新需求，封装基板厂商已逐步发展为按需生产的订单模式，且要求有强大的研发创新能力支撑，为芯片客户提供封装基板和互连解决方案。

在具体订单取得上，受芯片厂商的经营模式不同而存在区别：第一种为直接向 IC 厂商提供封装基板，第二种为向与 IC 厂商合作的封装测试厂商提供封装基板。

这两种模式本质上都由芯片设计方主导，封装基板厂商提供满足芯片设计方案的封装基板解决方案和产品。

3. 行业的周期性、区域性、季节性特征

（1）行业的周期性

从整个半导体行业来看，每 4 到 5 年会经历一次周期。在市场需求疲软时，半导体厂商会减少资本支出，削减产能，半导体产业步入下行周期；而在市场需求强劲时，半导体厂商就会增加资本支出，增加产能，半导体产业进入上升周期。

封装基板行业的波动周期与半导体行业周期相似，并受到全球消费电子产品更新换代周期的影响。从苹果及三星等厂商发布新产品的节奏来看，单款智能便携式无线通讯产品（包括手机、平板电脑等）的一般销售生命周期为 24 个月，最初的 10 个月左右是需求旺盛期，随后步入衰退期，而平均每 12 个月都会有一款新产品问世，因此电子类消费品及相应的封装基板产品呈 10-12 个月的波动周期。为了保证需求的稳定性，封装基板厂商通常在量产一款产品的同时，着手制作下两代的产品。

（2）行业的区域性

目前刚性有机 IC 封装基板制造业主要集中在日本、韩国和中国台湾，根据 Prismark 的统计，这些国家或地区的封装基板产能占全球总产能的比例接近 90%。近些年来，随着国外封装基板制造企业陆续在中国大陆开设工厂、转移产能，带动本土封装基板企业发展。但中国大陆所占市场份额较小。未来随着中国封装产业的逐步升级，中国本土的封装基板制造企业有望得到进一步发展。

（3）行业的季节性

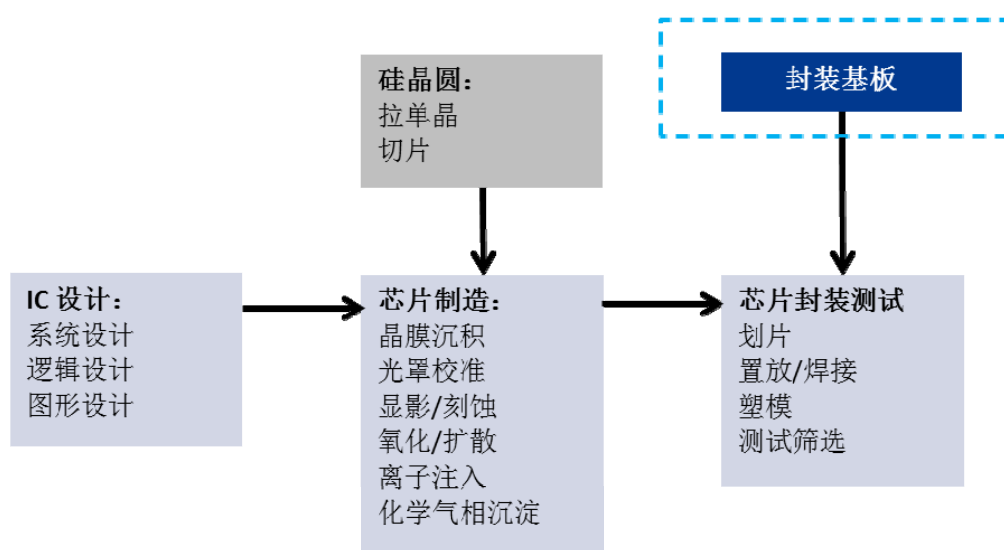
封装基板出货量受终端电子类消费产品市场需求的季节性需求影响，呈季节性波动。由于欧美的圣诞节、感恩节，中国的元旦和春节是消费旺季，电子类消费品厂商通常会提前在第三、四季度加大采购量进行备货，并在节日前夕推出新产品以刺激人们新的消费需求。对于封装基板厂商而言，通常第一、第二季度是行业淡季，第三、第四季度则是行业旺季。

4. 与上下游行业之间的关联性

（1）上下游行业的界定

IC 封装基板位于集成电路产业链中。集成电路产业链具体包括 IC 设计业、晶圆制造业及 IC 封装测试业三个子产业群。IC 设计是指运用专业的逻辑和电路设计技术设计集成电路的过程，晶圆制造是指制造独立的晶圆的过程，IC 封装测试是指将通过测试的晶圆封装得到独立芯片的过程。封装基板是集成电路封装测试中极为重要的封装材料，性能良好的封装基板和精密的集成电路封装制程是集成电路功能得到充分发挥的必要条件。

集成电路（IC）产业链示意图



①本行业的上游行业

电子材料制造行业为本公司所处行业的上游行业。本行业的主要原材料包括各种型号的铜箔、干膜、半固化片以及各种功能的药水和化学材料，如铜光亮剂、碱性蚀刻液、金盐、油墨等等。总体上呈现种类繁多、市场供应充足的特点。

本行业的另一个主要上游行业为专业设备供应商，拥有专业的设备是封装基板精密制造的基础，设备的先进性、稳定性对本行业产品有直接的影响。近几年通过技术引进和消化吸收，国内该行业也形成了一批具有一定规模和实力的制造厂家，能够在一定程度上满足本行业的部分通用工艺流程需求，但对于高端的设备仍主要依赖进口设备。

②本行业的下游行业

IC 厂商和封装测试厂商是公司所处行业的下游行业。IC 厂商对封装基板供应商提出需求，封装基板厂商向其提供封装基板技术解决方案和测试样板，样板通过测试后，IC 厂商则直接或通过其合作封装测试厂商对封装基板厂商进行采购，随后由 IC 厂商或其合作封装测试厂商进行集成电路封装、测试，最后销售给电子整机产品生产企业。



(2) 与上下游行业的关联性

封装基板行业与上、下游行业的关联密切，一方面，需要上游行业的配套完善，保证原物料和设备及时供应；另一方面，封装基板生产模式属于订单式生产，由于终端产品更新换代周期加快，封装基板厂商需贴近客户需求，不断开发新产品，满足下游 IC 设计厂商对技术革新和产品交货期限缩短的要求。

5. 主要产品进口国的有关政策、贸易摩擦对进口产品的影响以及进口国同类产品的竞争格局

(1) 主要产品进口国的有关进口政策、贸易摩擦对进口产品的影响

公司产品主要出口到韩国、马来西亚、中国香港等国家或地区。集成电路行业是各国政府重点扶持的国家战略性产业，通过重大战略规划和政策予以支

持，对贸易实施保护政策。随着我国经济发展，对外贸易活动的增加，贸易摩擦也随之增多，但我国的贸易摩擦主要体现在轻工、纺织、机电和钢铁等劳动密集型产品上，大多数为反倾销类贸易摩擦。而发行人所处行业为资金和技术密集型行业，根据产品成本、技术水平和全球市场供需情况进行定价，因此尚未受到贸易摩擦的影响。

（2）进口国同类产品的竞争格局

世界范围内，IC 封装基板厂商主要有十几家，主要分布在韩国、日本、中国台湾等国家或地区，这些厂商在全球范围内展开竞争。

三、发行人在行业中的竞争地位

（一）发行人的竞争优势

1. 独特的产品与技术优势

公司基于自身的发明专利和多项专有技术，实现了刚性有机无芯 IC 封装基板的产业化，其产品不仅能够满足封装基板高性能和微型化的需求，同时利用铜柱法制作导通孔区别于其他无芯封装基板制造技术，使公司具备较好的差异化竞争优势。

（1）无芯封装基板能够满足高性能和微型化的需求

本公司研发生产的无芯封装基板具备以下技术和产品优势：

①双面增层技术优势

随着芯片的输入输出间距、晶体管以及线路连接布局越来越精密，现代芯片需要非常平整的封装基板来保证封装的可靠性。某些采用单边增层方式的无芯基板技术会产生不平衡的结构，不利于封装基板的板翘控制。同时，单边增层会因增加了生产步骤和材料消耗而增加制造成本。因此采用双边增层法是解决板翘问题的有效途径。公司掌握了双边增层技术，能够同时在生产板的上下两面增层，从而生产更平整的无芯封装基板产品。

②超薄无芯封装基板的优势

为了满足手机通讯及其他应用设备微型化对封装形式越来越薄的需求，以及解决封装基板厚度高造成集成电路封装体电感和热阻大，降低芯片整体性能表现的问题，封装基板不断向薄形化发展。传统有芯封装基板厂商只能通过缩减芯板层/堆积层的厚度来减小总厚度，而公司在生产过程中使用薄铜板为支撑

载体，该载体在后续生产过程中将被消除或分离，因此封装基板中没有芯板，厚度更薄。

③精细线路和精细间距的优势

对于传统厂商，堆积层和芯板层需要采用不同的设计标准制作导通孔。由于芯板层厚度较厚，需要采用机械/激光钻孔方式，且芯板层主要采用电解铜箔作为种子层，因此必须采用较大的钻孔尺寸和线路图形的线宽线距，从而影响了线路的精细程度。而公司采用无芯板的技术路径，每层都遵循相同设计准则，实现微小导通孔及精细图形，确保了封装基板的微型化。

（2）采用铜柱法制作导通孔

导通孔是实现内层电路连接的金属化孔，它为封装基板 Z 轴提供电子通路。传统的封装基板厂商采用芯板层激光/机械钻孔、堆积层激光钻孔后用电镀技术金属填孔的工艺制作导通孔。而公司采用其专利技术“铜柱法”来实现导通孔。发行人拥有两个制造“铜柱”的方法，一种是通过光刻胶材料选择性曝光显影实现图形，并进行电镀；另一种为通过金属喷溅技术和/或电镀铜形成连续铜层，并通过蚀刻多余的材料剩下直立的“铜柱”。目前，公司主要运用第一种方法。

①实现更小孔径的优势

传统厂商的“钻孔、填孔”技术由于对钻孔的孔径有最小尺寸的限制，因而限制了孔盘的尺寸以及焊盘间的布线空间，并最终限制了产品的微型化。而珠海越亚的“铜柱”技术可以在更小的孔盘上制作更小孔径的孔，从而留出更多的布线空间，以实现精细线路。目前公司实现的量产产品的最小孔径为 50 μm ，处于行业前列，并具备进一步缩小的潜力。

②孔壁光滑且垂直从而减少信号衰减的优势

在绝缘层上进行钻孔时，由于绝缘层材料通常都是由聚合物、玻璃纤维以及无机填充料组成的复合材料。在激光钻孔消融过程中，不同成分的材料对激光能量的吸收程度不同，因此导致所钻孔的孔壁表面粗糙。另外，激光所钻孔为孔顶大孔底小的锥形孔。这两个因素影响了封装基板可靠性和电气噪声性能。而公司“铜柱”技术通过在同质的可曝光显影感光材料上形成图形来实现“孔”，因此不受限于绝缘层的物理性质。同时，“铜柱”在感光材料的开窗图形内形成，形状复制感光材料上的开窗图形形状，能够获得孔壁光滑且垂直度高的孔，因此较钻孔技术实现的孔，具备在高频信号下更低电感系数，更少信号衰减（集肤效应 Skin effect）的优势。

③生产高端产品时具备较低成本的优势

高级的集成电路设计要求封装基板具备更多的层数，每层拥有更多的导通孔，以达到更密集的线路图形和更多的功能整合。传统的“钻孔、填孔”技术由于每个孔都是独立制作，且因每次只能加工一个钻孔，提高了单位成本并减慢了制造速度。越复杂的封装基板就需要越长的制造时间，因此阻碍了封装基板功能的进一步整合。公司采用“铜柱法”能够同时制作大量的孔，减少了制作时间，并在未来封装基板需要更多更密的导通孔时，具备较强的成本优势。

④通过不同规格的导通孔提高产品散热能力的优势

新一代集成电路设计要求更高的运行速度和频率，因而增加了能量消耗，产生了更多需要扩散的热量。封装基板是把集成电路芯片产生的热量扩散到印刷电路板（PCB）上的主要途径。传统的钻孔技术只能制作圆形孔，且每层的钻孔直径大小接近，否则在对孔进行电镀后就会出现电镀不均匀，孔径大的孔顶部出现小凹陷的问题。如果采用“超额电镀”不同直径的孔来克服凹陷问题，则难以避免小直径孔过镀，造成填孔上方出现隆起的铜块的现象。凹陷和隆起问题都影响了下一步的孔积层，因此传统厂商为了促进热量扩散，只能采用排列大量圆形孔的方式，这些孔的制作增加了制作时间和成本并限制了客户的设计方案。而与之相反，公司采用“感光材料干膜的定型”来确定孔的形状和大小，可以在同一层上制造不同规格的孔。公司部分量产产品根据客户的需求在芯片区域下面制造方形、长方形和条状的孔来提高散热能力，确保了高散热性和客户设计方案的灵活性。

2. 研发和创新优势

公司多年以来致力于成为领先的封装基板产品和技术解决方案的提供商，通过与 IC 设计厂商密切沟通与协作，共同进行技术研发，形成“以客户为中心”的销售、研发体系，力求公司开发的产品更加符合市场需求，更容易从众多竞争者当中脱颖而出获得客户的认可。公司凭借其雄厚的研发实力，以及充足的技术储备后盾，在具有丰富经验的技术团队的带领下，公司能够对终端市场的新需求迅速反应，及时为 IC 厂商提供先进的封装基板解决方案，赢取商机。

电子类消费品更新换代的速度加快，从而对 IC 封装基板的技术革新提出了更高的要求。公司拥有无芯板技术、铜柱技术、采用半固化片在铜柱上层压的技术、化学机械抛光（CMP）磨板技术、真空喷溅（Sputtering）技术等国际先进的核心技术，并紧跟行业发展趋势，在完善现有技术的同时不断开发新技术，

进行技术储备，完善公司技术战略布局，实现现有技术水平可以达到行业后两代的技术要求，保持公司在行业内的创新优势。

为了更好地对核心技术进行保护，发行人进行专利技术战略规划，以专利群保护方法围绕核心专利进行关键技术部署和专利申请，并且注重积累生产经验和技术秘密，为发行人产品提供完善的技术保障体系。目前，公司拥有 13 项授权发明专利，分别在中国、美国、韩国以及以色列等国家或地区获得专利授权。同时，公司在世界不同国家或地区申请专利超过 70 项。

发行人致力于人才培养与技术团队的建设，拥有一支优秀的研究开发团队，主要由化学工程、微电子制造工程、应用物理、机械自动化等专业的工程师构成，他们拥有丰富的半导体行业研究与管理经验。公司实施严格研发管理制度、绩效激励制度，充分调动科研人员的积极性，为公司的快速发展奠定了良好的基础，提供了坚强的后盾。截至 2013 年 12 月 31 日，公司研发技术人员为 215 人，占全体员工的 28.18%，每年进行的研发投入占销售收入的比例平均超过 5%，有力地保证了研发创新的持续与活跃。

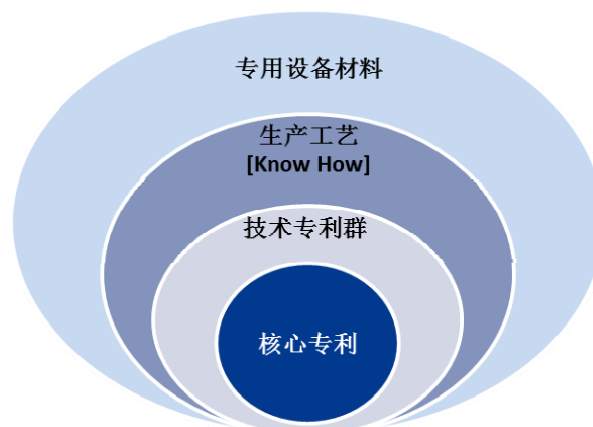
3. 生产及制造优势

发行人的核心技术决定了其生产和制造工艺。无芯封装基板技术从实验室技术转化为量产技术的过程中遇到了大量工艺瓶颈，发行人通过优化工艺流程，引进新设备并调节设备参数，不断攻克工艺难关，成功实现了无芯封装基板的量产，并实现了较好的良率。公司在技术研发和产品生产过程中积累了丰富的专有工艺技术，如通过真空喷溅（Sputtering）技术制造种子层，利用化学机械抛光（CMP）磨板技术打磨绝缘层，通过直接成像技术实现先进的层间对准，使用电镀技术制作实心铜柱等，并且使用自动化技术进行过程检测、监管及控制等。

公司的生产流程为非流水线生产，产品经关键工序进行制造并在各个工序间流转。为了防止因产品生产超过特定的时间段而产生废品，各个工艺车间的分布位置非常重要，上下工序的流转时间也需要经过严格的测算和控制。为了提高生产效率，提高产品合格率并降低生产成本，公司合理规划了厂内的工艺车间布局，并通过优化生产流程，实现了精益生产。

公司生产的无芯封装基板制程对生产设备和原材料有特定的要求，因此公司与设备供应商和原材料供应商保持着密切的沟通与合作。在与设备供应商合作方面，发行人和设备供应商共同研究开发，不断调整设备参数，解决关键工艺难题。例如：发行人引入半导体制造的金属喷溅设备制造种子层；改造显影线托板架，避免了生产过程中出现折板现象造成报废；量身定做设备软件，使

市场大众化设备能够满足公司产品的特殊检验要求等，从而提高公司产品的良品率。在与原材料供应商合作方面，公司与材料供应商共同开发适用于公司产品的新材料。



4. 人才及管理优势

公司经营管理团队由以色列、美国、马来西亚、中国台湾、中国大陆多个国家或地区的人士共同组成，具有丰富的研发、销售和生产管理经验。公司国际化的管理模式优化了人力资源配置，充分融合经营管理团队各自在技术、客户开发和服务、建厂管理、质量和成本控制等多方面的经验和优势。

公司为了吸引业界出色的专业研发人才，建立了技术中心，并设立了有效的管理办法和奖励机制，确保核心技术人员的长期稳定和关键核心技术长期保持竞争力，充分保证了合理的人才结构和充足的人才储备。

本公司已建立了完善的管理体系，并形成了一系列作业流程及操作规范，实现了各部门之间的有效沟通，保障了公司的高效运作。公司在生产经营过程的规范制度为公司探索生产经营最优配比方案提供了现实基础，有利于公司对生产流程、产品质量以及采购、销售等经营环节进行有效的控制，提升企业竞争力，降低经营成本。为了更好地进行生产管理，公司创立了生产部门小组（Business Units，以下简称 BU），通过从制造部、工艺部以及品质部分别抽取核心技术人员组合成针对不同工序的 BU 小组，对制造流程中工艺和品质的难题进行研究讨论，高效地找出问题并提出解决方案，有效地减少了产品的报废，提高了产品的良率。

5. 经验、技术积累优势

公司依托具有自主知识产权的核心技术，提供针对性的定制开发服务。报告期内公司面对的芯片厂商主要为安华高科技（Avago）和威讯联合半导体（RFMD）。IC 封装基板作为集成电路的重要封装材料，其质量和性能直接影响

整个集成电路功能的实现，因此芯片厂商会对封装基板供应商进行严格的认证，认证通常需要 1 年甚至以上的时间，而客户一旦与封装基板供应商形成稳定的合作关系后通常不会轻易变更供应商。公司长期在解决方案提供、产品周期开发、量产支持等方面提供优质产品和服务，积累了丰富的经验，为公司未来发展奠定了良好的市场基础。目前，公司已进入多个国内外知名芯片企业的客户认证程序，客户基础的扩大有利于公司业务的持续发展。同时，公司通过为这些优秀芯片厂商提供技术支持，保证了公司的技术一直处于行业的前沿。

（二）竞争劣势

封装基板行业具有规模经济性特征，适合大规模生产。公司从进行客户认证到获得量产订单需要较长的时间，而充足的产能是通过客户认证的必要条件，因此公司需提前准备产能，这将造成公司在获得量产订单前部分产能的闲置，进而影响了公司的盈利能力。同时，公司新增产能所需的设备价格昂贵，每年的运行保养、设备更新与新技术开发等都需要充足的资金支持。资金缺乏和产能利用不足是目前制约公司发展的竞争劣势。

（三）发行人在行业中的地位

基于自身核心发明专利，公司是世界首家采用“铜柱法”技术量产无芯封装基板产品的厂商和技术解决方案供应商。

公司通过 RF Module 封装基板产品切入 IC 封装基板市场并取得较好经营业绩，报告期内，RF Module 封装基板为公司主要收入和利润来源。公司产品于 2009 年获得国际知名半导体公司的认证后，迅速打开了 RF Module 封装基板市场，2010 年开始实现大规模量产，不断扩大其在全球市场中的份额，打破了日本、韩国和中国台湾厂商垄断高端封装基板的局面，实现了高端封装基板产业的本土化。

（四）竞争对手简况

在 RF Module 封装基板市场上，珠海越亚的主要竞争对手是伊诺特（LG Innotek）、欣兴电子（Unimicron）、南亚电路板（NanYa PCB）、景硕科技（Kinsus）、三星电机（SEMCO）和信泰电子（Simmtech）等。

1. 国际主要竞争对手

（1）伊诺特（LG Innotek）

伊诺特成立于 1970 年，其封装基板产品主要包括 FCBGA、FCCSP、WBPBGA 和 RF Module 封装基板等，2010 到 2011 年，其投资 1 亿美元开拓 FCCSP 产品，并成为高通的封装基板供应商。

（2）欣兴电子（Unimicron）

欣兴电子股份有限公司成立于 1990 年，中国台湾上市公司，在中国台湾、中国大陆均设有生产基地。公司生产种类齐全的封装基板，包括：WBCSP、WBBGA、FCCSP、FCBGA、PoP 和 Hybrid 等。其客户包括高通、博通、英特尔、超威半导体和英伟达等。

（3）南亚电路板（NanYa PCB）

南亚电路板股份有限公司成立于 1997 年，中国台湾上市公司，在江苏昆山市设有工厂，其封装基板产品涵盖了倒装封装基板和打线封装基板等。其封装基板产品客户包括英特尔、超威半导体、英伟达、博通和三星等。

（4）景硕科技（Kinsus）

景硕科技股份有限公司成立于 2000 年，中国台湾上市公司，其生产的封装基板产品主要包括 WBPBGA、WBCSP、EBGA、SiP、FCCSP、FCBGA、COP、COF 等。其客户包括高通、英特尔、博通等。

（5）三星电机（SEMCO）

三星电机有限公司创立于 1973 年，隶属韩国三星株式会社。其生产的 IC 封装基板产品主要包括 FCCSP、FCBGA 和 RF Module 封装基板等，是高通、三星、苹果的 FCCSP 封装基板的主要供应商。

（6）信泰电子（Simmtech）

韩国信泰电子股份有限公司成立于 1987 年，韩国上市公司，其封装基板产品主要包括 PBGA/CSP、BOC、FMC、MCP/UTCSP 及 FCCSP 等，主要客户为三星电子、Hitech 半导体、LG、摩托罗拉、SanDisk 等。

2. 国内主要竞争对手

中国大陆封装基板制造商主要为日本、韩国以及中国台湾的封装基板厂商在中国设立的生产基地，如：日月光材料、景硕科技、健鼎、美维电子。

随着中国产业结构不断的升级，国内部分厂商开始进入封装基板领域，主要包括本公司、深南电路有限公司以及深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司，深南电路有限公司及深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司主要生产印刷电路板，近年来开始进行封装基板产品的研发和生产。

四、发行人的主营业务情况

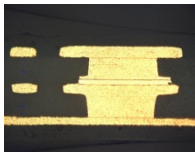
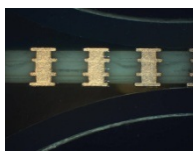
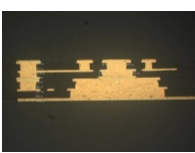
（一）发行人的主要产品及特点

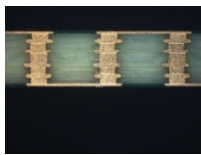
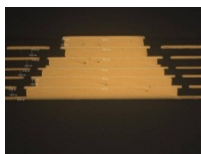
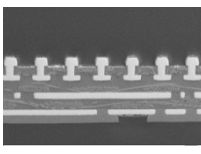
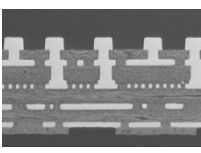
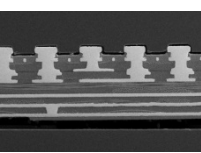
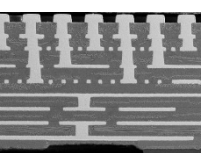
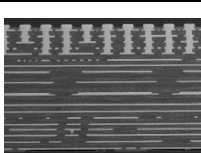
1. 主要产品

公司是世界上首家采用“铜柱”技术生产高密度无芯 IC 封装基板并实现量产的高科技企业。公司产品为采用无芯技术生产的高密度刚性有机无芯 IC 封装基板，该产品具备良好的导电性、散热性、耐热冲击性，能够较好的满足当今先进封装设计的高密度、高效低能耗需求。

RF Module 封装基板是公司目前实现大规模量产的产品，其主要应用于模拟芯片中的无线射频模块（RF Module）芯片封装领域，产品经过封装测试厂的封测后，最终运用在包括手机、平板电脑、游戏机等便携式电子类消费品上。这类产品已通过国际知名芯片企业威讯联合半导体（RFMD）、安华高科技（Avago）等客户认证，上述客户已进入苹果、三星的智能手机以及平板电脑的供应链。目前，公司主要客户为威讯联合半导体（RFMD）、安华高科技（Avago）以及与其合作的封装测试厂商。同时，公司还与其他芯片厂商和 IC 设计厂商提供样板，以支持它们进行革新芯片设计方案的研发活动，主要包括运用在模拟芯片上的 RF Module 1 层至 8 层封装基板，以及运用在数字芯片上的从 2 层至 18 层的 FCCSP、FCBGA 封装基板。公司 FC 产品已进入国内外知名芯片厂商的客户认证程序。公司无芯封装基板的销售应用领域有望得到进一步拓宽。

公司主要生产的产品情况如下：

产品类别	产品名称	类别	剖面图	产品应用领域	终端市场	投产情况
模拟芯片封装基板	无线射频模块封装基板（RF Module）	3 层		功率放大器、接收器、前端模块等	手机、平板电脑、游戏机等手持终端电子消费品	量产
		4 层				量产
		5 层				量产

产品类别	产品名称	类别	剖面图	产品应用领域	终端市场	投产情况
		6层				量产
		7层				量产
数字芯片封装基板	倒装芯片级封装基板（FCCSP）、倒装球栅阵列封装基板（FCBGA）	3层		基带芯片、应用处理器、专用集成电路（ASIC）	手机、平板电脑、游戏机、电脑、电视机等电子类消费品	样板及小规模量产
		5层				
		6层				
		9层				
		18层				

2. 产品特点

相对于传统有芯封装基板，或竞争对手采用其它生产工艺制造的无芯封装基板而言，发行人生产的产品上具备更高集成度、更薄、良好的散热性、高可靠性、稳定的信号传导性等优势，能够最大限度满足当今先进的封装设计对高密度、高效低能耗、高速度的需求。在制作工艺上不受奇偶层限制，可以生产单层至 18 层板，并拥有多种表面处理工艺技术，各层板产品可根据客户的需求运用不同的表面处理工艺。模拟芯片封装基板产品可分为电镍金、镍钯金、有机抗氧化保护（OSP）等多种表面处理工艺，数字芯片封装基板产品可采用电镍金、镍钯金、有机抗氧化保护（OSP）、沉锡、电锡和铜凸点（Bump,stamp）等多种表面处理工艺。在生产成本上，发行人采用铜柱法实现层间的导通孔，取

代传统钻孔填孔工艺的钻孔工序“逐孔制作”，在制作孔数和层数更多的封装基板时可节约制作成本。

产品优势	具体表现
更高集成度设计	实现孔尺寸量产最小50μm，已开发减小到40μm孔技术，所有层线路图形最小15/15μm，倒装（FC）产品铜凸点产品最小中心距离100μm
更薄的产品	可实现单层封装基板最小厚度50μm，总封装厚度250μm的最薄封装结构。四层板封装基板厚度，传统工艺基本在250μm以上，珠海越亚产品可实现150μm。
散热性	可以通过设计实心且任意形状的孔，可更好地把芯片产生的热量通过封装基板扩散。
高可靠性	可以承受高达5000次的液相冲击试验（-65℃到150℃）。
减少信号衰减	信号传输达到50GHZ的时候，信号衰减仅3dB。
基板层数无奇、偶数限制	可以制作传统工艺难以实现的奇数层板
没有天线效应	导通孔的孔壁垂直度好而且光滑，且线路表面光滑平整，提高信号传输的有效性而且降低了噪音影响。

（二）发行人的主要生产工艺

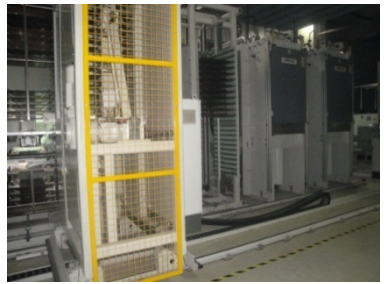
发行人生产封装基板制程复杂，工艺精密，主要包含七个关键工序及若干辅助工序，主要方式为采用铜柱法实现层间的导通孔，层压半固化片增加绝缘层，再采用磨板进行整平，随后在磨板后的表面采用真空喷溅制造种子层，并通过进一步增层生产有机无芯封装基板。

具体制程步骤如下：

- 1. 使用感光材料的曝光/显影在生产板上面形成铜柱层的图形
- 2. 采用电镀方法在感光材料的开窗形状区域电镀形成铜柱层
- 3. 采用层压方式将半固化片层压在铜柱层上
- 4. 磨板工艺把多余的绝缘材料去除，暴露出铜柱层
- 5. 在磨板后的表面真空喷溅铜层制作种子层
- 6. 使用感光材料的曝光/显影在生产板上面形成线路图形层的图形
- 7. 采用电镀方法在感光材料的开窗形状区域电镀线路图形层

后续双面增层将重复上述七个主要工序以实现更多的层数。

序号	流程	流程说明	关键设备示例

序号	流程	流程说明	关键设备示例
1	铜柱层的图形	使用感光材料的曝光/显影在生产板上形成铜柱层的图形	
2	电镀铜柱层	采用电镀方法在感光材料的开窗形状区域电镀形成铜柱层	
3	层压绝缘层	采用层压方式将半固化片层压在铜柱层上	
4	磨板	采用磨板工艺把多余的绝缘材料去除, 暴露出铜柱层	
5	真空喷溅	在磨板后的表面真空喷溅铜层制作种子层	

序号	流程	流程说明	关键设备示例
6	线路图形	使用感光材料的曝光/显影在生产板上形成线路图形层的图形	
7	线路图形电镀	采用电镀方法在感光材料的开窗形状区域电镀线路图形层	

（三）主要业务模式

1. 盈利模式

公司主要定位为 IC 封装基板产品及技术解决方案提供商，通过封装基板产品的研发、生产和销售实现盈利。即在为客户设计出封装基板解决方案后，生产出定制的封装基板产品。

公司的技术解决方案和产品可以分成两类：第一类是量产产品，主要产品是运用在模拟芯片上的有机无芯 RF Module 封装基板。公司在接到 IC 厂商提出的需求后，根据客户的需求特点进行定制化的开发，从而提供为该客户量身定做的解决方案和量产产品；第二类是样板产品，主要产品包括运用在模拟芯片上的 RF Module 封装基板样板和运用在数字芯片上的 FCCSP、FCBGA 等封装基板样板。封装基板技术解决方案是整个芯片设计方案中非常重要的一环，公司向 IC 厂商提供先进的封装基板技术解决方案，客户初步认可方案后将采购样板，并将样板用在完善整体芯片设计方案的研发活动中，并与公司密切配合，共同研究、改进样板产品。

发行人为客户提供的封装基板产品和解决方案都是在深刻理解客户个性化需求的基础上，为客户量身定做的。公司的产品均采用按订单生产的经营模式，通过与客户充分沟通，进行样板测试和不断研究调试后，寻找最有效的解决方案，生产出最符合客户需求的产品。选择能够互利互赢的国际知名半导体厂商成为公司的客户，并与其相互配合、共同发展是公司快速成长并迅速扩大

市场份额的关键。公司主要客户安华高科技（Avago）和威讯联合半导体（RFMD）是苹果、三星、诺基亚等知名品牌电子类消费品的供应商，在过去的几年内实现了较快增长。以安华高科技（Avago）为例，2009-2013年，安华高科技（Avago）的销售收入从14.84亿美元增长至25.20亿美元，年复合增长率为14.15%。

2. 采购模式

公司根据订单需求进行采购，生产所需的原材料和设备通过采购及物控部直接向国内外供应商采购。

公司采购的物料可分为计划性物料和非计划性物料，计划性物料是直接或间接用于生产的原材料、辅料和研发物料，属于常备物料，根据订单或备库计划进行例行或反复采购。这类物料统一由采购及物控部提出采购需求。非计划性物料是指除计划性物料、设备、零配件、固定资产之外的物料，是非计划性不常备物料，根据临时需求提出采购计划，原则上当月入库，当月出库，实现月进出平衡。这类物料由各职能部门提出采购需求。

物控人员根据生产计划部门提供的WIP（Works in Process，在线订单的进度情况）和市场部门提供的基于客户订单的销售预测，计算未来每周、月物料需求数量，并结合目前物料库存情况，计算制订计划性物料的采购需求计划。采购人员接收到采购需求计划后经询价、比价、议价并综合评估交货条件、付款条件等从《合格供应商名册》中选择最优的供应商进行采购。

采购回的材料经品质部IQC（Incoming quality checking，进料品质检验）进行抽检确保来料满足要求；仓库人员核对合格物料数量并完成入库；采购人员核对入库数据依据相应的账期做出付款计划；财务人员核对采购人员提供的付款计划并安排付款。

公司通过建立供应商考核机制，积极推动供应商的绩效改进，确保供应商的持续供应能力及供货品质的稳定性，降低公司成本，提升公司的竞争力。

3. 生产模式

公司生产采用“以销定产”模式。公司与客户签订订单后，严格按照订单组织生产。

市场部根据订单承接情况，下发订单；生产计划部门根据市场部提供的订单量和当前的品质合格率，编制《月生产计划》；生产计划组每天根据在线的生产进度表和生产数量，安排生产优先级，编制《日生产计划》，下发到生产部门作为公司每天组织生产的依据。物控部门根据《月生产计划》组织编制《月物料计划》，经相关责任人批准后下发。生产计划组依据市场部的《订单评审发布

表》，基于不同类型产品的合格率和交货数量，确定投料数量，并回复市场部产品交期。工程部根据订单的优先级别安排工程工具制作，完成工程工具制作后及时通知生产计划部门和市场部。制造部严格按照流程卡指示和《日生产计划》组织本工序的生产制作，并及时反馈生产流程中的各类品质异常和设备异常信息。工艺部和设备部及时根据制造部反馈的问题做出合理的解决方案，以保证生产计划的正常运转。品质部负责生产过程质量的监控，提供各类可靠性测试、出货报告及终检。

4. 销售模式

公司完成生产后直接向下单客户出货；销往国内客户的产品通过陆运或空运的内销方式进行销售；销往国外客户的产品是通过贸易报关方式空运出口。

公司提供涵盖从单层到 18 层以上，从打线技术到倒装封装技术，从模拟芯片到数字芯片领域产品，以及更细线路、更小更多形状实心铜柱导通、更多样的表面金属处理等方面的全面的产品和服务，通过一站式的产品和服务，充分满足客户对封装基板解决方案的需求。

公司除了推动上游原材料供应商提供更符合越亚 IC 封装基板技术要求及适价的材料外，更关注对下游封装厂和 IC 厂商的合作整合。公司会与目标客户 IC 厂商进行芯片和无芯封装基板优势结合的研发合作，在芯片设计前端即导入无芯封装技术的应用，然后透过 IC 厂商或具有 ODM/OEM 设计功能的封装公司，将无芯封装基板应用到芯片封装厂；公司持续结合终端产品和芯片制作技术未来的发展趋势，提前进行无芯封装基板技术的创新研发，及时在竞争对手所在地区进行知识产品产权保护，以保持技术的先进性和独特性；发挥无芯封装基板技术和设备的优势，将产品销售延伸扩展到更多可使用的芯片领域。

（四）发行人主要产品的销售情况

1. 最近 3 年公司主营业务收入情况

单位：万元

产品名称	2013 年度		2012 年度		2011 年度	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
无线射频模块封装基板	35,492.64	99.60%	48,300.78	99.95%	42,045.29	100.00%
其中：四层板	9,364.27	26.28%	9,261.23	19.17%	7,472.55	17.77%
五层板	7,034.87	19.74%	7,068.36	14.63%	11,719.05	27.87%
七层板	18,485.28	51.87%	31,385.11	64.95%	22,745.91	54.10%
其他	608.22	1.71%	586.08	1.21%	107.78	0.26%
倒装芯片级封装基板/ 倒装球栅阵列封装基板	105.54	0.30%	18.55	0.04%		
其他	36.30	0.10%	3.69	0.01%		

产品名称	2013 年度		2012 年度		2011 年度	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
主营业务收入	35,634.49	100.00%	48,323.02	100.00%	42,045.29	100.00%

2. 主要产品生产能力、实际产量及销售情况

(1) 产能及产能利用率情况

年度	产能（万面）	产出（万面）	产能利用率
2013 年	193.58	76.69	39.62%
2012 年	163.00	108.40	66.50%
2011 年	124.67	109.89	88.14%

公司的产能为瓶颈工序金属喷溅机的产能，产出是金属喷溅机有效喷溅的数量（以“面”为单位）。报告期内，公司产能利用率分别为 88.14%、66.50%和 39.62%。

2013 年公司产能利用率较低，主要原因在于：第一，智能手机、平板电脑等智能终端产品更新换代较快，2013 年，公司第一大客户安华高科技（Avago）为及时适应终端市场的不断变化，推出了新产品和技术方案，公司已通过认证的产品技术方案未能满足客户新需求，尽管公司推出了新的产品和解决方案，但未能及时通过客户认证，安华高科技（Avago）将部分订单转移至其他厂商，减少了对公司产品的采购；第二，公司其他潜在客户的技术和产品认证仍在进程中，该年度获取的新客户订单未能充分弥补安华高科技（Avago）减少的订货量；第三，为应对新客户认证的要求，并为生产新产品储备产能，公司于 2012 年进行了设备投资，部分设备于 2013 年转为固定资产，因此，2013 年产能较 2012 年有所增加。

(2) 报告期内公司产销量情况

项目	产量（万片）	销量（万片）	产销率
2013 年度	13.78	13.24	96.10%
2012 年度	16.70	16.17	96.83%
2011 年度	15.31	14.56	95.10%

(3) 销售价格的变动趋势

年度	销量（万片）	主营业务收入（万元）	销售价格（元/片）
2013	13.24	35,634.49	2,690.78
2012	16.17	48,323.02	2,988.44
2011	14.56	42,045.29	2,887.73

2011 年至 2013 年间，公司封装基板的单位平均销售价格有所波动，主要原因在于公司产品结构的变化，2012 年，单价较高的七层板销量占总销量的比重

较高，带动了平均售价的上升；2013 年，七层板销量占比有所下降，因此平均销售价格下降。

3. 发行人最近 3 年向前 5 名客户的销售情况

报告期内，公司来自前五名客户的营业收入金额具体如下：

单位：万元

序号	客户名称	2013 年销售额	占总销售额比例
1	ASE Korea	13,884.46	37.68%
2	威讯联合半导体(北京)有限公司	11,733.67	31.84%
3	Ambit microsystems corporation	3,062.64	8.31%
4	Inari Technology Sdn Bhd	1,424.78	3.87%
5	ASE Electronics(M) Sdn.Bhd	1,418.24	3.85%
合计		31,523.78	85.55%

单位：万元

序号	客户名称	2012 年销售额	占总销售额比例
1	ASE Korea	25,280.11	50.93%
2	威讯联合半导体(北京)有限公司	11,489.29	23.14%
3	Avago Technologies(Malaysia) Sdn Bhd	4,443.56	8.95%
4	Unique Logistics Limited	2,158.72	4.35%
5	Inari Technology Sdn Bhd	1,460.40	2.94%
合计		44,832.08	90.31%

单位：万元

序号	客户名称	2011 年销售额	占总销售额比例
1	ASE Korea	13,012.67	29.73%
2	威讯联合半导体(北京)有限公司	9,984.06	22.81%
3	Avago Technologies(Malaysia) Sdn Bhd	8,829.95	20.17%
4	Unique Logistics Limited	5,283.57	12.07%
5	Inari Technology Sdn Bhd	1,819.68	4.15%
合计		38,929.93	88.93%

发行人与芯片厂商确定产品方案后，芯片厂商会通过两种方式采购发行人的产品：一是由芯片厂商（含其下属公司）直接向发行人采购，二是由芯片厂商向其合作封装测试厂商指定发行人的产品，由封装测试公司向发行人采购。芯片厂商安华高科技（Avago）和威讯联合半导体（RFMD）是决定公司产品方案及订单数量的主要客户。威讯联合半导体（RFMD）旗下拥有封装测试厂，通常采用第一种方式进行采购，而安华高科技（Avago）采取上述两种方式进行采购。

上述客户中，除威讯联合半导体(北京)有限公司外，均为安华高科技（Avago）及其合作封装测试厂商或这些厂商的采购代理公司，其向发行人采购的产品在经过封装测试后将销售给安华高科技（Avago）。

2013 年、2012 年及 2011 年，将来自安华高科技（Avago）合作封装测试厂商的销售收入与来自安华高科技（Avago）（含其下属公司）的销售收入合并后，来自安华高科技（Avago）相关客户的收入与来自威讯联合半导体（RFMD）（含其下属公司）的收入合计占公司营业收入的比重见下表：

单位：万元

项目	客户名称	销售收入	占营业收入比例
2013 年度	安华高科技（Avago）相关	22,432.00	60.88%
	威讯联合半导体（RFMD）	12,231.09	33.19%
	合计	34,663.09	94.07%
2012 年度	安华高科技（Avago）相关	35,766.20	72.05%
	威讯联合半导体（RFMD）	12,266.61	24.71%
	合计	48,032.81	96.76%
2011 年度	安华高科技（Avago）相关	31,449.63	71.84%
	威讯联合半导体（RFMD）	10,450.45	23.87%
	合计	41,900.08	95.72%

（五）发行人主要情况

1. 主要产品的原材料供应

类别	主要物资	主要供应商
金属类	金盐、铜箔	珠海剧毒、柳鑫、奥林、庆龙
板材类	半固化片	日立、三菱
干膜类	电镀铜柱干膜、线路干膜等	杜邦、日立、殷田

2. 主要能源供应情况

公司生产所需的主要能源包括水、电、气，主要来自珠海市斗门区乾务水库、珠海水务集团有限公司、广东电网公司珠海供电局等。公司自设立以来，以上能源的供应均保持稳定。

3. 报告期内主要原材料和能源平均价格的变化情况

（1）原材料采购单价

单位：元

原材料	单位	2013 年均采购价	2012 年均采购价	2011 年均采购价
金盐	克	172.97	207.32	207.96
铜箔	公斤	74.57	82.67	94.24
半固化片	片	28.98	28.14	28.05
干膜	卷	1,960.76	2,134.38	2,145.51

（2）能源采购单价

项目	2013 年	2012 年	2011 年

项目	2013 年	2012 年	2011 年
自来水（元/吨）	1.72	1.65	1.65
水库水（元/吨）	0.75	0.59	0.59
电（元/度）	0.86	0.84	0.78
压缩空气（元/立方米）	0.86	0.84	0.78

4. 产品主要原材料所占成本比例

单位：万元

期间	主营业务成本合计	直接材料	直接材料占比（%）
2013 年	29,141.53	12,058.86	41.38%
2012 年	34,643.46	17,869.92	51.58%
2011 年	32,607.01	19,377.42	59.43%

5. 发行人最近 3 年向前 5 名原材料供应商的采购情况

单位：万元

2013 年原材料前五大供应商		
供应商名称	金额	比例
Hitachi Chemical Electronic Materials(Hong Kong) Ltd.	2,582.32	18.84%
珠海市剧毒物品专卖有限公司	2,514.57	18.35%
杜邦中国集团有限公司	1,528.48	11.15%
珠海镇东有限公司	885.10	6.46%
珠海市庆龙化工有限公司	489.09	3.57%
合计	7,999.56	58.37%
2012 年原材料前五大供应商		
供应商名称	金额	比例
珠海市剧毒物品专卖有限公司	5,158.34	25.36%
Hitachi Chemical Electronic Materials(Hong Kong)Ltd.	4,039.31	19.86%
杜邦中国集团有限公司	2,500.23	12.29%
珠海镇东有限公司	1,113.19	5.47%
珠海开能环保科技有限公司	660.3	3.25%
合计	13,471.37	66.23%
2011 年原材料前五大供应商		
供应商名称	金额	比例
珠海市剧毒物品专卖有限公司	7,420.28	29.23%
Hitachi Chemical Co.(Hong Kong) Ltd.	4,216.91	16.61%
杜邦中国集团有限公司	2,618.09	10.31%
珠海镇东有限公司	1,828.22	7.20%
深圳市柳鑫实业有限公司	1,690.44	6.66%
合计	17,773.93	70.01%

注：2012 年公司对 Hitachi Chemical Electronic Materials(Hong Kong)Ltd.的采购额中包含了对其关联企业 Hitachi Chemical Co.(Hong Kong) Ltd 的采购金额。

（六）发行人董事、监事、高管及其他核心人员、主要关联方或主要股东在上述供应商或客户中所占的权益

本公司董事、监事、高级管理人员及其他核心人员，主要关联方及持有本公司 5%以上股份的股东未在上述供应商或客户中持有任何权益。

五、环境保护及安全生产

公司在生产过程中可能产生的污染物包括废水、废气、固体废弃物及危险废弃物等。

公司制定了《质量，环境和职业健康与安全管理手册》、《环境目标指标方案管理程序》、《环境因素识别与评价程序》等一系列环保制度和规范指引，并建立了内部环境管理体系，严格控制生产过程中的环保工作。公司取得了珠海市环境保护局颁发的《广东省污染物排放许可证》（4404002011000004 号），并与中水处理公司合作，进行废水循环利用，提高水资源利用率；公司取得了珠海市安全生产监督管理局作出《广东省危险化学品储存安全备案告知书》（珠安监危化化储存备字[2012]011 号）；公司于 2009 年首次获得 ISO14001: 2004 环境管理体系认证，于 2012 年通过了环境管理体系的重新认证，并顺利通过每年的环境体系认证监督审核。公司严格控制废水排放，将污染物集中存放妥善处理；对噪音污染源采取严格的隔音、隔离措施。

广东省环保厅于 2013 年 2 月 6 日出具《关于珠海越亚封装基板技术股份有限公司上市环境保护核查情况的函》（粤环函[2013]136 号），同意发行人通过上市环保核查。同时，珠海市环境保护局于 2013 年 1 月 10 日及 2014 年 1 月 9 日出具《证明》，确认公司报告期内未因违反环保法律、法规受到行政处罚。

珠海市斗门区安全生产监督管理局于 2013 年 1 月 9 日和 2014 年 1 月 9 日出具《证明》，确认公司报告期内未因违反相关安全生产法律法规受到行政处罚。

公司近三年能够较好地贯彻执行国家有关环境保护和安全生产法律法规，未因违反环境保护和安全生产法律法规而被处罚。

六、发行人主要业务相关的固定资产和无形资产

（一）固定资产

1. 固定资产整体情况

截至 2013 年 12 月 31 日，公司固定资产整体情况如下：

单位：万元

类别	原值	累计折旧	净值	成新率
房屋建筑物及附属设施	24,408.75	1,765.04	22,643.71	92.77%
机器设备	65,061.58	14,572.20	50,489.38	77.60%
电子设备	1,063.33	541.31	522.03	49.09%
运输设备	196.36	70.66	125.70	64.01%
其他	786.40	277.98	508.42	64.65%
合计	91,516.42	17,227.18	74,289.24	81.18%

2. 关键设备

截至 2013 年 12 月 31 日，公司关键设备整体情况如下：

单位：万元

序号	设备名称	台数	账面原值	账面净值	成新率
1	BGA 侧喷流电铜生产线	3	1732.62	1400.21	80.81%
2	VCP 垂直连续电镀线	4	2331.44	1826.72	78.35%
3	垂直显影线	1	960.07	945.67	98.50%
4	金属喷溅机	10	14,061.69	10,963.22	77.97%
5	镭射直接成像机	27	14507.07	11632.85	80.19%
6	全自动图形电镀线	1	636.42	432.03	67.88%
7	直接图形曝光机	2	1072.95	736.89	68.68%

3. 土地及房产情况

截至本招股说明书签署日，公司拥有的厂房情况如下：

所有者	证书号码	地址	面积（平方米）	取得方式	抵押情况
珠海越亚	粤房地权证 珠字第 0300044404号	珠海市斗门 区珠峰大道 北3209号FPC 厂房	41,460.92	购买	无

截至本招股说明书签署日，公司土地使用权情况如下：

所有者	产权证号	面积/m ²	地址	土地 用途	取得方式	使用期限	抵押 情况
珠海越亚	粤房地权证 珠字第 0300044404 号	22,567.04	房地产座落于珠海市 珠峰大道北 3209 号 (FPC 厂房)	工业	出让取得	2005 年 8 月 11 日至 2055 年 8 月 11 日	无

4. 租赁房产

(1) 越亚香港租赁房产

越亚香港租用一间位于香港湾仔骆克道 212 至 220 号洛洋阁商业大厦 18 楼 B 室的办公室，租赁期从 2014 年 1 月 1 日起至 2014 年 12 月 31 日止，出租方为最佳顾问有限公司。

(2) 越亚美国租赁房产

越亚美国与 Cupertino 公司于 2013 年 2 月 14 日签署的《房屋租赁协议》,租用一间位于 19925 Stevens Creek Boulevard, Suite 100, Cupertino, California 95014-2358 的办公套房及有关办公设施,租赁期限为自 2013 年 3 月 1 日起 12 个月,该《房屋租赁协议》已于 2014 年 3 月 1 日起自动续期 12 个月。

(二) 主要产品的专利状况

截至本招股说明书签署日,发行人已经获取 13 项发明专利,具体情况如下:

序号	专利名称	申请国家	专利号	授权日	取得方式
1	新型集成电路支撑结构及其制作方法	中国	ZL 20068 0046501.7	2012 年 1 月 25 日	2011 年 8 月 10 日自 AMITEC 公司受让取得
2	多层无芯支撑结构及其制作方法	中国	ZL 20071 0105226.8	2011 年 4 月 13 日	2011 年 8 月 8 日自 AMITEC 公司受让取得
3	Integrated Circuit Support Structures and their Fabrication	美国	US7635641	2009 年 12 月 22 日	2011 年 8 月 4 日自 AMITEC 公司受让取得
4	Advanced Multilayer Coreless Support Structures and Method for their Fabrication	美国	US7682972	2010 年 3 月 23 日	2011 年 8 月 4 日自 AMITEC 公司受让取得
5	Coreless Cavity Substrates for Chip Packaging and their Fabrication	美国	US7669320	2010 年 3 月 2 日	2011 年 8 月 4 日自 AMITEC 公司受让取得
6	Novel Integrated Circuit Support Structures and the Fabrication thereof	以色列国	171378	2011 年 3 月 1 日	2011 年 10 月 11 日自 AMITEC 公司受让取得
7	Coreless Cavity Substrates for Chip Packaging and their Fabrication	以色列国	175011	2011 年 12 月 28 日	2011 年 10 月 11 日自 AMITEC 公司受让取得
8	Advanced Multilayered Coreless Support Structure and their Fabrication	韩国	10-0915145	2009 年 8 月 26 日	2011 年 8 月 26 日自 AMITEC 公司受让取得

序号	专利名称	申请国家	专利号	授权日	取得方式
9	Novel Integrated Circuit Support Structures and the Fabrication thereof	韩国	10-0983320	2010 年 9 月 14 日	2011 年 8 月 26 日自 AMITEC 公司受让取得
10	Novel Integrated Circuit Support Structures and their Fabrication	日本	5290761	2013 年 6 月 14 日	2011 年 8 月 12 日自 AMITEC 公司受让取得专利申请权, 2013 年 6 月正式获得专利授权
11	Advanced Multilayered Coreless Support Structure and their Fabrication	日本	5309311	2013 年 7 月 12 日	2011 年 8 月 12 日自 AMITEC 公司受让取得专利申请权, 2013 年 7 月正式获得专利授权
12	多层无芯支撑结构的制作方法	中国台湾	I423752	2014 年 1 月 11 日	2011 年 12 月 16 日自 AMITEC 公司受让取得专利申请权, 2014 年 1 月正式获得专利授权
13	Multilayer Electronic Structures with Vias Having Different Dimensions	韩国	10-1385007	2014 年 4 月 8 日	自主研发

(三) 注册商标

截至本招股说明书签署日, 发行人已经取得的注册商标情况如下:

序号	申请商标	商标注册号	类别	注册有效期	注册人
1		9692470	9	2012 年 8 月 21 日至 2022 年 8 月 20 日	珠海越亚
2	越亚	9692515	9	2012 年 9 月 7 日至 2022 年 9 月 6 日	珠海越亚
3		9692547	35	2012 年 8 月 21 日至 2022 年 8 月 20 日	珠海越亚
4		9692581	42	2012 年 8 月 21 日至 2022 年 8 月 20 日	珠海越亚
5	越亚	9692599	42	2012 年 8 月 21 日至 2022 年 8 月 20 日	珠海越亚

序号	申请商标	商标注册号	类别	注册有效期	注册人
6	越亚	9692561	35	2012年11月21日至 2022年11月20日	珠海越亚

（四）软件著作权

截至本招股说明书签署日，发行人拥有软件著作权证书或申请情况如下：

序号	软件名称	登记号	首次发表日期	著作权人
1	X-OUT 系统 [简称：X-OUT 系统] V1.0	2012SR108689	2010年3月22日	珠海越亚
2	SPC 系统 [简称：SPC 系统] V1.0	2012SR108700	2009年07月06日	珠海越亚
3	智能报价系统 [简称：报价系统] V1.0	2012SR108693	2011年01月18日	珠海越亚

七、发行人的技术水平与研发

（一）技术水平及所处的阶段

发行人目前所掌握的核心技术主要来自于创始股东的转让以及发行人的自主研发。发行人设立之初，股东方以色列 AMITEC 公司授权许可发行人使用其处于实验室技术阶段的无芯封装基板技术，经过发行人核心研发团队的努力配合，逐渐将处于实验室技术阶段的无芯封装基板技术转化为生产线上的量产技术，与此同时，发行人逐渐形成了基于核心技术的生产工艺，为发行人未来的快速发展奠定了良好的基础。

发行人拥有一项关于新型集成电路支撑结构及其制作方法的专利（US 7682972、ZL 200680046501.7、10-0915145 和 5309311），此项专利涵盖了制作无芯封装基板的方法，是公司技术的核心。

同时，发行人在此技术的基础上，通过多年研究开发的经验积累，掌握了众多非专利技术（工艺技术知识），工艺流程以及设备的使用知识。例如通过真空喷溅技术制造种子层，利用化学机械研磨（CMP）技术打磨绝缘层，通过分步重复（Step&Repeat）的方式利用直接成像技术实现先进的层间对准，以及先进的电镀、层压技术，绝缘层应用技术和过程检测，监测，控制技术。除此之外，发行人还在铜凸点的表面处理上有着先进的技术解决方案，可实现镍钯金、锡以及有机抗氧化等多种表面处理方式。目前公司已成功研发了无绿油的基板表面处理技术，可实现例如无电镀引线的电镍金加棕化表面处理和无电镀引线的电镍金加有机抗氧化表面处理等。

发行人五项主要核心技术如下：

技术名称	所处阶段	研发方式	所属专利或专利申请
无芯板（Coreless）技术	量产	股东转让	多层无芯支撑结构及其制作方法、新型集成电路支撑结构及其制作方法
铜柱（Copper Pillar）技术	量产	股东转让	多层无芯支撑结构及其制作方法、新型集成电路支撑结构及其制作方法
采用半固化片在铜柱上层压的技术	量产	股东转让	多层无芯支撑结构及其制作方法、新型集成电路支撑结构及其制作方法
化学机械抛光（CMP）磨板技术	量产	自主研发	-
真空喷溅（Sputtering）技术	量产	自主研发	-

1. 无芯板（Coreless）技术

公司掌握的无芯板技术以芯板作为支持载体，在一步或多步增层后便将芯板分离或去除，以实现无芯板层的“无芯”封装基板，从而减小了封装基板的整体厚度，并降低了传热阻力，改善了电气性能。同时，无芯封装基板技术使得芯板层和堆积层可以采用相同的精细设计，进一步满足了封装基板尺寸缩小，线路密度增大的发展要求，并能够实现更多的精细线路设计的功能层。

2. 铜柱（Copper Pillar）技术

公司采用自孔底向上电镀的铜柱制造技术制作导通孔，该技术已在中国、美国、韩国三个国家获得了专利授权。在实现导通孔的方法上，与其它生产无芯板 IC 封装基板的厂商不同，珠海越亚不需要采用“钻孔、填孔”工艺对绝缘层进行钻孔，并对钻孔进行金属化从而形成导通孔。而是通过在曝光显影后的感光材料上进行图形电镀，或者通过板面电镀金属导通孔层然后蚀刻掉多余的金属的方法来制作。公司目前可以同时在一块板（Panel）的每个导电层上制作超过 200 万个铜柱，避免了竞争对手逐孔制作而导致较长制作时间和较高单位制孔成本的问题。

3. 采用半固化片在铜柱上层压的技术

发行人制造 IC 封装基板是通过在线路图形层和铜柱层上面层压绝缘材料的方法来实现。这种绝缘材料为半固化片，主要由聚合物和玻璃纤维组成，它拥有稳定且较低的热膨胀系数（CTE），高杨氏模量（High Young's modulus），从而减少板翘问题，保证产品的平整性和挠曲强度。同时，这样的材料组合能够更好地支撑和保护芯片，在同样的形状结构和层数下，增强了封装的可靠性。

4. 化学机械抛光（CMP）磨板技术

发行人运用先进的化学机械抛光（CMP）磨板技术去除铜柱顶部多余的半固化片材料，并采取无损检验的方法测量并控制经磨板抛光后的绝缘层厚度，以实现薄形化的封装基板。

5. 真空喷溅（Sputtering）技术

发行人采用半导体晶圆行业通用的技术——真空喷溅技术来制作种子层。种子层薄且均匀，有效配合快速蚀刻流程，降低对线路两侧及两侧底部的蚀刻，从而实现精细线路。公司目前能够生产 15 μm 线宽度/15 μm 线间隙的产品，并将开发 10/10 μm 及更精密的产品。

（二）发行人正在从事的主要研发项目

珠海越亚通过不断研发新技术和制造工艺制造新一代超薄结构和高密度线路的无芯封装基板。为了保护公司的核心技术，限制竞争对手采取现有工艺实现类似的产品特征，公司已对这些技术特征和制造工艺申请了专利。

序号	技术名称	所处阶段	研发方式	所属专利或专利申请
1	包含内置散热器/金属核的新型散热特性	小批量量产	自主研发	Multilayer Electronic Structure With Cofabricated Metal Core
2	整合的静电屏蔽	试生产	自主研发	Multilayer Electronic Structure With Integral Faraday Shielding
3	通过基板内不同形状的通孔和盲孔运用光学元件对准的精确对位	小批量量产	自主研发	Alignment Between Layers Of Multilayer Electronic Support Structures
4	包含整合形成的被动元器件--如电感器，电容器，保险丝以及电阻器的封装基板	试生产	自主研发	Multilayer Electronic Structure With Integral Construction Elements
5	埋入技术整合电容电感为滤波器技术开发	试生产	自主研发	预备申请
6	芯片内埋技术开发	试生产	自主研发	预备申请
7	整合被动器件技术	试生产	自主研发	预备申请

公司根据行业技术发展方向，不断提升公司技术能力，进行各种新技术的研究和开发，未来几年将重点加强以下两项技术的研发：

1、芯片内埋技术(Embedded die, ED)

芯片内埋技术是将一个或多个芯片嵌埋于封装基板的互连层内而完成封装的技术。采用此类技术的封装一般是由“芯片先置”（指把芯片先放置在封装体内，然后在芯片上制造封装基板的互连层）的技术方法产生，封装基板的互连层

在芯片上面和围绕芯片制造，除了可以减低整个封装的厚度、获得较低的整体成本，也允许封装基板的互连层起到屏蔽射频干扰/电磁干扰的功能。

“芯片先置”封装技术通常可分为两个主要类型：芯片内埋拼板封装和晶圆级扇出封装。前者已被印刷电路板和 IC 封装基板制造商采用并可以使用他们的流程与设备能力，来处理含内埋“重新排布”芯片的大板生产；后者则采用晶圆制造厂流程，因其具有较好的互连密度，更高的电气性能和较好的流程良率，已成为许多终端客户首选的制造流程。晶圆级扇出封装通常按应用类型来分类，移动/无线电子消费品行业、工业、汽车和医疗行业是晶圆级扇出封装的四个主要应用。法国知名的半导体行业调研公司 Yole Développement 预计采用晶圆级扇出封装方式的“芯片内埋封装”的整个市场规模将从 2014 年的 1.1 亿美元增长到 2020 年的超过 6.4 亿美元，年复合增长率达 24% 以上。

近年来，公司一直在从事芯片内埋拼板封装技术的研发，该技术基于公司现有的“无芯板技术”，“铜柱法技术”等技术，结合目前的大板无芯封装基板工艺技术，采用高密度“插入中介载体结构”的技术方法，形成一种新的芯片内埋拼板封装技术路径，使其与当前的晶圆级扇出封装技术相比较更具有竞争性。公司预期芯片内埋拼板封装技术在移动设备，电源转换和汽车等细分市场具备良好的发展前景。

2、整合被动器件技术(Integrated Passive Devices, IPDs)

整合被动器件技术是将传统上多颗分散的被动射频组件整合到封装基板的技术。该技术通过将阵列的电容和电感整合在一个共同载体上，能产生很多电子功能模块，例如：阻抗匹配电路，谐波滤波器，耦合器，平衡-不平衡变压器，功率合成器和功率分配器。

整合被动器件技术一般使用“厚膜”或者“薄膜”制造技术。厚膜整合被动器件技术采用应用于印刷电路板或陶瓷工艺技术的流程；而薄膜整合被动器件技术普遍采用通常用于晶圆制造的技术，如薄膜沉积流程。

薄膜整合被动器件通常按应用类型分类，其中四个主要应用为：无线射频模块、LED 照明、静电释放/电磁干扰防护、数字/混合信号。法国知名的半导体行业调研公司 Yole Développement 预计薄膜整合被动器件整个市场规模将从 2013 年的约 8 亿美元增长到 2017 年的约 12 亿美元，年复合增长率约为 8.4%，其中增长最快的两个细分市场是 LED 照明市场和无线射频模块市场，年复合增长率分别为 26% 和 17%。当更符合成本效益的整合被动器件技术和产品变得可行时，预计整合被动器件技术将会在行业内得到广泛应用，特别在快速发展的无线射频模块和 LED 照明市场。

自 2013 年以来, 公司一直在从事整合被动器件技术的研发, 该技术基于公司的“无芯板技术”, “铜柱法技术”等技术, 同时结合了源于厚膜的大板 IC 封装基板流程和源于薄膜的、公司在物理气相沉积技术的优势。如果研发成功, 公司的整合被动器件技术将可以在提供比薄膜被动器件类似或更佳性能的同时, 保持厚膜被动器件的成本优势。公司预期这种将晶圆制造工艺和先进的印刷电路板制造技术整合并应用于无芯封装基板制造的技术具有良好的市场前景。

(三) 研发支出

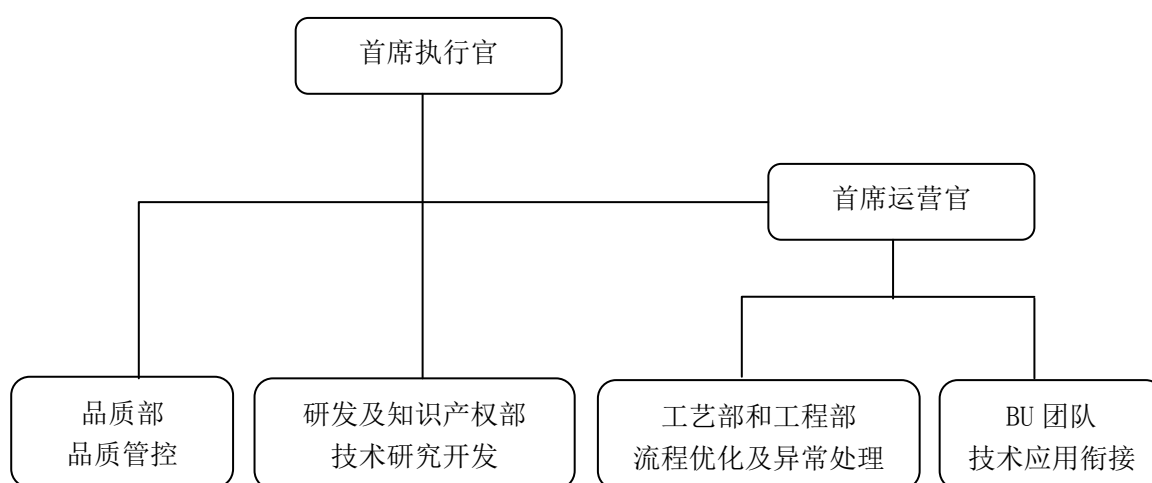
本公司研发支出包括项目研究开发过程中所发生的直接材料、直接人工及其他相关支出等。报告期内, 研发支出占营业收入比例情况如下:

单位: 万元

项目	2013 年	2012 年	2011 年	合计
研发支出 (含资本化)	2,533.19	2,684.27	2,199.27	7,416.73
营业收入	36,847.10	49,641.70	43,774.74	130,263.54
研发支出/营业收入	6.87%	5.41%	5.02%	5.69%

(四) 发行人的技术创新机制

1. 研发组织设置



越亚研发组织机构由技术方案研究及技术方案实现两部分组成, 分别由公司总经理暨首席执行官 Dror Hurvits 及公司副总经理暨首席运营官陈先明领导, 负责越亚整体的研发管理工作:

(1) 建立并不断完善公司研发管理体系;

(2) 管理和组织公司的研发规划工作; 制定和执行企业技术发展战略和技术创新、技术改造、技术开发规划;

(3)对研发年度计划实行统一管理，审核所属公司的研发工作年度计划，监督实施并对执行情况进行评价；

(4)对公司研发项目实行统一管理，参与重点研发项目的立项评审、过程监督和评价；

(5)对公司所有研发项目实施备案管理，并进行相关的分析；

(6)负责制定、实施研发知识管理政策和制度，协调公司研发知识管理的共享和交流，并对公司的研发知识管理工作进行检查、考核等相关日常管理；

(7)开展国际国内技术合作和交流；收集、分析与本企业相关的技术和市场信息，分析、研究行业发展动态，为企业产品开发和技术发展决策提供依据。

研发组织机构具体职责如下：

首席执行官 Dror Hurvits：确定技术研发方向，研发过程中指导及监督；

首席运营官陈先明：组织公司内外资源，制定、跟进、监督、考核研发技术项目，对公司运营进行全面管理；

研发及知识产权部：研究开发新产品、新工艺，为工业化生产提供关键技术支撑；

品质部：技术研发品质支持；

工艺部和工程部：流程优化管理及异常处理；

BU 团队：技术应用衔接与成果反馈，作为技术理念与技术应用之纽带。

2. 促进技术创新的制度安排

(1) 健全的研发管理规定，完善的技术保密制度

发行人拥有独立的研发机构和研发人员，建立了健全的研发机制，具备雄厚的技术创新能力。

为了提高公司整体研发管理水平，保障研发活动的科学性和计划性，增强企业技术创新能力和市场竞争力，使研发活动的成果能够有效的支持企业的业务发展，公司根据有关管理制度，制定了《研发管理规定》规范新产品整个开发运作过程，确保项目顺利进行。除此之外，为了保护公司创新技术，发行人建立健全的《技术保密制度》，实行信息化档案管理，并与研发技术人员签订《技术保密协议》保障研发项目的有序进行。

(2) 鼓励技术创新，加强人才培养

为适应电子信息产业的快速发展，公司加大对现有研发技术人员和技术工人的培养，对企业研发人员进行新技术、新工艺方面的业务培训，以保证公司的研发能够紧密结合市场、紧跟技术发展方向。

八、境外经营情况

截至本招股说明书签署日，公司设立了全资子公司越亚香港和越亚香港的全资子公司越亚美国。上述两家公司的经营情况请详见本招股说明书“第四章 发行人基本情况”之“七、发行人股权投资情况”之相关内容。

九、主要产品或服务的质量控制情况

（一）质量管理的组织、控制或认证情况

公司建立了包括采购、生产、销售的全过程质量管理体系。在此业务链上的部门及组织对各个环节严格控制，以保证产品质量。

公司设立了专门的品质部，负责公司产品 and 原材料的质量管理，参与供应商质量环境评审，监督生产工艺、工序控制，质量统计和废品隔离，组织质量培训，会审新工艺开发的有关文件等。此外，公司设立专门的质量管理部，组织品质控制部门（Quality Control, QC）进行生产检验，反馈产品质量信息，发送不合格报告，协同品质保证（Quality Assurance, QA）部门处理客户投诉。而采购与物控部负责供应商评审，保证优质的原料、辅料供应，制造部在生产过程中确保产品质量，设备部在设备采购、维护中发挥作用，参与公司品质环境系统改善。

因此，公司在物料的采购、供应商质量保证体系的建立、生产过程的控制、产品销售等一系列工作流程中，都制定了相应的质量责任，保证了产品质量。

公司于 2007 年通过英国 SGS 机构的 ISO9001:2008 版质量管理认证，此后公司连续通过质量管理认证监督审核和复核。上述质量管理体系认证证书于 2013 年 12 月 23 日换发，有效期至 2016 年 12 月 23 日。

（二）质量控制措施

1. 新产品研发和导入的质量控制

本公司设立了专业的研发团队，拥有各项新产品的研发实验室和设备。在新产品项目启动之初，便依据《质量控制计划》程序，进行工艺流程和品质策划，同时，实施失效模式与后果分析（FMEA），按照国际先进的品质控制方法，

系统化地采取事先措施，提前预防缺陷的发生。通过严格的品质控制，保证新产品顺利通过客户的产品认证，从而获得量产合同。

2. 生产销售过程质量控制

（1）具备完善的作业指引文件体系

所有的流程都制定了相应的作业指导书，做到文件化和标准化。

（2）人员控制

所有关键岗位的操作，都对操作人员进行理论和实操培训，并有培训记录，经考试合格者，持上岗证上岗操作。

（3）设备控制

编制《设备管理程序》，对生产中使用的所有设备都进行严格的控制，合理使用，按时保养，定期检查，即时维修，必要时调整和测定机械性能，使设备性能能够符合工序质量的要求。测量设备实行定期的检定和校正以及测量系统分析（Measurement System Analysis, MSA），保证测量的一致性、准确性和精确性。

（4）检验控制

一是过程检验：根据公司产品的特点，每经过一道加工工序，都要对产品做严格的检验检测。二是最终产品检验和可靠性试验。在过程检验合格、最终产品检验合格并且通过了可靠性测试之后，产品方可入库出货。

（5）销售过程及售后品质服务

公司配置具有丰富流程工艺专业知识和品质管理经验的一流客户服务团队。按照《客户沟通和服务控制程序》、《客户满意度控制程序》等标准要求，负责客户沟通和服务，包括客户标准和技术问题的讨论和产品售后服务。客户沟通和服务的方式包括电话会议、邮件和互访等，通过和客户之间紧密和良好的沟通，提供及时的服务，客户满意度得到持续提升。

（6）变更控制

公司执行完善的变更管理体系，来保证产品和品质的长期稳定和提升。所有可能影响外观，尺寸，功能，品质或可靠性的产品或制程改变，都经过评估和认证。

（7）统计过程控制

公司建立了智能统计过程控制（SPC）系统。从原材料品质控制，到整个制造过程的关键工艺参数和质量特性的控制，到最终产品检验，关键流程的所有控制都进行了数字化，数据自动导入智能 SPC 系统，自动按照统计控制原理，在过程出现异常波动趋势时，自动报警，以便及时采取改善措施；如果异常未被处理，智能 SPC 系统将执行“产品暂停”动作，直到异常报警被解除。应用智能统计过程控制系统，使本公司的生产过程质量控制处于行业先进水平。

3. 质量控制的持续改进

公司常年开展旨在持续改善品质的品质改善小组（Quality Improvement Team, QIT）活动。每年实施两次质量管理体系内部审核和管理评审。同时，客户和第三方也不定期进行稽查审核。力求通过以上质量控制的持续改善，提高客户的满意度。

十、产品质量纠纷情况

公司报告期内无重大产品质量纠纷情况。

第六章 同业竞争与关联交易

一、同业竞争

（一）与关联方的同业竞争情况

本公司主要从事刚性有机无芯 IC 封装基板的研发、生产与销售。

本公司无实际控制人，截至本招股说明书签署日，本公司并列第一大股东为方正信产和 AMITEC 公司，各自持有 232,110,412 股股份，占本公司发行前总股本的比例为 38.3575%。

1. 与公司并列第一大股东方正信产及其控股股东、实际控制人的同业竞争情况

（1）方正信产及其控制的其他企业

方正信产为本公司并列第一大股东，其经营范围为：项目投资；投资管理；资产管理；经济信息咨询（不含中介）；开发、销售计算机软件及硬件产品；计算机系统集成；技术服务（股权出资 70,000 万元）。其拥有的主要资产为对下属企业的股权投资。

截至 2014 年 6 月 10 日，方正信产直接控制的企业的基本情况如下：

序号	企业名称	注册资本	持股比例	经营范围
1	北京方正阿帕比技术有限公司	10,000.00 万元	100.00%	生产计算机及软硬件产品；销售自产产品；货物进出口、技术进出口。（知识产权出资 2000 万元）
2	深圳市北大方正数码科技有限公司	14,000.00 万元	100.00%	兴办实业（具体项目另行申报）；计算机软硬件及外围设备、网络设备、通讯设备、办公自动化设备、计算机应用产品的技术开发、生产和销售（生产项目按深经复[2000]243 号文规定办），生产彩色液晶显示器、CRT 彩电、交换机、CRT 显示器、液晶电视、车载 DVD、GPS 全球定位器（不含地面卫星接收设施）、数码相框、等离子电视、家庭影院、数字高新背投机、DCP 光学背投、CCOS 电视、路由器；货物及技术进出口，自有房屋租赁，软件开发，档案整理。（以上项目均不含法律、行政法规、国务院决定规定需前置审批及禁止项目）

序号	企业名称	注册资本	持股比例	经营范围
3	方正国际软件有限公司	24,899.57 万元	67.96%	许可经营项目：无。一般经营项目：计算机软件、硬件及外部设备、机电一体化产品的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务、技术培训、集成；管理咨询；数据库服务；销售本公司研发的产品并提供售后服务；从事计算机软件、硬件级外部设备、机电一体化产品及技术的进出口业务；监控设备租赁；承接各类市政工程；户外设施安装建设工程；智能候车亭建设安装工程；电子站牌建设安装工程。
4	方正科技集团股份有限公司	219,489.12 万元	11.65%	电子计算机及配件、软件，非危险品化工产品，办公设备及消耗材料，电子仪器，建筑、装潢材料，百货，五金交电，包装材料；经营各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外，税控收款机（涉及行政许可的凭许可证经营）。
5	方正信息技术（苏州）有限公司	5,000.00 万元	100.00%	许可经营项目：无。一般经营项目：开发、销售计算机软件及硬件产品，计算机系统集成，提供相关技术服务；实业投资；投资管理；资产管理；经济信息咨询。
6	上海方正数字出版技术有限公司	10,000.00 万元	65.00%	数字出版技术的开发，计算机软硬件的开发、销售（除计算机信息系统安全专用产品），系统集成，并提供相关的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，电子商务（不得从事增值电信、金融业务），图文设计，工艺礼品的销售，制作、代理、利用自有媒体发布广告，摄影服务，以数字印刷方式从事出版物、包装装潢印刷品和其他印刷品的印刷（凭许可证经营），图书、报刊、期刊、电子出版物批发、零售、网上发行（凭许可证经营），从事货物及技术进出口业务。
7	方正移动传媒技术（北京）有限公司	5,408.63 万元	51.77%	技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；基础软件服务；应用软件服务；计算机系统服务；计算机技术培训；经济贸易咨询；设计、制作、代理、发布广告；企业策划；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、通讯设备
8	方正控股有限公司	21,000.00 万港元	31.42%	注册登记文件中未明确限制经营范围，现主要从事投资控股业务。
9	北大医疗信息技术有限公司	10000.00 万元	70.00%	计算机软件、硬件及外部设备、机电一体化产品的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；计算机系统集成；管理咨询；数据处理；销售本公司研发的产品并提供售后服务。（依法须经批准的项目，

序号	企业名称	注册资本	持股比例	经营范围
				经相关部门批准后方可开展经营活动)

方正信产自身不直接从事任何与本公司业务相同或相似的封装基板制造业务，除持有本公司股份外，不再持有其他从事封装基板经营的企业股权，与本公司不存在同业竞争。上述其他企业均不从事与本公司相同或相似的业务，与本公司不存在同业竞争。

(2) 方正集团及其控制的其他企业情况

本公司并列第一大股东方正信产的控股股东为方正集团。方正集团营业范围为：许可经营项目：房地产开发；物业管理。一般经营项目：制造方正电子出版系统、方正-SUPPER 汉卡、计算机软硬件及相关设备、通讯设备、仪器仪表、办公自动化设备；技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术推广；投资管理；财务咨询(不得开展审计、验资、查账、评估、会计咨询、代理记账等需经专项审批的业务，不得出具相应的审计报告、验资报告、查账报告、评估报告等文字材料)；销售电子产品、自行开发的产品、计算机、软件及辅助设备、仪器仪表、机械设备、非金属矿石、金属矿石、金属材料、建筑材料、化工产品(不含危险化学品及一类易制毒化学品)；货物进出口、代理进出口、技术进出口；装卸服务；仓储服务；包装服务。(未取得行政许可的项目除外)

截至 2014 年 6 月 10 日，方正集团直接控制的除方正信产外的其他企业情况如下：

序号	企业名称	注册资本	持股比例	经营范围
1	北京方正实业开发公司	1,000.00 万元	100.00%	许可经营项目：无。一般经营项目：科技、旅游设施和危旧房改造项目的开发建设、经营销售商品房、电子产品及通信设备、建筑材料、电器机械、普通机械的技术开发、技术服务、销售。室内外装饰工程。(未取得行政许可的项目除外。)
2	方正产业控股有限公司	120,000.00 万元	94.17%	许可经营项目：无。一般经营项目：投资管理；项目投资；销售通讯设备、电子产品、计算机、软件及辅助设备、农产品、非金属矿石及制品、金属矿石、金属材料、建筑材料、化工产品(不含危险化学品及一类易制毒化学品)、机械设备、办公用品。(未取得行政许可的项目除外)

序号	企业名称	注册资本	持股比例	经营范围
3	方正证券股份有限公司	610,000.00 万元	41.22%	证券经纪（除广东省深圳市前海深港现代服务业合作区之外）；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券自营；证券资产管理；融资融券；证券投资基金代销；代销金融产品；为期货公司提供中间介绍业务（凭许可证经营，有效期至 2015 年 3 月 7 日）。
4	北大医疗产业集团有限公司	250,000.00 万元	85.60%	许可经营的项目：建设工程项目管理。一般经营的项目：医院管理；投资及投资管理；资产管理；技术开发；技术服务；技术咨询；房地产咨询；仪器租赁；机械设备租赁；销售铁矿砂、钢材、建筑材料、皮革及制品、五金、家用电器、粮食、谷物、豆及薯类、棉花、麻类、煤炭（不在北京地区开展实物煤的交易、储运活动）、非金属矿石及制品、金属矿石、金属材料、金属制品、建筑材料、化工产品（不含化学危险品及一类易制毒化学品）、机械设备、皮革及制品、五金交电、家用电器、计算机、软件及辅助设备（不含计算机信息系统安全专用设备）、通用设备、专用设备、交通运输设备、电气机械、电子产品、器件和元件、仪器仪表及文化、办公用机械；货物进出口；技术进出口、代理进出口；组织文化艺术交流活动（不含演出）。
5	北大方正投资有限公司	15,000.00 万元	80.00%	许可经营项目：无。一般经营项目：高新技术项目投资管理；企业管理咨询；企业形象策划；市场调查；信息咨询（中介除外）；组织文化艺术交流活动（演出除外）；承办展览展示会；技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询、技术培训；购销针纺织品、百货、五金交电化工、计算机软硬件及外部设备、机械电器设备、通讯设备、医疗器械、工艺美术品、建筑材料、金属材料、装饰材料；设备租赁；接受委托提供劳动服务；接受委托对企业进行管理；货物进出口、技术进出口、代理进出口。
6	深圳方正微电子有限公司	59,000.00 万美元	63.69%	研究开发集成电路芯片及相关产品；加工、生产经营线宽 0.35 微米及以下大规模集成电路芯片、线宽 0.35 微米以上集成电路芯片（包括 SiGe 集成电路芯片和 Si 集成电路芯片）；产品的售后技术服务和应用开发。从事货物、技术进出口（不含分销、国家专营专控商品）。
7	香港方正资讯有限公司	14,394.20 万港币	46.36%	注册登记文件中未明确限制经营范围，现主要从事咨询服务业务。
8	北大方正培训中心	500.00 万元	100.00%	外语类培训（包括英语、日语）计算机应用、书版排版、维思排版等相关培训；办学层次：高级。

序号	企业名称	注册资本	持股比例	经营范围
9	北大方正集团财务有限公司	500,000.00 万元	50.00%	许可经营项目：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；承销成员单位的企业债券；对金融机构的股权投资；有价证券投资（其中股票二级市场投资仅限于成员单位股票）。一般经营项目：无
10	方正东亚信托有限责任公司	120,000.00 万元	70.01%	资金信托；动产信托；不动产信托；有价证券信托；其他财产或财产权信托；作为投资资金或基金管理公司的发起人从事投资基金业务；经营企业资产的重组、购并及项目融资、公司理财、财务顾问等业务；受托经营国务院有关部门批准的证券承销业务；办理居间、咨询、资信调查等业务；代保管及保管箱业务；以存放同业、拆放同业、贷款、租赁、投资方式运用固有财产；以固有财产为他人提供担保；从事同业拆借；法律法规规定或中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。
11	方正资本控股股份有限公司	20,000.00 万元	70.00%	许可经营项目：无。一般经营项目：投资及资产管理；经济信息咨询。
12	方正宽带网络服务有限公司	6,000.00 万元	55.00%	互联网信息服务业务，因特网接入服务业务；有线电视站、共用天线设计、安装。技术咨询、技术服务、技术开发；技术推广；销售自行开发后的产品、电子元器件、文化用品、体育用品；设计、制作、代理、发布广告。（未取得行政许可的项目除外）
13	北大方正人寿保险有限公司	118,000.00 万元	51.00%	在上海市行政辖区内及已设立分公司的省、自治区、直辖市内经营下列业务（法定保险业务除外）：一、人寿保险、健康保险和意外伤害保险等保险业务；二、上述业务的再保险业务（涉及行政许可的凭许可证经营）
14	中国高科集团股份有限公司	29,332.80 万元	24.37%	实业投资，创业投资，技术及商品展示，投资及经济技术咨询服务，电子通讯产品的生产销售，国内贸易（除国家专项审批），自营和代理各类商品及技术的进出口业务（不另附加进出口商品目录，但国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外），经营进料加工和“三来一补”业务，开展对销贸易和转口贸易。（企业经营涉及行政许可的，凭许可证经营）。

序号	企业名称	注册资本	持股比例	经营范围
15	方正集团（香港）有限公司	3,000.00 万美元	100.00%	注册登记文件中未明确限制经营范围，现主要从事投资及贸易业务。

方正集团自身不直接从事任何与本公司业务相同或相似的封装基板制造业务，除间接持有本公司股份外，不再持有其他从事封装基板经营的企业股权，与本公司不存在同业竞争。上述其他企业均不从事与本公司相同或相似的业务，与本公司不存在同业竞争。

（3）北京大学、北大资产及所控制的其他企业情况

方正集团的控股股东为北大资产，北大资产为北京大学的全资子公司，其主要业务为接受委托经营管理北京大学的经营性资产；因此，方正信产的实际控制人为北京大学。

截至 2014 年 6 月 10 日，北京大学通过北大资产直接控制的除方正集团之外的其他企业情况如下：

序号	企业名称	注册资本	持股比例	经营范围
1	北京北大英华科技有限公司	1000.00 万元	57.50%	互联网信息服务业务（除新闻、出版、教育、医疗保健、药品、医疗器械和 BBS 以外的内容；含利用 www.chinalawinfo.com 网站发布广告）。技术开发、技术转让、技术咨询；经济贸易咨询；计算机系统集成。（未取得行政许可的项目除外）
2	北京北大宇环微电子有限公司	840.00 万元	95.00%	许可经营项目：电子产品制造。一般经营项目：电子产品的技术开发、技术服务；销售电子产品。（未取得行政许可的项目除外）
3	北大资源集团有限公司	20000.00 万元	40.00%	房地产开发、出租自有房屋；代理进出口、货物进出口、技术进出口；技术开发；销售金属材料、矿产品；企业管理；投资管理、资产管理、经济贸易咨询。（未取得行政许可的项目除外）

序号	企业名称	注册资本	持股比例	经营范围
4	北京北大科技园有限公司	10000.00 万元	40.00%	许可经营项目：无。一般经营项目：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；投资管理；经济贸易咨询、房地产咨询、企业管理咨询；企业管理；资产管理；物业管理；房地产开发；销售自行开发的商品房；机动车公共停车服务；会议服务；承办展览展示活动；组织文化艺术交流活动（不含演出）；货物进出口；销售建筑材料、五金、交电、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、仪器仪表、工艺品、汽车零配件、非家用制冷空调设备、矿产品、金属制品、纺织品、电子产品、机械设备、通讯设备、计算机、软件及辅助设备（未取得行政许可的项目除外）
5	北京北大临湖科技发展有限公司	1000.00 万元	80.00%	许可经营项目：无。一般经营项目：技术推广；房地产开发；物业管理；出租办公用房。（未取得行政许可的项目除外）
6	北京北大科技园建设开发有限公司	50000.00 万元	42.00%	许可经营项目：以下项目限分支机构经营：住宿；洗浴；理发；游泳馆；餐饮服务；销售定型包装食品；冷热饮；酒；饮料；本店内零售烟、雪茄烟。一般经营项目：投资管理；投资咨询；人才培养；技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；对自有房产进行物业管理；信息咨询；房地产开发，销售商品房；销售建筑材料、装饰材料、机械电器设备；房地产信息咨询；资产管理；机动车公共停车场服务；以下项目限分支机构经营：会议服务；酒店管理。
7	北京燕园天地科技有限公司	100.00 万元	52.00%	技术开发、技术服务、技术咨询；环境监测；教育咨询；销售首饰、金属矿石、非金属矿石。（未取得行政许可的项目除外）。
8	北京开元数图科技有限公司	300.00 万元	95.00%	许可经营项目：无。一般经营项目：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务、技术培训；计算机系统服务；数据处理；基础软件服务；应用软件服务；销售计算机、软件及辅助设备。（未取得行政许可的项目除外）
9	北京北大明德科技发展有限公司	1500.00 万元	20.00%	新材料、新能源、分析测试产品的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；工程和技术研究与试验发展；销售仪器仪表、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）。（未取得行政许可的项目除外）其中知识产权出资为 97.05 万元

序号	企业名称	注册资本	持股比例	经营范围
10	北京大学出版社有限公司	20000.00 万元	100.00%	许可经营项目：出版本校设置的学科、专业、课程所需的教材；本校教学所需的教学参考书、教学工具书，与本校主要专业方向相一致的学术专著、译著；适合高等学校教学需要的政治理论读物；根据学校主管部门确定的分工和安排，为尚未成立出版社的高校出版同一专业系统的高校教材。不得出版文艺创作、翻译小说、实用性图书及中小学辅导教材。出版本校教师所著的专业著作，只限于上述范围之内。一般经营项目：设计、制作、代理、发布广告。（未取得行政许可的项目除外）
11	北京大学音像出版社有限公司	260.00 万元	100.00%	许可经营项目：出版、发行、教育及教学科研方面的音像制品；零售国家正式出版的音像制品；出租国家正式出版的节目录像带。一般经营项目：零售计算机软件。（未取得行政许可的项目除外）
12	北京北大青鸟软件系统有限公司	2279.00 万元	48.00%	许可经营项目：无。一般经营项目：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；销售计算机、软件及辅助设备。
13	北京大学医学出版社有限公司	9000.00 万元	100.00%	许可经营项目：出版、发行本校设置的主要学科、专业、课程所需要的教材；本校教学需要的教学参考书、教学工具书；与本校主要专业方向相一致的学术专著、译著；适合高等学校教学需要的通俗政治理论读物。一般经营项目：无
14	北大培文教育文化产业（北京）有限公司	200.00 万元	100.00%	许可经营项目：零售、网上销售图书、报纸。（出版物经营许可证有效期至2015年12月31日）一般经营项目：组织文化艺术交流活动（不含营业性演出）；教育咨询；投资咨询；企业管理咨询；经济贸易咨询；承办展览展示活动；市场调查；企业策划、设计；电脑动画设计；会议服务；销售小礼品、文化用品、体育用品。（未取得行政许可的项目除外）

北大资产作为国有资产管理平台，自身不直接从事任何与本公司业务相同或相似的封装基板研发制造业务，其直接或间接持股的封装基板制造企业仅有本公司。北京大学、北大资产除间接持有本公司股份外，不再持有其他从事封装基板经营的企业股权，与本公司不存在同业竞争。

2. 与公司并列第一大股东 AMITEC 公司及其股东、实际控制人的同业竞争情况

（1）AMITEC 公司

AMITEC 公司为本公司并列第一大股东，除了作为本公司及 AMITEC 香港公司的股东和持有根据《无形资产转让协议》约定无需向本公司转让的某些知识产权（包括已注册的知识产权），AMITEC 公司和 AMITEC 香港公司目前不从事任何其他业务。

2011 年，AMITEC 公司已将与本公司主营业务相关的技术组合通过增资的方式投入到公司。目前，公司并列第一大股东 AMITEC 公司及其关联方 P.C.B 公司名下仍持有与制作互联结构或封装基板相关的专利。

AMITEC 公司及 P.C.B 公司持有这些专利是对其早期研发成果的保护，并无具体产业化方案和具体行动。这些专利与本公司 IC 封装基板产品的技术路线有较大差异，且公司认为这些专利在其专利有效期内不具备产业化价值，因此未将相关技术投入本公司。

同时 AMITEC 公司、AMITEC 公司和 P.C.B 公司的控股股东 Priortech 公司以及 Priortech 公司的实际控制人 Rafi Amit 和 Yotam Stern 均出具了《关于避免同业竞争的声明与承诺函》。

因此，公司认为，AMITEC 公司及其关联方 P.C.B 公司仍持有与制作互联结构或封装基板相关的专利对本公司生产经营无重大实质性影响，未导致 AMITEC 公司及其关联方 P.C.B 公司与公司形成同业竞争。

（2）AMITEC 公司之控股股东、实际控制人

AMITEC 公司的控股股东为以色列公司 Priortech Ltd.，实际控制人为以色列籍自然人 Rafi Amit 和 Yotam Stern。

除了 Priortech Ltd.外，Rafi Amit 和 Yotam Stern 不直接控制其他公司。截至 2014 年 5 月 29 日，Priortech Ltd.直接控制的除 AMITEC 公司以外的其他公司情况如下：

序号	企业名称	已发行股本	持股比例	主营业务
1	Camtek Ltd.	新谢克尔 1,000,000	55.52%	半导体晶元集成电路（半导体晶元）、印刷电路板和高级电子基板（IC 基板）的自动光学检验系统（AOI-自动光学检验系统）的生产、数字档案和油墨印入印刷电路板材料布置系统等
2	P.C.B Technologies Ltd.	新谢克尔 18,000,000	69.96%	PCB 产品的制造业务
3	Afik （Nadlan） Ltd	新谢克尔 1,383,440	100.00%	除拥有 Priortech 集团相关房产外无其他业务

P.C.B 公司是以色列特拉维夫股票交易所上市公司，其专门从事军事电子工业、医疗和民用精密 PCB 产品的制造业务。

P.C.B 公司目前直接控制两家全资子公司，Cellergy Ltd.和 PCE Inc。Cellergy Ltd.主要从事超级电容器制造技术的开发、制造和营销；PCE Inc 主要负责营销并维护 P.C.B 公司在美国的客户。

Camtek Ltd.是一家设备制造商，主要研发、制造和销售适用于半导体晶元计算机集成电路（半导体晶元）、印刷电路板和高级封装基板（IC 基板）的自动光学检验系统（AOI-自动光学检验系统）；数字档案和油墨印入印刷电路板材料布置系统等。Camtek Ltd.是世界知名的 AOI-自动光学检验设备制造商，于 2000 年和 2002 年分别在美国纳斯达克和以色列特拉维夫股票交易所上市。

截至 2014 年 5 月 29 日，Camtek Ltd.直接控制 5 家全资子公司和 1 家控股子公司，具体持股比例及主营业务情况如下表所示：

序号	子公司	持股比例	主营业务
1	Camtek USA Inc.	100.00%	在美国市场分销 Camtek 产品
2	Camtek (EUROPE) NV	100.00%	在欧洲市场分销 Camtek 产品
3	Sela Semiconductor Engineering Laboratories Ltd	100.00%	开发、生产和营销自动 SEM（扫描式电子显微镜）和 TEM（透射式电子显微镜）、制样设备，主要用于前端半导体产业。
4	Panta-I	100.00%	无业务
5	Camtek H.K. Ltd.	99.00%	在远东市场分销 Camtek 产品
6	康代影像科技（苏州）有限公司	100.00%	制造 Camtek 的产品和零配件

Afik （Nadlan） Ltd.是 Priortech Ltd.的全资子公司，负责 Priortech Ltd.内部的部分运营场地，是一家房地产公司。

综上，AMITEC 公司及其关联方与发行人所处的行业具有较大差异，与发行人不存在同业竞争。

3. 与其他股东的同业竞争情况

本公司其他股东均与本公司主营业务不同，不存在同业竞争。具体情况请详见本招股说明书“第四章 发行人基本情况”之“二、发行人改制重组情况”之“（三）发行人设立前后主要发起人拥有的主要资产和实际从事的主要业务”。

（二）避免同业竞争的承诺

发行人第一大股东方正信产及其实际控制人北京大学向本公司出具了《关于避免同业竞争的声明与承诺函》，承诺如下：

（1）截至本承诺函出具之日，本公司（本单位）及本公司（本单位）所控制的其他企业未从事任何在商业上对珠海越亚构成直接或间接同业竞争的业务或活动；本公司（本单位）保证将来也不会从事或促使本公司（本单位）所控制的其他企业从事任何在商业上对珠海越亚构成直接或间接同业竞争的业务或活动。

（2）本公司（本单位）将不利用对珠海越亚的投资关系或其他关系进行损害珠海越亚及其股东合法权益的经营活动。

（3）本公司（本单位）确认本承诺函所载的每一项承诺均为可独立执行之承诺，任何一项承诺若被视为无效或终止将不影响其他各项承诺的有效性。

（4）本公司（本单位）将忠实履行承诺并保证确认的真实性，如果违反上述承诺或确认不真实，本公司（本单位）将承担由此引发的一切法律责任，包括全额赔偿珠海越亚及其其他股东因此遭受的损失、损害和开支。

（5）本承诺函自本公司（本单位）签署之日起生效，本承诺函所载上述各项由本公司（本单位）作出之承诺分别在本公司（本单位）作为珠海越亚的并列第一大股东（或并列第一大股东实际控制人）期间及自本公司（本单位）不再为珠海越亚的并列第一大股东（或并列第一大股东实际控制人）之日起三年内持续有效且不可变更和撤销。

发行人并列第一大股东 AMITEC 公司向本公司出具了《关于避免同业竞争的声明与承诺函》，承诺如下：

（1）截至本承诺函出具之日，本公司及本公司所控制的其他企业未从事任何在商业上与珠海越亚现有业务构成直接或间接同业竞争的业务或活动；本公司保证将来也不会从事或促使本公司所控制的其他企业从事任何在商业上与珠海越亚现有业务构成直接或间接同业竞争的业务或活动。

（2）本公司将不利用对珠海越亚的投资关系或其他关系进行损害珠海越亚及其股东合法权益的经营活动。

（3）本公司确认本承诺函所载的每一项承诺均为可独立执行之承诺，任何一项承诺若被视为无效或终止将不影响其他各项承诺的有效性。

(4) 本公司将忠实履行承诺并保证确认的真实性, 如果违反上述承诺或确认不真实, 本公司将承担由此引发的一切法律责任, 包括全额赔偿珠海越亚及其股东因此遭受的损失、损害或开支。

(5) 截至本函出具之日, 本公司及本公司关联企业 P.C.B 公司拥有本函附件所列专利, 拥有该等专利不会减损本公司在此做出的避免同业竞争的声明和承诺。

(6) 本承诺函自本公司签署之日起生效, 本承诺函所载上述各项由本公司作出之承诺分别在本公司作为珠海越亚的单独或并列第一大股东期间及自本公司不再为珠海越亚的单独或并列第一大股东之日起两年内持续有效且不可变更或撤销。如珠海越亚放弃上市或上市被否决, 本承诺函将自动失效。

发行人并列第一大股东 AMITEC 公司的控股股东 Priortech Ltd.向本公司出具了《关于避免同业竞争的声明与承诺函》, 做出如下承诺:

(1) 截至本承诺函出具之日, 本公司及本公司所控制的其他企业未从事任何在商业上与珠海越亚现有业务构成直接或间接同业竞争的业务或活动; 本公司保证将来也不会从事或促使本公司所控制的其他企业从事任何在商业上与珠海越亚现有业务构成直接或间接同业竞争的业务或活动。

(2) 本公司将不利用对珠海越亚的投资关系或其他关系进行损害珠海越亚及其股东合法权益的经营活动。

(3) 截至本承诺函出具之日, 本公司控制的 AMITEC 公司和 P.C.B 公司拥有本函附件所列专利。本公司作为上述两家公司的控股股东, 确认上述两家公司拥有该等专利不会减损本公司在此做出的避免同业竞争的声明和承诺。

(4) 本公司确认本承诺函所载的每一项承诺均为可独立执行之承诺, 任何一项承诺若被视为无效或终止将不影响其他各项承诺的有效性。

(5) 本公司将忠实履行承诺并保证确认的真实性, 如果违反上述承诺或确认不真实, 本公司将承担由此引发的一切法律责任, 包括全额赔偿珠海越亚及其股东因此遭受的损失、损害或开支。

(6) 本承诺函自本公司签署之日起生效, 本承诺函所载上述各项由本公司作出之承诺分别在本公司作为珠海越亚的单独或并列第一大股东的控股股东期间及自本公司不再为珠海越亚的单独和并列第一大股东之日起两年内持续有效且不可变更或撤销。如珠海越亚放弃上市或上市被否决, 本承诺函将自动失效。

发行人并列第一大股东 AMITEC 公司的实际控制人 Rafi Amit 和 Yotam Stern 向本公司出具了《关于避免同业竞争的声明与承诺函》，承诺如下：

(1) 截至本承诺函出具之日，本人及本人所控制的其他企业未从事任何在商业上与珠海越亚现有业务构成直接或间接同业竞争的业务或活动；本人保证将来也不会从事或促使本人所控制的其他企业从事任何在商业上与珠海越亚现有业务构成直接或间接同业竞争的业务或活动。

(2) 本人将不利用对珠海越亚的投资关系或其他关系进行损害珠海越亚及其股东合法权益的经营活动。

(3) 截至本承诺函出具之日，本人控制的 AMITEC 公司和 P.C.B 公司拥有本函附件所列专利。本人作为上述两家公司的实际控制人，确认上述两家公司拥有该等专利不会减损本人在此做出的避免同业竞争的声明和承诺。

(4) 本人确认本承诺函所载的每一项承诺均为可独立执行之承诺，任何一项承诺若被视为无效或终止将不影响其他各项承诺的有效性。

(5) 本人将忠实履行承诺并保证确认的真实性，如果违反上述承诺或确认不真实，本人将承担由此引发的一切法律责任，包括全额赔偿珠海越亚及其股东因此遭受的损失、损害或开支。

(6) 本承诺函自本人签署之日起生效，本承诺函所载上述各项由本人作出之承诺分别在本人作为珠海越亚的单独或并列第一大股东的实际控制人期间及自本人不再为珠海越亚的单独和并列第一大股东的控制人之日起两年内持续有效且不可变更或撤销。如珠海越亚放弃上市或上市被否决，本承诺函将自动失效。

二、关联方与关联关系

根据《公司法》和《企业会计准则第 36 号——关联方披露》的相关规定，对照发行人实际情况，截至本招股说明书签署日，发行人存在的关联方及其关联关系如下：

(一) 方正信产、方正集团、北大资产、北京大学

方正信产持有本公司 38.3575%的股权，为本公司并列第一大股东；方正集团持有方正信产 100%的股权，是方正信产的控股股东，北大资产持有方正集团 70%的股权，是方正集团的控股股东；北京大学为北大资产唯一出资人。方正信产、方正集团、北大资产和北京大学具体情况详见本招股说明书“第四章 发行人基本情况”之“八、发行人股东基本情况”。

（二）AMITEC 公司、Priortech Ltd、Rafi Amit 和 Yotam Stern

AMITEC 公司持有本公司 38.3575%的股权，为本公司并列第一大股东；Priortech 公司是 AMITEC 公司的控股股东，Rafi Amit 和 Yotam Stern 是 Priortech Ltd. 的实际控制人，从而也是 AMITEC 公司的实际控制人。AMITEC 公司、Priortech Ltd. 及 Rafi Amit 和 Yotam Stern 具体情况详见本招股说明书“第四章 发行人基本情况”之“八、发行人股东基本情况”。

（三）持有发行人 5%以上股份的其他股东

持有本公司 5%以上股份的其他股东为东方富海。其详细情况详见本招股说明书“第四章 发行人基本情况”之“八、发行人股东基本情况”。

（四）方正信产、方正集团、北大资产、北京大学直接控制的其他企业

方正信产、方正集团、北大资产、北京大学直接控制的其他企业详见本招股说明书“第六章 同业竞争与关联交易”之“一、同业竞争”。

（五）AMITEC 公司、Priortech、Rafi Amit 和 Yotam Stern 控制的其他企业

AMITEC 公司、Priortech 及 Rafi Amit 和 Yotam Stern 控制的其他企业详见本招股说明书“第六章 同业竞争与关联交易”之“一、同业竞争”。

（六）本公司控制的企业

本公司控制的公司有两家，即本公司全资子公司越亚香港和越亚香港的全资子公司越亚美国。

本公司控制的公司的具体情况请详见本招股说明书“第四章 发行人基本情况”之“七、发行人股权投资情况”。

（七）本公司关键管理人员及与其关系密切的家庭成员

根据《企业会计准则第 36 号——关联方披露》及相关规定，关键管理人员包括本公司董事、监事及高级管理人员；与其关系密切的家庭成员指其父母、配偶、兄弟姐妹、子女以及其他关系密切的家庭成员。

本公司的关键管理人员情况详见本招股说明书“第七章 董事、监事、高级管理人员和核心技术人员”之“一、董事、监事、高级管理人员和核心技术人员简介”。

（八）本公司关键管理人员控制、共同控制或施加重大影响的其他企业

截至本招股说明书签署日，本公司关键管理人员投资或兼职的企业情况，详见本招股说明书“第七章 董事、监事、高级管理人员和核心技术人员”之“三、董事、监事、高级管理人员和核心技术人员的其他对外投资情况”和本招股说明书“第七章 董事、监事、高级管理人员和核心技术人员”之“五、董事、监事、高级管理人员和核心技术人员相互之间的关系及兼职情况”之“（二）董事、监事、高级管理人员和核心技术人员的兼职情况”。

（九）其他关联方

报告期内，公司并列第一大股东方正信产及其控股股东、实际控制人和AMITEC 公司及其控股股东、实际控制人间接控制的与本公司发生交易、存在应收应付款项公司的具体情况如下：

关联方名称	关联关系
珠海方正科技多层电路板有限公司	本公司并列第一大股东控制的企业
珠海方正科技高密电子有限公司	本公司并列第一大股东控制的企业
珠海方正印刷电路板发展有限公司	本公司并列第一大股东控制的企业
深圳市方正信息系统有限公司	本公司并列第一大股东控制的企业
杭州方正速能科技有限公司	本公司并列第一大股东控制的企业
北大方正集团财务有限公司	本公司并列第一大股东之母公司控制的企业
深圳市高科国融实业发展有限公司	本公司并列第一大股东之母公司控制的企业
重庆方正高密电子有限公司	本公司并列第一大股东控制的企业
Camtek H.K. Limited.	本公司并列第一大股东之母公司控制的企业
Camtek USA Inc.	本公司并列第一大股东之母公司控制的企业
康代影像科技（苏州）有限公司	本公司并列第一大股东之母公司控制的企业
康代电子科技（苏州）有限公司 ^注	本公司并列第一大股东之母公司控制的企业

注：根据江苏省苏州工业园区工商行政管理局于 2013 年 12 月 30 日核发的《外商投资公司准予注销登记通知书》（（05940043）外商投资公司注销登记[2013]第 12300001 号），康代电子科技（苏州）有限公司已在该局注销登记。

三、关联交易事项

（一）报告期内经常性关联交易

1. 向关联方采购原料

报告期内，公司向关联方进行了少量材料采购。报告期内，公司向关联方采购材料的具体情况如下：

年份	关联方名称	采购内容	采购金额/ 元	占当期 营业成 本比重	占当期 同类交 易比重

年份	关联方名称	采购内容	采购金额/ 元	占当期 营业成 本比重	占当期 同类交 易比重
2013 年	珠海方正科技高密电子有限公司	原材料	5,881.80	0.00%	0.00%
	康代影像科技（苏州）有限公司	生产耗材	128,365.40	0.04%	0.09%
	深圳市高科国融实业发展有限公司	材料	2,137.00	0.00%	0.00%
2012 年	珠海方正科技高密电子有限公司	原材料	30,320.08	0.01%	0.01%
	康代影像科技（苏州）有限公司	生产耗材	411,273.20	0.12%	0.20%
	深圳市高科国融实业发展有限公司	材料	299,309.04	0.08%	0.15%
2011 年	珠海方正科技多层电路板有限公司	原材料	68,456.96	0.02%	0.03%
	珠海方正科技高密电子有限公司	原材料	10,975.59	0.00%	0.00%
	康代电子科技（苏州）有限公司	生产耗材	142,195.20	0.04%	0.06%
	康代影像科技（苏州）有限公司	生产耗材	29,078.98	0.01%	0.01%
	深圳市高科国融实业发展有限公司	材料	749,063.80	0.22%	0.30%

2. 接受关联方服务

（1）采购服务

报告期内，公司因加工测试、机器设备的维修调试及车间装修等，向关联方进行了相关服务采购。公司对关联方就上述事项进行的服务采购金额总体较小，2011年至2013年，合计采购金额占公司当期营业成本的比重分别为1.38%、0.22%和0.12%。报告期内，公司向关联方采购服务的具体情况如下：

年份	关联方名称	采购内容	采购金额/ 元	占当期 营业成 本比 重	占当期 同类交 易比 重
2013 年	珠海方正科技高密电子有限公司	加工、测试	22,977.64	0.01%	0.49%
	康代影像科技（苏州）有限公司	设备调试	340,315.50	0.11%	3.59%
	深圳市高科国融实业发展有限公司	工程装修服务	11,500.00	0.00%	0.05%
2012 年	珠海方正科技多层电路板有限公司	加工、测试	22,551.98	0.01%	0.94%
	珠海方正科技高密电子有限公司	加工、测试	116,929.29	0.03%	4.86%
	康代影像科技（苏州）有限公司	设备调试	31,086.02	0.01%	0.68%
	深圳市高科国融实业发展有限公司	工程装修服务	596,806.19	0.17%	2.59%
2011 年	珠海方正科技多层电路板有限公司	加工、测试	135,917.56	0.04%	2.81%
	珠海方正科技高密电子有限公司	加工、测试	1,519,570.96	0.44%	31.46%
	康代电子科技（苏州）有限公司	设备维修	207,852.00	0.06%	2.03%
	康代影像科技（苏州）有限公司	设备调试	87,448.61	0.03%	0.86%
	深圳市高科国融实业发展有限公司	工程装修服务	2,752,923.31	0.81%	13.04%

（2）接受园区公共服务

根据公司设立时中外股东签署的《合资经营合同》，中方股东负责为发行人提供公共设施及相关服务。报告期内，公司接受了关联方提供的辅助生产和后勤行政相关服务。公司接受关联方提供服务的具体情况如下：

年份	关联方名称	采购内容		采购金额/元	占当期 营业成 本比重	占当期 同类交 易比重
2013 年	珠海方正印刷电路板发展有限公司	辅助生 产类	电费	16,518,674.67	5.46%	68.62%
			水费	-260,452.41 ^注	-0.09%	-1.08%
			药剂	2,241,570.20	0.74%	9.31%
			维修费	748,781.55	0.25%	3.11%
			油费	71,252.72	0.02%	0.30%
		服务后 勤类	园区行政 服务费	3,284,238.60	1.09%	13.64%
			其他服务	194,451.95	0.06%	0.81%
	珠海方正科技高密 电子有限公司	辅助生 产类	药剂	806,813.14	0.27%	3.35%
			维修费	175,959.51	0.06%	0.73%
			油费	786.48	0.00%	0.00%
		服务后 勤类	公共设施 服务费	291,414.18	0.10%	1.21%
	珠海方正科技多层 电路板有限公司	服务后 勤类	其他服务	857.00	0.00%	0.00%
	2012 年	珠海方正印刷电路板发展有限公司	辅助生 产类	电费	36,681,161.33	10.29%
水费				784,907.39	0.22%	1.62%
药剂				3,703,522.89	1.04%	7.63%
维修费				1,316,900.46	0.37%	2.71%
油费				79,067.55	0.02%	0.16%
服务后 勤类			园区行政 服务费	5,163,461.37	1.45%	10.63%
			其他服务	823,965.66	0.23%	1.70%
珠海方正科技高密 电子有限公司		服务后 勤类	其他服务	9,274.58	0.00%	0.02%
珠海方正科技多层 电路板有限公司		服务后 勤类	其他服务	5,709.54	0.00%	0.01%
2011 年		珠海方正印刷电路板发展有限公司	辅助生 产类	电费	30,645,033.23	8.97%
	水费			578,497.61	0.17%	1.46%
	药剂			3,600,254.96	1.05%	9.11%
	维修费			1,326,326.65	0.39%	3.36%
	油费			789,493.97	0.23%	2.00%
	服务后 勤类		园区行政 服务费	2,133,977.09	0.62%	5.40%
			其他服务	407,631.57	0.12%	1.03%

	珠海方正科技多层 电路板有限公司	服务后 勤类	其他服务	28,762.38	0.01%	0.07%

注：珠海越亚所消耗的水费的结算，根据其“实际占用量占园区总用量比例”与水费总金额计算出来珠海越亚应承担的水费金额，与珠海越亚直接向独立第三方缴纳的水费金额的差异部分，由珠海越亚和珠海发展之间按月单独结算。2013 年度，该差异部分的累计金额为负，即珠海越亚直接向独立第三方缴纳的水费金额大于其应承担的水费金额。

为进一步规范该等关联交易，公司与珠海多层、珠海发展之间于 2013 年 4 月 1 日，签订了《园区综合服务协议》，就珠海多层和珠海发展为公司提供辅助性生产服务支持、行政服务及后勤服务事项达成协议。协议约定，珠海多层和珠海发展为发行人提供综合服务的范围分为公用设施服务和行政及后勤服务。公用设施服务是由珠海多层负责提供方正 PCB 产业园内生产、生活所需污水处理设施，以及生产所需的动力设施（冷水机组、纯化水机组、空压机组等）和消防设施，珠海发展负责提供符合珠海越亚工艺设计及标准的污水处理服务，并对设施进行维护保养，负责上述设施日常运行所需的投放药剂、柴油等消耗品服务，保证上述设施的正常运转；珠海发展负责提供自来水、冷冻水、DI 水（去离子水）、RO 水（反渗透水）、压缩空气等生产所需的辅助动力和能源供珠海越亚使用；珠海发展负责园区消防设施（除珠海越亚方拥有产权的 FPC 厂房内的设施）的维护保养，保证消防设施正常运转。行政及后勤服务是由珠海多层提供宿舍（按珠海越亚书面申请）、食堂等场所，珠海发展负责配套提供产业园内的行政及后勤服务，包括宿管、食堂、班车、保安、绿化、清洁等服务，并负责园区的统一行政管理和物业管理。

2013 年 10 月 1 日，公司与珠海多层、珠海发展、珠海高密重新签订了《园区综合服务协议》，将园区内公用设施运营服务改由珠海高密提供。根据该协议，珠海多层为产业园内不动产和相关附属设施的产权所有人，负责提供宿舍、食堂等场所，以及方正 PCB 产业园内生产、生活所需自来水设施、污水设施以及生产所需的动力设施和消防设施；珠海发展负责配套提供产业园内的行政及后勤服务，包括宿管、食堂、班车、保安、绿化、清洁等服务，并负责园区的统一行政管理和物业管理；珠海高密负责提供污水处理服务并对设施进行维修保养，负责上述设施日常运行所需的投放药剂、柴油等消耗品服务、保证上述设施的正常运转，负责提供冷冻水、DI 水、RO 水、SW 水、压缩空气等生产所需的辅助动力和能源供各方使用，负责园区消防设施的维护保养以及园区内自来水设施管线的维护保养。

3. 向关联方的销售业务

报告期内，公司向关联方销售了少量生产使用的材料并提供了相应加工服务。该部分销售金额，占公司同期营业收入比重极小。报告期内，公司向关联方销售的具体情况如下：

年份	关联方名称	销售内容	销售金额/元	占当期营业收入比重
2013年	珠海方正科技高密电子有限公司	材料、加工费	296,811.28	0.08%
	珠海方正印刷电路板发展有限公司	成品	24,100.00	0.01%
2012年	珠海方正科技多层电路板有限公司	材料、加工费	24,211.84	0.00%
	杭州方正速能科技有限公司	材料	724.82	0.00%
	珠海方正科技高密电子有限公司	材料、加工费	38,727.21	0.01%
2011年	珠海方正科技多层电路板有限公司	材料、加工费	41,255.28	0.01%
	杭州方正速能科技有限公司	材料	10,239.39	0.00%
	珠海方正科技高密电子有限公司	材料、加工费	51,955.06	0.01%

4. 外方股东的技术许可

2007年6月26日，发行人前身越亚有限与AMITEC公司签订《技术及专有技术许可协议》，AMITEC公司许可越亚有限使用“利用射频无核技术进行射频和无线应用领域内的压合无核半导体封装基板”有关的专利和专有技术进行生产和销售相关产品，越亚有限就使用被许可技术向AMITEC公司支付等值于越亚有限利润10%的技术许可费，协议有效期限等同于越亚有限的经营期限。

该协议已被越亚有限与AMITEC公司于2011年7月11日签订的《无形资产转让协议》所终止，该协议项下AMITEC公司许可越亚有限使用的全部技术已由AMITEC公司通过以无形资产对珠海越亚增资的方式转让给越亚有限。

就该技术许可事宜，AMITEC公司出具了《关于技术许可费用的确认函》，确认“由于珠海越亚在使用该专有技术期间并未盈利，未达到许可协议约定支付许可费的条件，珠海越亚未向我司支付技术许可费。我司特此确认知悉上述事宜，并对此没有异议，上述技术许可协议项下的技术许可费支付事宜没有任何争议。”

（二）报告期内偶发性关联交易情况

1. 向关联方采购机器设备

报告期内，公司向关联方采购机器设备，主要是向关联方康代影像科技（苏州）有限公司和Camtek H.K. Limited采购自动光学检测设备。

本公司对关联方的机器设备采购遵循市场定价原则。报告期内，公司向关联方采购机器设备的具体情况如下：

年份	关联方名称	采购内容	采购金额/元	占当期营业成本比重	占当期同类交易比重
2013 年	康代影像科技（苏州）有限公司	机器设备	1,054,000.00	0.35%	1.45%
2012 年	康代影像科技（苏州）有限公司	软件	680,913.00	0.19%	17.20%
	Camtek H.K. Limited	机器设备	8,740,785.40	2.45%	6.05%
2011 年	深圳市方正信息系统有限公司	电脑	4,991.45	0.00%	0.22%
	珠海方正科技高密电子有限公司	机器设备及电脑	5,205,389.03	1.52%	2.69%
	Camtek H.K. Limited	机器设备	6,539,877.00	1.91%	3.38%
	康代影像科技（苏州）有限公司	机器设备	6,546,376.92	1.92%	3.39%

2. 关联租赁

根据公司设立时中外股东签署的《合资经营合同》，中方股东负责为发行人提供生产所需的厂房。同时，发行人工厂位于方正 PCB 产业园内，报告期内发行人曾向关联方租赁厂房、公用设施及后勤设施。关联方向公司提供租赁，租金按出租方提供相关的租赁标的物所需的成本为基础定价。具体情况如下：

年份	出租方	租赁资产	租赁起始日	租赁终止日	租赁金额/元
2013 年	珠海方正科技多层电路板有限公司	方正 PCB 产业园内公用设施及后勤设施	2013/1/1	2013/12/31	3,430,767.00
2012 年	珠海方正科技多层电路板有限公司	方正 PCB 产业园 FPC 厂房一、二层、园区公用设施及后勤设施	2012/1/1	2012/9/30	5,585,458.00
	珠海方正科技多层电路板有限公司	方正 PCB 产业园内公用设施及后勤设施	2012/10/1	2012/12/31	1,205,428.00
2011 年	珠海方正科技多层电路板有限公司	方正 PCB 产业园 FPC 厂房一层、园区公用设施及后勤设施	2011/1/1	2011/12/31	4,176,061.00
	重庆方正高密电子有限公司	设备	2011/3/1	2011/6/30	36,784.36

2012 年，公司购买了方正 PCB 产业园 FPC 厂房，此后不再需要租赁该厂房。

3. 接受关联方资产转让

(1) 厂房及所属土地

2012 年 9 月 24 日，珠海多层与公司签署了《工业厂房转让协议》，约定珠海多层将其拥有的坐落于珠海市珠峰大道北 3209 号的厂房、厂房内附属设施及

该厂房占有范围内的土地使用权转让给公司。房屋建筑面积为 41,460.92 平方米，该房屋占用范围内土地使用权面积为 19,378.13 平方米，土地使用权期限至 2055 年 8 月 11 日止，转让总价款为 1.46 亿元。

根据广东中广信资产评估有限公司出具的《关于珠海方正科技多层电路板有限公司拟进行房地产转让所涉及位于珠海市斗门区珠峰大道北 3209 号 FPC 厂房项目资产评估报告书》（中广信珠评报字[2012]第 020 号），确认以 2012 年 8 月 31 日为基准日，FPC 厂房的市场价值为 145,942,438.40 元。

FPC 厂房转让的全部转让价款及相关税费已于 2012 年 9 月 27 日付清。公司于 2012 年 9 月 28 日完成 FPC 厂房过户手续，并取得记载其为产权人的粤房地权证珠字第 0300042385 号《房地产权证》。

为使公司单独取得上述厂房所涉土地使用权，确保本公司资产独立性，2012 年 11 月 7 日，珠海多层与公司签署了《工业厂房转让协议之补充协议》，约定将 FPC 厂房基地面积及外延 4.5 米范围的土地面积合计 21,862.042 平方米、以及通往 PCB 产业园外主干道最近道路 705 平方米土地使用权分割归珠海越亚所有，即珠海越亚单独所有的土地使用权面积为 22,567.042 平方米，方正 PCB 产业园内其余土地使用权面积 131,877.978 平方米归珠海多层单独所有，土地使用权转让价款为 118.2 万元。

厂房所涉土地使用权转让的全部转让价款及相关税费已于 2012 年 11 月 22 日付清。公司取得珠海市房地产登记中心向其换发的粤房地权证珠字第 0300044404 号《房地产权证》，其中记载土地自用面积为 22,567.042 平方米。

（2）电力增容与配套设施

2012 年 9 月 24 日，珠海发展与公司签署了《电力增容配套设施转让协议》，约定公司同意一并受让 FPC 厂房内高低压配电二期增容配套设施，受让价格为 485 万元，于 FPC 厂房登记至珠海越亚名下之前交付。

北京恒信德律资产评估有限公司就 FPC 厂房内高低压配电二期增容配套设施转让出具了《珠海方正印刷电路板发展有限公司拟转让设备资产项目资产评估报告书》（京恒信德律评字（2012）0164 号），确认以 2012 年 8 月 31 日为基准日，FPC 厂房内高低压配电二期（电房及外线）增容工程资产的评估值为 484.90 万元。

2013 年 5 月 7 日，公司在广东电网公司珠海供电局办理了非居民用户变更用电业务，并与广东电网公司珠海斗门供电局签订了《电费结算协议书》。2013 年 5 月 21 日，公司与广东电网公司珠海供电局签订了《供电合同》（高压）。

4. 向股东借款及利息支付

根据公司设立时，中外股东签署的《合资经营合同》，中方股东有责任为公司提供必要的融资扶持，帮助公司获得扩大生产所必要的资金。报告期内，公司股东借款及利息支付情况如下：

(1) 2011 年度

单位：元

关联方	2010 年 12 月 31 日	本期借款	本期还款	2011 年 12 月 31 日	本期计提利 息	期末应付利 息
方正集团	248,000,000.00	12,000,000.00	260,000,000.00	0.00	11,112,572.98	3,616,187.39
方正集团-国家 开发银行股份 有限公司（“国 开行”）	0.00	113,840,020.50	840,020.50	113,000,000.00	4,301,531.67	439,062.03
方正集团-中国 进出口银行 （“进出口 行”）	0.00	62,680,122.29	0.00	62,680,122.29	460,600.00	0.00
方正财务公司	0.00	69,500,000.00	0.00	69,500,000.00	0.00	0.00
合计	248,000,000.00	258,020,142.79	260,840,020.50	245,180,122.29	15,874,704.65	4,055,249.42

就 2011 年度方正集团向公司提供资金用于设备和工程投资事宜、用于支付材料贷款和日常费用开支事宜，方正集团和公司于 2011 年签署了三份《借款协议》，协议约定利率以中国人民银行公布同档次贷款基准利率为准，如遇中国人民银行调整基准利率，则相应调整。2011 年 3 月，方正集团向公司提供了人民币 1,200 万元的借款，用于支持公司购买设备和工程投资。

2011 年 2 月 28 日，方正集团与国开行签署《人民币资金借款合同》（合同编号为 1100409502011021009 号）、《人民币资金借款合同》（合同编号为 1100409502011021010 号）和《人民币资金借款合同》（合同编号为 1100409502011041011 号），该系列借款合同为支持珠海越亚新建 TAPP 及 Coreless 封装基板项目。该系列借款合同下国开行共计放款人民币 113,840,020.50 元，由方正集团转账借款给越亚有限使用。

2011 年 6 月 22 日，方正集团与进出口行签署《借款合同（一般机电产品、高新技术出口卖方信贷）》（合同编号为 2120001022011110995 号），方正集团从进出口行贷款后再向珠海越亚提供借款，支持其进行设备和工程投资。根据珠海越亚 2011 年 7 月向进出口行提供的原材料设备采购合同清单，方正集团在该借款合同下向珠海越亚提供的借款共计人民币 62,680,122.29 元。

2011年12月29日，方正集团与方正财务公司签署《委托贷款委托合同》，约定方正集团委托方正财务公司向越亚有限发放委托贷款，金额为6,950万元，用于补充生产经营流动资金及购买设备，利率为6.56%，借款期限为12个月，自2011年12月29日至2012年12月28日。为此，越亚有限和方正财务公司于同日签署了《委托贷款借款合同》，由方正财务公司依《委托贷款委托合同》约定的条件向越亚有限发放贷款6,950万元。

方正集团于2013年3月13日签署《确认函》，确认该等借款事实及利息支付情况。

(2) 2012 年度

单位：元

关联方	2011 年 12 月 31 日	本期借款	本期还款	2012 年 12 月 31 日	本期计提利 息	期末应付利 息
方正集团-国开 行	113,000,000.00	0.00	113,000,000.00	0.00	511,741.66	0.00
方正集团-进出 口行	62,680,122.29	0.00	62,680,122.29	0.00	1,188,358.60	0.00
方正财务公司	69,500,000.00	0.00	69,500,000.00	0.00	177,302.22	0.00
合计	245,180,122.29	0.00	245,180,122.29	0.00	1,877,402.48	0.00

公司在2012年度未新增关联方借款，并完成了以前年度剩余的关联方借款本金和利息的偿还。

(3) 2013 年度

公司在2013年度未发生关联方借款。

5. 关联担保

根据公司设立时，中外股东签署的《合资经营合同》，中方股东需为发行人的融资提供必要的支持。

报告期内，公司关联方方正集团为公司融资提供的担保情况如下：

年份	担保方	被担保方	担保金额	币别	担保起始日	担保到期日	是否 履行 完毕
2012 年	北大方正集团有限公司	越亚有限	20,000,000.00	RMB	2012-2-27	2012-12-9	是
	北大方正集团有限公司	越亚有限	48,681.00	USD	2012-2-8	2012-4-8	是
	北大方正集团有限公司	越亚有限	198,338.00	USD	2012-2-8	2012-4-8	是

年份	担保方	被担保方	担保金额	币别	担保起始日	担保到期日	是否履行完毕
	北大方正集团有限公司	越亚有限	517,742.00	USD	2012-2-13	2012-5-13	是
	北大方正集团有限公司	越亚有限	81,680.00	USD	2012-3-9	2012-6-9	是
	北大方正集团有限公司	越亚有限	154,870.00	USD	2012-3-29	2012-6-29	是
	北大方正集团有限公司	越亚有限	741,761.70	USD	2012-2-7	2012-3-26	是
	北大方正集团有限公司	越亚有限	386,200.03	USD	2012-2-29	2012-4-24	是
	北大方正集团有限公司	越亚有限	503,476.30	USD	2012-2-23	2012-4-24	是
	北大方正集团有限公司	越亚有限	499,414.36	USD	2012-3-12	2012-4-24	是
	北大方正集团有限公司	越亚有限	756,000.00	USD	2012-3-22	2012-4-24	是
	北大方正集团有限公司	越亚有限	359,700.00	USD	2012-5-23	2012-7-30	是
	北大方正集团有限公司	越亚有限	517,350.50	USD	2012-2-17	2012-3-26	是
2011 年	北大方正集团有限公司	越亚有限	30,000,000.00	RMB	2011-6-29	2012-6-29	是
	北大方正集团有限公司	越亚有限	20,000,000.00	RMB	2011-7-20	2012-7-20	是
	北大方正集团有限公司	越亚有限	1,062,061.00	USD	2011-9-2	2011-11-2	是
	北大方正集团有限公司	越亚有限	263,546.00	USD	2011-9-14	2011-11-14	是
	北大方正集团有限公司	越亚有限	69,550.00	USD	2011-9-15	2011-12-15	是
	北大方正集团有限公司	越亚有限	192,820.00	USD	2011-9-26	2011-12-26	是
	北大方正集团有限公司	越亚有限	61,940.00	USD	2011-10-17	2011-12-17	是
	北大方正集团有限公司	越亚有限	101,090.00	USD	2011-9-28	2011-12-28	是
	北大方正集团有限公司	越亚有限	130,070.00	USD	2011-10-17	2012-1-17	是
	北大方正集团有限公司	越亚有限	300,000.00	USD	2011-11-30	2012-2-29	是
	北大方正集团有限公司	越亚有限	116,145.00	USD	2011-11-30	2012-2-29	是
	北大方正集团有限公司	越亚有限	407,137.00	USD	2011-12-21	2012-3-21	是
	北大方正集团有限公司	越亚有限	350,000.00	USD	2011-1-4	2011-3-2	是
	北大方正集团有限公司	越亚有限	885,000.00	USD	2011-2-17	2011-4-11	是
	北大方正集团有限公司	越亚有限	551,818.97	USD	2011-1-20	2011-4-20	是
	北大方正集团有限公司	越亚有限	865,000.00	USD	2011-3-1	2011-4-29	是
	北大方正集团有限公司	越亚有限	920,000.00	USD	2011-3-17	2011-5-6	是
	北大方正集团有限公司	越亚有限	950,000.00	USD	2011-3-22	2011-5-6	是
	北大方正集团有限公司	越亚有限	926,000.00	USD	2011-4-7	2011-5-30	是
	北大方正集团有限公司	越亚有限	1,390,000.00	USD	2011-5-18	2011-6-29	是
	北大方正集团有限公司	越亚有限	1,550,000.00	USD	2011-8-29	2011-9-23	是
	北大方正集团有限公司	越亚有限	240,000.00	USD	2011-8-31	2011-10-25	是
	北大方正集团有限公司	越亚有限	970,000.00	USD	2011-8-31	2011-10-25	是
	北大方正集团有限公司	越亚有限	700,000.00	USD	2011-8-31	2011-11-3	是
	北大方正集团有限公司	越亚有限	650,000.00	USD	2011-9-8	2011-11-4	是
	北大方正集团有限公司	越亚有限	369,000.00	USD	2011-9-19	2011-12-2	是
	北大方正集团有限公司	越亚有限	830,000.00	USD	2011-9-26	2011-12-2	是
	北大方正集团有限公司	越亚有限	210,000.00	USD	2011-9-27	2011-12-3	是
	北大方正集团有限公司	越亚有限	604,000.00	USD	2011-9-30	2011-12-6	是

年份	担保方	被担保方	担保金额	币别	担保起始日	担保到期日	是否履行完毕
	北大方正集团有限公司	越亚有限	1,715,000.00	USD	2011-10-14	2011-12-2	是
	北大方正集团有限公司	越亚有限	1,034,000.00	USD	2011-10-25	2011-12-30	是
	北大方正集团有限公司	越亚有限	1,245,000.00	USD	2011-11-7	2012-1-2	是
	北大方正集团有限公司	越亚有限	643,000.00	USD	2011-11-1	2012-1-2	是
	北大方正集团有限公司	越亚有限	300,000.00	USD	2011-11-1	2012-1-2	是
	北大方正集团有限公司	越亚有限	680,000.00	USD	2011-11-14	2012-1-2	是
	北大方正集团有限公司	越亚有限	1,827,000.00	USD	2011-11-25	2012-1-27	是
	北大方正集团有限公司	越亚有限	1,220,000.00	USD	2011-11-28	2012-1-27	是
	北大方正集团有限公司	越亚有限	416,000.00	USD	2011-12-5	2012-2-3	是
	北大方正集团有限公司	越亚有限	724,664.13	USD	2011-12-29	2012-3-1	是
	北大方正集团有限公司	越亚有限	638,028.97	USD	2011-12-29	2012-3-1	是
	北大方正集团有限公司	越亚有限	955,000.00	USD	2011-12-13	2012-1-20	是
	北大方正集团有限公司	越亚有限	705,350.00	USD	2011-10-28	2011-12-27	是
	北大方正集团有限公司	越亚有限	15,000,000.00	RMB	2011-11-11	2012-12-2	是
2010 年	北大方正集团有限公司	越亚有限	602,833.00	USD	2010-12-13	2011-2-11	是
	北大方正集团有限公司	越亚有限	670,000.00	USD	2010-12-21	2011-2-15	是

报告期内，公司关联方与发行人签署的《保证合同》或《保证书》情况如下：

2010 年 12 月 20 日，方正集团与中国建设银行股份有限公司珠海分行签署了《最高额保证合同》，约定方正集团为越亚有限对中国建设银行股份有限公司珠海分行的债务提供最高额连带责任保证，债权确定期间为 2010 年 11 月 30 日至 2011 年 11 月 30 日，保证责任的最高限额为 5,500 万元。

2011 年 6 月 17 日，方正集团与中国建设银行股份有限公司珠海分行签署了《最高额保证合同》，约定方正集团为越亚有限对中国建设银行股份有限公司珠海分行的债务提供最高额连带责任保证，债权确定期间自 2011 年 6 月 17 日至 2012 年 6 月 17 日，保证责任的最高限额为 14,600 万元。

2011 年 6 月 10 日，方正集团向招商银行股份有限公司珠海分行出具了《最高额不可撤销担保书》，约定方正集团为越亚有限与招商银行股份有限公司珠海分行于 2011 年 6 月 8 日签署的《授信协议》（2011 年珠字第 0011568003 号）项下的所有债务承担连带保证责任，主合同授信期间自 2011 年 6 月 10 日到 2012 年 6 月 10 日，授信额度为 12,000 万元。

2011 年 11 月 10 日，方正集团与深圳发展银行股份有限公司珠海分行签署了《最高额保证担保合同》，约定方正集团为越亚有限自 2011 年 11 月 10 日至 2012 年 5 月 30 日与深圳发展银行股份有限公司珠海分行签订的所有主合同项下债务的履行提供连带责任保证，债务本金最高额为 1,500 万元。

上述主债权合同均已履行完毕，截至本招股说明书签署之日，不存在关联方为发行人提供担保之情形。本公司关联方为本公司银行贷款提供的担保或抵押未收取任何费用。

除了上述关联方直接为发行人融资提供担保支持外，发行人也通过为关联方担保方式，获得贷款支持。

2011年2月28日，方正集团与国开行签署《人民币资金借款合同》（合同编号为1100409502011021009号）、《人民币资金借款合同》（合同编号为1100409502011021010号）和《人民币资金借款合同》（合同编号为1100409502011041011号），该系列借款合同目的是支持珠海越亚新建TAPP及Coreless封装基板项目。同日，越亚有限与国开行签署了《国家开发银行股份有限公司人民币资金贷款抵押合同》，约定越亚有限以其新建TAPP及Coreless封装基板项目所属设备作抵押，为北大方正集团与国家开发银行股份有限公司间《人民币资金借款合同》（1100409502011021010号）项下债务提供担保，抵押物总价值为6,208万元，主债权数额为24,564万元，主债权借款期限自2011年2月28日至2017年2月27日；该动产抵押已于2011年8月24日办理了抵押登记（0756斗门20110824037号）。前述系列借款合同下国开行共计放款人民币113,840,020.50元由方正集团转账借款给越亚有限使用。

因主合同贷款已还清，该等动产抵押已于2012年8月9日注销。截至本招股说明书签署之日，不存在发行人为关联方提供担保之情形。

6. 计算机软件著作权转让

2012年10月25日，方正集团与发行人签署了《计算机软件著作权转让协议》，约定方正集团将原为二者共有的PCB X-OUT系统（V1.0）、PCB SPC系统（V1.0）及PCB智能报价系统（V1.0）的软件著作权自该协议签署之日起无地域限制并无偿转让给发行人。

7. 其他关联交易

报告期内，本公司曾聘请Menlo group作为美国市场的销售咨询顾问。根据本公司和Menlo group签署的《咨询服务合同》，本公司需于合同履行期间代Menlo group支付每月不超过1500美元的房屋租赁、电话等办公费用。

鉴于Menlo group向Camtek USA Inc租赁办公用房。根据《咨询服务合同》，2011年和2012年，本公司代Menlo group向Camtek USA Inc支付的办公用房及电话等办公费用分别为114,903.86元和99,290.19元。

2013年，公司已聘请 Menlo group 的主席 Nicholas Stukan 为公司下属企业越亚美国的首席营销官，并终止了与 Menlo group 之间的协议。2013年3月，Menlo group 的公司登记已被注销。

（三）关联方往来期末余额

单位：元

项目	关联方名称	2013 年末	2012 年末	2011 年末
应收款项	珠海方正印刷电路板发展有限公司	28,197.00	0.00	0.00
预付款项	康代影像科技（苏州）有限公司	0.00	398,334.10	0.00
应付账款	Camtek H.K. Limited.	0.00	0.00	2,419,545.60
	康代电子科技（苏州）有限公司	0.00	0.00	274,459.81
	康代影像科技（苏州）有限公司	291,270.00	1,078,845.58	45,369.86
	深圳市高科国融实业发展有限公司	927.46	133,122.30	470,004.81
	珠海方正科技高密电子有限公司	309,422.45	0.00	0.00
其他应付款	珠海方正科技高密电子有限公司	74,500.00	0.00	0.00
	珠海方正科技多层电路板有限公司	377,962.00	0.00	0.00
	Camtek USA, INC.	0.00	9,428.25	9,451.35
	AMITEC 公司	0.00	0.00	93,767.85
	深圳市北大方正数码科技有限公司	0.00	0.00	28,000.00
	珠海方正印刷电路板发展有限公司	200,000.00	4,265,790.49	4,272,765.72
	北大方正集团有限公司	0.00	0.00	3,616,187.39

（四）关联交易对公司财务状况和经营成果的影响

发行人具有完整的业务体系以及直接面向市场经营的能力，报告期内，公司与关联方之间的关联交易定价合理，发行人与关联方发生的关联交易不存在损害公司及其他非关联股东利益的情况。

四、规范关联交易的主要制度安排

发行人的《公司章程》第八十二条、第一百一十五条和第一百一十八条及《关联交易管理制度》规定了关联交易的特殊决策程序；发行人的《关联交易管理制度》第八条、第九条、第十条、第十一条规定了关联交易的特殊审议及披露程序；发行人的《独立董事工作细则》第十九条、第二十三条规定了发行人独立董事在关联交易中的特别职权。

《公司章程》第八十二条“股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东不应当参与投票表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数；股东大会决议应当充分说明非关联股东的表决情况。”

《公司章程》第一百一十五条“董事会依法行使下列职权：

.....

(八)在股东大会授权范围内,决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项;

.....”

《公司章程》第一百一十八条“董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易的权限,建立严格的审查和决策程序;重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审,并报股东大会批准。”

《关联交易管理制度》第八条“公司与关联自然人发生的交易金额在 30 万元以上的关联交易(公司提供担保除外),应当经董事会审议后及时披露。公司不得直接或者通过子公司向董事、监事、高级管理人员提供借款。”

《关联交易管理制度》第九条“公司与关联法人发生的交易金额在 300 万元人民币以上,且占公司最近一期经审计净资产绝对值 0.5%以上的关联交易(公司提供担保除外),应当由总经理向董事会提交议案,经董事会批准后生效并及时向股东披露。”

《关联交易管理制度》第十条“公司与关联人发生的交易(公司提供担保、受赠现金资产、单纯减免公司义务的债务除外)金额在 3,000 万元人民币以上,且占公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上的关联交易,除应当及时披露外,还应当聘请具有执行证券、期货相关业务资格的中介机构,对交易标的进行评估或审计,并将该交易提交股东大会审议。”

《关联交易管理制度》第十一条“公司为关联人提供担保的,不论数额大小,均应当在董事会审议通过后提交股东大会审议。”

《独立董事工作细则》第十九条“独立董事除应当具有《公司法》和其他相关法律、行政法规赋予董事的职权外,公司还应当赋予独立董事以下特别职权:(一)重大关联交易(指公司拟与关联自然人发生的交易金额在人民币 30 万元以上的关联交易以及公司拟与关联法人发生的交易金额在人民币 300 万元以上、且占公司最近一期经审计净资产绝对值 0.5%以上的关联交易)应由独立董事认可后,提交董事会讨论;独立董事作出判断前,可以聘请中介机构出具独立财务顾问报告,作为其判断的依据;...”

《独立董事工作细则》第二十三条“独立董事除履行上述职责外,还应当按照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等内部管理制度的规

定对以下事项向董事会或股东大会或在公司年度报告中发表独立意见：...（四）关联交易（含公司向股东、实际控制人及其关联企业提供资金）；...”

五、发行人报告期内关联交易的执行情况及独立董事意见

（一）报告期内关联交易制度的执行情况

公司产供销系统独立、完整，生产经营上不存在依赖关联方的情形；报告期内公司的关联交易不存在损害公司和股东合法权益的情形。发行人自股份公司成立以来发生的关联交易均严格履行了必要的审议程序。

发行人 2012 年第四次临时股东大会和 2013 年第二次临时股东大会审议分别通过了《关于对 2010 年 1 月 1 日至 2012 年 9 月 30 日公司与关联方之间关联交易事项予以确认的议案》和《关于对 2012 年 10 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日公司与关联方之间关联交易事项予以确认的议案》，对发行人关联交易事项进行了审议确认。

（二）独立董事关于关联交易的意见

公司自 2011 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日发生的关联交易均已履行了《公司章程》规定的程序，独立董事对上述关联交易履行审议程序的合法性和交易价格的公允性发表了无保留意见。独立董事认为：公司在报告期内发生的关联交易履行了法律法规、其他规范性文件及《公司章程》规定的应该履行的程序，审议程序合法、有效。在报告期内发生的关联交易执行了市场定价原则，价格合理、客观公允，不存在通过实施关联交易操纵公司利润的情形，不存在损害公司及中小股东利益的情况。公司在为首次公开发行（A 股）股票并在主板上市而编制的《招股说明书》中按照相关法律法规及其他规范性文件的规定对报告期内的关联交易进行了全面的披露，披露内容真实、准确、完整。

六、公司减少关联交易的措施

（一）方正信产、AMITEC、东方富海、方正集团、北大资产、北京大学、Priortech 出具的承诺函

截至本招股说明书签署日，持有公司 5%以上股份的股东（方正信产、AMITEC 公司和东方富海）及其关联机构（方正集团、北大资产、北京大学、Priortech）向公司出具了《关于减少和规范关联交易的承诺函》，作出如下承诺：

1、本公司（本单位）及本公司（本单位）所控制的其他企业将尽量减少并避免与珠海越亚及其控股公司发生关联交易；对于确有必要且无法回避的关联

交易，均按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格按市场公认的合理价格确定，并严格按相关法律、法规以及规范性文件的规定履行交易审批程序及信息披露义务，切实保护珠海越亚及其中小股东的利益。

2、本公司（本单位）保证严格遵守法律、法规和规范性文件及《珠海越亚封装基板技术股份有限公司公司章程》等的规定，依照合法程序，与其他股东平等行使股东权利、履行股东义务，不利用关联关系谋取不当的利益，不损害珠海越亚及其他股东的合法权益。

3、本公司（本单位）确认本承诺函所载的每一项承诺均为可独立执行之承诺，任何一项承诺若被视为无效或终止将不影响其他各项承诺的有效性。

4、本公司（本单位）将忠实履行承诺并保证确认的真实性，如果违反上述承诺或确认不真实，本公司（本单位）将承担由此引发的一切法律责任，包括全额赔偿珠海越亚及其其他股东因此遭受的损失、损害和开支。

5、本承诺函自本公司（本单位）签署之日起生效，本承诺函所载上述各项由本公司（本单位）作出之承诺分别在本公司（本单位）及本公司（本单位）所控制的企业持有珠海越亚 5%以上股份期间及自本公司（本单位）及本公司（本单位）所控制的企业不再持有珠海越亚 5%以上股份之日起一年内持续有效且不可变更和撤销。

（二）Yotam Stern 和 Rafi Amit 的承诺函

截至本招股说明书签署日，Yotam Stern 和 Rafi Amit 作为本公司并列第一大股东 AMITEC 的实际控制人，向公司出具了《关于减少和规范关联交易的承诺函》，作出如下承诺：

1、本人为其他所控制企业的实际控制人期间，本人将行使本人作为该企业实际控制人的权利及授权，确保本人及该企业尽量减少并避免与珠海越亚及其控股的公司发生关联交易；对于确有必要且无法回避的关联交易，均按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格按市场公认的合理价格确定，并严格按相关法律、法规以及规范性文件的规定履行交易审批程序及信息披露义务，切实保护珠海越亚及其中小股东的利益。

2、本人保证严格遵守法律、法规和规范性文件及《珠海越亚封装基板技术股份有限公司公司章程》等的规定，确保本人控制的相关企业作为珠海越亚的股东依照合法程序，与其他股东平等行使股东权利，履行股东义务，不利用本人的关联关系谋取不当的利益，不损害珠海越亚及其股东的合法权益。

3、本人确认本承诺函所载的每一项承诺均为可独立执行之承诺，任何一项承诺若被视为无效或终止将不影响其他各项承诺的有效性。

4、本人将忠实履行承诺并保证确认的真实性，如果违反上述承诺或确认不真实，本人将承担由此引发的一切法律责任，包括全额赔偿珠海越亚及其股东因此遭受的损失、损害和开支。

5、本承诺函自本人签署之日其生效，本承诺函所载上述各项由本人作出之承诺分别在本人及本人所控股企业持有珠海越亚 5%以上股份期间及自本人及本人所控股企业不再持有珠海越亚 5%以上股份之日起一年内持续有效且不可变更和撤销。

第七章 董事、监事、高级管理人员和核心技术人员

一、董事、监事、高级管理人员和核心技术人员简介

(一) 董事

本公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名。本公司董事由股东大会选举产生，任期3年，任期届满可连选连任。本公司董事简历如下：

1、方中华先生：公司董事长，中国籍，无境外永久居留权。1963年生，北京大学EMBA。方中华先生曾任中航集团商贸总公司财务经理，进出口部经理；深圳博兰实业总经理；东方时代投资有限公司副总经理；中国高科集团股份有限公司董事长等。2003年6月至2005年7月任西南合成制药（集团）有限公司董事长；2004年12月至2012年7月，担任方正科技董事长（2012年7月至今担任方正科技董事）。2004年至今，担任北大方正集团有限公司副总裁、高级副总裁；2011年至今，担任方正信产CEO。

2、Yotam Stern 先生：公司董事，以色列籍，以色列永久居留权，1953年生，经济学学士学位。Yotam Stern 先生于1986年至今一直在 Priortech Ltd.工作，于1986年至2005年担任 Priortech Ltd. CFO 和董事，2005年至今担任 Priortech Ltd. 董事和 CEO 职务。2000年3月至今在 AMITEC 公司担任董事职务。

3、刘欲晓女士：公司董事，中国籍，无境外永久居留权。1976年生，研究生学历，经济学硕士。刘欲晓女士曾先后任职于元富证券上海代表处、上海尔迪集团投资管理部等；2003年至2006年任职于方正科技担任投资管理部经理；2006年于北大方正集团有限公司担任IT硬件事业部总监；2006年至2012年在方正PCB事业部历任运营管理部总经理、事业部副总经理等职。2012年2月至今任职方正信产，担任副总裁。

4、Rafi Amit 先生：公司董事，以色列籍，以色列永久居留权。1949年生，学士学位。Rafi Amit 先生1980年至今在 Priortech Ltd.担任董事职务。1987年至今在 Camtek Ltd.先后担任首席执行官、董事长等职；2000年至今在 AMITEC 公司担任董事。

5、梅健先生：公司董事，中国籍，澳大利亚永久居留权。1966年出生，研究生学历，管理学硕士。梅健先生曾先后任北京市生物化学制药厂助理工程师、珠海经济特区生物化学制药厂质量部经理、深圳市海王药业有限公司总经理办主任、中国科技开发院医药科技开发所副所长、深圳市创新投资集团有限公司资产经营部总经理等职；2007年至今任深圳市东方富海投资管理有限公司合

伙人。

6、Yoon Sung Yong 先生：公司董事，韩国籍，韩国永久居留权。1968 年生，本科学历。Yoon Sung Yong 先生自 2000 年至 2011 年在 KTB Ventures, Inc. 担任董事长，2006 年至 2011 年任 KTB Investment & Securities Co., Ltd. 全球投资部总经理；2010 年至今任开铂（成都）创业管理有限公司董事长；2012 年 1 月至今任 KTB Private Equity Co.,Ltd. 全球投资部总经理。

7、赵晋琳女士：公司独立董事，中国籍，1968 年出生。赵晋琳女士 1995 年毕业于西南财经大学，获会计学硕士学位，2005 年毕业于暨南大学，获会计学博士学位，现任深圳大学财会学院副院长，硕士生导师等职。

赵晋琳女士主要从事财务管理和税务管理方面的教学与研究，独著或合著了《跨国公司预约定价研究》、《公司理财学教程（中国注册理财规划师考试指定用书）》等 5 部著作。在核心期刊上发表学术论文 40 多篇，其中 20 多篇被多次转载，多篇获奖。近年来主持和完成了省部级、市校级科研项目 7 项。

赵晋琳女士目前兼任岁宝百货控股（中国）有限公司、深圳英飞拓科技股份有限公司、深圳西龙同辉技术股份有限公司、深圳市易尚展示股份有限公司独立董事。

8、赵大利先生：公司独立董事，中国籍，1961 年生，吉林大学法学博士，辽宁大学经济法学博士后，教授，硕士生导师，现任东北财经大学法学院院长等职。主要从事刑事法学、刑事诉讼法学、经济犯罪研究、经济法学的教学与科研工作。赵大利先生出版专著 4 部，发表论文 50 余篇，主持多项国家级省部级科研项目，多部著作、论文获得省部级科研奖励。

赵大利先生目前兼任大连电瓷集团股份有限公司及威海华东数控股份有限公司独立董事职务。

9、郭国庆先生：公司独立董事，中国籍，1962 年生，经济学博士，第十一届全国人大代表，第八、九、十届全国政协委员，第七届全国青联委员。郭国庆先生现任民盟中央委员、民盟北京市委副主委，民盟中国人民大学委员会主委，中国人民大学商学院教授、博士生导师等职。

郭国庆先生目前兼任格力地产股份有限公司、酒鬼酒股份有限公司、中钢集团吉林炭素股份有限公司、北京王府井百货（集团）股份有限公司、丽珠医药集团股份有限公司及龙润茶集团有限公司独立董事和深圳市大富科技股份有限公司监事会主席职务。

（二）监事

本公司监事会由 3 名监事组成，其中包括 1 名股东代表监事和 2 名职工代表监事。股东代表监事由股东大会选举产生，职工代表监事由本公司职工通过职工代表大会民主选举产生。本公司监事任期 3 年，任期届满可连选连任。本公司监事简历如下：

1、刘兰兰女士：公司监事会主席，中国籍，无境外永久居留权。1984 年生，本科学历，法学学士。刘兰兰女士曾任珠海方正科技多层电路板有限公司法务专员、珠海方正印刷电路板发展有限公司法务专员。2012 年 5 月至今在本公司任法务专员。刘兰兰女士本届任期自 2012 年 7 月至 2015 年 7 月。

2、谢凤霞女士：公司监事，中国籍，无境外永久居留权。1980 年 9 月出生，研究生学历，工学硕士。谢凤霞女士自 2004 年至 2006 年在珠海方正科技多层电路板有限公司担任研发工程师职务；2006 年至 2013 年在本公司担任采购及物控部副经理；目前担任公司采购及物控部经理。谢凤霞女士本届任期自 2012 年 7 月至 2015 年 7 月。

3、王秋虎先生：公司监事，中国籍，无境外永久居留权。1974 年生，清华大学 MBA。王秋虎先生曾任百事（中国）有限公司区域销售经理、惠而浦（大中华）有限公司大区商务经理、北京顺成大观文化传播有限公司副总裁、北京普能世纪科技有限公司执行董事等职。2010 年至今任上海开物合伙人。王秋虎先生本届任期自 2012 年 7 月至 2015 年 7 月。

（三）高级管理人员

根据《公司章程》，本公司的高级管理人员为公司的总经理、副总经理、财务负责人与董事会秘书。本公司高级管理人员简历如下：

1、Dror Hurvits 先生：公司总经理暨首席执行官，以色列籍，以色列永久居留权。1959 年生，Israeli Institute of Technology 化学工程专业本科毕业，获工学学士学位。Dror Hurvits 先生自 1985 年至 1992 年，任职于 Tadiran Communications，历任工艺经理、工艺副总；1993 年至 1999 年，任职于 P.C.B Technologies，担任首席运营官；2000 年至 2008 年，任职于 AMITEC 公司，是 AMITEC 公司的创始人之一，曾担任 AMITEC 公司首席执行官，2006 年至今于本公司担任公司总经理暨首席执行官。

2、陈先明先生：公司副总经理暨首席运营官，中国籍，无境外永久居留权。1975 年生，上海交通大学工学双学士；电子科技大学软件工程硕士。陈先明先生 1999 年至 2001 年于珠海德丽科技有限公司担任主管工程师；2001 年于德资兴华集团担任制造部及工程部经理；2001 年至 2004 年于香港美维集团东莞益生电子有限公司担任设备部及信息中心助理经理；2004 年至 2006 年于珠海方正

科技多层线路板有限公司担任设备部及采购部经理；2006 年至今，于本公司担任公司副总经理暨首席运营官。

3、向文胜先生：公司副总经理，中国籍，无境外永久居留权，1967 年生，国防科技大学航天技术系固体火箭发动机专业本科毕业，获工学学士学位，东华大学旭日工商管理学院 EMBA。向文胜先生 1989 年至 1993 年，任三江航天集团（066 基地）质量工程师；1993 年至 1994 年，任富士康精密接插件有限公司质量工程师；1994 年至 1998 年，在辉开科技开发（深圳）有限公司先后任质量部经理、生产技术部经理等职；1998 年至 2001 年，在星科金朋（上海）有限公司任质量经理；2001 至 2010 年，在安靠封装测试上海有限公司任质量总监；2010 年至今，于本公司担任公司副总经理，主管产品品质。

4、陈春灵先生：公司首席财务官、董事会秘书，中国香港籍，获中国香港永久居留权，1974 年生，香港中文大学 MBA。陈春灵先生于 1995 年至 2004 年在南方航空珠海航空有限公司担任结算科副科长；2004 至 2010 年于上海方正科技（香港）有限公司担任财务总监；2010 年至 2011 年于珠海方正印刷电路板发展有限公司担任财务管理部总监；2011 年 4 月至今于本公司担任公司首席财务官、董事会秘书。

5、黄士辅先生：公司副总经理，中国台湾籍，获中国台湾永久居留权，1969 年生，逢甲大学材料科学专业本科毕业，获工学学士学位。黄士辅先生 2004 年至 2011 年任职于日月光电子股份有限公司中坜分公司，任资深研发经理；2011 年起任职于本公司，担任公司副总经理，主管工艺及研发。

（四）核心技术人员

1、Dror Hurvits，公司总经理暨首席执行官，简历详见本章“（三）高级管理人员”。

2、陈先明先生，公司副总经理暨首席运营官，简历详见本章“（三）高级管理人员”。

3、向文胜先生，公司副总经理，简历详见本章“（三）高级管理人员”。

4、黄士辅先生，公司副总经理，简历详见本章“（三）高级管理人员”。

5、姜俊文先生：公司工程部经理，中国籍，无境外永久居留权，1968 年生，大学本科学历。2008 年 1 月至 2009 年 5 月任领跃电子科技（珠海）有限公司工程部经理。2009 年 5 月起任职于本公司，目前担任公司工程部经理。

6、郭进良先生：公司产品工程部经理，中国籍，无境外永久居留权，1979

年生，大学本科学历。2007年2月至2008年5月任星科金朋（上海）有限公司工程师，2008年5月起任职于本公司，目前担任公司产品工程部经理。

7、许元鸿先生：公司工艺部和研发及知识产权部资深经理，中国台湾籍，获中国台湾永久居留权，1978年生，台北科技大学化学工程专业硕士毕业，获工学硕士学位。许元鸿先生2011年至2013年任职于南亚电路板股份有限公司，担任研发经理；2013年起任职于本公司，担任公司工艺部和研发及知识产权部资深经理。

8、王建皓先生：公司工程部资深经理，中国台湾籍，获中国台湾永久居留权，1980年生，成功大学化学工程专业硕士毕业，获工学硕士学位。王建皓先生2012年至2013年任职于南茂科技股份有限公司，担任研发经理；2013年起任职于本公司，担任公司工程部资深经理。

二、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属直接或间接持有本公司股权情况

截至本招股说明书签署日，本公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属不存在直接持有本公司股份情况，其间接持有本公司股份情况如下表：

名称	职务及近亲属关系	持股形式	持股比例（%）
方中华	董事长	间接持有	3.0943
Yotam Stern	副董事长	间接持有	3.3133
Rafi Amit	董事	间接持有	3.6539
梅健	董事	间接持有	0.0099
刘兰兰	监事会主席	间接持有	0.0061
谢凤霞	监事	间接持有	0.0493
王秋虎	监事	间接持有	0.0075
Dror Hurvits	总经理暨首席执行官	间接持有	0.5518
陈先明	副总经理暨首席运营官	间接持有	0.2026
向文胜	副总经理	间接持有	0.0979
陈春灵	首席财务官、董事会秘书	间接持有	0.0919
黄士辅	副总经理	间接持有	0.0108
姜俊文	工程部经理	间接持有	0.0486
郭进良	产品工程部经理	间接持有	0.0138
许元鸿	工艺部和研发及知识产权部资深经理	间接持有	0.0039
王建皓	工程部资深经理	间接持有	0.0039

公司董事长方中华通过北京招润投资管理有限公司间接持有公司股份；副

董事长 Yotam Stern 通过 Priortech 公司和 AMITEC 公司间接持有公司股份；董事 Rafi Amit 通过 Priortech 公司间接持有公司股份；公司监事刘兰兰、谢凤霞及核心技术人员姜俊文、郭进良，通过珠海睿鑫间接持有公司股份；公司监事王秋虎通过上海开物间接持有公司股份；公司总经理 Dror Hurvits、高级管理人员黄士辅、核心技术人员许元鸿、王建皓通过香港睿祺间接持有公司股份；公司高级管理人员陈先明、向文胜及陈春灵通过珠海睿祺间接持有公司股份。同时，根据 AMITEC 公司批准的《期权计划》，AMITEC 公司授予 Dror Hurvits 购买 AMITEC 公司普通股（每股面额为 0.01 以色列新谢克尔）500,000 股的期权，占 AMITEC 公司当时发行股本的 8%；公司董事梅健通过持有深圳东方富海 8% 的股份间接持有公司股份，其具体持股结构详见本招股说明书“第四章 发行人基本情况”之“九、发行人股本情况”之“（四）本次发行前各股东间的关联关系及关联股东的各自持股比例”。

除上述持股外，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属不存在以其他方式直接或间接持有本公司股份的情况。上述持股均不存在质押或冻结的情况。

三、董事、监事、高级管理人员和核心技术人员的其他对外投资情况

本公司董事、监事、高级管理人员中持有本公司股份情况详见本章“二、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属直接或间接持有本公司股权情况”。根据本公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员出具的承诺函，截至承诺函出具之日，公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员除直接持有下列公司股权外，无其他对外投资情况。

序号	姓名	在本公司任职	其他对外投资企业	出资额/万元	出资比例 (%)
1	方中华	董事长	北京招润投资管理有限公司	268.9	26.89
2	Yotam Stern	副董事长	Priortech	---	9.29
			Camtek Ltd.	---	0.36
			P.C.B Technologies Ltd	---	0.11
			AMITEC 公司	---	0.01
3	刘欲晓	董事	---	---	---
4	Rafi Amit	董事	Camtek Ltd.	---	0.16

序号	姓名	在本公司任职	其他对外投资企业	出资额/万元	出资比例(%)
			Priortech	---	10.25
5	梅健	董事	深圳市东方富海投资管理有限公司	80	8
6	Yoon Sung Yong	董事	---	---	---
7	刘兰兰	监事会主席	珠海睿鑫投资合伙企业	5.00	1.43
8	谢凤霞	监事	珠海睿鑫投资合伙企业	40.60	11.63
9	王秋虎	监事	上海开物股权投资管理有限公司	125	25
			湖南开宜投资有限公司	900	90
			北京取道兴业科技有限公司	40	14
			北京中交票联信息科技有限公司	1	5
			成都云遥互动科技有限公司	40	8
			北京凯盛绿能科技有限公司	5	2.5
10	Dror Hurvits	总经理暨首席执行官	香港睿祺投资有限公司	71.72 (美元)	79.85
			拥有购买 AMITEC 公司普通股 500,000 股的期权, 占 AMITEC 公司当时发行股本的 8%		
11	陈先明	副总经理暨首席运营官	珠海睿祺投资合伙企业	166.76	51.64
12	陈春灵	首席财务官, 董事会秘书	珠海睿祺投资合伙企业	75.59	23.41
13	向文胜	副总经理	珠海睿祺投资合伙企业	80.59	24.95
14	黄土辅	副总经理	香港睿祺投资有限公司	1.41 (美元)	1.57
15	姜俊文	工程部经理	珠海睿鑫投资合伙企业	39.97	11.44
16	郭进良	产品工程部经理	珠海睿鑫投资合伙企业	11.35	3.25
17	许元鸿	工艺部和研发及知识产权部资深经理	香港睿祺投资有限公司	0.50 (美元)	0.56
18	王建皓	工程部经理	香港睿祺投资有限公司	0.50 (美元)	0.56

四、董事、监事、高级管理人员和核心技术人员薪酬情况

2013 年度, 本公司的董事、监事、高级管理人员和核心技术人员的薪酬情况如下:

序号	姓名	职务	2013 年度薪酬/元
1	方中华	董事长	未在本公司领薪
2	Yotam Stern	董事	未在本公司领薪
3	刘欲晓	董事	未在本公司领薪
4	Rafi Amit	董事	未在本公司领薪
5	梅健	董事	未在本公司领薪
6	Yoon Sung Yong	董事	未在本公司领薪
7	赵晋琳	独立董事	120,000.00
8	赵大利	独立董事	120,000.00
9	郭国庆	独立董事	120,000.00
10	刘兰兰	监事会主席	85,855.78
11	谢凤霞	职工监事	174,480.00
12	王秋虎	监事	未在本公司领薪
13	Dror Hurvits	总经理暨首席执行官	2,996,869.76
14	陈先明	副总经理暨首席运营官	1,370,673.60
15	陈春灵	首席财务官，董事会秘书	558,081.34
16	向文胜	副总经理	1,011,275.00
17	黄土辅	副总经理	1,064,980.00
18	姜俊文	工程部经理、核心技术人员	308,480.00
19	郭进良	产品工程部经理、核心技术人员	249,480.00
20	许元鸿	工艺部和研发及知识产权部资深经理、核心技术人员	348,275.55
21	王建皓	工程部资深经理、核心技术人员	368,435.00

在本公司领取薪酬的非独立董事、监事、高级管理人员和核心技术人员，除依法享有住房公积金、医疗保障等各项福利外，公司还按照国家 and 地方的有关规定，依法为其办理失业、养老、工伤等保险，并定期向社保部门缴纳各项保险基金。独立董事在本公司仅领取独立董事津贴 12 万元/年，不享有其他福利待遇。

目前，本公司不存在其他特殊的待遇和退休金计划，本公司也未制定董事、监事、高级管理人员和核心技术人员的认股权计划。

五、董事、监事、高级管理人员和核心技术人员相互之间的关系及兼职情况

（一）董事、监事、高级管理人员和核心技术人员相互之间的关系

截至本招股说明书签署日，本公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员之间均不存在配偶关系、三代以内直系或旁系亲属关系。

（二）董事、监事、高级管理人员和核心技术人员的兼职情况

根据本公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员的承诺函，截至承诺函签署日，公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员除在下列单位兼职外，无其他兼职情况。

姓名	在本公司任职	在其他单位任职情况	兼职单位与本公司关系
方中华	董事长	方正国际软件有限公司法定代表人、董事长	公司并列第一大股东方正信产控制的公司
		方正移动传媒技术（北京）有限公司法定代表人、董事长	公司并列第一大股东方正信产控制的公司
		方正移动传媒技术（重庆）有限公司法定代表人、执行董事	公司并列第一大股东方正信产控制的公司
		北京方正阿帕比技术有限公司法定代表人、董事长	公司并列第一大股东方正信产控制的公司
		上海方正数字出版技术有限公司法定代表人、董事长	公司并列第一大股东方正信产控制的公司
		北大医疗信息技术有限公司法定代表人、董事长	公司并列第一大股东方正信产控制的公司
		方正信息技术（苏州）有限公司法定代表人、执行董事	公司并列第一大股东方正信产控制的公司
		方正宽带网络服务有限公司董事	公司并列第一大股东方正信产的控股股东控制的公司
		北京方正众邦数字医疗系统有限公司法定代表人、执行董事	公司并列第一大股东方正信产控制的公司
		北京北大方正电子有限公司董事	公司并列第一大股东方正信产控制的公司
		光明方正信息技术（北京）有限公司董事	公司并列第一大股东方正信产参股的公司
		上海方正信息安全技术有限公司董事	公司并列第一大股东方正信产控制的公司
		深圳市北大方正数码科技有限公司董事	公司并列第一大股东方正信产控制的公司
		北大方正信息产业集团有限公司董事、首席执行官	公司并列第一大股东
		方正控股有限公司主席兼执行董事	公司并列第一大股东方正信产控制的公司
		方正科技集团股份有限公司董事	公司并列第一大股东方正信产控制的公司
		北大方正集团有限公司高级副总裁	公司并列第一大股东方正信产的控股股东
Yotam	副董事长	Priortech Ltd. CEO、董事	公司并列第一大股东 AMITEC 公

姓名	在本公司任职	在其他单位任职情况	兼职单位与本公司关系
Stern			公司的控股股东
		AMITEC 公司董事	公司并列第一大股东
		P.C.B Technologies Ltd.CEO 和董事	公司并列第一大股东 AMITEC 公司的控股股东控制的公司
		Camtek Ltd.董事	公司并列第一大股东 AMITEC 公司的控股股东控制的公司
		Afik (Nadlan) Ltd.董事	公司并列第一大股东 AMITEC 公司的控股股东控制的公司
		Cellergy Ltd. 董事	公司并列第一大股东 AMITEC 公司的控股股东控制的公司
		Sela Semiconductor Engineering Laboratories Ltd. 董事	公司并列第一大股东 AMITEC 公司的控股股东控制的公司
		Panta-I 董事	公司并列第一大股东 AMITEC 公司的控股股东控制的公司
		Camtek USA Inc. 董事	公司并列第一大股东 AMITEC 公司的控股股东控制的公司
		Amitec-Advanced Multilayer Interconnect Technologies HK Limited 董事	公司并列第一大股东 AMITEC 公司控制的公司
		Camtek H.K. Ltd. 董事	公司并列第一大股东 AMITEC 公司的控股股东控制的公司
		Precision Circuits, Inc. 董事	公司并列第一大股东 AMITEC 公司的控股股东控制的公司
		ACCESS Technologies USA 董事	公司控制的公司
刘欲晓	董事	珠海方正印刷电路板发展有限公司法定代表人、董事长	公司并列第一大股东方正信产控制的企业
		珠海方正科技多层电路板有限公司董事	公司并列第一大股东方正信产控制的企业
		珠海方正科技高密电子有限公司董事	公司并列第一大股东方正信产控制的企业
		杭州方正速能科技有限公司董事	公司并列第一大股东方正信产控制的企业
		重庆方正高密电子有限公司董事	公司并列第一大股东方正信产控制的企业
		越亚封装基板（香港）有限公司董事	公司全资子公司
		ACCESS Technologies USA. 董事	公司控制的公司
		北京北大方正电子有限公司董事	公司并列第一大股东方正信产控制的公司
		北京方正印捷数码技术有限公司董事	公司并列第一大股东方正信产控制的公司

姓名	在本公司任职	在其他单位任职情况	兼职单位与本公司关系
		北大方正信息产业集团有限公司董事副总裁	公司并列第一大股东
		北京方正阿帕比技术有限公司董事	公司并列第一大股东方正信产控制的公司
		方正控股有限公司执行董事	公司并列第一大股东方正信产控制的公司
		方正移动传媒技术（北京）有限公司董事	公司并列第一大股东方正信产控制的公司
		北京方正数字印刷技术有限公司法定代表人、董事长	公司并列第一大股东方正信产控制的公司
		方正国际软件有限公司董事	公司并列第一大股东方正信产控制的公司
		方正国际软件（北京）有限公司董事	公司并列第一大股东方正信产控制的公司
		方正宽带网络服务有限公司法定代表人、董事长	公司并列第一大股东方正信产的控股股东控制的公司
Rafi Amit	董事	Prioritech Ltd. 董事长	公司并列第一大股东 AMITEC 公司的控股股东控制的公司
		AMITEC 公司董事	公司并列第一大股东
		P.C.B Technologies Ltd. 董事会主席	公司并列第一大股东公司的控股股东控制的公司
		Camtek Ltd. 董事会主席	公司并列第一大股东 AMITEC 公司的控股股东控制的公司
		Afik （Nadlan） Ltd. 董事	公司并列第一大股东 AMITEC 公司的控股股东控制的公司
		Cellergy Ltd. 董事	公司并列第一大股东 AMITEC 公司的控股股东控制的公司
		Camtek USA Inc. 董事	公司并列第一大股东 AMITEC 公司的控股股东控制的公司
		Camtek （EUROPE） NV 董事	公司并列第一大股东 AMITEC 公司的股东控制的公司
		Amitec-Advanced Multilayer Interconnect Technologies HK Limited 董事	公司并列第一大股东 AMITEC 公司的子公司
		Camtek H.K. Ltd. 董事	公司并列第一大股东 AMITEC 公司的控股股东控制的公司
		Precision Circuits, Inc. 董事	公司并列第一大股东 AMITEC 公司的控股股东控制的公司
		越亚封装基板（香港）有限公司董事	公司全资子公司
梅健	董事	深圳市东方富海投资管理有限	公司股东皖江物流、东方富海、

姓名	在本公司任职	在其他单位任职情况	兼职单位与本公司关系
		公司董事、合伙人	东方富海二号的间接股东
		深圳市创赛一号创业投资股份有限公司监事	公司董事参股公司
		深圳市浩能科技有限公司董事	公司董事参股公司
		深圳市兴耀华实业有限公司监事	公司股东参股公司
		江阴浩博科技有限公司董事	公司董事参股公司
		重庆秦川实业（集团）股份有限公司董事	公司董事参股公司
		昆明制药股份有限公司独立董事	无
		杨凌圣妃乳业有限公司董事	公司董事参股公司
		深圳巴蜀企业家俱乐部有限公司董事	公司董事参股公司
Yoon Sung Yong	董事	KTB Private Equity Co.,Ltd.全球投资部总经理	公司股东开铂银科之间接股东
		开铂（成都）创业管理有限公司董事长	公司股东开铂银科之管理人
赵晋琳	独立董事	深圳大学会计学院教授	无
		岁宝百货控股（中国）有限公司独立非执行董事	无
		深圳英飞拓科技股份有限公司独立董事	无
		深圳西龙同辉技术股份有限公司独立董事	无
		深圳市易尚展示股份有限公司独立董事	无
赵大利	独立董事	东北财经大学法学院教授	无
		大连电瓷集团股份有限公司独立董事	无
		威海华东数控股份有限公司独立董事	无
郭国庆	独立董事	中国人民大学商学院教授	无
		格力地产股份有限公司独立董事	无
		酒鬼酒股份有限公司独立董事	无
		北京王府井百货（集团）股份有限公司独立董事	无
		中钢集团吉林炭素股份有限公司	无

姓名	在本公司任职	在其他单位任职情况	兼职单位与本公司关系
		司独立董事	
		丽珠医药集团股份有限公司独立董事	无
		龙润茶集团有限公司独立非执行董事	无
		深圳市大富科技股份有限公司监事会主席	无
王秋虎	监事	上海开物股权投资管理有限公司合伙人、监事	公司股东之普通合伙人
		湖南开宜投资有限公司法定代表人、执行董事兼总经理	公司监事参股公司
Dror Hurvits	总经理暨首席执行官	香港睿祺投资有限公司董事	公司股东（员工持股公司）
		ACCESS Technologies USA 总裁、CEO	公司控制的公司
		越亚封装基板（香港）有限公司总经理	公司全资子公司
陈春灵	首席财务官、董秘	香港睿祺投资有限公司董事	公司股东（员工持股公司）
		珠海睿祺投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人	公司股东（员工持股企业）
		ACCESS Technologies USA. CFO，公司秘书	公司控制的公司
		越亚封装基板（香港）有限公司财务总监	公司全资子公司

六、董事、监事、高级管理人员和核心技术人员有关协议

（一）公司与上述人员签订的协议或合同

截至本招股说明书签署日，本公司与在公司任职并领薪的董事、监事、高级管理人员和核心技术人员除签署了劳动合同书、保密协议书和竞业禁止协议书外，未签署其他协议。

（二）上述协议的履行情况

截至本招股说明书签署日，公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员与公司签定的上述协议、所作的承诺都得到很好的履行。

七、董事、监事、高级管理人员的任职资格

本公司董事、监事、高级管理人员均符合《公司法》及其他国家有关法律法規规定的任职资格条件。

八、董事、监事、高级管理人员报告期内的变动情况

（一）报告期内董事变动情况

越亚有限系中外合资企业，按照《中外合资经营企业法》和《公司章程》的规定，越亚有限董事由股东委派。

2010年1月1日，越亚有限共有4名董事，分别为方中华（董事长）、Yotam Stern（副董事长）、刘欲晓和Dror Hurvits。其中方中华、刘欲晓由原股东深圳数码委派，Yotam Stern、Dror Hurvits由AMITEC公司委派。

2012年1月，越亚有限通过董事会决议，引入东方富海、东方富海二号、皖江物流和上海开物等投资者，其中东方富海、东方富海二号、皖江物流共同委派梅健担任董事；股东AMITEC公司委派Rafi Amit取代Dror Hurvits作为公司新的董事会成员，其余董事不变。

2012年3月，越亚有限通过董事决议，因引入投资者宁波科发和开铂银科，调整董事会，董事会由6名董事组成，原董事方中华、Yotam Stern、刘欲晓、Rafi Amit、梅健不变，新增董事Yoon Sung Yong由开铂银科委派。

2012年7月，越亚有限整体变更为股份公司。公司召开股份公司创立大会并选举第一届董事会，董事会成员为方中华、Yotam Stern、刘欲晓、Rafi Amit、梅健和Yoon Sung Yong。

2012年9月，为保护中小股东的利益、完善发行人公司治理结构，公司召开2012年度第三次临时股东大会，将董事人数调整为九名，并增选赵晋琳、赵大利、郭国庆为发行人第一届董事会的独立董事。

公司报告期内董事长未发生变动，最近三年内引入投资者继而增加董事会（包括独立董事）成员，是为了增强董事会的管理、决策能力，完善公司法人治理结构，未影响发行人的持续经营、发展战略及业务目标的延续性，没有给公司的生产经营、管理造成不利影响，董事会成员的更迭已履行了必要的法律程序。

（二）报告期内监事变动情况

越亚有限不设监事会，亦不设监事。2012年6月25日，发行人召开职工代表大会，选举刘兰兰和谢凤霞为职工代表监事。2012年7月6日，发行人召开创立大会选举王秋虎为股东代表监事。

2012年7月6日，第一届监事会第一次会议选举刘兰兰为监事会主席。

公司在改制成股份公司之前，没有设立监事会。在改制成股份公司时，发行人设立了监事会，选举了职工代表监事和股东代表监事，充分发挥监事会的监督职能，完善公司法人治理结构，尽管发行人最近三年监事发生变化，但对发行人的经营决策未产生重大影响。

（三）报告期内高级管理人员变动情况

2011年4月1日，发行人聘任陈春灵为财务总监，其他高级管理人员未发生变动。

2012年7月，公司整体变更成股份公司，并召开第一届董事会第一次会议，聘任 Dror Hurvits 为公司总经理，陈先明、向文胜及 Nicholas Stukan 为公司副总经理（Nicholas Stukan 未实际履职，于 2013 年 2 月越亚美国设立后任其首席营销官，发行人第一届董事会九次会议通过了《关于撤销公司第一届董事会第一次会议聘任 Nicholas Stukan 为公司副总经理决议的议案》，撤消了对其副总经理职务的任命），陈春灵为公司财务总监兼董事会秘书。

2012 年 9 月，公司召开第一届董事会第四次会议，聘任黄士辅为公司副总经理。

上述人员的引进未影响发行人的持续经营及发展战略、业务目标的延续性，没有给公司的生产经营、管理造成不利影响，高级管理人员的更迭已履行了必要的法律程序。

第八章 公司治理结构

本公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等有关法律、行政法规和规范性文件的规定，建立了健全的股东大会、董事会、监事会、独立董事和董事会秘书等制度。公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会四个专门委员会，为董事会重大决策提供咨询和建议，保证董事会议事、决策的专业化和高效化。

公司股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会专门委员会以及董事会秘书均能够按照公司章程依法独立规范运作，履行各自的权利和义务，切实保障了公司及全体股东的利益。

一、发行人股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的建立健全及运行情况

公司根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规的要求，逐步建立健全了股东大会、董事会、监事会、独立董事和董事会秘书制度。公司制订的上述制度符合《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规和其他有关上市公司治理规范性的文件要求，完善了由公司股东大会、董事会、监事会和管理层组成的公司治理架构，形成了权力机构、决策机构、监督机构和管理层之间权责明确、运作规范、相互协调和相互制衡的机制。

（一）股东大会制度的建立健全及运行情况

2012年7月6日公司创立大会根据《公司法》和《公司章程》的规定通过了《股东大会议事规则》；2013年2月19日，公司2013年第二次临时股东大会对《股东大会议事规则》进行了修订。股东大会和股东严格按照《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定行使自己的权利。

1. 股东的权利与义务

根据《公司章程》的规定，公司股东享有如下权利：（1）依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配；（2）依法请求、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加股东大会，并依照其所持有的股份份额行使表决权；（3）对公司的经营进行监督，提出建议或者质询；（4）依照法律、行政法规及本章程的规定转让、赠与或质押所持有的股份；（5）依照法律、行政法规和本章程的规定获得有关信息，包括：有权查阅本章程、股东名册、公司债券存根、股东大会会议记录、董事会会议决议、监事会会议决议、财务会计报告；

(6) 公司终止或者清算时, 按其所持有的股份份额参加公司剩余财产的分配;
(7) 对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议的股东, 要求公司收购其股份;
(8) 法律、行政法规、部门规章及公司章程所赋予的其他权利。

根据《公司章程》规定, 公司股东承担下列义务: (1) 遵守法律、行政法规和本章程, 不得滥用股东权利损害公司或者其他股东的利益; 不得滥用公司法人独立地位和股东有限责任损害公司债权人的利益; (2) 执行股东大会决议, 维护公司的合法权益; (3) 依其所认购股份和入股方式缴纳股金; (4) 除法律、法规规定的情形外, 不得退股; (5) 以其所认购的股份为限, 对公司承担责任; (6) 法律、行政法规和本章程规定应当承担的其他义务。

公司股东滥用股东权利给公司或者其他股东造成损失的, 应当依法承担赔偿责任。公司股东滥用公司法人独立地位和股东有限责任, 逃避债务, 严重损害公司债权人利益的, 应当对公司债务承担连带责任。

2. 股东大会的职责

根据《公司章程》和《股东大会议事规则》规定, 股东大会是公司的权力机构, 依法行使下列职权: (1) 决定公司的经营方针和投资计划; (2) 选举和更换董事、非由职工代表担任的监事, 决定有关董事、监事的报酬事项; (3) 审议批准董事会的报告; (4) 审议批准监事会的报告; (5) 审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案; (6) 审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案; (7) 对公司增加或者减少注册资本作出决议; (8) 对发行公司债券作出决议; (9) 对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议; (10) 修改公司章程; (11) 对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议; (12) 审议批准《股东大会议事规则》第五条规定的担保事项; (13) 审议批准《股东大会议事规则》第六条规定的交易事项; (14) 审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产 30% 的事项; (15) 审议批准公司拟与关联人发生的交易金额在 3000 万元以上, 且占公司最近一期经审计净资产绝对值 5% 以上的关联交易; (16) 审议批准变更募集资金用途事项; (17) 审议股权激励计划; (18) 审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定应当由股东大会决定的其他事项。

3. 股东大会议事规则

股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召开一次, 于上一会计年度结束后的六个月内举行。股东大会召集人应当在年度股东大会召开 20 日前以书面方式通知各股东, 临时股东大会应当于会议召开 15 日前以书面方式通知各股东。股东大会决议分为普通决议和特别决议。股东大会作

出普通决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。股东大会作出特别决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

4. 股东大会运作情况

截至本招股说明书签署日，本公司自股份公司设立以来共召开了 11 次股东大会，历次股东大会召开情况如下：

序号	时间	届次	出席情况
1	2012年7月6日	创立大会暨第一次股东大会	8人，代表100%股份
2	2012年8月10日	2012年第一次临时股东大会	8人，代表100%股份
3	2012年8月24日	2012年第二次临时股东大会	8人，代表100%股份
4	2012年9月25日	2012年第三次临时股东大会	11人，代表100%股份
5	2012年12月17日	2012年第四次临时股东大会	11人，代表100%股份
6	2013年1月4日	2013年第一次临时股东大会	11人，代表100%股份
7	2013年2月19日	2013年第二次临时股东大会	11人，代表100%股份
8	2013年6月28日	2012年度股东大会	11人，代表100%股份
9	2013年9月30日	2013年第三次临时股东大会	11人，代表100%股份
10	2014年3月17日	2014年第一次临时股东大会	11人，代表100%股份
11	2014年6月17日	2013年度股东大会	11人，代表100%股份

历次股东大会的召开、决议的内容及签署符合《公司章程》、《股东大会议事规则》等相关制度的要求；不存在董事会、管理层等违反《公司法》、《公司章程》及相关制度等要求行使职权的行为。

（二）董事会的建立健全及运行情况

2012年7月6日公司创立大会选举产生公司第一届董事会，同时根据《公司法》、《公司章程》的规定通过了《董事会议事规则》；2013年2月19日，公司2013年第二次临时股东大会对《董事会议事规则》进行了修订。董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名，董事会和董事严格按照《公司章程》和《董事会议事规则》的规定行使自己的职权。

1. 董事会职权

根据《公司章程》和《董事会议事规则》规定，董事会行使以下职权：（1）召集股东大会会议，并向股东大会报告工作；（2）执行股东大会的决议；（3）决定公司的经营计划和投资方案；（4）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；（5）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；（6）制订公司增加或者减少注册资本以及公司发行债券和其他证券及上市的方案；（7）制订公司合并、分立、解散或者变更公司形式的方案；（8）在股东大会授权范围内，决定公司

对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保、委托理财、关联交易等事项；（9）决定公司内部管理机构的设置；（10）决定聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理的提名决定聘任或者解聘公司副总经理、财务总监等高级管理人员，并决定其报酬和奖惩事项；（11）向股东大会提请聘任或者解聘承办公司审计业务的会计师事务所；（12）制定公司的基本管理规定；（13）制订《公司章程》的修改方案；（14）管理公司信息披露事项；（15）听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；（16）审议批准《董事会议事规则》第五条规定的交易事项；（17）审议批准公司拟与关联自然人发生的交易金额在 30 万元以上的关联交易（公司提供担保除外）；审议批准公司拟与关联法人发生的交易金额在 300 万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值 0.5%以上的关联交易（公司提供担保除外）；（18）法律、行政法规和公司章程规定以及股东大会授权的其他事项。

2. 董事会议事规则

董事会会议分为定期会议和临时会议。董事会每年至少召开两次定期会议。董事会审议通过会议提案并形成相关决议，必须有超过公司全体董事人数之半数的董事对该提案投赞成票。法律、法规及《公司章程》规定董事会形成决议时应当取得更多董事同意的，从其规定。董事会根据本公司《公司章程》的规定，在其权限范围内对担保事项作出决议，除全体董事过半数同意外，还必须经出席会议的三分之二以上董事的同意。

3. 董事会运作情况

本公司设立以来，董事会按照《公司章程》、《董事会议事规则》及相关规定，规范运作，严格履行有关法律规定的召集程序及信息披露义务。截至本招股说明书签署日，公司共召开了 15 次董事会，历次董事会召开情况如下：

序号	时间	届次	出席情况
1	2012年7月6日	第一届董事会第一次会议	董事6人出席
2	2012年8月9日	第一届董事会第二次会议	董事6人出席
3	2012年8月24日	第一届董事会第三次会议	董事6人出席
4	2012年9月24日	第一届董事会第四次会议	董事6人出席
5	2012年9月29日	第一届董事会第五次会议	董事9人出席
6	2012年12月1日	第一届董事会第六次会议	董事9人出席
7	2012年12月20日	第一届董事会第七次会议	董事9人出席
8	2013年2月2日	第一届董事会第八次会议	董事8人出席
9	2013年4月29日	第一届董事会第九次会议	董事9人出席
10	2013年6月8日	第一届董事会第十次会议	董事9人出席
11	2013年7月16日	第一届董事会第十一次会议	董事9人出席

序号	时间	届次	出席情况
12	2013年9月13日	第一届董事会第十二次会议	董事9人出席
13	2013年11月30日	第一届董事会第十三次会议	董事9人出席
14	2014年2月28日	第一届董事会第十四次会议	董事9人出席
15	2014年5月23日	第一届董事会第十五次会议	董事9人出席

报告期内，公司各董事均亲自出席或依法委托代表出席历次董事会会议。各与会董事均认真参与了董事会各项议案的讨论，在协商一致后最终形成董事会决议及会议纪要，并均书面签字。

（三）监事会的建立健全及运行情况

公司设监事会。监事会是公司常设的监督性机构，负责对董事会及其成员以及总经理等高级管理人员进行监督，防止其滥用职权，侵犯股东、公司及公司员工的合法权益。《公司章程》和《监事会议事规则》对公司监事和监事会的各方面情况做出了详细全面的规定。根据《公司章程》规定，本公司监事会由3名监事组成，监事会设主席1人。

1. 监事会职权

根据《公司章程》和《监事会议事规则》规定，监事会行使下列职权：（1）对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见；（2）检查公司财务；（3）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、本章程或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；（4）当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正；（5）提议召开临时股东大会，在董事会不履行《公司法》及《公司章程》规定的召集和主持股东大会会议职责时负责召集和主持股东大会会议；（6）向股东大会会议提出议案；（7）依照《公司法》和《公司章程》的相关规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；（8）发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作，费用由公司承担；（9）法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》规定或股东大会授予的其他职权。

2. 监事会议事规则

监事会由3名监事组成，监事会设主席1人。监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务时，由该主席指定一名监事代行其职权。监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比例不低于1/3。监事会中的职工代表由公司职工代表大会选举和罢免。监事会每6个月至少召开一次会议；监

事会决议应当经出席会议监事过半数同意。

3. 监事会运作情况

自本公司设立至本招股说明书签署日，公司共召开了 4 次监事会，历次监事会召开情况如下：

序号	时间	届次	出席情况
1	2012年7月6日	第一届监事会第一次会议	监事3人出席
2	2013年2月2日	第一届监事会第二次会议	监事3人出席
3	2013年6月8日	第一届监事会第三次会议	监事3人出席
4	2014年5月23日	第一届监事会第四次会议	监事3人出席

本公司上述历次监事会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序、决议的内容及签署等，均符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，不存在监事违反《公司法》、《公司章程》及其他相关制度要求行使职权的行为。

（四）独立董事制度的建立健全及运行情况

目前，本公司已设 3 位独立董事，分别为赵晋琳、郭国庆和赵大利，占本公司董事人数的 1/3，符合有关规定的比例要求。

1. 独立董事工作制度安排

本公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，并参照中国证监会颁布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《上市公司治理准则》，于 2012 年 9 月 25 日召开的 2012 年第三次临时股东大会制定了《独立董事工作细则》；公司于 2013 年 2 月 19 日召开的 2013 年第二次临时股东大会对《独立董事工作细则》进行了修订，对独立董事任职资格、选聘、任期、享有职权、发表独立意见等作了详细的规定，符合上市公司治理的规范性文件要求，且与该等规范性文件的要求不存在实质差异。独立董事负有诚信与勤勉义务，独立履行职责，维护公司整体利益。

2. 独立董事职权

根据《独立董事工作细则》规定，独立董事除具有《公司法》、其他相关法律、法规和《公司章程》赋予董事的职权外，还具有以下特别职权：（1）重大关联交易（指公司拟与关联自然人发生的交易金额在人民币 30 万元以上的关联交易以及公司拟与关联法人发生的交易金额在人民币 300 万元以上、且占公司最近一期经审计净资产绝对值 0.5%以上的关联交易）应由独立董事认可后，提交董事会讨论；独立董事作出判断前，可以聘请中介机构出具独立财务顾问报

告，作为其判断的依据；（2）向董事会提议聘用或解聘会计师事务所；（3）向董事会提请召开临时股东大会；（4）提议召开董事会；（5）独立聘请外部审计机构和咨询机构；（6）在股东大会召开前公开向股东征集投票权；（7）法律、行政法规及《公司章程》规定的独立董事其他职权。独立董事行使上述职权应当取得全体独立董事的二分之一以上同意。

此外，独立董事还应当对以下事项向董事会或股东大会或在公司年度报告中发表独立意见：（1）提名、任免董事；（2）聘任或解聘高级管理人员；（3）公司董事、高级管理人员的薪酬；（4）关联交易（含公司向股东、实际控制人及其关联企业提供资金）；（5）变更募集资金用途；（6）公司对外担保事项；（7）股权激励计划；（8）独立董事认为可能损害中小股东权益的事项；（9）《公司章程》规定的其他事项；（10）中国证监会或上海证券交易所要求独立董事发表意见的其他事项。

3. 独立董事履职情况

公司独立董事按照《公司章程》、《独立董事工作细则》等工作要求，履行独立董事的职责。独立董事重点对公司报告期内关联交易履行审议程序的合法性和交易价格的公允性进行了核查验证，基于独立判断的立场发表独立意见情况如下：

序号	时间	发表意见的事项	意见
1	2012年12月1日	关于2010年1月1日至2012年9月30日公司与关联方关联交易事宜的独立意见。	无保留
2	2013年2月2日	关于公司与关联方签署《园区综合服务协议》的独立意见； 关于2012年10月1日至2012年12月31日公司与关联方之间关联交易事项的独立意见。	无保留
3	2013年9月13日	关于公司修改与关联方签署《园区综合服务协议》的独立意见。	无保留
4	2014年5月23日	关于2013年1月1日至2013年12月31日公司与关联方关联交易事宜的独立意见。	无保留

（五）董事会秘书制度的建立健全及运行情况

2012年7月6日召开的第一届董事会第一次会议审议通过《董事会秘书工作细则》，同时聘任陈春灵先生为公司董事会秘书；2013年2月2日召开的第一届董事会第八次会议，对《董事会秘书工作细则》进行了修订。根据《公司章程》和《董事会秘书工作细则》规定，董事会秘书是公司高级管理人员，对董事会负责。

1. 董事会秘书职权

依据《公司章程》和《董事会秘书工作细则》，董事会秘书主要行使下列职权：（1）依法准备和及时递交国家有关部门要求的董事会和股东大会出具的报告和文件；（2）协助筹备董事会会议和股东大会，负责会议的记录工作，并负责保管会议文件和记录；（3）为董事会决策提供意见或建议，协助董事会行使职权时切实遵守国家法律、法规、本章程有关规定，在董事会作出违反有关规定的决议时，应及时提出异议；（4）负责管理和保存公司股东名册资料，保管董事会印章，确保符合资格的投资人及时得到公司披露的资料；（5）负责公司咨询服务，协调处理公司与股东之间的相关事务和股东日常接待及信访工作；（6）董事会授予的其他职权。

2. 董事会秘书履职情况

截至本招股说明书签署日，公司董事会秘书按照《公司章程》和《董事会秘书工作细则》筹备董事会会议和股东大会，确保了公司董事会会议和股东大会依法召开、依法行使职权，及时向公司股东、董事通报公司的有关信息，建立了与股东的良好关系，为公司治理结构的完善和董事会、股东大会正常行使职权发挥了重要的作用。

（六）董事会专门委员会的设置情况

为进一步完善公司治理结构，更好地发挥独立董事的作用，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等有关法律法规和规范性文件，本公司在董事会下设立战略委员会、审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会。

2012年9月29日，公司召开的第一届董事会第五次会议决议设立董事会专门委员会，并通过了各专门委员会的工作细则，确保董事会专门委员会制度的规范执行。

公司董事会专门委员会成员的构成情况如下：

专门委员会名称	委员	召集人
战略委员会	方中华、郭国庆、Rafi Amit、Yoon Sung Yong	方中华
审计委员会	赵晋琳、郭国庆、赵大利、Yotam Stern、刘欲晓	赵晋琳
提名委员会	郭国庆、赵大利、刘欲晓、Rafi Amit、赵晋琳	郭国庆
薪酬与考核委员会	赵大利、郭国庆、梅健	赵大利

上述专门委员会成员在任职期间均遵守《公司法》、《公司章程》、《董事会战略委员会工作细则》、《董事会审计委员会工作细则》、《董事会提名委员会工作细则》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关制度的规定，认真履行了相关工作职责，对公司相应部门的运行情况起到了良好的监督及规范作

用，保证了公司整体的良好运作及稳定发展。

二、报告期内发行人的违法违规情况

2008 年至 2010 年间，越亚有限在从广州口岸和深圳口岸出口货物过程中共计有 37 票货物出现向海关申报出口价格和实际货物价格不符的情况，多报关出口货物金额合计为 262,496.09 美元，共涉及出口退税 296,516.23 元。就该等行为，广州白云机场海关于 2011 年 5 月 17 日向越亚有限出具了机关缉违字[2011]000161 号《中华人民共和国广州白云机场海关行政处罚决定书》，对公司处以罚款 30 万元。

公司已经根据上述决定书的处罚要求缴纳了相应罚款；同时公司已采取措施提升报关管理质量，此后未再发生类似的失误。

此外，拱北海关于 2012 年 11 月 19 日作出《企业管理类别调整决定书》（拱北分决[2012]02071 号），决定对公司按《中华人民共和国海关企业分类管理办法》适用 A 类管理。拱北海关于 2013 年 1 月 6 日出具《企业守法情况核查反馈表》，确认发行人自 2009 年 1 月 1 日至 2013 年 1 月 5 日期间未发现有走私违规记录；于 2014 年 1 月 15 日出具《企业守法情况核查反馈表》，确认发行人自 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日期间未发现有走私违规记录；斗门海关于 2012 年 12 月 4 日出具《稽查结论》（斗关稽结(2012)JC201257700043 号），确定公司在 2009 年 10 月 26 日至 2012 年 10 月 25 日期间，该海关未发现发行人存在违反海关监管规定情形。

除上述情形外，报告期内公司不存在其他违法违规的行为，也不存在被其他相关主管机关处罚的情况。

三、近三年发行人资金占用和对外担保的情况

公司已建立了严格的资金管理制度，报告期内不存在资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业以借款、代偿债务、代垫款项或其他方式占用的情形。

报告期内，发行人对外担保情况详见“第六章 同业竞争与关联交易”之“三、关联交易事项”。

除此之外，本公司不存在为公司股东、关联方及其控制的其他企业担保的情况。截至本招股说明书签署日，本公司不存在为发行人股东以及关联方违规提供担保的情况。

四、发行人内部控制制度

（一）发行人管理层的自我评估意见

公司管理层对内部控制制度进行评估后认为，公司的内部控制的设计是完整合理的，并在实际经营活动中有效执行，能够合理地保证内部控制目标的达成。

（二）注册会计师评价意见

根据瑞华会计师出具的瑞华专审字[2014] 40030009 号《内部控制鉴证报告》，瑞华认为，发行人按照财政部等五部委颁发的《企业内部控制基本规范》规定的标准于 2013 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。

五、基于股权结构、行业特点等保证其内控制度完整合理有效、公司治理完善的具体措施

（一）公司治理

公司在改制设立股份公司后即已建立并不断完善有关内控制度，且根据公司本身特点在有关内控制度中做了针对性规定和设计。

1. 发行人建立了健全的内部管理制度保证公司治理的有效性

公司依法制定了健全的各项内部管理制度；公司通过了《独立董事工作细则》，通过设立独立董事等方式，强化对董事会、管理层的约束和监督；公司任何股东单独均不能通过实际支配公司股份表决权决定公司董事会半数以上成员选任。公司历次股东大会、董事会、监事会均按照公司法和公司章程规定的职权履行职责，股东大会、董事会、监事会会议议案均是由全体股东、董事、监事一致表决通过。

2. 发行人建立了健全的内部控制制度防范内部人控制以保障股东利益

公司制定了《对外担保管理制度》、《关联交易管理制度》、《对外投资管理制度》，从而避免因可能的内部人控制而损害股东利益；同时考虑到上市后公众股东的利益保障，公司还制定了《投资者关系管理制度》、《信息披露管理制度》，确保本公司上市后公众股东能及时、准确地获取本公司对外披露的信息，从而有利于公众股东有效地参与公司的治理，保障公众股东的利益。公司制定了一套包括组织架构、治理结构、管理制度、财务制度等在内的较为健全有效的内部控制体系，以确保公司的各项生产、经营活动都能有章可循。

3. 发行人股东承诺上市后锁定股份

详见本招股说明书“重大事项提示”之“一、股份限制流通及自愿锁定承诺”。

（二）内部控制

公司主要从事 IC 封装基板的研发、生产和销售，属于封装基板制造行业，集成电路产业。行业特点决定了公司在制定有关内控制度时除应按照中国证监会、证券交易所有关上市公司治理的要求执行外，还应按照其生产经营的特点制定和完善有关特别制度。针对公司日常生产经营需要以及各职能部门的工作职责和要求，公司制订了生产经营相关的多项制度，包括但不限于《固定资产管理制度》、《安全生产管理制度》、《合同管理制度》、《印章管理制度》等。上述制度的制定与实施系公司从生产经营的实际需求出发，为加强内部控制而制定的有关专项制度，有利于公司根据行业特点采取具有针对性的内控完善举措。

第九章 财务会计信息

本章引用的财务数据，非经特别说明，均引自经审计的公司财务报表及其附注，并以合并数反映。公司提醒投资者关注本招股说明书所附财务报告和审计报告全文，以获取全部的财务资料。本章所引用数据，若各分项数字之和（或差）与合计数字存在微小差异（如 0.01），系四舍五入原因导致。

一、发行人财务报表

（一）合并资产负债表

单位：元

资 产	2013 年 12 月 31 日	2012 年 12 月 31 日	2011 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	22,592,630.46	42,650,219.86	165,085,680.51
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款	58,050,129.11	109,363,311.50	79,323,427.54
预付款项	20,285,626.11	20,546,645.55	16,450,631.72
应收利息			
应收股利			
其他应收款	7,902,577.83	12,634,747.46	7,800,789.35
买入返售金融资产			
存货	47,709,804.28	56,030,416.13	61,070,352.08
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计	156,540,767.79	241,225,340.50	329,730,881.20
非流动资产：			
可供出售金融资产			
长期股权投资			
投资性房地产			
固定资产	742,892,425.68	667,611,253.60	353,513,089.10
在建工程	137,948,349.92	170,651,413.19	169,464,704.03
无形资产	90,656,135.62	88,386,711.42	95,375,017.33
开发支出	2,907,508.78	4,807,238.50	0.00
商誉			
长期待摊费用		0.00	21,434,999.30
递延所得税资产	209,937.11	89,320.37	12,349.88
其他非流动资产			
非流动资产合计	974,614,357.11	931,545,937.08	639,800,159.64
资产总计	1,131,155,124.90	1,172,771,277.58	969,531,040.84

负债及股东（所有者）权益	2013 年 12 月 31 日	2012 年 12 月 31 日	2011 年 12 月 31 日
流动负债：			
短期借款	30,623,702.19	54,816,663.03	319,334,285.33
应付票据		13,274,733.36	9,294,974.50
应付账款	114,984,863.26	167,639,256.76	215,768,265.28
预收款项	15,610.00	0.00	22,737.43
应付职工薪酬	4,627,520.14	9,599,314.42	10,219,710.42
应交税费	-20,081,183.56	-38,193,570.51	-56,398,117.88
应付利息	60,813.76	184,630.55	439,062.03
应付股利			
其他应付款	933,279.82	6,343,889.30	11,940,027.55
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	131,164,605.61	213,664,916.91	510,620,944.66
非流动负债：			
长期借款	143,330,778.84	124,242,509.94	0.00
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债	7,570,731.15	5,819,571.00	2,127,972.84
非流动负债合计	150,901,509.99	130,062,080.94	2,127,972.84
负债合计	282,066,115.60	343,726,997.85	512,748,917.50
股东（所有者）权益：			
股本（实收资本）	605,124,067.00	605,124,067.00	468,825,159.87
资本公积	179,349,594.18	179,349,594.18	0.00
减：库存股			0.00
专项储备			0.00
盈余公积	8,626,208.59	6,268,377.53	0.00
一般风险准备			0.00
未分配利润	55,896,922.07	38,302,329.31	-12,043,036.53
外币报表折算差额	92,217.46	-88.29	
归属于母公司股东权益合计	849,089,009.30	829,044,279.73	456,782,123.34
少数股东权益	0.00		
股东（所有者）权益合计	849,089,009.30	829,044,279.73	456,782,123.34
负债和股东（所有者）权益总计	1,131,155,124.90	1,172,771,277.58	969,531,040.84

（二）合并利润表

单位：元

项 目	2013 年度	2012 年度	2011 年度

项 目	2013 年度	2012 年度	2011 年度
一、营业总收入	368,470,968.60	496,417,011.15	437,747,385.52
其中：营业收入	368,470,968.60	496,417,011.15	437,747,385.52
二、营业总成本	351,889,893.24	407,780,432.54	392,554,268.44
其中：营业成本	302,349,206.95	356,410,308.21	341,747,532.80
营业税金及附加			
销售费用	4,176,975.03	3,778,540.76	4,103,908.79
管理费用	41,327,304.20	41,671,262.93	32,886,473.33
财务费用	3,228,019.12	5,423,650.57	13,717,554.47
资产减值损失	808,387.94	496,670.07	98,799.05
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	16,581,075.36	88,636,578.61	45,193,117.08
加：营业外收入	6,239,917.89	1,852,420.71	522,814.61
减：营业外支出			309,770.75
其中：非流动资产处置损失			9,611.05
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	22,820,993.25	90,488,999.32	45,406,160.94
减：所得税费用	2,868,569.43	7,779,263.65	-12,349.88
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	19,952,423.82	82,709,735.67	45,418,510.82
其中：被合并方在合并前实现利润			
归属于母公司所有者的净利润	19,952,423.82	82,709,735.67	45,418,510.82
少数股东损益			
六、每股收益：			
（一）基本每股收益	0.03	0.14	
（二）稀释每股收益	0.03	0.14	
七、其他综合收益	92,305.75	-88.29	
八、综合收益总额	20,044,729.57	82,709,647.38	45,418,510.82
归属于母公司所有者的综合收益总额	20,044,729.57	82,709,647.38	45,418,510.82
归属于少数股东的综合收益总额			

（三）合并现金流量表

单位：元

项 目	2013 年度	2012 年度	2011 年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金	438,767,219.98	486,385,076.54	424,453,467.61
收到的税费返还	50,618,032.72	60,245,110.67	43,944,724.22
收到其他与经营活动有关的现金	10,524,225.47	8,299,671.11	9,405,971.81
经营活动现金流入小计	499,909,478.17	554,929,858.32	477,804,163.64

项 目	2013 年度	2012 年度	2011 年度
购买商品、接受劳务支付的现金	280,444,433.46	305,561,518.93	337,018,748.40
支付给职工以及为职工支付的现金	64,089,446.89	63,654,813.41	55,105,753.73
支付的各项税费	8,091,787.53	7,351,949.24	563,102.34
支付其他与经营活动有关的现金	9,925,423.05	11,799,552.20	9,048,333.89
经营活动现金流出小计	362,551,090.93	388,367,833.78	401,735,938.36
经营活动产生的现金流量净额	137,358,387.24	166,562,024.54	76,068,225.28
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,855.93	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		1,855.93	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	139,890,282.23	375,187,355.29	283,016,411.35
投资支付的现金			
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计	139,890,282.23	375,187,355.29	283,016,411.35
投资活动产生的现金流量净额	-139,890,282.23	-375,185,499.36	-283,016,411.35
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		289,872,009.01	227,263,197.37
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
借款收到的现金	139,276,311.56	347,943,237.07	457,263,939.81
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			12,000,000.00
筹资活动现金流入小计	139,276,311.56	637,815,246.08	696,527,137.18
偿还债务支付的现金	142,747,127.57	487,785,080.81	183,502,157.68
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,364,772.34	10,472,479.70	14,144,803.80
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			260,000,000.00
筹资活动现金流出小计	152,111,899.91	498,257,560.51	457,646,961.48
筹资活动产生的现金流量净额	-12,835,588.35	139,557,685.57	238,880,175.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,443,089.61	434,244.45	-373,707.75

项 目	2013 年度	2012 年度	2011 年度
五、现金及现金等价物净增加额	-12,924,393.73	-68,631,544.80	31,558,281.88
加：期初现金及现金等价物余额	18,413,378.13	87,044,922.93	55,486,641.05
六、期末现金及现金等价物余额	5,488,984.40	18,413,378.13	87,044,922.93

(四) 母公司资产负债表

单位：元

资 产	2013 年 12 月 31 日	2012 年 12 月 31 日	2011 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	22,237,228.18	41,366,541.24	165,085,680.51
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款	63,073,715.22	110,700,927.69	79,323,427.54
预付款项	20,285,626.11	20,546,645.55	16,450,631.72
应收利息			
应收股利			
其他应收款	7,895,042.36	12,634,747.46	7,800,789.35
存货	47,709,804.28	56,030,416.13	61,070,352.08
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计	161,201,416.15	241,279,278.07	329,730,881.20
非流动资产			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	95,546.40	95,546.40	0.00
投资性房地产		0.00	0.00
固定资产	742,892,425.68	667,611,253.60	353,513,089.10
在建工程	137,948,349.92	170,651,413.19	169,464,704.03
无形资产	90,656,135.62	88,386,711.42	95,375,017.33
开发支出	2,907,508.78	4,807,238.50	0.00
商誉			
长期待摊费用			21,434,999.30
递延所得税资产	209,937.11	89,320.37	12,349.88
其他非流动资产			
非流动资产合计	974,709,903.51	931,641,483.48	639,800,159.64
资产总计	1,135,911,319.66	1,172,920,761.55	969,531,040.84
负债和股东（所有者）权益	2013 年 12 月 31 日	2012 年 12 月 31 日	2011 年 12 月 31 日
流动负债：			
短期借款	30,623,702.19	54,816,663.03	319,334,285.33
交易性金融负债		0.00	0.00

应付票据		13,274,733.36	9,294,974.50
应付账款	114,984,863.26	167,639,256.76	215,768,265.28
预收款项	15,610.00	0.00	22,737.43
应付职工薪酬	4,524,524.01	8,413,652.03	10,219,710.42
应交税费	-20,081,183.56	-38,193,570.51	-56,398,117.88
应付利息	60,813.76	184,630.55	439,062.03
应付股利		0.00	0.00
其他应付款	923,743.29	6,343,889.30	11,940,027.55
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	131,052,072.95	212,479,254.52	510,620,944.66
非流动负债：			
长期借款	143,330,778.84	124,242,509.94	0.00
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债	7,570,731.15	5,819,571.00	2,127,972.84
非流动负债合计	150,901,509.99	130,062,080.94	2,127,972.84
负债合计	281,953,582.94	342,541,335.46	512,748,917.50
股东（所有者）权益：			
股本（实收资本）	605,124,067.00	605,124,067.00	468,825,159.87
资本公积	179,349,594.18	179,349,594.18	0.00
减：库存股			
专项储备			
盈余公积	8,626,208.59	6,268,377.53	0.00
一般风险准备			
未分配利润	60,857,866.95	39,637,387.38	-12,043,036.53
股东（所有者）权益合计	853,957,736.72	830,379,426.09	456,782,123.34
负债和股东（所有者）权益总计	1,135,911,319.66	1,172,920,761.55	969,531,040.84

（五）母公司利润表

单位：元

项 目	2013 年度	2012 年度	2011 年度
一、营业收入	367,968,152.14	496,417,011.15	437,747,385.52
减：营业成本	302,349,206.95	356,410,308.21	341,747,532.80
营业税金及附加			
销售费用	2,087,160.59	3,464,565.76	4,103,908.79
管理费用	39,321,872.05	40,651,288.49	32,886,473.33
财务费用	3,198,838.76	5,422,541.94	13,717,554.47

项 目	2013 年度	2012 年度	2011 年度
资产减值损失	804,111.62	496,670.07	98,799.05
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	20,206,962.17	89,971,636.68	45,193,117.08
加：营业外收入	6,239,917.89	1,852,420.71	522,814.61
减：营业外支出			309,770.75
其中：非流动资产处置损失			9,611.05
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	26,446,880.06	91,824,057.39	45,406,160.94
减：所得税费用	2,868,569.43	7,779,263.65	-12,349.88
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	23,578,310.63	84,044,793.74	45,418,510.82

（六）母公司现金流量表

单位：元

项 目	2013 年度	2012 年度	2011 年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金	434,537,390.33	485,048,139.90	424,453,467.61
收到的税费返还	50,618,032.72	60,245,110.67	43,944,724.22
收到其他与经营活动有关的现金	10,524,149.77	8,299,671.11	9,405,971.81
经营活动现金流入小计	495,679,572.82	553,592,921.68	477,804,163.64
购买商品、接受劳务支付的现金	280,444,433.46	305,561,518.93	337,018,748.40
支付给职工以及为职工支付的现金	60,145,123.31	63,548,549.84	55,105,753.73
支付的各项税费	8,091,787.53	7,351,949.24	563,102.34
支付其他与经营活动有关的现金	8,688,785.29	11,757,099.65	9,048,333.89
经营活动现金流出小计	357,370,129.59	388,219,117.66	401,735,938.36
经营活动产生的现金流量净额	138,309,443.23	165,373,804.02	76,068,225.28
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,855.93	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		1,855.93	

项 目	2013 年度	2012 年度	2011 年度
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	139,890,282.23	375,187,355.29	283,016,411.35
投资支付的现金		95,546.40	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计	139,890,282.23	375,282,901.69	283,016,411.35
投资活动产生的现金流量净额	-139,890,282.23	-375,281,045.76	-283,016,411.35
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		289,872,009.01	227,263,197.37
借款收到的现金	139,276,311.56	347,943,237.07	457,263,939.81
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			12,000,000.00
筹资活动现金流入小计	139,276,311.56	637,815,246.08	696,527,137.18
偿还债务支付的现金	142,747,127.57	487,785,080.81	183,502,157.68
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,364,772.34	10,472,479.70	14,144,803.80
支付其他与筹资活动有关的现金			260,000,000.00
筹资活动现金流出小计	152,111,899.91	498,257,560.51	457,646,961.48
筹资活动产生的现金流量净额	-12,835,588.35	139,557,685.57	238,880,175.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,420,309.96	434,332.75	-373,707.75
五、现金及现金等价物净增加额	-11,996,117.39	-69,915,223.42	31,558,281.88
加：期初现金及现金等价物余额	17,129,699.51	87,044,922.93	55,486,641.05
六、期末现金及现金等价物余额	5,133,582.12	17,129,699.51	87,044,922.93

二、注册会计师审计意见类型

瑞华对本公司 2011 年 12 月 31 日、2012 年 12 月 31 日、2013 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表，2011 年度、2012 年度、2013 年度的利润表、合并利润表、现金流量表、合并现金流量表、股东权益变动表、合并股东权益变动表及财务报表附注进行了审计，并出具了瑞华审字[2014]40030105 号标准无保留意见的《审计报告》。

瑞华认为，本公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了本公司 2011 年 12 月 31 日、2012 年 12 月 31 日、2013 年 12 月 31 日的财务状况以及 2011 年度、2012 年度、2013 年度的经营成果和现金流量。

三、财务报表编制基础及合并财务报表范围

（一）财务报表的编制基础

本公司按照财政部 2006 年颁布的《企业会计准则——基本准则》和 38 项具体会计准则及其应用指南、解释及其他有关规定（统称“企业会计准则”）编制了财务报表，并按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》（2010 年修订）对相关财务信息进行了披露。

本公司财务报表以持续经营为基础列报。

（二）合并财务报表范围及变动

本公司合并财务报表包含了越亚香港和越亚美国的财务数据。越亚香港系本公司的全资子公司，于 2012 年 9 月 17 日在香港注册成立；越亚美国系越亚香港的全资子公司，于 2013 年 2 月 22 日在美国加州注册成立。报告期内，除新增越亚香港和越亚美国外，本公司的合并财务报表范围未发生变化。

四、报告期内的主要会计政策和会计估计

（一）金融资产及金融负债

金融工具是指形成一个企业的金融资产、并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。

1. 金融资产和金融负债的确认和终止确认

本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

金融资产满足下列条件之一的，终止确认：

- ①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
- ②该金融资产已转移，且符合下述金融资产转移的终止确认条件。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。

2. 金融资产和金融负债的分类和计量

本公司的金融资产和金融负债于初始确认时分为以下五类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债、持有至到期投资、应收款项、可供出售金融资产和其他金融负债。金融资产或金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产或金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。

- （1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债。交易性金融资产，主要指企业为了近期内出售而持有的股票、债券、基金以及不作为有效套期工具的衍生工具或近期内回购而承担的金融负债；直接指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，主要是指本公司基于风险管理，战略投资需要等所作的指定。

此类金融资产或金融负债采用公允价值进行后续计量。除作为有效的套期工具外，此类金融资产或金融负债所有已实现和未实现损益均计入当期损益。

（2）持有至到期投资

持有至到期投资，是指本公司购入的到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力持有至到期的固定利率国债、浮动利率公司债券等非衍生金融资产。

本公司对持有至到期投资在持有期间采用实际利率法、按照摊余成本计量。持有至到期投资发生减值、摊销或终止确认时产生的利得或损失，均应当计入当期损益。处置持有至到期投资时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

（3）应收款项

应收款项，是指本公司对外销售商品或提供劳务形成的应收账款等债权，包括应收账款、其他应收款、长期应收款等。

应收款项按从购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额，在持有期间采用实际利率法，按摊余成本计量。收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

（4）可供出售金融资产

包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款和应收款项、持有至到期投资以外的金融资产。

可供出售债务工具投资的期末成本按照其摊余成本法确定，即初始确认金额扣除已偿还的本金，加上或减去采用实际利率法将该初始确认金额与到期日金额之间的差额进行摊销形成的累计摊销额，并扣除已发生的减值损失后的金额。可供出售权益工具投资的期末成本为其初始取得成本。

可供出售金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产与摊余成本相关的汇兑差额计入当期损益外，确认为其他综合收益并计入资本公积，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。

可供出售金融资产持有期间取得的利息及被投资单位宣告发放的现金股利，计入投资收益。

（5）其他金融负债

其他金融负债，是指没有划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

本公司对其他负债采用摊余成本或成本计量。其他金融负债在摊销、终止确认时产生的利得或损失，应当计入当期损益。

3. 金融资产转移

本公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的或既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬、但放弃了对该金融资产控制的，终止对该金融资产的确认。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项的差额计入当期损益：

①所转移金融资产的账面价值；

②因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

①终止确认部分的账面价值；

②终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，将所收到的对价确认为一项金融负债。

对于采用继续涉入方式的金融资产转移，本公司按照继续涉入所转移金融资产的程度确认一项金融资产，同时确认一项金融负债。

4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

存在活跃市场的金融资产或金融负债，用活跃市场中的报价来确定公允价值；金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。

5. 金融资产（不含应收款项）减值测试方法

本公司在资产负债表日对金融资产（不含应收款项）的账面价值进行检查，有客观证据表明发生减值的，计提减值准备。

（1）持有至到期投资

根据账面价值与预计未来现金流量的现值之间的差额计算确认减值损失。具体比照应收款项减值损失计量方法处理。

如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关（如债务人的信用评级已提高等），原确认的减值损失应当予以转回，计入当期损益。但是，该转回后的账面价值不应当超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

（2）可供出售金融资产

有客观证据表明可供出售金融资产公允价值发生较大幅度下降，并预期这种下降趋势属于非暂时性的，可以认定该可供出售金融资产已发生减值，确认减值损失。可供出售金融资产发生减值的，在确认减值损失时，应当将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，计入减值损失。该转出的累计损失，等于可供出售金融资产的初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。可供出售权益工具投资发生的减值损失，在该权益工具价值回升时，通过权益转回，不通过损益转回。

（二）应收款项及坏账准备

1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

公司以期末余额占应收款项余额 5%及以上为单项金额重大的判断依据，对经单独进行减值测试有客观证据表明发生减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备；经单独进行减值测试未发生减值的或者无法准确预计其未来现金流量现值的，参照信用风险组合以账龄分析法计提坏账准备。

2. 按组合计提坏账准备应收款项

确定组合的依据	以账龄为信用风险组合确认依据
按组合计提坏账准备的计提方法	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

账龄	应收账款计提比例（%）	其他应收款计提比例（%）
75 天及以内	0%	0%
76 天至 1 年	5%	5%
1 年至 2 年	20%	20%
2 年至 3 年	50%	50%
3 年以上	100%	100%

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

组合名称	方法说明
出口退税款和海关保证金	不计提坏账准备
对于其他应收款项（包括应收票据、预付款项、应收利息、长期应收款等）	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备

3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单项计提坏账准备的理由	应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应收款项组合的未来现金流量现值存在显著差异
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备

（三）存货及存货跌价准备

1. 存货的分类

本公司将存货分为原材料、在产品、产成品、低值易耗品等。

2. 发出存货的计价方法

取得和发出的计价方法：取得时按实际成本计价，本公司各类存货的购入与入库按实际成本计价，原材料、低值易耗品的发出采用先进先出法核算；产成品的发出采用加权平均法核算。

3. 存货可变现净值的确认依据及存货跌价准备的计提方法

产成品、商品、用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值。

需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值。

为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为计算基础，若持有存货的数量多于销售合同订购数量，超出部分的存货可变现净值以一般销售价格为计算基础；没有销售合同约定的存货（不包括用于出售的材料），其可变现净值以一般销售价格（即市场销售价格）作为计算基础；用于出售的材料等通常以市场价格作为其可变现净值的计算基础。

本公司于资产负债表日对存货进行全面清查，按存货成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。通常按照单个（或类别）存货项目计提存货跌价准备；对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，合并计提存货跌价准备。若以前减记存货价值的影响因素已经消失，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

4. 存货的盘存制度

存货盘存制度为永续盘存制。

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品中的设备零备件从领用时按一至两年摊销，其他低值易耗品在领用时采用一次摊销法摊销。

包装物在领用时采用一次摊销法摊销。

（四）长期股权投资

1. 投资成本确定

（1）同一控制下的企业合并取得的长期股权投资

通过同一控制下企业合并取得的长期股权投资，以本公司在被合并方于合并日按本公司会计政策调整后的账面净资产中所享有的份额作为初始投资成本。

（2）非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资

通过非同一控制下的控股合并取得的长期股权投资，以购买日确定的合并成本作为初始投资成本。

通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并的，应当以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和作为该项投资的初始投资成本。

（3）其他方式取得的长期股权投资

以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照所发行权益性证券的公允价值（不包括自被投资单位收取的已宣告但未发放的现金股利或利润）作为初始投资成本。

投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本，但合同或协议约定的价值不公允的除外。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

2. 后续计量及损益确认方法

本公司对子公司的投资，以及对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算。本公司对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

按权益法核算长期股权投资时：

长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额应当计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。在确认应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资

产的公允价值为基础，按照本公司的会计政策及会计期间，并抵消与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照持股比例计算归属于本公司的部分（但未实现内部交易损失属于资产减值损失的，应全额确认），对被投资单位的净利润进行调整后确认。

确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，但合同或协议约定负有承担额外损失义务的除外。被投资单位以后实现净利润的，本公司在其收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应冲减长期股权投资的账面价值。

对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，在持股比例不变的情况下，本公司按照持股比例计算应享有或承担的部分，调整长期股权投资的账面价值，同时增加或减少资本公积。

持股比例减少后被投资单位仍然是本公司的联营企业或合营企业时，本公司应当继续采用权益法核算剩余投资，并按处置投资的比例将以前在其他综合收益（资本公积）中确认的利得或损失结转至当期损益。

持股比例增加后被投资单位仍然是本公司的联营企业或合营企业时，本公司应当按照新的持股比例对投资继续采用权益法进行核算。在新增投资日，新增投资成本与按新增持股比例计算的被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额按照前述原则处理；该项长期股权投资取得新增投资时的原账面价值与按增资后持股比例扣除新增持股比例后的持股比例计算应享有的被投资单位可辨认净资产公允价值份额之间的差额，应当调整长期股权投资账面价值和资本公积。

3. 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

（1）共同控制的判断依据

共同控制，是指任何一个合营方均不能单独控制合营企业的生产经营活动，涉及合营企业基本经营活动的决策需要各合营方一致同意等。

（2）重大影响的判断依据

重大影响，是指对一个企业的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。当本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位 20%（含 20%）以上但低于 50% 的表决权股份时，除非有明确证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策从而不形成

重大影响外，均确定对被投资单位具有重大影响；本公司拥有被投资单位 20%（不含）以下的表决权股份，一般不认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确证据表明该种情况下能够参与被投资单位的生产经营决策，能够形成重大影响。

4. 减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、合营企业和联营企业的长期股权投资，本公司按照本节“（十一）资产减值”所述方法计提减值准备。

对持有的被投资单位不具有共同控制或重大影响、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，本公司按照本节“（一）金融资产及金融负债”之“5. 金融资产（不含应收款项）减值测试方法”所述方法计提资产减值准备。

（五）投资性房地产

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。本公司投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物。

本公司对投资性房地产按照取得时的成本进行初始计量，并按照固定资产或无形资产的有关规定，按期计提折旧或摊销。

采用成本模式进行后续计量的投资性房地产，计提资产减值方法详见本章“（十一）资产减值”。

（六）固定资产

1. 固定资产的确认条件

固定资产，是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理，使用寿命超过一个会计年度而持有的有形资产。在满足与固定资产有关的经济利益很可能流入本公司及固定资产的成本能够可靠地计量时予以确认。

2. 各类固定资产的折旧方法

固定资产折旧采用年限平均法分类计提。固定资产自达到预定可使用状态时开始计提折旧，终止确认时或划分为持有待售非流动资产时停止计提折旧（已提足折旧仍继续使用的固定支持和单独计价入账的土地除外）。在不考虑减值准备的情况下，按固定资产类别、预计使用寿命和预计残值，本公司确定各类固定资产的年折旧率如下：

类别	折旧年限（年）	残值率	年折旧率

房屋建筑物及附属设施	5-40	10%	2.25-18%
机器设备	10	10%	9%
运输工具	5	10%	18%
电子设备	5	10%	18%
其他设备	5-10	10%	9-18%

3. 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

本公司固定资产减值准备的计提方法详见本章“（十一）资产减值”。

4. 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

本公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值。

融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

5. 其他说明

每年年度终了，本公司对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。使用寿命预计数与原先估计数有差异的，调整固定资产使用寿命；预计净残值预计数与原先估计数有差异的，调整预计净残值。

固定资产发生的修理费用，符合固定资产确认条件的计入固定资产成本，不符合规定的固定资产确认条件的在发生时直接计入当期成本、费用。

符合资本化条件的固定资产装修费用：在两次装修期间与固定资产尚可使用年限两者中较短的期间内，采用年限平均法单独计提折旧。

（七）在建工程

1. 在建工程核算方法

本公司在建工程按实际成本计量，按立项项目分类核算。

2. 在建工程结转为固定资产的时点

在建工程达到预定可使用状态时，按实际发生的全部支出转入固定资产核算。若在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

3. 在建工程减值准备

本公司在建工程减值准备的计提方法详见本节“（十一）资产减值”。

（八）无形资产

1. 无形资产的初始计量

本公司无形资产按照实际成本进行初始计量。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本为购买价款的现值。

通过债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值；在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产通常以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

2. 无形资产的后续计量

本公司于取得无形资产时分析判断其使用寿命。无形资产的使用寿命如为有限的，本公司估计该使用寿命的年限或者构成使用寿命的产量等类似计量单位数量，无法预见无形资产为本公司带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。

使用寿命有限的无形资产，自取得当月起在预计使用寿命内采用直线法摊销；使用寿命不确定的无形资产，不予摊销，期末进行减值测试。

本公司至少于每年年度终了时，对无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，必要时进行调整。

本公司期末预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益的，将该项无形资产的账面价值全部转入当期损益。

3. 无形资产的减值

本公司无形资产的减值准备计提方法详见本节“（十一）资产减值”。

（九）研发支出

本公司内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出与开发阶段支出。研究阶段支出，于发生时计入当期损益；开发阶段支出，同时满足下列条件的，予以资本化：

(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

(3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；

(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

不满足上述条件的开发支出计入当期损益。

对于同一项无形资产，在开发过程中达到资本化条件前已经费用化计入损益的支出，不再进行资本化。

(十) 长期待摊费用

长期待摊费用是指本公司已经发生但应由本期和以后各期负担的期限在一年以上的各项费用。长期待摊费用在受益期内平均摊销，其中：

(1) 预付经营租入固定资产的租金，按租赁合同规定的期限平均摊销。

(2) 经营租赁方式租入的固定资产改良支出，按剩余租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期限平均摊销。

(3) 融资租赁方式租入的固定资产，其符合资本化条件的装修费用，在两次装修间隔期间、剩余租赁期和固定资产尚可使用年限三者中较短的期限平均摊销。

(十一) 资产减值

本公司对子公司、联营企业和合营企业的长期股权投资、采用成本模式进行后续计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、生产性生物资产、无形资产、商誉、探明石油天然气矿区权益和井及相关设施等(存货、按公允价值模式计量的投资性房地产、递延所得税资产、金融资产除外)的资产减值，按以下方法确定：

本公司于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本公司将估计其可收回金额，进行减值测试。对因企业合并所形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本公司以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时，本公司将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

商誉的减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合，且不大于本公司确定的报告分部。减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，首先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，确认商誉的减值损失。

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

（十二）预计负债

因未决诉讼、产品质量保证、亏损合同、油气资产弃置义务等形成的现实义务，其履行很可能导致经济利益的流出，在该义务的金额能够可靠计量时，确认为预计负债。

预计负债按照履行相关现实义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

满足预计负债确认条件的油气资产弃置义务确认为预计负债，同时计入相关油气资产的原价，金额等于根据当地条件及相关要求作出的预计未来支出的现值。

不符合预计负债确认条件的，在废弃时发生的拆卸、搬移、场地清理等支出在实际发生时作为清理费用计入当期损益。

（十三）股份支付

1. 股份支付种类

本公司股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

2. 股份支付的会计处理

对于权益结算的涉及职工的股份支付，按照授予日权益工具的公允价值计入成本费用和资本公积（其他资本公积），不确认其后续公允价值变动；对于现金结算的涉及职工的股份支付，按照每个资产负债表日权益工具的公允价值重新计量，确定成本费用和应付职工薪酬。

3. 权益工具公允价值的确定方法

对于授予的期权等权益工具存在活跃市场的，按照活跃市场中的报价确定其公允价值。对于授予的期权等权益工具不存在活跃市场的，采用期权定价模型等确定其公允价值。

4. 确认可行权权益工具最佳估计的依据

等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。在可行权日，最终预计可行权权益工具的数量应当与实际可行权数量一致。

5. 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

根据上述权益工具的公允价值和预计可行权的权益工具数量，计算截至当期累计应确认的成本费用金额，再减去前期累计已确认金额，作为当期应确认的成本费用金额。

（十四）递延所得税资产和递延所得税负债

本公司根据资产、负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税。除由于企业合并产生的调整商誉，或与直接计入所有者权益的交易或者事项相关的递延所得税计入所有者权益外，递延所得税均作为所得税费用计入当期损益。

各项应纳税暂时性差异均确认相关的递延所得税负债，除非该应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：

商誉的初始确认，或者具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资产，除非该可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的：

该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

资产负债表日，本公司对递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量，并反映资产负债表日预期收回资产或清偿负债方式的所得税影响。

本公司在资产负债表日对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法取得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值，减记的金额计入当期的所得税费用。原确认时计入所有者权益的递延所得税资产部分，其减记金额也应计入所有者权益。在很可能取得足够的应纳税所得额时，减记的递延所得税资产账面价值可以恢复。

（十五）收入确认

1. 销售商品

销售商品收入，同时满足下列条件时予以确认：已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；相关的经济利益很可能流入本公司；相关的收入和成本能够可靠的计量。

公司的产品销售主要分为国内销售和出口销售。国内销售是公司根据客户订单要求完成产品生产后发货，双方核对确认对账单后，相关的风险和报酬已转移，并已取得收款的相关权利，公司据此确认收入。公司的国外销售是在货物发运并办理相关手续后，即商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，且

对应的成本能够可靠计量时，确认销售收入。公司出口销售主要采用 FOB、EX-WORKS、DDU 的贸易条款，各类贸易方式销售收入确认的具体标准如下：

FOB，公司负责将货物送至海关，承担这一阶段的运费，并办理出口报关，货物装机后完成所有权交割，即标志着已将产品所有权上的主要风险和报酬转移，并已取得收款的相关权利，公司据此确认收入。

EX-WORKS，客户指定承运人在越亚工厂提货后即完成所有权交割。即标志着已将产品所有权上的主要风险和报酬转移，并已取得收款的相关权利，公司据此确认收入。

DDU，公司负责送货至客户指定的地点，支付全程运费以及出口报关费用，即完成所有权交割，并已取得收款的相关权利，公司据此确认收入。

2. 提供劳务

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认。按照从接受劳务方已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

已发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。

已发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

3. 让渡资产使用权

与交易相关的经济利益很可能流入本公司，收入的金额能够可靠地计量时，分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

利息收入金额，按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定。

使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

（十六）政府补助

政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府作为所有者投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

本公司将所取得的用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助界定为与资产相关的政府补助；其余政府补助界定为与收益相关的政府补助。若政府文件未明确规定补助对象，则采用以下方式将补助款划分为与收益相关的政府补助和与资产相关的政府补助：（1）政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；（2）政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

本公司对于政府补助通常在实际收到时，按照实收金额予以确认和计量。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产的使用寿命内平均分配计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用和损失的，或者用于补偿已经发生的相关费用和损失，但需要以后期间政府验收的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间或验收合格后计入当期损益；用于补偿已经发生的相关费用和损失且无需以后期间政府验收的，直接计入当期损益。

已确认的政府补助需要返还时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

（十七）借款费用

1. 借款费用资本化的确认原则

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。借款费用包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

(1) 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

(2) 借款费用已经发生；

(3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

2. 借款费用资本化期间

为购建或者生产符合资本化条件的资产发生的借款费用，在该资产达到预定可使用或者可销售状态前发生的，计入该资产的成本；在该资产达到预定可使用或者可销售状态后发生的，计入当期损益。

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，借款费用暂停资本化。当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

3. 费用资本化金额的确定方法

本公司按每月计算借款费用资本化金额。

专门借款的利息费用(扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益)及其辅助费用在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态前，予以资本化。

根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。

在资本化期间内，外币专门借款本金及利息的汇兑差额，应当予以资本化，计入符合资本化条件的资产成本。

(十八) 外币业务和外币报表折算

1. 外币业务

外币交易在初始确认时，采用交易发生当月月初中国人民银行公布的人民币外汇牌价中间价将外币金额折算为人民币金额。

于资产负债表日，按照下列方法对外币货币性项目和外币非货币性项目进行处理：

外币货币性项目，采用资产负债表日中国人民银行公布的人民币外汇牌价中间价折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益。

以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额；以公允价值计量的交易性金融资产，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动（含汇率变动）处理，计入当期损益。

货币性项目，是指公司持有的货币资金和将以固定或可确定的金额收取的资产或者偿付的负债。

非货币性项目，是指货币性项目以外的项目。

2. 外币报表折算

本公司对境外子公司外币财务报表进行折算时，资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，股东权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算；现金流量表所有项目均按照现金流量发生日的即期汇率或即期汇率的近似汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列示“汇率变动对现金及现金等价物的影响”项目反映。

由于外币财务报表折算产生的差额，在合并资产负债表的股东权益项目下单独作为“外币报表折算差额”项目列示。

五、报告期内重大会计政策、会计估计变更及差错更正

（一）会计政策变更

报告期内，公司无会计政策变更。

（二）会计估计变更

2011 年度经重新估计后改变应收款项坏账计提比例，具体改变如下：

变更前		变更后	
账龄	计提比例	账龄	计提比例
90 天及以内	0%	75 天及以内	0%

变更前		变更后	
账龄	计提比例	账龄	计提比例
91 天至 1 年	5%	76 天至 1 年	5%
1 年至 2 年	10%	1 年至 2 年	20%
2 年至 3 年	30%	2 年至 3 年	50%
3 年至 4 年	70%	3 年以上	100%
4 年以上	100%		

上述坏账准备计提比例变更对 2011 年度利润总额影响数-5,928.20 元，对 2012 年度利润总额影响数-76,016.71 元，对 2013 年度利润总额影响数-31,574.30 元。

（三）重大会计差错更正

报告期内，公司无重大会计差错变更。

六、税项

（一）主要税种及税率

本公司缴纳的主要税种包括所得税、增值税，报告期内各主要税种及法定税率列示如下：

税种	计税依据	税率
增值税	销售收入	17%
企业所得税	应纳税所得额	12%、12.5%、15%、16.5%、23.84%
城市维护建设税	应纳流转税	7%
教育费附加	应纳流转税	3%
地方教育费附加	应纳流转税	2%

（二）报告期内适用税率及税负减免情况

1. 所得税

按国务院国发〔2007〕39 号关于实施企业所得税过渡优惠政策的通知，自 2008 年 1 月 1 日起，原享受企业所得税低税率优惠政策的企业，在新税法施行后 5 年内逐步过渡到法定税率，2010 年度按 22%税率执行；2011 年度按 24%税率执行；本公司经珠海市斗门区国家税务局“珠斗国税函[2008]53 号”文件批复，自获利年度起，第一至二年免征企业所得税，第三至五年减半征收企业所得税，企业因未获利而尚未享受税收优惠的，其优惠期限从 2008 年度起计算。2010 年、2011 年、2012 年为本公司减半征收的第一、第二、三年，分别按 11%、12%、12.5%缴纳企业所得税。

2013 年公司减按 15%的税率征收企业所得税。据科技部、财政部、国家税务总局于 2008 年 4 月 14 日联合签发的国科发火[2008]172 号《关于印发<高新技术

企业认定管理办法》的通知》，经认定的高新技术企业，减按 15% 的税率征收企业所得税。2012 年 3 月 26 日，根据广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国家税务局、广东省地方税务局联合下发的《关于公布广东省 2011 年第二批高新技术企业名单的通知》（粤科高字〔2012〕47 号），本公司被认定为高新技术企业，发证日期 2011 年 11 月 17 日，有效期为三年，从 2011 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日。

越亚香港适用香港 16.5% 的企业所得税税率。

越亚美国适用的美国联邦税税率为 15%，加州税税率为 8.84%。

2. 增值税

报告期内，公司出口产品享受增值税“免、抵、退”优惠政策，出口产品退税率为 17%。

七、主营业务分部报告信息

（一）主营业务收入按产品分部

单位：万元

产品名称	2013 年度		2012 年度		2011 年度	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
无线射频模块封装基板	35,492.64	99.60%	48,300.78	99.95%	42,045.29	100.00%
其中：四层板	9,364.27	26.28%	9,261.23	19.17%	7,472.55	17.77%
五层板	7,034.87	19.74%	7,068.36	14.63%	11,719.05	27.87%
七层板	18,485.28	51.87%	31,385.11	64.95%	22,745.91	54.10%
其他	608.22	1.71%	586.08	1.21%	107.78	0.26%
倒装芯片级封装基板/ 倒装球栅阵列封装基板	105.54	0.30%	18.55	0.04%	-	-
其他	36.30	0.10%	3.69	0.01%	-	-
主营业务收入	35,634.49	100.00%	48,323.02	100.00%	42,045.29	100.00%

（二）主营业务收入按地区分部

单位：万元

地区	2013 年度		2012 年度		2011 年度	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
国内	11,885.77	33.35%	11,515.77	23.83%	9,996.02	23.77%
国外	23,748.72	66.65%	36,807.25	76.17%	32,049.27	76.23%
合计	35,634.49	100.00%	48,323.02	100.00%	42,045.29	100.00%

八、非经常性损益

瑞华对公司近三年的非经常性损益明细表进行了审核，并出具了瑞华核字[2014]40030023 号《非经常性损益明细表之审核报告》。依据经申报会计师审核的本公司近三年《非经常性损益明细表之审核报告》，近三年本公司非经常性损益的具体内容、金额及扣除非经常性损益后的净利润金额如下表：

单位：万元

项目	2013 年度	2012 年度	2011 年度
非流动资产处置损益	-	0.01	-0.96
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	-	-	-
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	552.94	87.28	51.24
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	-	-	-
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	71.06	97.95	-28.98
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-	-	-
非经常性损益总额	623.99	185.24	21.30
减：非经常性损益的所得税影响数	93.60	23.16	-
非经常性损益净额	530.39	162.09	21.30
减：归属于少数股东的非经常性损益净影响数（税后）	-	-	-
归属于公司普通股股东的非经常性损益	530.39	162.09	21.30
扣除非经常性损益后归属母公司普通股股东的净利润	1,464.85	8,108.89	4,520.55

九、主要资产情况

（一）固定资产

截至 2013 年 12 月 31 日，公司主要固定资产类别、折旧年限、原值、减值准备及净值情况如下：

单位：万元

项目	原值	累计折旧	减值准备	净值	折旧年限	成新率
房屋建筑物及附属设施	24,408.75	1,765.04	-	22,643.71	5-40 年	92.77%
机器设备	65,061.58	14,572.20	-	50,489.38	10 年	77.60%
电子设备	1,063.33	541.31	-	522.03	5 年	49.09%
运输设备	196.36	70.66	-	125.70	5 年	64.01%
其他	786.40	277.98	-	508.42	5-10 年	64.65%
合计	91,516.42	17,227.18	-	74,289.24		81.18%

截至 2013 年 12 月 31 日，公司固定资产不存在减值迹象，未计提减值准备。

截至 2013 年 12 月 31 日，公司固定资产不存在被抵押等使用受限的情况。

（二）在建工程

截至 2013 年 12 月 31 日，公司在建工程余额为 13,794.83 万元，其中待安装设备及厂房改造项目余额分别为 11,170.68 万元及 2,624.16 万元，占全部在建工程余额的比例分别为 80.98%及 19.02%。

（三）无形资产

截至 2013 年 12 月 31 日，公司无形资产资产类别、摊销年限、原值、减值准备及净值情况如下：

单位：万元

项目	原值	累计摊销	减值准备	净值
软件	320.26	112.23	-	208.03
技术资产组合	10,278.13	1,420.55	-	8,857.58
合计	10,598.39	1,532.77	-	9,065.61

截至 2013 年 12 月 31 日，公司无形资产不存在被抵押等使用受限的情况。

（四）母公司报告期末的长期股权投资

截至 2013 年 12 月 31 日，母公司财务报表中长期股权投资的明细情况如下：

单位：万元

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期末投资成本	持股比例	减值准备
越亚香港	成本法	9.55	9.55	100%	-

十、主要债务情况

（一）银行借款

截至 2013 年 12 月 31 日，公司短期借款余额的明细情况如下：

项 目	金额(万元)	占比
信用借款	2,202.71	71.93%
质押、担保借款	859.66	28.07%
合 计	3,062.37	100.00%

截至 2013 年 12 月 31 日，公司长期借款余额为 14,333.08 万元，全部为信用借款。

（二）应付账款

截至 2013 年 12 月 31 日，公司应付账款余额为 11,498.49 万元，主要为应付机器设备及原材料采购款。报告期末，应付账款前五名单位合计为 5,013.84 万元，占应付账款的比例为 43.60%，具体情况如下表所示：

单位：万元

单位名称	金额	比例（%）	业务内容
ORBOTECH ASIA LTD	1,956.87	17.02	设备款
中国电子系统工程第四建设有限公司	990.89	8.62	工程款
超淦企业国际有限公司	814.55	7.08	设备款
GEBR.SCHMID GMBH + CO	771.87	6.71	设备款
Hitachi Chemical Electronic Materials(Hong Kong) Ltd.	479.66	4.17	材料款
合 计	5,013.84	43.60	

（三）应付职工薪酬

截至 2013 年 12 月 31 日，公司应付职工薪酬余额为 462.75 万元，占负债总额的比例为 1.64%。应付职工薪酬余额全部为工资、奖金、津贴及补贴项目。

（四）应交税费

截至 2013 年 12 月 31 日，公司应交税费余额为-2,008.12 万元、占负债总额的比例为-7.12%。报告期末，应交税费构成情况如下：

单位：万元

项目	2013/12/31
增值税	-1,922.45
企业所得税	-86.15
个人所得税	18.55
印花税	2.28
房产税	-20.35
合计	-2,008.12

（五）其他应付款

截至 2013 年 12 月 31 日公司其他应付款余额为 93.33 万元，占负债总额的比例为 0.33%。报告期末，其他应付款主要构成情况如下：

单位：万元

账龄	2013/12/31	
	金额	比例
1 年以内	91.90	98.47%

账龄	2013/12/31	
	金额	比例
1 年至 2 年	-	-
2 年至 3 年	-	-
3 年以上	1.43	1.53%
合计	93.33	100.00%

十一、所有者权益变动情况

报告期内各期末公司所有者权益构成情况如下：

单位：元

项目	2013/12/31	2012/12/31	2011/12/31
股本（实收资本）	605,124,067.00	605,124,067.00	468,825,159.87
资本公积	179,349,594.18	179,349,594.18	0.00
盈余公积	8,626,208.59	6,268,377.53	0.00
未分配利润	55,896,922.07	38,302,329.31	-12,043,036.53
外币报表折算差额	92,217.46	-88.29	-
归属于母公司股东权益合计	849,089,009.30	829,044,279.73	456,782,123.34

（一）股本

报告期内，公司股本（实收资本）变动情况详见本招股说明书“第四章 发行人基本情况”之“四、发行人设立以来的股本形成及变化和重大资产重组情况”。

（二）资本公积变动情况

资本公积主要为 2012 年 7 月 31 日整体变更设立股份公司以及股份公司增资时形成的股本溢价。

（三）盈余公积变动情况

盈余公积主要系按照母公司净利润 10%的比例计提盈余公积金形成。

（四）未分配利润

未分配利润主要系公司历年实现的净利润积累形成。报告期内，公司未进行股利分配。

十二、现金流量情况

报告期内，公司现金流量的基本情况如下：

单位：元

项目	2013 年度	2012 年度	2011 年度
一、经营活动产生的现金流量净额	137,358,387.24	166,562,024.54	76,068,225.28
二、投资活动产生的现金流量净额	-139,890,282.23	-375,185,499.36	-283,016,411.35
三、筹资活动产生的现金流量净额	-12,835,588.35	139,557,685.57	238,880,175.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,443,089.61	434,244.45	-373,707.75
五、现金及现金等价物净增加额	-12,924,393.73	-68,631,544.80	31,558,281.88
六、期末现金及现金等价物余额	5,488,984.40	18,413,378.13	87,044,922.93

十三、资产负债表日后事项、或有事项、承诺事项及其他重要事项

（一）或有事项

截至 2013 年 12 月 31 日，本公司无需要披露的重大或有事项。

（二）资产负债表日后事项

截至财务报告批准报出日，本公司无其他需要披露的期后事项。

（三）承诺事项

截至 2013 年 12 月 31 日，根据公司向中国建设银行股份有限公司珠海市分行提交的结售汇交易申请书的履行情况，尚有 1,210.02 万美元的远期结汇合约待履行。

（四）其他重要事项

截至 2013 年 12 月 31 日，本公司无需要披露的其他重要事项。

十四、最近三年主要财务指标

（一）主要财务指标

项目	2013 年	2012 年	2011 年
流动比率（倍）	1.19	1.13	0.65
速动比率（倍）	0.83	0.87	0.53
资产负债率（母公司）	24.82%	29.20%	52.89%
无形资产（扣除土地使用权）占净资产的比例	10.68%	10.66%	20.88%
应收账款周转率（次/年）	4.40	5.26	6.98
存货周转率（次/年）	5.83	6.09	7.72
息税折旧摊销前利润（万元）	10,962.67	15,648.70	9,253.93
利息保障倍数（倍）	3.41	14.54	3.36
归属于本公司股东的净利润（万元）	1,995.24	8,270.97	4,541.85
归属于本公司股东扣除非经常性损益后的净利润（万元）	1,464.85	8,108.89	4,520.55

项目	2013 年	2012 年	2011 年
归属于本公司股东的每股净资产（元/股）	1.40	1.37	
每股经营活动产生的现金流量（元/股）	0.23	0.28	
每股净现金流量（元/股）	-0.02	-0.11	
加权平均净资产收益率（扣除非经常性损益后归属普通股股东的净利润）	1.75%	11.05%	19.30%

上述指标的计算以本公司合并财务报表的数据为基础进行计算（资产负债率除外），改制前涉及股本数时以实收资本金额计。

上述财务指标的计算公式如下：

流动比率=流动资产/流动负债

速动比率=（流动资产-存货-一年内到期的非流动资产-其他流动资产）/流动负债；

资产负债率=总负债/总资产×100%

应收账款周转率=营业收入/应收账款平均净额

存货周转率=营业成本/存货平均净额

息税折旧摊销前利润=利润总额+利息支出+计提折旧、摊销

利息保障倍数=（利润总额+利息支出）/利息支出

每股经营活动产生的现金流量=经营活动产生的现金流量净额/期末股本总额

每股净现金流量=现金流量净额/期末股本总额

无形资产（土地使用权、特许经营资产除外）占净资产的比例=无形资产（土地使用权、特许经营资产除外）/期末净资产

（二）净资产收益率和每股收益

根据中国证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则第9号—净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010年修订）》要求，计算公司近3年的净资产收益率和每股收益情况如下：

期间	报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益（元/股）	
			基本每股收益	稀释每股收益
2013 年度	归属公司普通股股东的净利润	2.38%	0.0330	0.0330
	扣除非经常性损益后归属普通	1.75%	0.0242	0.0242

期间	报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益（元/股）	
			基本每股收益	稀释每股收益
	股股东的净利润			
2012 年度	归属公司普通股股东的净利润	11.27%	0.1382	0.1382
	扣除非经常性损益后归属普通股股东的净利润	11.05%	0.1355	0.1355
2011 年度	归属公司普通股股东的净利润	19.39%		
	扣除非经常性损益后归属普通股股东的净利润	19.30%		

注：截至 2013 年 12 月 31 日，本公司无稀释性潜在普通股。

上表相关指标的计算公式：

（1）加权平均净资产收益率

$$\text{加权平均净资产收益率} = P / (E_0 + \frac{NP}{2} + E_i \times \frac{M_i}{M_0} - E_j \times \frac{M_j}{M_0} \pm E_k \times \frac{M_k}{M_0})$$

其中：P 分别对应于归属于公司普通股股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润；NP 为归属于公司普通股股东的净利润；E₀ 为归属于公司普通股股东的期初净资产；E_i 为报告期发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产；E_j 为报告期回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产；M₀ 为报告期月份数；M_i 为新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数；M_j 为减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数；E_k 为因其他交易或事项引起的净资产增减变动；M_k 为发生其他净资产增减变动下一月份起至报告期期末的月份数。

（2）基本每股收益

$$\text{基本每股收益} = \frac{P}{S}$$

$$S = S_0 + S_1 + S_i \times \frac{M_i}{M_0} - S_j \times \frac{M_j}{M_0} - S_k$$

其中：P 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S 为发行在外的普通股加权平均数；S₀ 为期初股份总数；S₁ 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；S_i 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；S_j 为报告期因回购等减少股份数；S_k 为报告期缩股数；M₀ 为报告期月份数；M_i 为增加股份下一月份起至报告期期末的月份数；M_j 为减少股份下一月份起至报告期期末的月份数。

（3）稀释每股收益

稀释每股收益=[P+（已确认为费用的稀释性潜在普通股利息-转换费用）×（1-所得税率）]/（ $S_0+S_1+S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k$ +认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数）

其中，P 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润。 S_0 为期初股份总数； S_1 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数； S_i 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数； S_j 为报告期因回购等减少股份数； S_k 为报告期缩股数； M_0 报告期月份数； M_i 为增加股份下一月份起至报告期期末的月份数； M_j 为减少股份下一月份起至报告期期末的月份数。公司在计算稀释每股收益时，考虑所有稀释性潜在普通股的影响，直至稀释每股收益达到最小。

十五、发行人设立时及报告期内的资产评估情况

（一）2012 年 1 月 19 日增资时的资产评估情况

2012 年 1 月 19 日公司增资前，委托北京龙源智博资产评估有限责任公司以 2011 年 11 月 30 日为评估基准日对珠海越亚封装基板技术有限公司股东全部权益价值进行了评估。北京龙源智博资产评估有限责任公司于 2011 年 12 月 18 日出具了龙源智博评报字（2011）第 B-126 号《评估报告书》。经评估，越亚有限股东全部权益价值在评估基准日的评估价值为 37,513.91 万元。

（二）2012 年 4 月 20 日增资时的资产评估情况

2012 年 4 月 20 日公司增资前，委托北京龙源智博资产评估有限责任公司以 2012 年 2 月 29 日为评估基准日对越亚有限股东全部权益价值进行了评估。北京龙源智博资产评估有限责任公司于 2012 年 3 月 12 日出具了龙源智博评报字（2012）第 1006 号《评估报告书》。经评估，越亚有限股东全部权益价值在评估基准日的评估价值为 68,274.12 万元。

（三）股份公司设立时资产评估情况

2012 年 7 月 31 日公司整体变更设立股份公司前，委托广东中广信资产评估有限公司以 2012 年 4 月 30 日为评估基准日对珠海越亚封装基板技术有限公司股东全部权益价值进行了评估。广东中广信资产评估有限公司于 2012 年 5 月 15 日出具了中广信珠评报字[2012]第 012 号《评估报告书》。经评估，越亚有限股东全部权益价值在评估基准日的评估价值为 77,449.89 万元。

（四）2012 年 9 月 28 日增资时资产评估情况

2012年9月28日公司增资前，委托广东中广信资产评估有限公司以2012年7月31日为评估基准日对珠海越亚封装基板技术股份有限公司股东全部权益价值进行了评估。广东中广信资产评估有限公司于2012年8月17日出具了中广信珠评报字[2012]第018号《评估报告书》。经评估，公司股东全部权益价值在评估基准日的评估价值为79,309.57万元。

十六、发行人历次验资情况

发行人历次验资情况详见本招股说明书“第四章 发行人基本情况”之“五 发行人历次验资情况”。

第十章 管理层讨论与分析

根据本公司最近三年经瑞华审计的财务报告，本公司管理层做出以下分析。非经特别说明，以下数据均为合并财务报表口径；若各分项数字之和（或差）与合计数字存在微小差异（如 0.01），系四舍五入原因导致。

一、发行人财务状况分析

（一）资产构成及变动分析

1. 资产的整体情况

报告期各期末，公司资产的主要构成如下：

单位：万元

项目	2013/12/31		2012/12/31		2011/12/31	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
流动资产	15,654.08	13.84%	24,122.53	20.57%	32,973.09	34.01%
非流动资产	97,461.44	86.16%	93,154.59	79.43%	63,980.02	65.99%
资产总额	113,115.51	100.00%	117,277.13	100.00%	96,953.10	100.00%

2013 年末、2012 年末、2011 年末资产总额分别为 113,115.51 万元、117,277.13 万元、96,953.10 万元。其中，2012 年末资产总额较上年末增长了 20.96%，2013 年末资产总额较上年末下降了 3.55%。

2012 年末，公司总资产增加较快，主要原因在于：（1）公司获得东方富海等投资者看好，获得资金投入，显著增强了公司资金实力；（2）得益于智能手机、平板电脑等消费电子产品的市场发展，IC 封装基板的市场需求较好，当年公司营业收入达到 49,641.70 万元，净利润达到 8,270.97 万元，增厚了公司净资产。

2013 年末，尽管公司净资产较上年末增长 2.42%，但由于偿还了短期借款和应付账款，负债总额较上年末下降 17.94%，导致总资产较上年末略有下降。

公司主要资产包括货币资金、应收账款、存货等流动资产和固定资产、无形资产等非流动资产。2013 年末、2012 年末、2011 年末流动资产占总资产的比例分别为 13.84%、20.57%、34.01%。

公司非流动资产在报告期内逐年增加，非流动资产占总资产的比例整体呈现上升趋势，主要原因在于：公司业务规模的扩张带动了固定资产、在建工程等资本性支出的增加。

2. 流动资产

报告期内，公司流动资产主要包括货币资金、应收账款、预付款项、其他应收款和存货等，其具体构成如下：

单位：万元

项目	2013/12/31		2012/12/31		2011/12/31	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
货币资金	2,259.26	14.43%	4,265.02	17.68%	16,508.57	50.07%
应收账款	5,805.01	37.08%	10,936.33	45.34%	7,932.34	24.06%
预付款项	2,028.56	12.96%	2,054.66	8.52%	1,645.06	4.99%
其他应收款	790.26	5.05%	1,263.47	5.24%	780.08	2.37%
存货	4,770.98	30.48%	5,603.04	23.23%	6,107.04	18.52%
流动资产合计	15,654.08	100.00%	24,122.53	100.00%	32,973.09	100.00%

2012 年末，公司流动资产较 2011 年末减少 8,850.56 万元，降幅为 26.84%，主要原因是偿还债务及大额的资本性支出导致了公司货币资金大幅减少。2013 年，公司仍有较大规模的资本性支出，支付了较多货币资金；同时，当年公司收入减少，应收账款、存货等项目相应减少，流动资产余额较上年末下降。

公司流动资产中，货币资金、应收账款、存货占比较大，2013 年末，货币资金、应收账款和存货占流动资产的比例分别为 14.43%、37.08%和 30.48%。

（1）货币资金

报告期各期末，公司货币资金构成的明细如下：

单位：万元

项目	2013/12/31		2012/12/31		2011/12/31	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
现金	4.17	0.18%	4.87	0.11%	8.11	0.05%
银行存款	544.73	24.11%	1,836.46	43.06%	8,696.39	52.68%
其他货币资金	1,710.36	75.70%	2,423.68	56.83%	7,804.08	47.27%
合计	2,259.26	100.00%	4,265.02	100.00%	16,508.57	100.00%

2013 年末、2012 年末、2011 年末公司货币资金余额分别为 2,259.26 万元、4,265.02 万元、16,508.57 万元，占流动资产的比例分别为 14.43%、17.68%、50.07%。

报告期末，公司货币资金主要为其他货币资金，其他货币资金主要包括信用证保证金及票据保证金等。报告期内，由于公司进口了较多机器设备，相关的信用证保证金占用大量的货币资金。2012 年末、2013 年末，由于公司资本性支出较大，且清偿负债较多，货币资金余额逐年下降。

由于其他货币资金的用途受限，已从现金流量表中的现金及现金等价物中扣除。

(2) 应收账款

2013 年末、2012 年末、2011 年末，公司应收账款账面价值分别为 5,805.01 万元、10,936.33 万元、7,932.34 万元，占流动资产的比例分别为 37.08%、45.34%、24.06%。2012 年末，公司应收账款占流动资产比例增加较快主要是因为公司收入增长较快，应收账款同步增长；同时，公司的其他流动资产增长缓慢，尤其是 2012 年货币资金的大幅减少导致应收账款在全部流动资产的占比大幅上升；2013 年末，受公司营业收入下降的影响，该比例有所下降。

报告期内，公司应收账款账龄及分布比例如下：

单位：万元

账龄	2013/12/31		2012/12/31		2011/12/31	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
75 天及以内	5,551.78	94.94%	10,560.63	96.33%	7,756.21	97.67%
76 天至 1 年	110.33	1.89%	358.82	3.27%	185.35	2.33%
1 年至 2 年	185.52	3.17%	43.54	0.40%	0.07	0.00%
合计	5,847.63	100.00%	10,962.98	100.00%	7,941.62	100.00%

注：上表中应收账款数字为未扣除坏账准备的账面余额。

公司应收账款期末余额账龄结构稳定，客户大多为国际知名厂商，商业信誉卓著，且主要集中在 75 天以内，应收账款质量良好。

2012 年末，公司应收账款余额比 2011 年末增加 3,021.36 万元，增幅为 38.04%，其中账龄在 75 天以内的增加 2,804.42 万元、账龄在 76 天至 1 年的增加 173.47 万元，主要原因是公司业务规模的迅速扩张，期末信用期内的应收账款大幅增加。

2013 年末，公司应收账款账面余额较上年末减少 5,115.35 万元，下降幅度为 46.66%，主要是由于营业收入下降所致。

截至 2013 年 12 月 31 日，应收账款前五名客户的合计应收账款账面余额为 5,343.70 万元，占应收账款比例为 91.38%，具体情况如下表所示：

单位：万元

单位名称	是否关联方	金额	占应收账款总额的比例
威讯联合半导体(北京)有限公司	否	2,060.58	35.24%
ASE Korea	否	2,102.05	35.95%
Ambit microsystems corporation	否	747.70	12.79%
Amkor Technology.Inc	否	281.23	4.81%
ASE Electronics(M) Sdn.Bhd	否	152.13	2.6%
合 计		5,343.70	91.38%

公司主要客户均为国际知名企业，且与公司有着长期的合作关系，回款正常，资信良好，应收账款风险较低。

公司于各期末对应收账款进行减值测试，并按照会计政策计提坏账准备，2013 年末、2012 年末及 2011 年末，公司应收账款坏账准备占应收账款余额的比例分别为 0.73%、0.24%、0.12%。公司应收账款坏账准备计提情况如下：

单位：万元

账龄	2013/12/31		2012/12/31		2011/12/31	
	原值	坏账准备	原值	坏账准备	原值	坏账准备
75 天及以内	5,551.78	-	10,560.63	-	7,756.21	-
76 天至 1 年	110.33	5.52	358.82	17.94	185.35	9.27
1 年至 2 年	185.52	37.10	43.54	8.71	0.07	0.01
合计	5,847.63	42.62	10,962.98	26.65	7,941.62	9.28

报告期各期末，公司应收账款主要集中在 75 天以内，按照公司的坏账政策对该账龄内的应收账款不计提坏账准备，因此公司应收账款坏账准备占应收账款原值的比例较小，符合公司应收账款的实际情况。

（3）预付款项

2013 年末、2012 年末、2011 年末，公司预付款项余额分别为 2,028.56 万元、2,054.66 万元、1,645.06 万元，占流动资产的比例分别为 12.96%、8.52%、4.99%。公司预付款项占流动资产比例较小，主要为预付供应商的机器设备和原材料采购款，报告期各期末，80%以上的预付款项的账龄均在一年以内。

单位：万元

账龄	2013/12/31		2012/12/31		2011/12/31	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
1 年以内	1,705.78	84.09%	2,054.66	100%	1,645.06	100%
1-2 年	322.79	15.91%	-	-	-	-
合计	2,028.57	100%	2,054.66	100%	1,645.06	100%

截至 2013 年 12 月 31 日，预付款项前五名单位合计为 1,039.53 万元，占全部预付款项的比例为 51.24%，具体情况如下表所示：

单位：万元

单位名称	是否关联方	金额	占预付款项总额的比例	业务内容
ORBOTECH ASIA LTD	否	506.25	24.95%	设备款
招商证券股份有限公司	否	155.00	7.64%	上市费用
奥宝电子(深圳)有限公司	否	137.85	6.80%	设备款
珠海市剧毒物品专卖有限公司	否	128.15	6.32%	材料款

单位名称	是否关联方	金额	占预付款项总额的比例	业务内容
珠海市庆龙化工有限公司	否	112.28	5.53%	材料款
合计		1,039.53	51.24%	

(4) 其他应收款

2013 年末、2012 年末、2011 年末，公司其他应收款净额分别为 790.26 万元、1,263.47 万元、780.08 万元，占流动资产的比例分别为 5.05%、5.24%、2.37%。公司其他应收款主要为应收增值税出口退税款，还包括员工借款、备用金、保证金、押金等项目。其他应收款的变动主要受期末应收增值税出口退税款的影响，其他应收款余额明细情况如下：

单位：万元

项目	2013/12/31		2012/12/31		2011/12/31	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
应收出口退税款及海关保证金	770.36	97.24%	1,151.31	90.87%	748.56	95.89%
其他	21.83	2.76%	115.62	9.13%	32.12	4.11%
合计	792.20	100.00%	1,266.93	100.00%	780.68	100.00%

注：以上数据为未扣除坏账准备的余额。

根据公司的坏账计提政策，对应收出口退税款不计提坏账，对其他部分按照账龄组合计提坏账，其具体情况如下：

单位：万元

账龄	2013/12/31		2012/12/31		2011/12/31	
	原值	坏账准备	原值	坏账准备	原值	坏账准备
75 天及以内	73.74	-	60.44	-	24.78	-
76 天至 1 年	6.61	0.33	53.64	2.68	5.80	0.29
1 年至 2 年	0.34	0.07	-	-	1.54	0.31
2 年至 3 年	-	-	1.54	0.77	-	-
3 年以上	1.54	1.54	-	-	-	-
合计	82.23	1.94	115.62	3.45	32.12	0.60

截至 2013 年 12 月 31 日，其他应收款中前五名单位合计为 776.71 万元，占全部其他应收款的比例为 98.04%，具体情况如下表所示：

单位：万元

单位名称	是否关联方	金额	占其他应收款总额的比例
应收出口退税	否	709.96	89.62%
海关保证金	否	60.40	7.62%
韦仁静	否	2.34	0.30%
郭雷	否	2.00	0.25%

单位名称	是否关联方	金额	占其他应收款总额的比例
曾琼生	否	2.00	0.25%
合计		776.71	98.04%

(5) 存货

2013 年末、2012 年末、2011 年末，公司存货账面价值分别为 4,770.98 万元、5,603.04 万元、6,107.04 万元，占流动资产的比例分别为 30.48%、23.23%、18.52%。报告期各期末，存货的主要构成情况如下：

单位：万元

项目	2013/12/31		2012/12/31		2011/12/31	
	原值	比例	原值	比例	原值	比例
原材料	1,228.51	25.24%	1,681.15	29.85%	1,547.65	25.34%
在产品	1,064.62	21.88%	2,640.22	46.87%	2,985.73	48.89%
发出商品	519.16	10.67%	227.87	4.05%	19.15	0.31%
产成品	1,733.69	35.62%	586.06	10.40%	871.90	14.28%
低值易耗品	320.82	6.59%	497.18	8.83%	682.60	11.18%
合计	4,866.80	100.00%	5,632.49	100.00%	6,107.04	100.00%

注：上表中数据为未扣除跌价准备的余额。

由于订单式生产的特点，公司存货主要由原材料及在产品构成。报告期内，为满足客户日益趋紧的供货期要求，公司通过对生产工艺的改进，逐渐缩短了产品的平均生产周期，合理控制了在产品及其他存货的余额，并使得同期的存货变动率低于营业收入的变动率。

单位：万元

项目		2013 年	2012 年	2011 年
存货	余额	4,866.80	5,632.49	6,107.04
	变动率	-13.59%	-7.77%	122.38%
营业收入	发生额	36,847.10	49,641.70	43,774.74
	变动率	-25.77%	13.40%	159.66%

注：上表中数据为未扣除跌价准备的余额。

公司于各期期末对存货进行减值测试，并按照会计政策计提减值准备，2013 年末、2012 年末，公司存货减值准备占存货原值的比例分别为 1.97%、0.52%。公司存货减值准备情况如下：

单位：万元

项目	2013/12/31		2012/12/31		2011/12/31	
	原值	减值准备	原值	减值准备	原值	减值准备

项目	2013/12/31		2012/12/31		2011/12/31	
	原值	减值准备	原值	减值准备	原值	减值准备
原材料	1,228.51	22.59	1,681.15	29.45	1,547.65	-
在产品	1,064.62	-	2,640.22	-	2,985.73	-
发出商品	519.16	-	227.87	-	19.15	-
库存商品	1,733.69	73.23	586.06	-	871.90	-
低值易耗品	320.82	-	497.18	-	682.60	-
合计	4,866.80	95.82	5,632.49	29.45	6,107.04	-

公司于 2013 年末按照谨慎性原则对部分存货计提了减值准备。

3. 非流动资产

报告期内，公司非流动资产包括固定资产、在建工程、无形资产、开发支出、长期待摊费用、递延所得税资产等，其具体构成如下：

单位：万元

项目	2013/12/31		2012/12/31		2011/12/31	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
固定资产	74,289.24	76.22%	66,761.13	71.67%	35,351.31	55.25%
在建工程	13,794.83	14.15%	17,065.14	18.32%	16,946.47	26.49%
无形资产	9,065.61	9.30%	8,838.67	9.49%	9,537.50	14.91%
开发支出	290.75	0.30%	480.72	0.52%	-	0.00%
长期待摊费用	-	0.00%	-	0.00%	2,143.50	3.35%
递延所得税资产	20.99	0.02%	8.93	0.01%	1.23	0.00%
合计	97,461.44	100.00%	93,154.59	100.00%	63,980.02	100.00%

公司非流动资产主要为固定资产、在建工程 and 无形资产，截至 2013 年末，固定资产、在建工程和无形资产占非流动资产的比例分别为 76.22%、14.15%、9.30%。

(1) 固定资产

2013 年末、2012 年末、2011 年末，公司固定资产账面价值分别为 74,289.24 万元、66,761.13 万元、35,351.31 万元，占非流动资产的比例分别为 76.22%、71.67%、55.25%。报告期各期末，固定资产的主要构成情况如下：

单位：万元

项目	2013/12/31		2012/12/31		2011/12/31	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
房屋建筑物及附属设施	22,643.71	30.48%	19,414.87	29.08%	-	-
机器设备	50,489.38	67.96%	46,253.10	69.28%	34,378.77	97.25%
电子设备	522.03	0.70%	478.44	0.72%	374.86	1.06%

项目	2013/12/31		2012/12/31		2011/12/31	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
运输设备	125.70	0.17%	107.43	0.16%	31.01	0.09%
其他	508.42	0.68%	507.29	0.76%	566.67	1.60%
合计	74,289.24	100.00%	66,761.13	100.00%	35,351.31	100.00%

2013 年末公司固定资产净值较 2012 年末增加了 7,528.11 万元,增幅为 11.28%,主要原因在于,公司 2012 年四季度开始建设“珠海越亚封装基板技术股份有限公司改扩建项目”,2013 年部分厂房、设备达到预定可使用状态,转为固定资产。该项目情况详见“第十二章 募集资金运用”之“三、募集资金投资项目简介”。

2012 年末公司固定资产净值较 2011 年末增加了 31,409.82 万元,增幅为 88.85%,主要原因包括:(1)公司于 2012 年 9 月从珠海多层及珠海发展购买原先租赁使用的厂房、土地及附属设施,共计支付价款 15,203.20 万元,同时将与之相关长期待摊费用 3,860.00 万元转入固定资产核算,相关转让情况详见“第六章 同业竞争与关联交易”之“三、关联交易事项”之“(二)报告期内偶发性关联交易情况”之“3. 接受关联方资产转让”;(2)为满足市场对无芯封装基板产品的需求,公司购买设备以扩大产能,2012 年在建工程转固定资产 16,193.98 万元。

截至 2013 年 12 月 31 日,公司主要固定资产类别、折旧年限、原值、减值准备及净值情况如下:

单位:万元

项目	原值	累计折旧	减值准备	净值	折旧年限	成新率
房屋建筑物及附属设施	24,408.75	1,765.04	-	22,643.71	5-40 年	92.77%
机器设备	65,061.58	14,572.20	-	50,489.38	10 年	77.60%
电子设备	1,063.33	541.31	-	522.03	5 年	49.09%
运输设备	196.36	70.66	-	125.70	5 年	64.01%
其他	786.40	277.98	-	508.42	5-10 年	64.65%
合计	91,516.42	17,227.18	0.00	74,289.24		81.18%

2013 年末,公司固定资产账面价值为 74,289.24 万元,根据减值测试的结果,相关资产并未发生减值,因此公司未计提减值准备。同时,公司固定资产不存在抵押等资产受限的情形。

(2) 在建工程

2013 年末、2012 年末、2011 年末,公司在建工程账面价值分别为 13,794.83 万元、17,065.14 万元、16,946.47 万元,占非流动资产的比例分别为 14.15%、18.32%、26.49%。报告期各期末,在建工程的主要构成情况如下:

单位：万元

项目	2013/12/31		2012/12/31		2011/12/31	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
待安装设备	11,170.68	80.98%	14,145.94	82.89%	15,833.97	93.44%
其中：电镀/湿法	4,581.27	33.21%	1,937.69	11.35%	2,284.82	13.48%
金属喷溅/机加工	697.34	5.06%	5,009.24	29.35%	2,124.05	12.53%
图形转移/曝光	4,090.27	29.65%	6,424.50	37.65%	8,004.33	47.23%
质检	1,290.44	9.35%	647.14	3.79%	2,795.38	16.50%
其他	511.36	3.71%	127.38	0.75%	625.40	3.69%
厂房改造	2,624.16	19.02%	2,919.20	17.11%	1,112.50	6.56%
合计	13,794.83	100.00%	17,065.14	100.00%	16,946.47	100.00%

报告期内，公司在建工程项目主要是待安装的设备，公司为扩大产能，生产设备投资较大。由于公司所需的生产设备专用性较强，同时生产工艺处于不断改进之中，大多数设备在正式使用前需要经过一段时间的生产调试，经调试合格的设备才能正式投入规模生产并转入固定资产核算，对于安装调试中的机器设备则列入在建工程中核算。

报告期内，主要在建工程项目的变动情况如下：

单位：万元

项目	2013 年末		2012 年末		2011 年末
	金额	增长率	金额	增长率	金额
待安装设备	11,170.68	-21.03%	14,145.94	-10.66%	15,833.97
厂房改造	2,624.16	-10.11%	2,919.20	162.40%	1,112.50
合计	13,794.83	-19.16%	17,065.14	0.70%	16,946.47

报告期内，待安装设备减少全部系在建工程转固所致；2012 年，公司开始对厂房进行改扩建，当年末厂房改造项目的余额有所增加；2013 年，部分改扩建项目转为固定资产，因此厂房改造项目的金额有所下降。

报告期内，在建工程利息资本化总额为 422.12 万元，全部为采购待安装设备形成的利息支出，其具体情况如下：

单位：万元

项目	2013 年	2012 年	2011 年	报告期内
资本化利息	78.15	103.33	240.64	422.12
在建工程新增额	11,175.95	17,425.15	20,435.54	49,036.64
资本化利息/在建工程新增额	0.70%	0.59%	1.18%	0.86%

截至 2013 年 12 月 31 日，公司在建工程的余额为 13,794.83 万元。根据公司减值测试的结果，未计提减值准备。同时，在建工程不存在抵押等资产受限的情形。

(3) 无形资产

2013 年末、2012 年末、2011 年末，公司无形资产账面价值分别为 9,065.61 万元、8,838.67 万元、9,537.50 万元，占非流动资产的比例分别为 9.30%、9.49%、14.91%。公司无形资产主要为股东 AMITEC 投入的技术资产组合。报告期各期末，无形资产的主要构成情况如下：

单位：万元

项目	2013/12/31		2012/12/31		2011/12/31	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
软件	208.03	2.29%	71.35	0.81%	91.42	0.96%
技术资产组合	8,857.58	97.71%	8,767.33	99.19%	9,446.09	99.04%
其中：AMITEC 公司投入的技术	8,088.57	89.22%	8,767.33	99.19%	9,446.09	99.04%
合计	9,065.61	100.00%	8,838.67	100.00%	9,537.50	100.00%

截至 2013 年 12 月 31 日，公司无形资产类别、累计摊销、原值、减值准备及净值情况如下：

单位：万元

项目	原值	累计摊销	减值准备	净值
软件	320.26	112.23	-	208.03
技术资产组合	10,278.13	1,420.55	-	8,857.58
合计	10,598.39	1,532.77	-	9,065.61

截至 2013 年 12 月 31 日，公司无形资产的余额为 9,065.61 万元。根据公司减值测试的结果，未计提减值准备。同时，无形资产不存在抵押等资产受限的情形。

(4) 开发支出

2013 年末、2012 年末，公司开发支出账面价值分别为 290.75 万元、480.72 万元，占非流动资产的比例分别为 0.30%、0.52%。报告期内，开发支出的构成情况如下：

单位：万元

项目	2013/12/31		2012/12/31		2011/12/31	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
FCCSP 基板技术-20/20um 精细线路开发	-	-	183.99	38.27%	-	-
FCCSP 基板技术-E705G 引入及标准化	-	-	173.35	36.06%	-	-
FCCSP 基板技术-Copper bump 制造技术开发	290.75	100.00%	123.39	25.67%	-	-
合计	290.75	100.00%	480.72	100.00%	-	-

报告期内，公司共计发生研发支出 7,416.73 万元，其中，在各期共将 6,350.51 万元计入当期损益，在 2012 年、2013 年分别将 480.72 万元、585.5 万元计入开发支出，并在 2013 年将 775.48 万元开发支出转入无形资产。报告期内，公司开发支出具体情况如下：

单位：万元

项目		2013 年	2012 年	2011 年
期初余额		480.72	-	-
本期增加		2,533.19	2,684.27	2,199.27
本期减少	计入当期损益	1,947.69	2,203.55	2,199.27
	确认为无形资产	775.48	-	-
期末余额		290.75	480.72	-

公司属于高科技制造型企业，研发支出对公司开拓市场，提升产品质量，控制生产成本均具有重要的意义。2011 年 12 月之前，公司的核心生产技术所有权属于股东 AMITEC，根据授权使用协议，公司基于该核心生产技术开发的技术成果归属于 AMITEC，因此公司在 2011 年及之前未对开发支出进行资本化处理；2011 年 12 月，公司接受了股东 AMITEC 以无形资产增资入股，解除了前述的技术开发成果归属的约定，因此从 2012 年起，公司根据会计准则和公司会计政策，并结合研发的实际情况，将符合资本化条件的开发支出进行了资本化处理。

（5）长期待摊费用

2011 年末，公司长期待摊费用账面价值为 2,143.50 万元，占非流动资产的比例为 3.35%。报告期各期末，长期待摊费用的主要构成情况如下：

单位：万元

项目	2013/12/31		2012/12/31		2011/12/31	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
车间工程	-	-	-	-	984.03	45.91%
高低压变配电三期增容工程	-	-	-	-	635.98	29.67%
全套 PO 水和 SW 水处理系统	-	-	-	-	388.03	18.10%
车间电缆工程等	-	-	-	-	52.66	2.46%
其他项目	-	-	-	-	82.80	3.86%
合计	-	-	-	-	2,143.50	100.00%

公司长期待摊费用主要为租赁厂房的装修及配套支出，2012 年 9 月公司购置了原先租赁的厂房后，相关余额全部转入固定资产核算。

4. 资产减值准备

2013 年末、2012 年末、2011 年末，公司资产减值准备余额分别为 140.38 万元、59.55 万元、9.88 万元，占总资产的比例分别为 0.13%、0.05%、0.01%。报告期各期末，公司资产减值准备余额的构成情况如下：

单位：万元

项目		2013/12/31		2012/12/31		2011/12/31	
		金额	比例	金额	比例	金额	比例
应收账款	坏账准备	42.62	30.36%	26.65	44.75%	9.28	93.93%
	占应收账款比例	0.73%		0.24%		0.12%	
其他应收款	坏账准备	1.94	1.38%	3.45	5.80%	0.60	6.07%
	占其他应收款比例	0.24%		0.27%		0.08%	
存货	跌价准备	95.82	68.26%	29.45	49.45%	-	-
	占存货比例	1.97%		0.52%		-	
总资产	资产减值准备合计	140.38	100.00%	59.55	100.00%	9.88	100.00%
	占总资产比例	0.12%		0.05%		0.01%	

报告期内，公司资产减值准备全部由流动资产减值引起，具体包括应收账款坏账准备、其他应收款坏账准备及存货跌价准备。公司固定资产、在建工程和无形资产等长期资产运行良好，经测试未发生资产减值。

公司主要客户系全球知名企业，商业信誉良好，并与公司保持着良好的合作关系，报告期内不存在重大商业信用违约记录。

公司与主要客户的合同中对付款时间和条件有较为明确的规定，一般为收货之后的 60 天左右。考虑到汇款时间、沟通时间等因素的影响以及简化会计核算的需要，公司将信用期由原来的 90 天调整为 75 天，同时按照商业惯例对此信用期内的应收账款不予计提坏账准备。该会计估计变更使得应收账款账龄的划分及坏账准备的计提更加符合公司实际经营情况，并且更为谨慎。

发行人与国内相近行业上市公司坏账计提准备政策的比较如下：

账龄	本公司	沪电股份	丹邦科技
75 天及以内	0%	1%	5%
76 天至 1 年	5%		
1 年至 2 年	20%	30%	10%
2 年至 3 年	50%		30%
3 年至 4 年	100%		50%
4 年至 5 年			80%
5 年以上		100%	100%

注：相近行业上市公司资料均取自其公开披露的年报

与相近行业上市公司相比，公司坏账准备计提政策谨慎，符合行业的状况以及发行人自身经营的特点。

公司制定并执行了稳健的会计政策和合理的会计估计，主要资产的减值准备计提充分、合理。截至 2013 年 12 月 31 日，公司整体资产质量良好，不存在重大的资产减值情况。公司资产减值准备占资产期末余额的比例较小，对公司正常经营及利润情况无重大影响，公司将继续加强资产运营管理，制定合理的信用政策，维持目前较好的资产质量。

（二）负债构成及变动分析

1. 负债的整体情况

报告期各期末，公司负债的主要构成如下：

单位：万元

项目	2013/12/31		2012/12/31		2011/12/31	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
短期借款	3,062.37	10.86%	5,481.67	15.95%	31,933.43	62.28%
应付票据	0.00	0.00%	1,327.47	3.86%	929.5	1.81%
应付账款	11,498.49	40.77%	16,763.93	48.77%	21,576.83	42.08%
预收款项	1.56	0.01%	-	-	2.27	0.00%
应付职工薪酬	462.75	1.64%	959.93	2.79%	1,021.97	1.99%
应交税费	-2,008.12	-7.12%	-3,819.36	-11.11%	-5,639.81	-11.00%
应付利息	6.08	0.02%	18.46	0.05%	43.91	0.09%
其他应付款	93.33	0.33%	634.39	1.85%	1,194.00	2.33%
流动负债合计	13,116.46	46.50%	21,366.49	62.16%	51,062.09	99.58%
长期借款	14,333.08	50.81%	12,424.25	36.15%	-	-
其他非流动负债	757.07	2.68%	581.96	1.69%	212.8	0.42%
非流动负债合计	15,090.15	53.50%	13,006.21	37.84%	212.8	0.42%
负债合计	28,206.61	100.00%	34,372.70	100.00%	51,274.89	100.00%

2013 年末、2012 年末、2011 年末负债总额分别为 28,206.61 万元、34,372.70 万元、51,274.89 万元，逐年下降，主要是因为，经过前期的探索与积累，公司产品从 2009 年起逐步获得了客户的认可，经营积累有所增加，与此同时，主要股东加大了对公司的资本投入。

报告期内，公司的负债结构有所改变，2011 年末，公司负债几乎全部为流动性负债，2012 年末，公司流动负债占全部负债的比例降为 62.16%，2013 年末，该比例降至 46.50%，降低了公司的短期偿债压力。

2. 主要负债项目

（1）银行借款

2013 年末、2012 年末、2011 年末，公司的长、短期银行借款合计余额分别为 17,395.45 万元、17,905.92 万元、31,933.43 万元，占负债总额的比例分别为 61.67%、52.09%、62.28%。报告期各期末，银行借款的主要构成情况如下：

单位：万元

项目	2013/12/31	2012/12/31	2011/12/31
短期借款	3,062.37	5,481.67	31,933.43
长期借款	14,333.08	12,424.25	-
一年内到期的长期借款	-	-	-
合计	17,395.45	17,905.92	31,933.43
银行借款占负债总额的比例	61.67%	52.09%	62.28%

报告期内，公司净资产规模持续增加，融资能力不断增强，银行借款规模占负债总额的比重较高。截至 2013 年 12 月 31 日，公司短期借款余额为 3,062.37 万元，其中，信用借款为 2,202.71 万元，质押借款为 859.66 万元。公司短期借款中的质押借款的质押物全部为应收账款债权。由于公司产品主要用于出口，结算货币主要为美元，为规避美元汇率风险并提高资金的利用率，公司根据实际经营需要，将部分应收账款债权质押给银行以获得美元借款，并根据资金安排及时换成人民币存款。

截至 2013 年 12 月 31 日，公司长期借款余额为 14,333.08 万元，主要用于构建固定资产。

（2）应付账款

2013 年末、2012 年末、2011 年末，公司应付账款余额分别为 11,498.49 万元、16,763.93 万元、21,576.83 万元，占负债总额的比例分别为 40.77%、48.77%、42.08%。报告期各期末，应付账款的主要构成情况如下：

单位：万元

账龄	2013 年		2012 年		2011 年	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
1 年以内	9,833.75	85.52%	14,821.95	88.42%	21,013.77	97.39%
1 年至 2 年	1,349.81	11.74%	1,547.63	9.23%	135.31	0.63%
2 年至 3 年	0.09	0.00%	10.84	0.06%	427.74	1.98%
3 年以上	314.84	2.74%	383.51	2.29%	-	-
合计	11,498.49	100.00%	16,763.93	100.00%	21,576.83	100.00%

2012 年末公司应付账款余额较 2011 年末减少 4,812.90 万元，降幅为 22.31%，主要是股东投资的增加及持续盈利使得公司现金流状况较好，公司及时支付了供应商设备购置款及材料款所致。2013 年末公司应付账款余额较 2012 年末减少 5,265.44 万元，降幅为 31.41%，主要是由于当年采购减少。

截至 2013 年 12 月 31 日，应付账款前五名单位合计为 5,013.84 万元，占应付账款的比例为 43.60%，具体情况如下表所示：

单位：万元

单位名称	金额	占应付账款比例	业务内容
ORBOTECH ASIA LTD	1,956.87	17.02%	设备款
中国电子系统工程第四建设有限公司	990.89	8.62%	工程款
超淦企业国际有限公司	814.55	7.08%	设备款
GEBR.SCHMID GMBH + CO.	771.87	6.71%	设备款
Hitachi Chemical Electronic Materials(Hong Kong) Ltd.	479.66	4.17%	材料款
合计	5,013.84	43.60%	

报告期内，公司应付账款账龄主要集中在 1 年以内，主要为正常的商业信用，公司商业信誉良好。账龄超过 1 年的大额应付账款主要是应付供应商设备款，形成原因是，部分供应商提供的设备不符合合同约定的使用精度或使用效率，公司尚未支付设备尾款。

截至 2013 年 12 月 31 日，账龄超过 1 年的应付账款前五名单位的列示如下：

单位：万元

单位名称	金额	比例	业务内容
ULVAC,INC.	303.30	2.64%	设备款
佳辉设备有限公司	450.46	3.92%	设备款
ORBOECH ASIA LTD	231.47	2.01%	设备款
台湾暹劲股份有限公司	138.35	1.20%	设备款
保佳利(亚洲)有限公司	168.88	1.47%	设备款
合计	1,292.46	11.24%	

(3) 应付职工薪酬

2013 年末、2012 年末、2011 年末，公司应付职工薪酬余额分别为 462.75 万元、959.93 万元、1,021.97 万元，占负债总额的比例分别为 1.64%、2.79%、1.99%。2013 年末，公司应付职工薪酬较上年减少 51.79%，主要原因在于，生产规模减少致使员工人数减少，同时由于公司业绩下滑，绩效薪酬支出减少。

(4) 应交税费

2013 年末、2012 年末、2011 年末，公司应交税费余额分别为-2,008.12 万元、-3,819.36 万元、-5,639.81 万元。

报告期各期末，公司应交税费均为负值，主要原因在于：自 2010 年起，公司业务增长迅速，并进口了大量的机器设备，受 2009 年起实施的消费型增值税

的影响，固定资产投资产生了大量的增值税进项税，因此报告期内公司的应交增值税一直为负值。

（5）其他应付款

2013 年末、2012 年末、2011 年末，公司其他应付款余额分别为 93.33 万元、634.39 万元、1,194.00 万元，占负债总额的比例分别为 0.33%、1.85%、2.33%。报告期各期末，其他应付款的主要构成情况如下：

单位：万元

账龄	2013/12/31		2012/12/31		2011/12/31	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
1 年以内	91.90	98.47%	632.89	99.76%	1,192.57	99.88%
1 年至 2 年	-	0.00%	0.07	0.01%	-	-
2 年至 3 年	-	0.00%	-	-	-	-
3 年以上	1.43	1.53%	1.43	0.23%	1.43	0.12%
合计	93.33	100%	634.39	100.00%	1,194.00	100.00%

截至 2013 年 12 月 31 日，其他应付款余额中包含了公司欠关联方的费用 65.25 万元，主要是未付的 2013 年 12 月的生产辅助及后勤服务类费用和租金，具体见“第六章 同业竞争与关联交易”之“三、关联交易事项”。

报告期内，公司逐步减少关联交易，其他应付款余额逐年降低。

（三）偿债能力分析

报告期内，公司主要偿债能力指标如下：

项目	2013 年	2012 年	2011 年
流动比率	1.19	1.13	0.65
速动比率	0.83	0.87	0.53
资产负债率（母公司）	24.82%	29.20%	52.89%
资产负债率（合并）	24.94%	29.31%	52.89%
息税折旧摊销前利润（万元）	10,962.67	15,648.70	9,253.93
利息保障倍数	3.41	14.54	3.36
净利润（万元）	1,995.24	8,270.97	4,541.85
经营活动现金流量净额（万元）	13,735.84	16,656.20	7,606.82

1. 短期偿债能力

报告期内，公司流动比率和速动比率等短期偿债能力指标较好。2013 年末、2012 年末、2011 年末，公司流动比率分别为 1.19、1.13、0.65，速动比率分别为 0.83、0.87、0.53，报告期内公司的流动比率与速动比率总体呈现上升趋势，公司经营趋于稳健，短期偿债能力逐渐增强。

公司应收账款及存货等资产周转情况良好，主要流动资产质量较高。公司具有良好的商业信用，报告期内，未发生重大贷款违约及商业违约行为。

2. 长期偿债能力

报告期内，公司盈利情况总体良好，同时受股东持续增资等因素的影响，公司的长期偿债能力显著增强。

报告期内，公司资产负债率下降明显，截至 2013 年 12 月 31 日，公司资产负债率（合并）为 24.94%，资本结构较为稳健，长期偿债能力较强。公司资产负债率逐年下降，一方面是因为公司为了加快发展，接受了原股东的增资，同时引入了新投资者，并利用新、老股东的资本投入及时归还了银行借款等债务，有效改善了公司的资本结构；另一方面随着公司经营积累逐年增加，股东权益相应增长，资产负债率逐步下降。

报告期内，公司息税折旧摊销前利润较高，2013 年、2012 年、2011 年，公司息税折旧摊销前利润为 10,962.67 万元、15,648.70 万元、9,253.93 万元。公司息税折旧摊销前利润充足，报告期内，公司利息保障倍数平均为 7.10，其中 2013 年为 3.41，公司具有较强的付息能力。

2013 年、2012 年、2011 年，公司经营活动现金流量净额分别为 13,735.84 万元、16,656.20 万元、7,606.82 万元，均超过同期净利润，这表明公司具有较高的利润质量，良好的利润质量也为公司的偿债能力提供了有力保障。

3. 同类上市公司比较

目前，国内 A 股市场除丹邦科技外，暂无其他主要经营 IC 封装基板业务的上市公司，沪电股份的主要产品为印刷电路板。同处于 IC 封装基板细分行业的丹邦科技，主要生产柔性印制电路板、COF 柔性封装基板及 COF 产品等，其生产材料、生产工艺及应用范围均与发行人生产的刚性有机封装基板存在重大差异。发行人产品主要用于智能手机或平板电脑的无线射频模块芯片，基带芯片和应用处理器芯片等，而 COF 柔性封装基板主要应用于晶体管液晶显示器（TFT-LCD）芯片封装。沪电股份、丹邦科技等上市公司与发行人同属相近行业，相关数据虽不具有完全可比性但仍具有一定的参考意义。

从全球范围内来看，台湾地区上市公司景硕科技、南亚电路板以及欣兴电子的部分业务与发行人业务相似度较高，但由于这些公司同时存在其他业务，相关数据的比较仅具有参考意义。

发行人与上述境内外上市公司 2013 年主要偿债能力指标对比情况如下：

证券代码	证券简称	流动比率	速动比率	资产负债率

证券代码	证券简称	流动比率	速动比率	资产负债率
002463.SZ	沪电股份	2.33	1.66	29.68%
002618.SZ	丹邦科技	4.30	2.84	25.92%
3189.TW	景硕科技（Kinsus）	2.42	2.19	27.77%
8046.TW	南亚电路板（NanyaPCB）	4.36	3.64	20.63%
3037.TW	欣兴电子（Unimicron）	2.99	2.33	30.76%
行业（算术）平均		3.28	2.53	26.95%
本公司		1.19	0.87	24.94%

注：数据来自各公司年报等公开资料

发行人的流动比率及速动比率指标与同类上市的平均水平相比存在较大的差异，主要原因是发行人的资产结构中流动资产占比较低。2013年末，在资产负债率与同类上市公司基本一致的情况下，发行人的流动资产占总资产的比例13.84%，远低于同期同类上市公司的平均水平，相应的流动比率及速动比率指标则具有同等幅度的偏差。

证券代码	证券简称	流动资产/总资产
002463.SZ	沪电股份	48.33%
002618.SZ	丹邦科技	48.75%
3189.TW	景硕科技（Kinsus）	57.23%
8046.TW	南亚电路板（NanyaPCB）	51.61%
3037.TW	欣兴电子（Unimicron）	43.73%
行业（算术）平均		49.93%
本公司		13.84%

注：数据来自各公司年报等公开资料

发行人流动资产占总资产比例较低，一方面是因为报告期内公司固定资产投资较大并接受了大额的无形资产增资，非流动资产增长迅速；另一方面公司主要流动资产应收账款及存货周转情况较好，余额水平较低。

4. 现金流量状况

报告期内，公司现金流量情况主要信息如下：

单位：万元

项目	2013 年	2012 年	2011 年
一、经营活动产生的现金流量净额	13,735.84	16,656.20	7,606.82
其中：销售商品、提供劳务收到的现金	43,876.72	48,638.51	42,445.35
经营活动产生的现金流量净额/净利润	688.43%	201.38%	167.48%
二、投资活动产生的现金流量净额	-13,989.03	-37,518.55	-28,301.64
其中：购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	13,989.03	37,518.74	28,301.64
三、筹资活动产生的现金流量净额	-1,283.56	13,955.77	23,888.02
其中：取得借款收到的现金	13,927.63	34,794.32	45,726.39
偿还债务支付的现金	14,274.71	48,778.51	18,350.22

项目	2013 年	2012 年	2011 年
四、现金及现金等价物净增加额	-1,292.44	-6,863.15	3,155.83

(1) 经营活动产生的现金流量

报告期内，公司的经营活动现金流入主要为销售商品、提供劳务收到的现金所得。2013 年、2012 年、2011 年销售商品相关的现金流入分别为 43,876.72 万元、48,638.51 万元、42,445.35 万元，占经营活动现金总流入的比重分别为 87.77%、87.65%、88.83%。公司营业收入的收现率良好，结合公司应收账款周转率及应收账款的账龄的分析，公司的经营活动现金流状况良好。

报告期内，公司的经营活动现金流量净额均超过了同期的净利润，2013 年、2012 年、2011 年，公司经营活动产生的现金流量净额占同期净利润的比例分别为 688.43%、201.38%、167.48%，公司经营活动现金流能够很好地保证利润质量。

(2) 投资活动产生的现金流量

2013 年、2012 年、2011 年公司投资活动现金流出净额分别为 13,989.03 万元、37,518.55 万元、28,301.64 万元，几乎全部为购建固定资产及在建工程的现金流出。长期资产的投入为公司研发及生产能力的进一步提升奠定了基础。公司的投资活动现金状态符合处于成长期的高科技制造型企业的特点。

(3) 筹资活动产生的现金流量

2013 年、2012 年、2011 年公司筹资活动收到的现金分别为 13,927.63 万元、63,781.52 万元、69,652.71 万元，其中收到股东投资分别为 0 万元、28,987.20 万元、22,726.32 万元。报告期内，筹资活动现金流入中，股东投资合计占比为 35.09%。

2011 年，公司筹资活动现金流入中包含了部分关联方借款，详见本招股说明书“第六章 同业竞争与关联交易”之“三、关联交易事项”。

报告期内，除吸收股东投资及上述关联方借款外，公司的其他筹资活动现金流入全部为银行借款。报告期内，随着公司盈利能力和偿债能力的不断增强，公司从银行筹资的能力得到了明显的改善。

报告期内，公司筹资活动现金持续大额流入，主要是因为从 2010 年起公司业务发展步入正轨，为提升制造水平和生产能力，公司的资本支出金额较大。为弥补大额的投资活动现金净流出，公司以吸收股东投资为基础，结合银行借款开展了与投资规模相适应的筹资活动。

2013 年、2012 年、2011 年公司筹资活动支付的现金分别为 15,211.19 万元、49,825.76 万元、45,764.70 万元，主要为偿还银行借款本息。报告期内，公司能够及时偿还各种借款，具有良好商业信用。

（4）现金及现金等价物净额增加

报告期内，公司现金及现金等价物中不包含使用受限的信用证保证金及票据保证金等其他货币资金。

2013 年，公司现金及现金等价物净额增加额为负数，主要原因在于：公司营业收入下降，经营活动产生的现金流量净额下降；偿还了部分银行借款，筹资活动产生的现金流量净额下降。

2012 年，公司现金及现金等价物净额增加额为负数，主要是因为 2012 年购置厂房、土地使用权及机器设备支付的资金较大，经营、筹资活动产生的现金流量净增加额不足以弥补上述资金需求。

2011 年，公司现金及现金等价物净增加额为 3,155.83 万元，主要是因为：一方面，2011 年经营活动产生的现金流量净增加额较高；另一方面受股东增资影响，筹资活动产生的现金流入净额较大。

（四）资产周转能力分析

报告期内，公司主要运营能力指标如下：

项目	2013 年	2012 年	2011 年
应收账款周转率（次/年）	4.40	5.26	6.98
存货周转率（次/年）	5.83	6.09	7.72
总资产周转率（次/年）	0.32	0.46	0.61

1. 应收账款周转率

2013 年、2012 年、2011 年公司应收账款周转率分别为 4.40、5.26、6.98。报告期内，公司应收账款周转情况良好，一方面是因为公司的主要客户均系国际著名厂商，商业信誉卓著；另一方面，公司的应收账款管理较好，高度重视收款过程中与客户的关系，并及时有效处理各种收款问题。

2012 年，公司应收账款周转率从 2011 年的 6.98 下降到 5.26，主要原因是，受行业形势影响，与前三季度相比，公司第四季度销售增长迅速，年末应收账款余额同步增加并处于全年高点，因此，在营业收入增长了 13.40%的同时，期末应收账款却增长了 38.87%，并最终导致了应收账款周转率的下降。

2013 年，公司应收账款周转率从 2012 年的 5.26 下降到 4.40，主要是由于当年销售收入下降所致。

2. 存货周转率

2013 年、2012 年、2011 年公司存货周转率分别为 5.83、6.09、7.72，周转情况整体良好。

2012 年，公司存货周转率从 2011 年的 7.72 下降到 6.09，主要原因在于，2011 年公司营业收入增长较快，且 2011 年初存货余额较低，因此 2011 年存货周转率较高；2012 年，公司营业收入增速放缓，且期初、期末存货余额较高，存货周转率降至 6.09。2013 年，公司存货周转率从 2012 年的 6.09 下降到 5.83，主要是受 2013 年业务规模下降的影响。

受订单式生产模式的影响，公司存货主要为原材料及在产品。

3. 总资产周转率

2013 年、2012 年、2011 年公司总资产周转率分别为 0.32、0.46、0.61。公司的总资产周转率略低，主要是因为公司系高科技制造型企业，机器设备等资本性投入较高；同时为适应公司发展需求，报告期内，新、老股东对公司的新增投资巨大，进一步影响了公司总资产周转效率。随着这些新增的投资逐步转化为有效产能及产品收入，公司的总资产周转效率将会得到显著提升。

2012 年，公司总资产周转率从 2011 年的 0.61 下降到 0.46，主要原因在于，公司营业收入增长率为 13.40%；同期，由于固定资产投资的连贯性及公司长期战略的考虑，固定资产及在建工程投资持续大幅增长，新增总资产 20,324.02 万元，增长率为 20.96%，由于资产增长速度快于收入增长速度，公司当年总资产周转率下降。

2013 年，公司总资产周转率从 2012 年的 0.46 下降到 0.32，主要是受营业收入下降所致。

4. 同类上市公司比较

发行人与同类上市公司 2013 年主要运营能力指标对比情况如下：

证券代码	证券简称	应收账款周转率	存货周转率	总资产周转率
002463.SZ	沪电股份	4.28	7.98	0.64
002618.SZ	丹邦科技	3.09	7.48	0.17
3189.TW	景硕科技（Kinsus）	7.51	5.49	0.62
8046.TW	南亚电路（NanyaPCB）	4.78	8.82	0.76
3037.TW	欣兴电子（Unimicron）	4.39	10.65	0.59

证券代码	证券简称	应收账款周转率	存货周转率	总资产周转率
行业（算术）平均		4.81	8.08	0.56
本公司		4.40	5.83	0.32

注：数据来自各公司年报等公开资料

发行人的应收账款周转率与上述相近或相似行业的上市公司平均数接近。得益于优质的客户资源及良好的产品质量。

产品生产周期是决定存货周转率的关键因素，而生产周期取决于产品特性和制造工艺。发行人与景硕科技的产品较为近似，因此存货周转率较为接近；其他上市公司产品结构与公司有一定差异，因而存货周转率有差异。

由于充分的产能是取得客户认证及订单的必要条件，发行人为拓展客户并提高产销规模，在报告期内进行了大规模的机器设备投资，与此同时公司还购进了价值较高的厂房并接受了较大金额的无形资产增资。资产规模的迅速增长导致了发行人 2013 年的总资产周转率与同类上市公司平均水平存在一定差异。

（五）管理层对公司财务状况的评价

报告期内，公司的流动比率、速动比率、资产负债率及利息保障倍数等偿债能力指标较好；公司的应收账款周转及存货周转情况良好，相关资产具有较高的流动性，资产质量总体较高。

目前，公司的偿债能力较强，财务风险较小，同时公司具有良好的银行及商业信用，报告期内未发生过银行借款本息偿还违约及重大商业付款违约的情况。良好的资信状况有助于公司偿债能力的维持并降低财务风险。截至本招股说明书签署日，公司不存在担保、或有负债等影响偿债能力的其他事项。

二、盈利能力分析

全球电子类消费产品市场需求的不断提高，带动了半导体行业的高速增长。封装基板行业作为半导体封装测试产业链中的封装材料提供方之一，其整体市场容量也随之扩大。

公司经过创业阶段的准备及近年来业务及产品的拓展丰富，已逐渐形成了以“铜柱法”等五大核心技术为基础，为国际知名半导体客户提供定制化封装基板产品和技术解决方案。IC 封装基板销售收入是公司营业收入的主要来源。2013 年、2012 年及 2011 年实现营业收入分别为 36,847.10 万元、49,641.70 万元及 43,774.74 万元；实现净利润分别为 1,995.24 万元、8,270.97 万元及 4,541.85 万元。

（一）营业收入整体情况

1. 营业收入的构成

报告期内，公司营业收入的具体构成如下：

单位：万元

项目	2013 年度		2012 年度		2011 年度	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
主营业务收入	35,634.49	96.71%	48,323.02	97.34%	42,045.29	96.05%
其他业务收入	1,212.61	3.29%	1,318.68	2.66%	1,729.45	3.95%
营业收入	36,847.10	100.00%	49,641.70	100.00%	43,774.74	100.00%

公司主要产品为 IC 封装基板，主营业务收入主要来自于量产无线射频模块（RF Module）封装基板的销售。公司其他业务收入为废液废料回收收入及报废产品销售收入等。报告期内，公司主营业务突出，主营业务收入占比一直维持较高水平。

2. 营业收入的变动趋势分析

2013 年、2012 年、2011 年，公司营业收入分别为 36,847.10 万元、49,641.70 万元、43,774.74 万元。

2012 年，公司营业收入较上年增长 13.40%，主要原因包括：（1）智能手机、平板电脑等移动通讯终端产品的旺盛需求为公司的发展提供了有利的市场环境；（2）随着公司“铜柱法”无芯封装基板制造技术的日趋成熟，产品得到了客户的进一步认可；（3）公司加大固定资产投资，改进生产工艺，扩大生产规模，有力的支撑了营业收入的增长。

2013 年，公司营业收入较上年下降 25.77%，主要原因为：智能手机、平板电脑等智能终端产品更新换代较快，公司第一大客户安华高科技（Avago）为及时适应终端市场的不断变化，推出了新产品和技术方案，公司已通过认证的产品技术方案未能满足客户新需求，尽管公司推出了新的产品和解决方案，但未能及时通过客户认证，安华高科技（Avago）将部分订单转移至其他厂商，减少了对公司产品的采购；另一方面，公司其他潜在客户的技术和产品认证仍在进程中，该年度获取的新客户订单未能充分弥补安华高科技（Avago）减少的订货量。为改善客户结构，降低经营风险，公司加大了开拓新市场和新客户的力度，2014 年上半年，公司处于认证过程中的客户达十多家，正在认证的新产品批次由 2013 年上半年的不超过 80 批次增加到超过 180 批次，目前公司逐步获得了中普微电子、国民技术等新客户的量产订单，进一步改善了客户结构。

（二）主营业务收入结构分析

1. 产品结构

报告期内公司主要产品分类收入情况如下：

单位：万元

产品名称	2013 年度		2012 年度		2011 年度	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
无线射频模块封装基板	35,492.64	99.60%	48,300.78	99.95%	42,045.29	100.00%
其中：四层板	9,364.27	26.28%	9,261.23	19.17%	7,472.55	17.77%
五层板	7,034.87	19.74%	7,068.36	14.63%	11,719.05	27.87%
七层板	18,485.28	51.87%	31,385.11	64.95%	22,745.91	54.10%
其他	608.22	1.71%	586.08	1.21%	107.78	0.26%
倒装芯片级封装基板/ 倒装球栅阵列封装基板	105.54	0.30%	18.55	0.04%	0.00	0.00%
其他	36.30	0.10%	3.69	0.01%	0.00	0.00%
主营业务收入	35,634.49	100.00%	48,323.02	100.00%	42,045.29	100.00%

（1）无线射频模块封装基板

公司主要产品无线射频模块（RF Module）封装基板，定制化程度高，品种及型号差异大，不属于标准化通用产品，因此对其进行严格的产品分类存在一定困难。从报告期内的情况来看，不同板层的产品在价格及客户分布上存在一定的差异，因此公司将板层作为无线射频模块（RF Module）封装基板产品的主要分类标准。2013 年、2012 年、2011 年，无线射频模块（RF Module）封装基板产品的分别实现销售收入 35,492.64 万元、48,300.78 万元、42,045.29 万元，占主营业务收入的的比例分别为 99.60%、99.95%、100.00%。

该类产品主要包括七层板、四层板和五层板。从不同板层对应的客户来看，七层板主要客户为安华高科技（Avago）及其合作封装测试厂商，四层板的主要客户为威讯联合半导体（RFMD），五层板的主要客户为上述二者。2013 年，安华高科技（Avago）减少了对公司的采购，相应地，公司七层板销售收入下降。

（2）倒装芯片级封装基板、倒装球栅阵列封装基板

倒装芯片级封装基板（FCCSP）、倒装球栅阵列封装基板（FCBGA）是公司正在培育的新产品。这类产品可广泛运用于基带芯片（Baseband）、应用处理器芯片（Application Processor）等领域，其市场规模更为广阔。目前，此类产品正处于新客户认证程序中，客户向公司采购样板用以测试并改善设计方案。报告期内，此类产品收入较低，且占主营业务收入比重较小。

2. 地区结构及客户结构

单位：万元

地区	2013 年度		2012 年度		2011 年度	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例

地区	2013 年度		2012 年度		2011 年度	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
国内	11,885.77	33.35%	11,515.77	23.83%	9,996.02	23.77%
国外	23,748.72	66.65%	36,807.25	76.17%	32,049.27	76.23%
合计	35,634.49	100.00%	48,323.02	100.00%	42,045.29	100.00%

报告期内，公司产品主要用于出口，2013 年、2012 年及 2011 年，境外销售收入占主营业务收入的比重分别为 66.65%、76.17% 及 76.23%。外销的主要客户为芯片设计厂商安华高科技（Avago）以及其合作封装测试厂商日月光（ASE）、国碁电子（Ambit）和 Inari。境内客户主要为威讯联合半导体（RFMD）的境内公司威讯联合半导体（北京）有限公司。

2013 年、2012 年、2011 年，将来自安华高科技（Avago）合作封装测试厂商的营业收入与来自安华高科技（Avago）（含其下属公司）的营业收入合并后，来自 Avago 相关客户的收入与来自 RFMD 的收入合计占公司营业收入的比重见下表：

单位：万元

项目	客户名称	销售收入	占营业收入比例
2013 年度	安华高科技（Avago）相关	22,432.00	60.88%
	威讯联合半导体（RFMD）	12,231.09	33.19%
	合计	34,663.09	94.07%
2012 年度	安华高科技（Avago）相关	35,766.20	72.05%
	威讯联合半导体（RFMD）	12,266.61	24.71%
	合计	48,032.81	96.76%
2011 年度	安华高科技（Avago）相关	31,449.63	71.84%
	威讯联合半导体（RFMD）	10,450.45	23.87%
	合计	41,900.08	95.72%

报告期内，来自上述两大客户的收入占比较高，主要原因在于：安华高科技（Avago）和威讯联合半导体（RFMD）是苹果、三星及诺基亚等国际知名手机或平板电脑厂商的通讯芯片供应商，具有较大的市场份额。2011 年至 2013 年间，智能手机和平板电脑市场的发展较快，因此上述客户对发行人无芯封装基板的采购量较大。

报告期内，公司与上述全球知名芯片厂商及其合作封装测试厂商建立起的稳定合作关系不仅成为公司盈利的保障，还有力的推进公司的新产品及新技术研发，对公司长远发展具有重要的意义。

（三）主营业务成本构成分析

单位：万元

项目	2013 年		2012 年		2011 年	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
主营业务成本	29,141.53	100.00%	34,643.46	100.00%	32,607.01	100.00%
其中：直接材料	12,058.86	41.38%	17,869.92	51.58%	19,377.42	59.43%
直接人工	2,413.18	8.28%	3,307.87	9.55%	2,807.06	8.61%
制造费用	14,669.49	50.34%	13,465.68	38.87%	10,422.53	31.96%

报告期内，公司主营业务成本占营业成本的比重在 95%以上。主营业务成本随着公司销售情况而变化。公司主营业务成本主要为直接材料和制造费用，二者合计占主营业务成本的比重约为 90%。

2012 年，公司产品销售情况较好，主营业务成本随之上升。但由于主要原材料铜箔的价格下降，且公司持续改善工艺流程，在保证质量的前提下降低了单位产品的材料消耗，因此直接材料成本较上年有所下降。

2013 年，公司产品销售较上年下滑，主营业务成本随之下降。但由于部分在建工程转为固定资产、折旧额增加，制造费用有所上升。

（四）主营业务毛利及毛利率分析

报告期内，公司毛利主要来自于主营业务，主营业务毛利占营业毛利的比重约 95%；主营业务毛利率与营业毛利率较为接近。

1. 主营业务毛利及毛利率综合分析

报告期内，公司主营业务毛利、毛利率水平以及变动情况如下所示：

单位：万元

项目	2013 年度		2012 年度		2011 年度
	金额/比率	增长率	金额/比率	增长率	金额/比率
主营业务收入	35,634.49	-26.26%	48,323.02	14.93%	42,045.29
主营业务毛利	6,492.96	-52.54%	13,679.55	44.94%	9,438.28
主营业务毛利率	18.22%	-	28.31%	-	22.45%

报告期内，公司主营业务毛利随着收入的增减同步变化，2013 年、2012 年、2011 年公司分别实现主营业务毛利 6,492.96 万元、13,679.56 万元、9,438.28 万元。受产品单价波动、材料成本变化、固定费用（折旧等）变动、工艺调整等多方面因素的影响，报告期内公司的主营业务毛利率有所波动，2013 年、2012 年、2011 年分别为 18.22%、28.31%、22.45%。

（1）2012 年毛利率水平变动原因分析

2012 年公司主营业务毛利率为 28.31%，较 2011 年有所上升，主要原因在于：

第一，智能手机和平板电脑市场需求旺盛，主要客户对七层板的需求明显增加，该年度七层板的营业收入较上年增长了接近 40%，在营业收入中所占的比重上升近 10 个百分点。七层板是公司主要产品中毛利率最高的品种，由于上述产品结构的变动，提升了公司整体毛利率。

第二，公司持续改善工艺流程，产品合格率提高，单位产品的材料消耗也有所降低；同时，主要原材料铜箔的价格下降，因此直接材料成本较上年有所下降。

（2）2013 年毛利率水平变动原因分析

2013 年公司主营业务毛利率为 18.22%，较 2012 年有所下降，主要原因在于：

第一，公司主要客户安华高科技（Avago）新产品的技术方案发生了变化，减少了对公司的采购量，导致毛利率较高的七层板销量较前期下滑，在营业收入所占比重也有所下降，拉低了公司整体毛利率。

第二，2013 年销量下降，营业收入和产能利用率下降；同时，新增固定资产较多，折旧等固定费用有所增加；上述两个因素使得主要产品的单位制造费用也有所上升，进一步影响了公司的毛利率水平。

2. 主要产品毛利及毛利率情况

报告期内，公司主导产品无线射频模块（RF Module）封装基板产品不同板层产品的毛利及毛利率情况如下表：

单位：万元

项目		四层板	五层板	七层板	其他	合计
2013 年度	收入	9,364.27	7,034.87	18,485.28	608.22	35,492.64
	毛利	-40.55	1,461.99	4,911.52	250.42	6,583.37
	毛利占比	-0.62%	22.21%	74.60%	3.80%	100.00%
	毛利率	-0.43%	20.78%	26.57%	41.17%	18.55%
2012 年度	收入	9,261.23	7,068.36	31,385.12	586.07	48,300.78
	毛利	1,189.08	1,465.24	10,778.36	272.45	13,705.13
	毛利占比	8.68%	10.69%	78.64%	1.99%	100.00%
	毛利率	12.84%	20.73%	34.34%	46.49%	28.37%
2011 年度	收入	7,472.55	11,719.05	22,745.91	107.78	42,045.29
	毛利	937.33	2,756.50	5,680.80	63.66	9,438.28
	毛利占比	9.93%	29.21%	60.19%	0.67%	100.00%
	毛利率	12.54%	23.52%	24.98%	59.06%	22.45%

上表中的“其他”主要是公司为客户定制的样板产品，毛利率较高，但销量较小，对公司经营业绩影响极小。

2013 年，公司主要产品毛利率均有所下降，其中，四层板的毛利率由上年的 12.84% 降至 -0.43%，七层板的毛利率由上年的 34.34% 降至 26.57%。

3. 同行业综合毛利率比较

发行人与同类境内外上市公司的综合毛利率对比情况如下：

证券代码	证券简称	综合毛利率		
		2013 年度	2012 年度	2011 年度
002463.SZ	沪电股份	18.01%	20.40%	22.10%
002618.SZ	丹邦科技	51.19%	52.34%	53.51%
3189.TW	景硕科技（Kinsus）	26.86%	23.71%	22.73%
8046.TW	南亚电路板（NanyaPCB）	1.26%	-3.66%	12.72%
3037.TW	欣兴电子（Unimicron）	10.94%	14.52%	15.79%
行业（算术）平均		21.65%	21.46%	25.37%
本公司营业毛利率		17.94%	28.20%	21.93%
本公司主营业务毛利率		18.22%	28.31%	22.45%

注：数据来自各公司年报等公开资料

从整体情况来看，发行人的综合毛利率与同行业上市公司的平均值较为接近。欣兴电子和南亚电路的毛利率低于公司的主要是因为这两家公司除了从事 IC 封装基板业务外，还从事印刷电路板等产品的生产和销售业务，拉低了其综合毛利率水平。景硕科技是主要从事 IC 封装基板研发与生产的公司，发行人的毛利率水平总体与其相当，2013 年，由于公司产能利用率下降，单位成本上升，毛利率水平较上年下降，低于景硕科技。

（五）利润表主要项目分析

单位：万元

项目	2013 年度		2012 年度		2011 年度	
	金额	/收入	金额	/收入	金额	/收入
一、营业收入	36,847.10	100.00%	49,641.70	100.00%	43,774.74	100.00%
减：营业成本	30,234.92	82.06%	35,641.03	71.80%	34,174.75	78.07%
营业税金及附加	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%
销售费用	417.70	1.13%	377.85	0.76%	410.39	0.94%
管理费用	4,132.73	11.22%	4167.13	8.39%	3,288.65	7.51%
财务费用	322.80	0.88%	542.37	1.09%	1,371.76	3.13%
资产减值损失	80.84	0.22%	49.67	0.10%	9.88	0.02%
加：投资收益	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%
二、营业利润	1,658.11	4.50%	8,863.66	17.86%	4,519.31	10.32%
加：营业外收入	623.99	1.69%	185.24	0.37%	52.28	0.12%
减：营业外支出	-	0.00%	-	0.00%	30.98	0.07%
三、利润总额	2,282.10	6.19%	9,048.90	18.23%	4,540.62	10.37%
减：所得税费用	286.86	0.78%	777.93	1.57%	-1.23	-0.01%

项目	2013 年度		2012 年度		2011 年度	
	金额	/收入	金额	/收入	金额	/收入
四、净利润	1,995.24	5.41%	8,270.97	16.66%	4,541.85	10.38%

1. 营业收入

2013 年、2012 年、2011 年公司营业收入分别为 36,847.10 万元、49,641.70 万元、43,774.74 万元，2012 年度同比增长 13.40%，2013 年度同比减少 25.77%。公司营业收入情况详见本章“二、盈利能力分析”之“（一）营业收入整体情况”。

2. 营业成本

单位：万元

项目	2013 年度		2012 年度		2011 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
主营业务成本	29,141.53	96.38%	34,643.46	97.20%	32,607.01	95.41%
其他业务成本	1,093.39	3.62%	997.57	2.80%	1,567.75	4.59%
营业成本合计	30,234.92	100.00%	35,641.03	100.00%	34,174.75	100.00%

报告期内，公司主营业务突出，主营业务成本占比全部营业成本的比例较高。公司主营业务成本的构成及变动情况见本章“二、盈利能力分析”之“（三）主营业务成本构成分析”。

3. 期间费用

报告期内，公司期间费用构成及占同期营业收入比例情况如下：

单位：万元

项目	2013 年度		2012 年度		2011 年度
	金额	增长率	金额	增长率	金额
销售费用	417.70	10.55%	377.85	-7.93%	410.39
管理费用	4,132.73	-0.83%	4,167.13	26.71%	3,288.65
财务费用	322.80	-40.48%	542.37	-60.46%	1,371.76
期间费用合计	4,873.23	-4.21%	5,087.35	0.33%	5,070.80

报告期内，公司期间费用的金额总体上变化不大。

（1）销售费用

报告期内，公司销售费用主要明细情况如下：

单位：万元

项目	2013 年度		2012 年度		2011 年度	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
咨询费	30.04	7.19%	209.82	55.53%	252.19	61.45%
工资薪酬	226.76	54.29%	82.40	21.81%	66.01	16.08%

项目	2013 年度		2012 年度		2011 年度	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
办公费	4.64	1.11%	10.90	2.88%	11.65	2.84%
差旅费	49.73	11.91%	15.13	4.00%	42.52	10.36%
车辆使用费	8.02	1.92%	11.73	3.10%	-	
运杂费	61.16	14.64%	32.84	8.69%	19.07	4.65%
其他	37.35	8.94%	15.03	3.98%	18.95	4.62%
合计	417.70	100.00%	377.85	100.00%	410.39	100.00%

销售费用主要为销售人员薪酬、差旅费及咨询费等。2013 年、2012 年、2011 年，公司销售费用分别为 417.70 万元、377.85 万元、410.39 万元，销售费用率分别为 1.13%、0.76%、0.94%。受公司产品特点和客户结构的影响，订单式生产销售模式及长期稳定的客户合作关系使得公司的销售费用能够维持在较低的水平。

（2）管理费用

报告期内，公司管理费用主要明细情况如下：

单位：万元

项目	2013 年度		2012 年度		2011 年度	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
研发支出	1,947.69	47.13%	2,203.55	52.88%	2,199.27	66.87%
工资薪酬	781.38	18.91%	860.21	20.64%	769.82	23.41%
办公费	19.78	0.48%	29.48	0.71%	20.05	0.61%
差旅费	90.65	2.19%	81.63	1.96%	58.48	1.78%
业务招待费	13.05	0.32%	11.2	0.27%	8.06	0.25%
车辆使用费	37.04	0.90%	29.79	0.71%	30.22	0.92%
邮电网络费	13.70	0.33%	12.82	0.31%	10.21	0.31%
审计评估	21.63	0.52%	68.68	1.65%	20.7	0.63%
各项税费	176.19	4.26%	95.44	2.29%	54.29	1.65%
无形资产摊销	741.58	17.94%	696.55	16.72%	56.56	1.72%
其他	290.03	7.02%	77.78	1.87%	60.99	1.85%
合计	4,132.73	100.00%	4,167.13	100.00%	3,288.65	100.00%

管理费用主要包括研发费用、管理员工薪及无形资产摊销，2013 年、2012 年、2011 年，公司管理费用分别为 4,132.73 万元、4,167.13 万元和 3,288.65 万元，管理费用率分别为 11.22%、8.39%、7.51%。

2012 年管理费用较 2011 年增加了 878.48 万元，增幅为 26.71%，主要是受无形资产摊销大幅增加的影响。2011 年 12 月，AMITEC 公司以无形资产（技术资产组合）向公司增资，导致公司无形资产摊销从 2011 年的 56.56 万元增加至 2012 年的 696.55 万元，增加额为 639.99 万元，占 2012 年全部新增管理费用的 72.85%。

2013 年管理费用较上年减少 0.83%，变化不大。

(3) 财务费用

报告期内，公司主要财务费用明细情况如下：

单位：万元

项目	2013 年		2012 年		2011 年	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
利息支出	835.05	258.68%	557.41	102.77%	1,579.37	115.14%
减：利息收入	25.18	7.80%	78.23	14.42%	206.19	15.03%
汇兑损益	-487.54	-151.03%	55.57	10.25%	-55.23	-4.03%
手续费支出	22.66	7.02%	37.09	6.84%	88.59	6.46%
其他	-22.18	-6.87%	-29.47	-5.43%	-34.79	-2.54%
合计	322.80	100.00%	542.37	100.00%	1,371.76	100.00%

财务费用主要为利息支出，2013 年、2012 年、2011 年，公司财务费用分别为 322.80 万元、542.37 万元、1,371.76 万元，财务费用率分别为 0.88%、1.09%、3.13%。报告期内，财务费用率逐步下降。

2012 年度财务费用较 2011 年大幅下降，主要是因为随着公司盈利能力的增强及股东投资的增加，公司及时偿还了部分借款，减少了利息支出。

2013 年度财务费用较 2012 年度下降，主要原因在于，公司的产品出口金额较大，在国际市场中主要以美元计价，公司通过远期结汇、增加美元借款等方式化解汇率风险。2013 年，人民币总体上升值，公司获取了较多汇兑收益，降低了财务费用。

4. 资产减值损失

报告期内，公司资产减值损失情况如下：

单位：万元

项目	2013 年	2012 年	2011 年
计提坏账准备	14.47	20.22	9.88
存货跌价损失	66.37	29.45	-
合计	80.84	49.67	9.88

应收款项坏账计提及存货跌价情况详见本章“一、发行人财务状况分析”之“（一）资产构成及变动分析”之“4. 资产减值准备”。

5. 营业外收支

报告期内，公司营业外收支情况如下：

单位：万元

项目	2013 年	2012 年	2011 年
营业外收入	623.99	185.24	52.28
其中：政府补助	552.94	87.28	51.24
其他营业外收入	71.06	97.95	1.04
营业外支出	-	-	30.98

2013 年、2012 年、2011 年，公司营业外收入占利润总额的比例分别为 27.34%、2.05%、1.15%。报告期内，公司的营业外收入主要为政府补助。除政府补助外，2012 年公司其他项目的营业外收入发生较大，主要是接受了客户试生产设备捐赠以及停电保险赔偿收入。

2013 年、2012 年、2011 年，发行人获得的政府补助分别为 552.94 万元、87.28 万元、51.24 万元，具体情况如下：

单位：万元

项目	2013 年	2012 年	2011 年	批准文件
进口设备贴息	36.57	19.26	10.35	《关于做好 2010 年广东省进口贴息资金有关工作的通知》（粤外经贸规财字[2010]13 号）、《关于做好 2011 年广东省进口贴息资金有关工作的通知》（粤外经贸规财字[2011]18 号）、《关于下达 2012 年广东省促进进口贴息资金的通知》（珠财工[2012]052 号）、《关于下达 2012 年下半年促进进口贴息资金的通知》（珠科工贸信[2013]172 号）
一般贸易出口退税征退差资金	21.60	27.01	40.89	《珠海市一般贸易出口退税征退差资金管理办法》
广东省节能先进单位和先进个人奖励资金	-	10.00	-	《关于评选 2011 年度珠海市节能先进单位和先进个人的通知》（珠科工贸信[2012]379 号）
知识产权优势企业奖励资金	-	5	-	《关于公布 2012 年珠海市知识产权优势企业认定和考核结果的通知》（珠知[2012]16 号）
节能专项资金补助	11.00	5	-	《关于印发 2012 年珠海市高效照明产品推广实施方案的通知》（珠科工贸信[2012]1161 号）
应用于高阶智能手机基带的 FCCSP 封装基板技术开发	-	21	-	《关于批复 2012 年高端外国专家项目（经济技术类）计划的通知》（粤外专[2012]24 号）
2011 年珠海市科学技术奖	10.00			《珠海市科学技术奖励证书》
2012 年珠海市扩	20.44			《关于拨付 2012 年珠海市扩大进口专

项目	2013 年	2012 年	2011 年	批准文件
大进口专项配套资金				项配套资金的通知》（珠科工贸信计[2013]11 号文）
2012 年珠海市鼓励企业转型升级扩大生产奖励资金	5.00			未下发文件
广东省第一、二批战略性新兴产业政银企合作专项资金（补充贴息）	32.00			《关于下达广东省第一、二批战略性新兴产业政银企合作专项资金项目补充贴息资金的通知》（珠科工贸信[2013]746 号文）
企业奖励扶持资金	34.31			未下发文件
2013 年市扶持中小企业发展资金	35.00			《关于下达 2013 年度珠海市扶持中小企业发展资金的通知》（珠中小企计[2013]1 号文）
2013 年度珠海市技术改造资金	68.00			《关于下达 2013 年度珠海市技术改造资金的通知》（珠科工贸信[2013]909 号文）
2013 年度珠海市扶优扶强贴息资金	62.42			《关于下达 2013 年度珠海市扶优扶强贴息资金的通知》（珠科工贸信[2013]929 号文）
上市奖励资金	70.00			《关于下达 2012 年度企业上市奖励资金的通知》（珠金[2013]130 号文）
2013 年中小企业发展专项贷款贴息资金	20.00			《关于下达 2013 年度省中小企业发展专项资金（中小企业、民营企业贷款贴息）的通知》（珠中小企计[2013]31 号文）
2013 年广东省促进进口贴息资金	1.24			《关于申报 2013 年广东省促进进口贴息的通知》
2012 年度珠海市企业研究开发费补助资金	45.35			《关于下达 2012 年度珠海市企业研究开发费补助资金的通知》（珠科工贸信[2013]928 号文）
引进专家项目经费	10.00			《关于下达 2013 年度引进外国专家项目（经济技术类）计划的通知》（粤外专[2013]7 号）
上市奖励资金（区配套）	70.00			《关于下达 2012 年度企业上市奖励资金的通知》（珠金[2013]130 号文）
合计	552.94	87.28	51.24	

6. 净利润

综上，报告期内，由于期间费用金额总体上较为稳定，公司的盈利水平主要取决于营业毛利，进而取决于营业收入和毛利率。

2012 年，公司营业收入较上年上升了 13.40%；同时，公司毛利率有所上升，公司营业毛利较上年增加 4,400.68 万元，营业利润较上年增加 4,344.35 万元，净利润增加 3,729.12 万元。

2013 年，公司营业收入较上年下降了 25.77%，且毛利率降低约 10 个百分点，公司盈利有所下滑。营业毛利较上年下降了 7,388.49 万元，营业利润较上年下降了 7,205.55 万元，净利润下降了 6,275.73 万元。

报告期内，公司营业收入变动原因见本章“二、盈利能力分析”之“（一）营业收入整体情况”，毛利率变动原因见本章“二、盈利能力分析”之“（四）主营业务毛利及毛利率分析”。

（六）非经常性损益对公司盈利的影响

本公司最近 3 年非经常性损益具体情况如下：

单位：万元

项 目	2013 年度	2012 年度	2011 年度
非流动资产处置损益	0.00	0.01	-0.96
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	0.00	0.00	0.00
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	552.94	87.28	51.24
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	71.06	97.95	-28.98
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0.00	0.00	0.00
非经常性损益总额	623.99	185.24	21.30
减：非经常性损益的所得税影响数	93.60	23.16	0.00
非经常性损益净额	530.39	162.09	21.30
减：归属于少数股东的非经常性损益净影响数（税后）	0.00	0.00	0.00
归属于公司普通股股东的非经常性损益	530.39	162.09	21.30

2011 年、2012 年，非经常损益对净利润影响较小；2013 年，公司毛利率下降，营业利润较上年明显下降，且该年度公司政府补助金额较大，导致非经常损益占归属于母公司股东净利润的比重为 26.58%。

三、发行人资本性支出分析

（一）最近 3 年的重大资本性支出

报告期内，公司重大资本性支出情况如下：

单位：万元

项目	2013 年		2012 年		2011 年	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
房屋建筑物及附属设施	1,548.76	11.07%	19,838.18	52.88%	2,184.58	7.72%
机器设备	12,065.93	86.25%	17,370.16	46.30%	25,689.19	90.77%
运输工具	47.5	0.34%	86.00	0.23%	-	-
电子设备	196.31	1.40%	162.41	0.43%	158.58	0.56%
其他设备	130.53	0.93%	61.99	0.17%	269.30	0.95%
购建固定资产等长期资产的现金流出	13,989.03	100.00%	37,518.74	100.00%	28,301.64	100.00%

报告期内，公司重大的资本性支出主要用于生产用机器设备投资，其中 2012 年包括了厂房及其附属物的购置支出。公司的重大资本性支出变动与固定资产及在建工程的变动情况一致，持续的大规模资本性支出有效的提升了公司的产能及自动化水平，为公司的长远发展奠定了良好的基础。

（二）未来可预见的重大资本性支出计划

公司拟以募集资金投资于珠海越亚改扩建项目。具体情况详见本招股说明书“第十二章 募集资金运用”。

四、股利分配情况

详见本招股说明书“第十三章 股利分配政策”。

五、未来盈利能力及经营前景分析

公司将充分利用现有的技术、研发等方面的优势，针对 IC 封装基板出现的新的需求热点，通过加大研发投入、开发新产品等措施，培育公司新的利润增长点。

公司未来将立足主业，充分利用国家鼓励发展集成电路的有关政策，抓住行业发展的机遇，不断进行技术改造，扩大生产规模，提高产品的技术含量和附加值，进一步增强公司的盈利能力。通过实施本次募集资金投资项目，公司的产品结构将更趋完善，生产技术水平 and 市场竞争能力将进一步得到提高。随着我国集成电路产业复苏，我国 IC 封装基板行业将面临难得的发展机遇。随着本次募集资金投资项目的实施，公司将紧跟集成电路封装测试行业的发展步伐，实现产品的升级换代，拓展盈利空间。

（一）强大的技术及经验积累和良好的客户关系是未来公司发展的基础

目前，公司是无芯封装基板产品及技术解决方案的供应商，已具备一定市场份额及产品知名度。公司的无线射频模块（RF Module）封装基板产品已通过威讯联合半导体（RFMD）、安华高科技（Avago）等国际知名半导体厂商的认证程序。公司强大技术及经验积累形成的技术壁垒以及与客户长期合作形成的良好客户关系是公司面对未来市场竞争并保持稳定发展的基础。

公司目前已掌握数字芯片封装领域 FCCSP、FCBGA 产品的生产技术，相应产品也已进入了新客户认证程序。产品体系的丰富以及客户集中度的降低可以有效地减少公司未来的经营风险。

（二）良率控制能力的提升是公司未来盈利的重要保证

良率是公司获得客户认证的重要指标之一，较高的良率水平有助于公司与客户形成长期稳定的合作关系。良率还对公司利润具有重要影响，较低的良率不仅会增加产品的质量成本，还会降低公司产品的定价能力。

为持续获得客户的认可并争取新的客户资源，同时提高产品利润率，报告期内公司研发创新稳步推进，生产工艺逐步完善，良率水平提升。公司将继续引进高科技制造装备，减少人工操作，提升自动化水平。

报告期内，公司通过对绩效考核体系的完善，营造出了重品质、重效率的生产环境。公司还通过对制造部、工艺部以及品质部的整合建立起了生产部门小组。生产部门小组的建立对完善生产过程参数，提高产品良率具有重要意义。

工艺技术的改进以及管理制度的完善，强化了公司的产品良率控制能力，有助于公司吸引更多优质客户，提升公司利润水平。

（三）产业转移为公司未来的持续发展提供了宝贵的机遇

目前，随着整个封装测试行业向中国大陆的转移，IC 封装基板行业内的主要产能逐随之迁移。日本、韩国以及中国台湾等地的主流封装基板厂商纷纷在中国大陆设立了生产基地。

IC 封装基板的产业转移以及国内封装测试产业链布局为本公司的发展提供了良好的机遇。产业的转移会带来规模效应，生产基地在国内的聚集将会促进产业链上、下游行业的发展，国内将会出现大量封装基板原材料供应商、芯片封测厂等，产业链的完善将降低公司的生产成本，拓宽产品销售渠道，为公司的发展创造良好的生存环境。

第十一章 业务发展目标

一、发行人当前及未来两年的发展规划及发展目标

（一）总体规划

发行人的总体规划为：立足封装基板行业，充分利用公司已经积累的各种优势，在“客户满意，准时交付；专精技术，行业领先；严格管理，提升品质；紧密合作，持续改进”的质量方针指引下，满足客户需求。在巩固及扩大模拟芯片封装基板的市场占有率的同时，开拓数字芯片封装基板市场，满足市场需求；通过技术创新，引领行业发展趋势，为客户提供创新型的封装基板解决方案，不断扩大公司产品和服务的差异化竞争优势；开拓国际市场并逐步发展国内市场，逐渐扩大公司市场份额和品牌影响力，积极回报股东、服务社会，为员工实现价值并创造更大的发展空间。

（二）具体经营目标

在完成本次募集资金投资项目的基础上，公司产能进一步扩大，业务规模进一步提升，销售的产品主要包括模拟芯片封装基板（主要包括无线射频模块封装基板和电源产品）以及数字芯片封装基板（主要包括 FCCSP 及 FCBGA 等倒装封装基板产品等），主营业务产品品种进一步增加。

（三）拟采取的措施

为实现上述总体规划和具体的经营目标，公司内部各部门需针对性的开展具体的措施，共同保证总体目标的实现。具体可包括如下方面：

1. 研发和技术创新策略

发行人将密切关注行业发展方向，及时跟进研发和技术创新策略，为市场提供先进的封装基板技术解决方案，保持公司在行业内的技术优势。“精细化”和“高集成化”是包括封装基板产品应用在内的半导体行业的永恒发展趋势，因此发行人在未来几年将针对这两个方面进行持续的研发和技术创新。

在“精细化”方面，发行人将开发 40 μ m 直径以下的孔、15/15 μ m 宽度以下的精细线路、30 μ m 以下的层间绝缘层厚度、中心距 100 μ m 及以下铜凸点（Copper bump），及中心距 130 μ m 的锡球（SOP）以实现更小间距的 FC 凸点中心距离。在“高集成化”方面，发行人将开发内置薄膜电感、内置薄膜电容、埋入式被动元器件电容、埋入式被动元器件电感、埋入式集成滤波器、埋入式芯片主动元器件的新型封装基板产品。

发行人为保护其研发和技术创新成果，将针对技术实现的流程和技术所达到的产品结构两个方面，在包括美国、中国、日本、韩国、以色列及欧洲各国和中国台湾地区进行专利申请。这种专利策略可防止竞争者复制公司的生产工艺流程，也可以防止竞争者模仿公司的技术路径来实现公司产品的结构特点。

2. 产品策略

发行人的产品开发计划将以现有的模拟芯片封装基板产品为基础，拓展在数字芯片市场中的产品，以覆盖更多的市场领域。

具体而言，公司将继续巩固和发展现有的 RF Module 封装基板产品，并将在未来采用倒装（FC）的封装形式代替现有的打线（WB）形式，提供顺应市场发展趋势的倒装形式的 RF Module 产品；公司将投入资源重点发展模拟芯片的电源（Power）产品，增加公司在模拟芯片市场的竞争力；发行人还将在未来几年内迅速切入市场空间更为广阔、增长更加强劲的数字芯片封装基板市场，量产用于基带芯片、应用处理芯片等数字芯片的 FCCSP、FCBGA 等倒装芯片封装基板。

3. 市场开发和销售策略

未来两年，公司将在巩固与扩大现有客户订单基础上，更多侧重于开发和量产应用于基带芯片、应用处理芯片等数字芯片的 FCBGA、FCCSP 等倒装封装基板，重点锁定这类产品位于行业前列国际芯片设计公司、封装设计公司以及包括中国在内的新兴市场发展较快的芯片设计公司，在开发海外市场需求的同时，同步增长国内市场的订单及营收机会；在扩充产品向更高集成、更多层次发展的同时，也将提供新型高附加值的解决方案，在封装基板内部嵌入被动元器件及主动元器件，同时用“铜柱法”所特有的高散热特性把产品应用扩充到电源类产品，以此全方位、一站式的服务满足各类型客户的需求，扩大业务增长机会。

公司现有客户主要集中在 RF 模拟信号射频领域，随着 3G 及 4G/LTE 通讯发展的需求，RF Module 相关的需求量也在迅速增加；封装设计也逐渐从打线（WB）转向倒装（FC）方式，公司可以凭借现有无芯封装基板及铜柱法等技术优势，从现有客户开发新产品开始即争取到这一新技术产品的评估机会，确保后续的顺利量产；拓展更多的国内和国外模拟信号无线射频领域的新客户，继续增加在这一领域的客户群和市场占有率。

4. 生产和品质控制计划

（1）品质控制的措施

① 量产产品

发行人以厂内执行的一致性为持续监控的关注点，每月根据各个工序、流程中表现出来的突发不良为切入点，制定针对性的纠偏措施，并纳入相关管理人员和技术人员的绩效考核指标，形成持续改善、稳定提高的态势。

②小批量量产

在小批量量产的产品上，公司有一定的工艺基础，已经通过了客户前期认证，目前处于持续的经验积累阶段，发行人以工艺方法和工艺参数持续优化为突破口，每月根据各个工序、流程中表现出的前几项缺陷为关注点，成立跨部门的多功能项目攻关小组，重点改善主要问题项。对于各项目小组制定过程良率改善的目标，逐步完善过程参数，周期性的召开进度检讨会议；根据改善情况，及时的给予绩效或项目奖励的方式激励员工，最终达成整体良率的提升，为稳定大量批量产提供品质保障。

③样板产品

公司现已成立样板制作跟进管理小组，包含进度管理和现场技术跟进，确保样品 100%按时、保质地交付给客户。在这类产品上，公司的产品工程师参与到客户端产品结构设计中，推荐结构、表面处理方式等，将与客户的合作前移到设计阶段，探讨既满足于产品的性能，又满足可制造的设计特性。在样板到量产的各个阶段，及时总结生产经验，技术经验，对内强化员工的培训和对新技术的热忱，对外加强对客户了解，增强服务和响应速度。在与客户的沟通中，充分理解客户的实际需求，并将这种需求及时转化为内部改善和提高的动力。

样品导入量产参考先期产品质量策划（APQP）四阶段的要求，从计划与确定项目（客户资料确认与审查，成本核算，原材料采购等），产品设计与开发验证（新产品品质控制计划，产品失效模式效应分析等），产品和过程确认（产品质量策划总结和认定，统计过程能力监控），到反馈、评定和纠正措施（客户满意度反馈，制定改善措施，过程控制体系文件更新和持续改善），形成一个循环的闭环，保证量产的顺利进行。

（2）提升生产效率的措施

公司将引进先进的自动化设备，逐步实现全线自动化生产；通过培训、考核和绩效管理等，保证生产一线操作人员达到操作技师资格水平，营造高品质、高效率的工作环境。优化产品生产制程，提升工艺技术，提高生产一次通过率和产品良率；通过交叉稽查、岗位自检、点检等，不断发现改善点，并持续改善，以提高生产效率。

5. 人力资源策略

根据公司未来三年的业务发展规划，分别制定“选、用、育、留”的人力资源发展计划，深度打造一支不断创新和务实团结的人才队伍。

（1）选才策略

持续完善内部人才培养机制及外部人才引进机制，快速壮大及巩固从基层作业员到高级管理层的各级人才梯队。一方面，十分注重内部培养干部；另一方面，积极拓展多元化选才渠道，透过与全球知名半导体猎头公司长期合作，成功引进业内知名公司的专业人才，加强了公司国际化经营阵容。

（2）用才策略

持续完善目标导向的业绩考核及 360 度素质考核机制，深入完善关键岗位及后备干部选拔机制。全面提升人均产值并高度注重优化人力结构，保持业内标杆水平。

（3）育才策略

提供系统的通用类、技术类及管理类培训，组织实施职业化培训计划和后备干部培训计划，资助员工取得专业资质及在职深造，并加强管理各级干部的经验传承和指导各单位完善学习型组织。公司每年组织各级管理干部参加北大在线哈佛管理导师培训，绝大部分学员能够按时完成学业并顺利通过考试。

（4）留才策略

持续完善激励及淘汰机制，深化差异化管理，透过全员分享公司成长利润及核心员工持股计划，高度凝聚员工向心力。

6. 国际化和国内化策略

半导体行业及封装行业具有客户高度集中的特点，公司的目标客户和目标市场主要定位在半导体行业应用于手机、平板电脑等移动终端的芯片设计和封装领域位于行业前列的厂商。

近几年随着国家陆续出台鼓励集成电路发展的政策，国内集成电路研发和生产迅速崛起，国内的手机、平板电脑等移动设备设计商和制造商发展迅速，并在移动终端产业链占据着越来越重要的位置。公司将继续加大国内市场的开拓力度和资源投入，与国内主要的芯片厂商加强合作，使得公司无芯封装基板能随着国内客户的成长而增加相应的市场份额。

7. 融资策略

本次发行是公司设立以来最重要的融资计划，募集资金运用将全部围绕提升公司核心竞争力展开。针对未来两年公司的发展规划所需的资金需求，公司在保证满足公司经营的资金需求的前提下，将通过选择不同的融资渠道，灵活运用股权性融资和债权性融资，优化公司资本结构，降低融资成本，满足公司的资金需求，保证公司经营的持续稳定健康发展。

8. 收购兼并及对外扩张计划

发行人暂时没有明确的收购兼并计划。但是公司在未来将从技术合作、市场扩张两方面进行相应的布局，以满足随时可能出现的新机会、新挑战带来的需求。在技术合作方面，公司既要就无芯封装基板技术市场化后可能面对的业务扩展所需要的相关技术进行储备，也需要与对无芯封装基板技术有强烈兴趣的同行业公司进行战略性合作。这两方面都可能会产生收购需求。

在市场扩张方面，在日本大地震、泰国洪水之后，客户对于第二来源的供应商（Second Source）的强制性要求越来越高，第二来源不一定是商业关系独立的两家供应商，而更需要的是地理位置相隔足够远的两家生产地点。从这个角度来看，公司将来可能需要考虑跨地域的产能扩张。

二、实现规划和目标所依据的假设条件

以下几点事项是上述发展计划制定及实施的前提条件：

- 1、本次发行上市按预期顺利完成，募集资金及时到位；
- 2、国内和国际的宏观经济未遭遇更大的经济危机，且政治、法律和社会环境稳定；
- 3、半导体集成电路行业保持正常的增长，未受到政策限制；
- 4、国家现行的税收、汇率和利率政策无重大不利变化；
- 5、公司能够持续保持现有管理层、核心技术人员稳定性和连续性；
- 6、公司管理层未有重大的决策失误；
- 7、无其他不可抗力造成的重大不利影响。

三、本公司实施上述计划将面临的主要困难

（一）资金短缺

封装基板行业属于资金密集、技术密集型行业，设备采购、技术开发、人员招聘、市场扩张等均需要大量资金支持，若公司不能筹措到足够的资金，上述计划的实施将受到影响。

（二）技术更新加快

随着芯片设计和制造工艺的不断提高，封装基板技术更新换代速度越来越快。若公司不能紧跟技术发展趋势，开发出领先的技术和相应的产品，则将无法实现未来的经营目标。

（三）市场竞争加剧

虽然发行人具有差异化的技术和产品优势，但相对于封装基板行业的传统大型企业，如景硕科技(Kinsus)、欣兴电子(Unimicron)、揖斐电(Ibiden)等，发行人规模相对较小，后者在行业的规模、资金及经验上存在优势。如果发行人无法采取有效措施应对，上述计划的实现将受到一定影响。

（四）专业人才的短缺

公司拟定的投资发展计划实施后，必须有相应的人力资源支持。封装基板行业在国内发展较晚，专业人才相对缺乏。随着公司的持续发展，未来几年需要加大人力资源的储备力度，否则可能会出现技术、市场、管理及财务人员短缺的情况，从而制约公司的长远发展。

（五）管理经验不足

未来几年公司将进入高速发展的阶段，这对公司的管理能力、资源协调能力、生产制程控制能力、成本控制等方面均提出新的要求。若公司未能及时适应上述变化，则上述计划的实施将会受到影响。

四、业务发展规划和目标与现有经营业务之间的关系

本公司的业务发展规划是以公司较强的无芯封装基板研发实力为依托，以公司现有人才、技术、业务为基础而作出的战略规划，是公司现有业务的全面拓展和提升，符合公司的总体发展战略。

发展计划如果能顺利实施，有利于继续扩大公司现有主要产品模拟市场无芯封装基板的市场份额，有利于开拓数字市场无芯封装基板的延伸产品，做大产业规模，提升公司在无芯封装基板设计和制造领域的核心竞争力和综合实力。

第十二章 募集资金运用

一、本次发行募集资金数额及依据

（一）本次发行募集资金数额及专项存储安排

公司公开发行 A 股股票总数不超过 20,170.8023 万股，其中公司公开发行新股数量上限为 20,170.8023 万股，公司股东公开发售股份数量上限为 5,000 万股且不超过自愿设定 12 个月及以上限售期的投资者获得配售股份的数量。发行后的流通股股份占公司股份总数的比例不低于 25.00%，实际新股发行募集资金扣除发行费用后的净额为【】万元，全部用于公司主营业务。

公司募集资金将存放在董事会决定的专户集中管理，做到专款专用。发行人《募集资金管理办法》已经于 2012 年第四次临时股东大会审议通过，2013 年第二次临时股东大会审议通过修改后的《募集资金管理办法》。该制度对募集资金的存储及使用管理、募集资金项目的管理与监督等进行了详细规定。

（二）本次募集资金投资项目

项目名称	项目总投资额/万元	募集资金投资额/万元
珠海越亚封装基板技术股份有限公司改扩建项目	62,000	52,000

就上述项目，珠海市富山工业园管理委员会建设环保局出具《关于珠海越亚封装基板技术股份有限公司改扩建项目环境影响报告书的批复》（珠富建环复[2012]048 号）；珠海市发展和改革局出具《关于珠海越亚封装基板技术股份有限公司改扩建项目核准的批复》（珠发改产业[2012]157 号）；广东省环境保护厅出具《广东省环境保护厅关于珠海越亚封装基板技术股份有限公司上市环保核查情况的函》（粤环函[2013]136 号）。

本次发行上市募集资金到位前，公司可根据项目的实际进度，以自筹资金支付项目所需款项；本次发行上市募集资金到位后，公司将严格按照有关的制度使用募集资金，募集资金可用于置换前期投入募集资金投资项目的自筹资金以及支付项目剩余款项，若本次发行实际募集资金低于募集资金项目投资额，公司将通过自筹资金解决。

二、募集资金投资项目的必要性和市场前景

（一）募集资金投资项目的必要性

1. 带动我国封装基板产业整体升级

IC封装基板行业一直是我国鼓励发展的行业。2009年9月，国家发展改革委员会、科技部、工信部、商务部、知识产权局颁布了《电子信息产业技术进步和技术改造投资方向》，并指出半导体集成电路、电子基础产品等7个领域是电子信息产业技术进步和技术改造投资的主要方向，其中重点支持高密度互联多层印制电路板、多层挠性板、刚挠印制电路板、IC封装基板、特种印制电路板等电子材料的发展。

随着集成电路产业链的产业分工日益专业化、精细化，晶圆制造、封装测试和封装基板制造逐步向亚洲转移。目前封装基板制造主要集中在日本、韩国和中国台湾，中国大陆封装基板行业逐渐发展，有少部分本土企业进入封装基板行业，同时由于人力及土地成本等原因，日韩台部分封装基板厂商也纷纷到中国大陆建分厂。2012年日本、韩国和中国（包括中国台湾地区）共实现封装基板销售收入79.19亿美元，占全球封装基板份额的95.27%。

发行人从2006年设立以来一直致力于高密度刚性有机无芯IC封装基板的研发和生产，是世界上首家运用“铜柱法”实现无芯封装基板量产的厂商。发行人将通过此项目，在现有技术的基础上继续改进和创新，进一步完善属于自己的技术体系，并通过新增生产线及建设生产车间，大幅提升公司在该领域的整体生产和制造能力。通过量产运用于模拟芯片领域和数字芯片领域的有机无芯IC封装基板，有效带动我国封装基板产业的整体升级。

2. 增强公司核心竞争力、进一步提升公司核心技术体系水平

在本项目中，发行人将对现有业务进行技术改造，并实施扩大再生产，产能进一步增加。

发行人所生产的封装基板产品最终主要用于手机、平板电脑等消费类电子产品。随着网络通信技术、多媒体技术、智能软件等技术的革新，消费类电子产品行业持续向“移动便利化”、“内容丰富化”、“功能融合化”发展，越来越多的新产品以越来越快的更迭速度在市场上出现，成为新的需求增长点。为了把握市场机遇，满足丰富多样的终端消费类电子产品对封装基板个性化的要求，公司不断进行技术创新和产品改造，将在本项目中丰富产品体系，继续补充公司在模拟芯片市场的封装基板产品，并拓展在数字芯片领域的封装基板产品，实现产品的多元化，保持市场竞争力。

本次募集资金项目除了继续应用无芯板（Coreless）技术、铜柱（Copper Pillar）技术、采用半固化片在铜柱上层压的技术、化学机械抛光（CMP）磨板技术和真空喷溅（Sputtering）技术外，通过实施本项目，公司还将应用新研制的条形实心铜微孔、埋入式静电屏蔽设计、超强散热多形状铜柱、高精细线路及间距等前

沿封装基板技术，通过技术升级和创新，增强公司核心竞争力。除此之外，公司还将在本项目中继续完善工艺流程，优化工艺标准，加快各生产线自动化进程，有效节约劳动力成本，提高产品良率，进一步巩固和深化发行人在刚性有机 IC 封装基板领域的竞争优势。

3. 公司将通过募投项目进入数字芯片封装基板领域

为了获得更大的增长空间，提升业绩表现，发行人需丰富产品体系，拓展在其他细分市场中的业务。在刚性有机 IC 封装基板市场中，数字芯片封装基板市场容量大，且成长性高。据 Prismark 预测，2017 年数字芯片封装基板市场容量将增长到 69.42 亿美元，其中 FCCSP 产品市场容量为 21.99 亿美元，年复合增长率高达 9.8%，同时预计 2017 年 RF Module 封装基板市场容量为 4.44 亿美元，数字芯片封装基板未来市场发展空间较 RF Module 封装基板市场更为广阔。因此发行人通过募投项目进入数字芯片市场后，将面对更大的市场空间，实现更丰富的产品组合以提升公司在全球刚性有机 IC 封装基板市场中的占有率，巩固公司的竞争地位，提高公司的核心竞争力。

数字芯片封装基板的终端市场与公司现有模拟芯片封装基板产品的终端市场大部分重合，仍主要为智能手机和平板电脑市场，公司经过在模拟芯片封装基板市场多年的研究、生产、销售活动，对此市场所需的技术水平和产品发展趋势有着深入的了解和丰富的经验积累，能够及时把握市场需求的变化，提供顺应市场变化趋势的封装基板产品和解决方案；另外，公司目前掌握的封装基板制造技术和生产工艺不仅使公司在模拟芯片封装基板市场上保持竞争优势，其技术工艺所能实现的封装形式、尺寸结构和性能也能充分满足数字芯片封装基板的要求。

4. 满足客户认证对数字芯片封装基板产能的需求

发行人是世界首家通过“铜柱法”技术实现刚性有机 IC 无芯封装基板量产的厂商。无芯封装基板技术为近年来发展起来的新兴封装基板技术，其性能和成本具有显著的竞争优势，最近几年迅速发展。刚性有机 IC 封装基板厂商与客户合作的模式有其独特性，在获得批量生产订单前需要首先得到客户的技术、产品认证，并向客户提供符合客户要求的产能规模。公司的数字芯片封装基板产品已进入了众多芯片厂商的认证过程，但公司缺少数字芯片封装基板产品的生产设备，不能提供客户所需的产能，公司将通过此项目改进生产工艺、购置新设备、改造厂房以补充现有产能。

（二）募集资金投资项目实施的可行性

1. “铜柱法”技术为募投项目的实施提供了可靠的技术基础

公司用“铜柱法”制造技术生产应用于模拟芯片领域的 RF Module 高密度无芯封装基板产品，并实现量产化。

数字芯片封装基板较公司目前生产的模拟芯片封装基板在技术上的主要差异包括两方面，一是在封装形式上前者通常采用倒装方式，而后者主要采用打线的方式；二是在结构尺寸和性能上，数字芯片封装基板需要更精细的线路，更小的孔，更佳的热管理以及更好的尺寸稳定性。目前，在封装形式上发行人已掌握了制造倒装封装基板的技术。在实现更精密的尺寸结构上和更优的性能方面，发行人所拥有的“无芯板（Coreless）技术”、“铜柱（Copper Pillar）技术”、“采用半固化片在铜柱上层压的技术”、“化学机械抛光（CMP）磨板技术”和“真空喷溅（Sputtering）技术”五项核心技术，以及多项技术储备能实现 15/15 μm 的精细线路，40 μm 的孔直径，并可实现任意层不同尺寸和规格的孔，从而实现更好的散热性。另外，公司生产的封装基板每层都采用玻璃纤维材料，具有低热膨胀系数，并结合能起到机械加强作用的线状“铜柱”，控制板弯曲度，保证封装基板的稳定性。

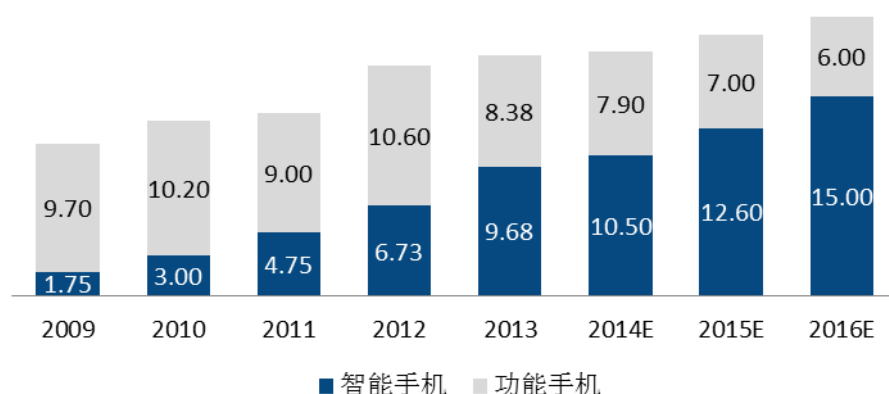
目前，公司已针对数字芯片领域 FCCSP 和 FCBGA 等倒装封装基板产品进行了创新技术研发，并进行专利申请。目前已经研制出条形实心铜微孔、埋入式静电屏蔽设计、超强散热多形状铜柱、高精细线路及间距等封装基板技术，为募投项目的成功提供了可靠的技术储备力量。

2. 下游终端需求市场的稳定发展为项目开展提供了市场保障

智能手机和平板电脑因其智能化、社交化、融合化、便携化等特点已成为消费电子产品市场中增长速度最快的产品。根据 Prismark 和 Gartner 的预测，智能手机和平板电脑在未来 5 年内仍将保持高速增长的态势。2013 年全球智能手机出货量已达 9.68 亿台，2009 年-2013 年，全球智能手机出货量年复合增长率为 53.36%，预计 2016 年全球智能手机出货量将达到 15 亿台。平板电脑作为新兴产品，其增长更为显著，全球平板电脑出货量由 2011 年的 0.6 亿台增长到 2013 年的 1.95 亿台。随着苹果 iPad 平板电脑的不断升级和创新，三星等厂商在平板电脑市场的及时跟进以及亚马逊、谷歌等厂商相继推出更为廉价产品，预计 2017 年平板电脑出货量将达到 4.55 亿台。

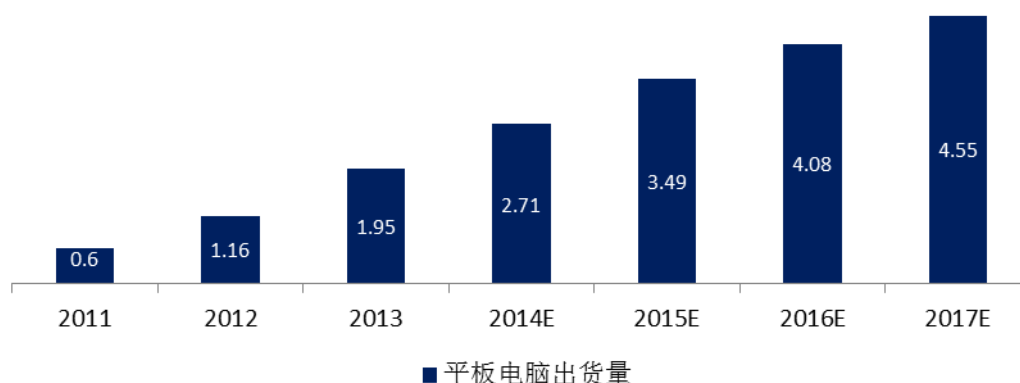
智能手机和平板电脑的热销，为 IC 封装基板供应商提供了广阔的市场基础，为本项目的开展提供了较为坚实的市场销售保障。

全球手机出货量（亿台）



资料来源：Prismark、Gartner

平板电脑出货量（亿台）



资料来源：Gartner、IDC

（三）募集资金投资项目的市场前景

根据 Prismark 的预测，下游终端市场旺盛的市场需求将推动刚性有机 IC 封装基板市场持续发展。2017 年刚性有机 IC 封装基板出货量将达到 530.42 亿颗，实现销售收入 92.30 亿美元。发行人将通过此扩产项目扩大产能、丰富产品体系，以顺应市场的增长趋势，扩大市场份额。

公司将在募投项目中生产的 RF Module 封装基板主要运用在移动终端设备中的模拟芯片领域。以智能手机、平板电脑和笔记本电脑为代表的移动终端设备面对着强劲的市场需求，给 RF Module 封装基板带来了广阔的市场空间。Prismark 预测显示，2017 年 RF Module 封装基板的出货量和销售收入将由 2012 年的 39.60

亿颗和 3.25 亿美元增长至 62.90 亿颗和 4.44 亿美元，销售收入年复合增长率为 6.43%。

公司将在募投项目中生产的 FCCSP 和 FCBGA 等倒装封装基板产品主要运用在移动终端设备的数字芯片领域，具体运用在智能手机、平板电脑等设备的基带芯片（Baseband）和应用处理器芯片（Application Processor）上。根据 Prismark 的预测，FCCSP 产品在未来将保持稳定的增长态势，预计 2017 年出货量将达到 74.76 亿颗，销售收入预计可达 46.54 亿美元，2012 至 2017 年销售收入年复合增长率为 3.91%。

另外，消费电子产品朝便携化和小型化、网络化和多媒体化转换，促使模拟集成电路朝高精度、低功耗、小封装方向发展，数字集成电路向更快、更复杂、更高集成度的方向演变，要求封装基板朝着具备更小的线宽线距、更密集的导通孔、更具有弹性的产品设计和更高的性能发展，因此满足上述产品特点的高端封装基板将面对更大的市场空间。发行人作为首家采用“铜柱法”生产高密度刚性有机无芯 IC 封装基板产品的厂家，其产品因具备尺寸和性能上的诸多优势，能顺应消费市场的需求变化，因此智能手机、平板电脑等消费电子产品的热销将为公司的募投项目提供巨大的市场空间。

三、募集资金投资项目简介

（一）项目建设内容

本项目的建设内容为现有生产厂房第二层的改、扩、建，具体为通过扩充及升级现有 RF Module 封装基板等模拟芯片封装基板产品产能的设备并引进 FCCSP、FCBGA 等数字芯片封装基板产品生产设备，建设电镀车间、LDI 车间、Sputter 车间、磨板车间、AOI 车间、FQC 车间，以实现新增无芯封装基板产能 12.4 万平方米/年。项目产品获得客户认证并实现量产后，公司将在扩大现有模拟芯片封装基板市场的基础上，进入数字芯片封装基板市场，进一步丰富产品类型，改善国内外客户结构，增大生产经营规模，增强市场竞争力。

（二）投资概算及使用计划

珠海越亚公司改扩建项目新增项目总投资 62,000 万元，其中建设投资 59,946 万元，占 96.69%；铺底流动资金 2,054 万元，占 3.31%。其中 52,000 万元通过上市募集资金解决，10,000 万元主要使用银行贷款解决。

其中建设投资使用计划如下：

单位：万元

建设投资使用计划					
年份	第一年	第二年	第三年	第四年	合计
金额	7,164.73	23,020.2	7,837.2	21,924	59,946
比例	11.95%	38.40%	13.07%	36.57%	100%

（三）产品方案

1. 项目产品

本项目全部建成投产后，产能为 12.4 万平方米/年，全部生产 IC 封装基板，进一步扩大了模拟芯片封装基板的产能，同时增加了市场上正在迅速发展的数字芯片封装基板产品的产能。

公司将在募投项目中实施的产品如下：

产品类别	主要产品名称	产品应用领域	终端运用领域
模拟芯片封装基板	主要包括 RF Module 封装基板等	功率放大器芯片、接收器、前端模块芯片、电源芯片模组等	手机、平板电脑、游戏机等终端电子产品
数字芯片封装基板	主要包括倒装芯片级封装基板（FCCSP）及倒装球栅阵列封装基板（FCBGA）等倒装封装基板	基带芯片、应用处理器、专用集成电路（ASIC）等	手机、平板电脑、游戏机、电脑、电视机等消费电子产品

2. 产品质量标准

发行人在此募投项目中实施严格的质量控制体系，各个生产环节都将进行质量检测，确保产品符合各项质量标准。公司产品遵循的质量标准如下：

标准编号	标准名称
IPC-TM-650	《PCB Test Methods Manual》/《PCB 试验方法手册》；
IPC-A-600H	《Acceptability of Printed Boards》/《印制电路板的验收标准》；
IPC-6011	《Generic Performance Specification for Printed Boards》/《印制板通用性能规范》；
IPC-6016	《Qualification and performance Specification for High Density Interconnect（HDI）Layers or Boards》/《高密度互连（HDI）层或印制板的鉴定与性能规范》；
IEC-60068	《Environmental testing》/《环境试验方法》；
ISTA 2A/ISTA 3A	《International Safe Transit Association》/《国际运输标准》；
JESD22-B117	《BGA Ball Shear BGA》/《焊球的剪切试验》；
JESD22-A104-C	《Temperature Cycling》/《温度循环试验》；

JESD22-A110-B	《Test Method A110-B Highly-Accelerated Temperature and Humidity Stress Test (HAST)》/《高加速寿命试验》；
JESD22-B104-A	《Mechanical Shock》/《机械冲击》；
J-STD-020D	《Moisture/Reflow Sensitivity Classification for Nonhermetic Solid State Surface Mount Devices》/《针对非密封表贴半导体器件的湿度/回流焊敏感度分类和级别》

3. 项目技术方案

发行人目前运用“无芯板(Coreless)技术”、“铜柱(Copper Pillar)技术”、“采用半固化片在铜柱上层压的技术”、“化学机械抛光(CMP)磨板技术”和“真空喷溅(Sputtering)技术”等核心技术进行IC封装基板的生产，本项目同样采用这些技术。本项目的核心技术均为公司自有技术。

数字芯片封装基板与模拟芯片封装基板在工艺技术上主要有两个方面的区别：一方面，数字芯片封装基板主要采用倒装的封装形式，因此增加了基板与IC连接的凸点阵列，目前公司已掌握数字芯片封装基板凸点层制作的技术，并成功实现了小批量量产；另一方面，数字芯片封装基板要求更精密的线路，更小的孔，更佳的热管理以及更好的尺寸稳定性，目前公司采用现有的五项核心技术可实现15/15 μ m的精细线路，40 μ m的孔直径，并能够在尺寸控制和散热性方面充分满足数字芯片的技术需求。此外发行人还将通过LDI控制技术实现每层的曝光尺寸控制，采用独特的线条形状的孔提升封装基板产品刚度，并将在所有层采用低热膨胀系数玻璃纤维环氧树脂布，确保产品具备更佳的散热性和极低的板弯曲度。

公司将通过此募投项目不断进行技术研发和创新，应用新研制的条形实心铜微孔、埋入式静电屏蔽设计、超强散热多形状铜柱、高精细线路及间距等前沿封装基板技术。

4. 生产方法、工艺流程

(1) 模拟芯片封装基板产品

公司将在募投项目中开展的模拟芯片封装基板产品仍采用公司现有的生产方法和工艺流程。同时公司将通过引进先进的设备提高生产自动化水平，例如垂直显影线、垂直褪膜线、种子层蚀刻线将采用自动机械手自动取放，减少人工操作，提高工作效率和产品良率。

(2) 数字芯片封装基板产品

数字芯片封装基板在生产方法和工艺流程方面与模拟芯片封装基板有两大区别，首先，其制作流程中需要增添凸点层的制作流程；其次因数字芯片封装

基板产品的要求更为精密的线路和孔，因此发行人将采用更为先进的设备进行产品生产。

5. 主要设备选择

公司利用二楼厂房，扩充包括电镀车间、LDI 车间、Sputter 车间、磨板车间、AOI 车间、FQC 车间内的已有设备，并采购新设备。设备投产后，预计二楼改扩建项目新增年产能 12.4 万平方米。本项目预计将投入的设备共 150 余台，投资额约 9,515 万美元。其中，进口设备 112 台，共 6,180 万美元；国产设备 27 台，共 1,424 万美元；其他设备若干台，共 1,911 万美元。

主要进口设备如下：

序号	设备名称	数量	金额（万美元）
1	热压机	10	147
2	数控钻机	6	78
3	数控铣床	9	117
4	垂直连续电镀线	5	660
5	铜柱电镀线	5	690
6	电镍金线	3	149
7	磨板机	8	56
8	三次元立体自动光学检测机	7	111
9	除胶渣线	1	8
10	等离子蚀刻机	8	447
11	金属喷溅机	7	1,204
12	真空压膜机	7	204
13	镭射直接成像机	23	1,691
14	铜柱显影线	1	120
15	线路显影线	2	240
16	奥宝自动光学检测机	10	258
	合计	112	6,180

主要国产设备：

序号	设备名称	数量	金额（万美元）
1	棕化线	1	120
2	三次元 X 光检查机	1	15
3	电镀前化学清洗	2	100
4	电镀后化学清洗	4	200
5	退膜线	2	300
6	种子蚀刻线	1	120
7	激光钻孔机	2	49

序号	设备名称	数量	金额（万美元）
8	金属喷溅前化学清洗	3	110
9	干膜前化学清洗	4	200
10	康代自动光学检测机	7	210
	合计	27	1,424

其他设备：

序号	设备名称	数量	金额（万美元）
1	其他设备	若干	1,911
	合计	—	1,911

6. 主要原材料、辅助材料及能源的供应情况

项目实施后，不改变现有的生产经营模式。公司生产现有产品的主要原材料为金盐、铜箔、干膜、半固化片和各类化学药剂，项目投产后不涉及新品种原辅料的增加。经过多年的合作，公司已与供应厂商建立了良好的供求关系，目前原材料供应渠道可以保证正常的生产需要，且区域基础设施完善，供水、供电等市政配套条件良好。

7. 项目人员编制

本项目新增人员约 601 人，其中一线操作工人 505 人，技术人员 30 人；车间管理人员 34 人，其他管理人员 32 人。

8. 环境保护和安全生产

本项目所处富山工业园区已通过广东省电镀基地的整体环境影响评价。相关审批情况见本章“一、本次发行募集资金数额及依据”之“（二）本次募集资金投资项目”。

9. 项目选址、组织方式与实施进展情况

本项目建设地位于珠海市斗门区乾务镇富山工业区方正 PCB 产业园内。公司已在园区内取得独立的土地和房产权证，房产权证号为：粤房地权证珠字第 0300044404 号。厂房占地面积 22,567.04 平方米，建筑面积 41,460.92 平方米。本次公司的改扩建项目将不新增占地面积，使用公司已装修完成的二楼厂房，建设电镀、LDI、SPUTTER、磨板、湿法等车间，建筑面积约为 19,000 平方米。

本项目由珠海越亚组织实施。

截至 2013 年 12 月 31 日，该项目已实际投入 11,943.46 万元。

10. 项目效益分析

项目全部建成投产后，经现金流量分析，各项评价指标均表明本项目具有较好的投资盈利水平。所得税后财务内部收益率为 28.21%；财务净现值（ $i=12\%$ ）31,559 万元，投资回收期 6.9 年（含建设期）；年均主营业务收入为 48,042.33 万元，利润总额为 11,609 万元，具有较好的经济效益。

四、募集资金运用对公司经营成果和财务状况的影响

（一）对净资产的影响

募集资金到位后，预计公司净资产将有所增长。

（二）对资产负债率和资本结构的影响

本次募集资金到位后，公司总资产将大幅度增加，短期内资产负债率将会有所下降，资产负债结构将得到改善。此外，公司偿债能力、持续经营能力将会得到进一步增强，进而提升信用和利用财务杠杆融资的空间，增强了公司防范财务风险的能力。

（三）对销售收入及净资产收益率的影响

本次发行募集资金到位后公司净资产将大幅提高，募集资金投资项目在短期内难以完全释放效益，公司存在发行当年净资产收益率大幅下降的风险。

本次募集资金投向均经过严格科学的论证，并获得公司董事会及股东大会批准，符合本公司发展规划。从中长期来看，募集资金投资项目具有良好的盈利前景。随着募集资金投资项目的展开，公司净资产收益率将逐步回复到合理的水平。但由于市场环境、国家政策的不确定性，也存在募投项目效益低于预期的风险。

（四）新增固定资产投资对未来经营成果的影响

本次募集资金投资项目将增加大量固定资产，按公司现行会计政策测算，将新增固定资产折旧总额为 57,056 万元。本次募集资金项目投产后，如果新增的净利润足以覆盖新增的固定资产折旧，则新增的折旧不会对公司未来经营成果产生不利影响；但如果募投项目的效益未达预期，可能会对未来经营成果产生不利影响。

第十三章 股利分配政策

一、发行人最近 3 年的股利分配政策

发行人系于 2012 年 7 月 31 日整体变更设立的股份有限公司，最近三年的股利分配政策如下：

（一）股份有限公司设立以前的利润分配政策

根据越亚有限《公司章程》之规定，董事会每年年初决定公司上一年度的红利分配方案。如果董事会未能一致通过公司的红利分配方案，则公司的可供分配利润的 50%应按各自出资占注册资本的比例向各方分配。

（二）股份有限公司设立以后的利润分配政策

发行人整体变更设立股份有限公司之后，根据有关法律法规和《公司章程》的规定，发行人实现的税后利润按以下政策进行分配：

“第一百七十六条 公司分配当年税后利润时，应当提取利润的 10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的 50%以上的，可以不再提取。

公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。

公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。

公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但公司持有的本公司股份不得分配利润。

股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。

第一百七十八条 公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是，资本公积金将不用于弥补公司的亏损。

法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的 25%。

第一百七十九条 公司可以采取现金或者股份方式分配股利。

第一百八十条 公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后 2 个月内完成股利（或股份）的派发事项。”

二、最近 3 年公司股利分配情况

本公司自成立以来，根据业务发展的需要和所处的发展阶段，将全部利润用于公司的业务发展，未进行股利分配。

三、本次发行后的股利分配政策

参见本招股说明书“重大事项提示”之“七、发行上市后的利润分配政策”。

四、本次发行完成前滚存利润的分配政策

参见本招股说明书“重大事项提示”之“八、本次发行前未分配利润的处理”。

五、上市当年及此后两个年度利润分配规划

公司 2013 年度股东大会审议通过了《修改<公司上市当年及此后两个年度利润分配规划的议案>的议案》，具体内容如下：

“为完善和健全珠海越亚封装基板技术股份有限公司（以下简称“公司”）科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报投资者，进一步细化《公司章程》中关于利润分配政策的条款，制定了公司上市当年及此后两个年度利润分配规划（以下简称“本规划”或“利润分配规划”）。本规划同时作为公司股东分红回报规划。

一、制定本规划考虑的因素

着眼于公司长远和可持续发展，在综合分析公司经营发展实际、股东要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、本次发行融资、银行信贷及债权融资环境等情况，建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制，对利润分配作出制度性安排，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。

二、本规划的制定及修订原则

（1）本规划的制定及修订应充分考虑和听取公司股东（特别是公众投资者）、独立董事和监事的意见；

（2）本规划应严格执行《公司章程》所规定的利润分配政策；

(3) 本规划的制定及修订应充分考虑投资者回报，合理平衡的处理好公司自身稳健发展和回报股东之间的关系，实施科学、持续、稳定的利润分配政策。

三、利润分配及股东分红回报规划

(1) 利润分配原则

公司实行积极、持续、稳定的利润分配政策，公司利润分配应重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司当年的实际经营情况和可持续发展；公司董事会、监事会和股东大会对利润分配政策的决策和论证应当充分考虑独立董事、监事和公众投资者的意见。

(2) 利润分配形式及优先顺序

公司可以采取现金或者股票或者现金与股票相结合的方式分配股利，且优先采取现金方式分配股利。公司的利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。

公司董事会应综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照本章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：

A、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；

B、公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；

C、公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%。

D、公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%。

(3) 利润分配的期间间隔

A、在公司该年度盈利且实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值的情形下，公司原则上每年度进行一次分红；

B、公司董事会可以根据当期的盈利规模、现金流状况、发展阶段及资金需求状况，提议公司进行中期分红。

(4) 现金分红比例

在满足公司章程规定的公司现金分红条件的情形下，公司每年以现金方式分配的利润应不少于当年实现的可供分配利润的 15%，保持利润分配政策的连续性和稳定性；且任意三个连续会计年度内，公司以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的 30%。

(5) 现金分红的具体条件（公司拟实施现金分红时应同时满足如下条件）

A、公司该年度盈利且实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值，实施现金分红不会影响公司后续持续经营；

B、审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；

C、公司资产负债率情况良好，未来十二个月内无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）。

重大投资计划或重大现金支出是指以下情形之一：

a、公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的 50%，且超过 3,000 万元；

b、公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的 30%。

(6) 发放股票股利的具体条件

根据累计可供分配利润、公积金及现金流状况等情况，在确保足额现金红利分配的前提下，可以采取股票股利的方式进行利润分配，但应当考虑公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。

(7) 未分配利润的用途

公司当年用于分配后剩余的未分配利润将根据公司当年实际发展情况和需要，主要用于保证公司正常开展经营业务所需的营运资金，用于合理业务扩张所需的投资以及其他特殊情况下的需求，具体使用计划安排、原则由董事会根据当年公司发展计划和公司发展目标拟定。

(8) 利润分配具体方案决策程序与机制

A、公司董事会应当根据当期的经营情况和项目投资的资金需求计划，在充分考虑股东利益的基础上正确处理公司的短期利益及长远发展的关系，确定合理的利润分配方案；

B、利润分配方案由公司董事会制定，公司董事会应根据公司的财务经营状况，提出可行的利润分配提案，并经全体董事过半数通过并决议形成利润分配方案；

C、独立董事在召开利润分配的董事会前，应当就利润分配的提案提出明确意见，同意利润分配提案的，应经全体独立董事过半数通过，如不同意利润分配提案的，独立董事应提出不同意的事实、理由，要求董事会重新制定利润分配提案，必要时，可提请召开股东大会；独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。

D、监事会应当就利润分配提案提出明确意见，同时充分考虑外部监事的意见（如有），同意利润分配提案的，应经全体监事过半数通过，如不同意利润分配提案的，监事会应提出不同意的事实、理由，并建议董事会重新制定利润分配提案，必要时，可提请召开股东大会；

E、利润分配方案经上述程序后同意实施的，由董事会提议召开股东大会，并提交股东大会批准。利润分配方案应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上通过；但如股东大会审议发放股票股利或以公积金转增股本的方案，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。同时，就该等议案公司必须根据证券交易所的有关规定提供网络或其他方式为公众投资者参加股东大会提供便利。

公司当年盈利，公司董事会未做出年度现金利润分配预案的，应当在定期报告中披露原因、公司留存资金的使用计划和安排。

存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。

（9）利润分配政策的调整

公司利润分配政策不得随意调整而降低对股东的合理回报。因公司外部环境或者自身经营状况发生较大变化而需要调整利润分配政策的，公司可对利润分配政策进行调整，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定。

A、由公司董事会制定利润分配政策调整方案，充分论证调整利润分配政策的必要性，并说明利润留存的用途，由公司董事会根据实际情况，在公司盈利转强时实施公司对过往年度现金分红弥补方案，确保公司股东能够持续获得现金分红。

B、公司独立董事对利润分配政策调整方案发表明确意见，并应经全体独立董事过半数通过；如不同意，独立董事应提出不同意的事实、理由，要求董事会重新制定利润分配政策调整方案，必要时，可提请召开股东大会。

C、监事会应当对利润分配政策调整方案提出明确意见，同意利润分配政策调整方案的，应形成决议；如不同意，监事会应提出不同意的事实、理由，并建议董事会重新制定利润分配调整方案，必要时，可提请召开股东大会。

D、利润分配政策调整方案应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 $\frac{2}{3}$ 以上通过。在发布召开股东大会的通知时，须公告独立董事和监事会意见。股东大会审议利润分配政策调整方案时，公司应根据证券交易所的有关规定提供网络或其他方式为公众投资者参加股东大会提供便利。

为免疑义，上述“公司外部经营环境或自身经营状况发生较大变化”系指下列情形之一：

a、国家制定的法律法规、行业政策及经济环境发生重大变化，非因公司自身原因导致公司经营亏损；

b、出现地震、台风、水灾、战争等不能预见、不能避免并不能克服的不可抗力因素，对公司生产经营造成重大不利影响导致公司经营亏损；

c、公司法定公积金弥补以前年度亏损后，公司当年实现净利润仍不足以弥补以前年度亏损；

d、公司的主营业务发生重大变化或实施重大资产重组，公司还处于业务调整期的；

e、中国证监会和证券交易所规定的其他事项。

（10）利润分配的信息披露

董事会秘书具体负责公司利润分配相关事项的信息披露。公司应当在定期报告中详细披露现金分红政策的制定及执行情况，说明是否符合公司章程的规定或者股东大会决议的要求，分红标准和比例是否明确和清晰，相关的决策程序和机制是否完备，独立董事是否尽职履责并发挥了应有的作用，中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益是否得到充分维护等。对现金分红政策进行调整或变更的，还要详细说明调整或变更的条件和程序是否合规和透明等。报告期盈利但董事会未作出现金分配预案的，还应当在定期报告中披露原因，以及未用于分红的资金留存公司的用途。

四、公司上市当年及此后两个年度利润分配的具体规划

（1）本次公开发行并上市当年及其后两年，公司每年以现金形式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的 15%;

（2）基于回报投资者和分享企业价值的考虑，从公司成长性、每股净资产的摊薄、公司股价与公司股本规模的匹配性等真实合理因素出发，公司可以在满足现金分红之余进行股票股利分配;

（3）公司目前发展阶段属于成长期且未来有重大资金投入支出安排，进行利润分配时，现金分红在利润分配中所占比例最低应达到 20%。”

第十四章 其他重要事项

一、信息披露制度相关情况

发行人为完善信息披露机制，根据中国证监会的有关规定，建立了信息披露制度，规定发行人必须严格按照法律、法规和《公司章程》规定的信息披露的内容和格式要求，真实、准确、完整、及时地报送及披露信息。发行人信息披露体现公开、公正、公平对待所有股东的原则。

公司负责信息披露及协调投资者关系的部门是证券法律事务部，公司信息披露的负责人为董事会秘书陈春灵先生，电话：0756-5656005。

二、重要合同

（一）重大借款合同及其他融资合同

1. 与中国建设银行股份有限公司珠海市分行签署的合同

2013年12月24日，珠海越亚与建设银行签署了《贸易融资额度合同》（建珠国际贸易融资2013年40号），约定建设银行向珠海越亚提供最高不超过5,000万元的贸易融资总额度，包括即期信用证、远期信用证、信用证项下信托收据贷款、非信用证项下信托收据贷款、出口商业发票融资、出口退税权利质押贷款等，有效期自2013年12月24日至2014年12月24日。

2013年8月27日，珠海越亚与建设银行签署了《海外代付业务合作协议书》（JHHWDF20130827），约定建设银行向珠海越亚提供最高不超过人民币3,000万元的信托收据额度以办理海外代付业务，该额度有效期为2013年8月27日至2014年8月26日。

2014年2月20日，珠海越亚与建设银行签署了《海外代付业务合作协议书》（建珠国际海外代付2014年004号），约定建设银行向珠海越亚提供最高不超过人民币3,000万元的信托收据额度以办理海外代付业务，该额度有效期为2014年2月20日至2014年12月24日。

2014年6月6日，珠海越亚与建设银行签署了《出口商业发票融资业务合作协议书》（建珠国际出口商业发票2014年0606号），约定建设银行向珠海越亚提供最高不超过人民币5,000万元的出口商业发票融资额度，该额度有效期为2014年6月6日至2015年6月5日。

2. 与招商银行股份有限公司珠海分行签署的合同

2012年7月5日，越亚有限与招商银行签署了《授信协议》（2012年珠字第0012560006号），约定招商银行向越亚有限提供10,000万元的授信额度，种类为固定资产贷款的单项授信额度，授信期间自2012年7月18日到2015年7月17日，担保方式为信用担保。

2012年9月27日，珠海越亚与招商银行签署了《固定资产借款合同》（2012年珠字第1112560001号），约定珠海越亚向招商银行申请固定资产贷款10,000万元，用于购买珠海多层之工业厂房，贷款期限为36个月，自2012年9月27日至2015年9月27日。

2013年9月12日，珠海越亚与招商银行签署了《授信协议》（2013年珠字第0013565029号），约定招商银行向珠海越亚提供循环额度人民币8,000万元的授信额度，授信额度为综合授信额度，具体业务种类包括流动资金贷款、银行承兑汇票（含人行电票、另收取不低于20%保证金）、商票保贴、开立国内国际信用证（另收取不低于20%保证金）、进出口押汇（进口开证远期加押汇期限不超过180天）、国内国际保理、非融资性保函（另收取不低于20%保证金），授信期间自2013年10月22日到2014年10月21日。

2013年9月12日，珠海越亚与招商银行签署了《授信协议》（2013年珠字第0113565030号），约定招商银行向珠海越亚提供一次性额度人民币6,000万元的授信额度，授信额度为固定资产贷款单项授信额度，授信期间自2013年10月22日到2016年10月21日。

3. 与南洋商业银行（中国）有限公司深圳分行签署的合同

2012年7月19日，越亚有限与南洋银行签署了《授信额度协议》（043-469-12400016C000号），约定南洋银行向越亚有限提供授信额度11,340万元，其中固定资产贷款授信额度为1,000万美元，不可循环使用；流动资金贷款授信额度为5,000万元，可循环使用；授信额度期限为2012年9月26日至2016年9月26日，担保方式为信用担保。

截至本招股说明书签署日，基于上述《授信额度协议》项下签署的《固定资产借款合同》情况如下：

编号	签署日期	固定资产借款合同	借款金额	借款期限
1	2013年9月27日	043-469-12400016C200号	888,400.00 美元	2012年9月27日 -2016年9月26日
			80,000.00 美元	2012年10月12日 -2016年9月26日
			1,069,455.44 美元	2012年10月23日

编号	签署日期	固定资产借款合同	借款金额	借款期限
				-2016 年 9 月 26 日
			1,483,205.72 美元	2012 年 11 月 07 日 -2016 年 9 月 26 日
			160,000.00 美元	2012 年 11 月 21 日 -2016 年 9 月 26 日
			175,833.27 美元	2013 年 12 月 21 日 -2016 年 9 月 26 日
			193,000.00 美元	2013 年 1 月 17 日 -2016 年 9 月 26 日
2	2013 年 5 月 23 日	043-469-12400016C20 0-1 号	368,217.05 美元	2013 年 5 月 23 日 -2016 年 9 月 26 日
3	2013 年 7 月 31 日	043-469-12400016C20 0-130731 号	409,666.40 美元	2013 年 7 月 31 日 -2016 年 9 月 26 日
4	2013 年 8 月 23 日	043-469-12400016C20 0-130823 号	819,332.80 美元	2013 年 8 月 23 日 -2016 年 9 月 26 日
5	2013 年 8 月 26 日	043-469-12400016C20 0-130826 号	210,000.00 美元	2013 年 8 月 26 日 -2016 年 9 月 26 日
6	2013 年 8 月 27 日	043-469-12400016C20 0-130827 号	210,000.00 美元	2013 年 8 月 27 日 -2016 年 9 月 26 日
7	2013 年 9 月 3 日	043-469-12400016C20 0-130903 号	242,400.00 美元	2013 年 9 月 3 日-2016 年 9 月 26 日
8	2013 年 9 月 4 日	043-469-12400016C20 0-130904 号	200,000.00 美元	2013 年 9 月 4 日-2016 年 9 月 26 日
9	2013 年 9 月 5 日	043-469-12400016C20 0-130905 号	232,000.00 美元	2013 年 9 月 5 日-2016 年 9 月 26 日
10	2013 年 9 月 11 日	043-469-12400016C20 0-130911 号	1,011,600.00 美元	2013 年 9 月 11 日 -2016 年 9 月 26 日

4. 与中国光大银行股份有限公司珠海分行签署的合同

2014 年 5 月 14 日，珠海越亚向光大银行提交《出口融资申请书》（FN7808140001AAI），当日光大银行向珠海越亚提供了融资期限 58 天、融资金额 42.50 万美元的出口押汇融资，融资利率为 3.392250%。

5. 与中国银行股份有限公司珠海分行签署的合同

2014 年 4 月 21 日，珠海越亚与中国银行签署了《授信额度协议》（GED476380120140102），约定中国银行向珠海越亚提供综合授信额度 6,000.00 万元，其中短期贷款不超过 1,500.00 万元，该授信额度为循环额度。

2014 年 4 月 22 日，珠海越亚与中国银行签署了《流动资金借款合同》（GDK476380120140037 号），约定珠海越亚向中国银行借款 600 万元，用于支付

货款，贷款期限为 12 个月，自 2014 年 4 月 22 日至 2015 年 4 月 21 日。

2014 年 5 月 27 日，珠海越亚与中国银行签署了《流动资金借款合同》（GDK476380120140146 号），约定珠海越亚向中国银行借款 237 万元，用于支付货款，贷款期限为 12 个月，自 2014 年 5 月 27 日至 2015 年 5 月 26 日。

6. 与汇丰银行（中国）有限公司珠海支行签署的合同

2014 年 2 月 8 日，汇丰银行向珠海越亚授予银行授信（银行授信 S/N: 131205 号），授信金额为最高不超过人民币 20,000,000.00 或等值的人民币/美元/欧元/港币贷款，授信提款为每笔提款之日后 1 年。

同日，汇丰银行向珠海越亚授予财资产品授信（银行授信 S/N: 131205&140115 号），财资产品授信总额度不超过 500,000.00 美元，最长到期期限为 12 个月，在财资产品授信下可交易的产品种类为普通外汇交易（包括普通远期/掉期交易/无本金交割远期/平价远期）和利率掉期交易。

2013 年 3 月 13 日，珠海越亚向汇丰银行提请贷款 8,565,822.91 港元，借款期限为 2013 年 3 月 13 日至 2015 年 3 月 13 日，利息每季度偿还一次。

2014 年 4 月 23 日，珠海越亚向汇丰银行提请贷款人民币 1,628,500.00 元，借款期限为 2014 年 4 月 23 日至 2015 年 4 月 22 日，利息每季度偿还一次。

2014 年 4 月 23 日，珠海越亚向汇丰银行提请贷款 6,494,783.00 港元，借款期限为 2014 年 4 月 23 日至 2015 年 4 月 22 日，利息每季度偿还一次。

7. 与中国工商银行股份有限公司珠海斗门支行签署的合同

2013 年 10 月 30 日，珠海越亚与工商银行签署了《进口 T/T 融资总协议》（斗门支行 2013 年 TT 字第 1023 号），协议规定由工商银行为珠海越亚办理进口 T/T 融资业务，每笔业务由珠海越亚另以书面形式逐笔申请，协议的有效期为 2013 年 10 月 30 日至 2014 年 12 月 31 日。

2013 年 9 月 18 日，珠海越亚与工商银行签署了《出口发票融资业务总协议》（2013 年斗发字 0723 号），协议规定由工商银行为珠海越亚办理出口发票融资业务，每笔业务由珠海越亚另以书面形式逐笔申请，珠海越亚将每一份《出口发票融资业务申请书》所对应的合同项下的应收账款转让/质押给工商银行，并保证所收货款汇入工商银行指定账户，用于偿还珠海越亚的融资款及有关利息、罚息、费用等。截至本招股说明书签署日，基于上述《出口发票融资业务总协议》（2013 年斗发字 0723 号）项下签署的《质押合同》情况如下：

编号	签署日期	质押合同编号	质权人	出质方	质物
1	2013 年 9 月 30 日	斗门支行 2013 年质押字第 0928 号	工商银行	珠海越亚	应收账款 580,031.56 美元
2	2013 年 10 月 30 日	斗门支行 2013 年质押字第 1101 号	工商银行	珠海越亚	应收账款 645,106.70 美元
3	2013 年 12 月 11 日	斗门支行 2013 年质押字第 1213 号	工商银行	珠海越亚	应收账款 1,125,254.84 美元
4	2014 年 2 月 28 日	斗门支行 2014 年质押字第 0228 号	工商银行	珠海越亚	应收账款 1,254,183.69 美元
5	2014 年 3 月 20 日	斗门支行 2014 年质押字第 0319 号	工商银行	珠海越亚	应收账款 1,613,134.37 美元
6	2014 年 3 月 20 日	斗门支行 2014 年质押字第 0320 号	工商银行	珠海越亚	应收账款 636,422.20 美元

8. 与中国农业银行股份有限公司珠海朝阳支行签署的合同

2014 年 2 月 10 日，珠海越亚与农业银行签署《出口贸易融资合同》（44140520140000235 号），合同约定农业银行向珠海越亚提供订单融资，融资期限为 2014 年 2 月 10 日至 2014 年 8 月 8 日。当日，农业银行向珠海越亚提供人民币 540 万元的融资款，融资期限自 2014 年 2 月 10 日至 2014 年 8 月 8 日，融资利息 4.7%。

2014 年 3 月 13 日，珠海越亚与农业银行签署《流动资金借款合同》（44010120140002330 号），合同约定珠海越亚向农业银行借款 600.00 万元用于流动资金周转，借款日期为 2014 年 3 月 13 日，借款期限为一年，借款利率为固定利率，按人民银行公布的同期同档次基准利率基础上浮 15%。

2014 年 4 月 10 日，珠海越亚与农业银行签署《出口贸易融资合同》（44060820140000223 号），合同约定农业银行向珠海越亚提供出口商票融资，融资期限为 2014 年 4 月 11 日至 2014 年 7 月 10 日。同日双方签订《权利质押合同》，珠海越亚以 4,001,208.71 美元的应收账款出质，被担保的债权本金为 380.00 万美元，双方就上述质押签署了《应收账款质押登记协议》。

2014 年 4 月 24 日，珠海越亚与农业银行签署《出口贸易融资合同》（44060820140000238 号），合同约定农业银行向珠海越亚提供出口商票融资，融资期限为 2014 年 4 月 24 日至 2014 年 7 月 23 日。同日双方签订《权利质押合同》，珠海越亚以 1,274,885.43 美元的应收账款出质，被担保的债权本金为 120.00 万美元，双方就上述质押签署了《应收账款质押登记协议》。

2014 年 5 月 21 日，珠海越亚与农业银行签署《出口贸易融资合同》

(44140520140000753 号), 合同约定农业银行向珠海越亚提供订单融资, 融资期限为 2014 年 5 月 21 日至 2014 年 11 月 17 日。当日, 农业银行向珠海越亚提供人民币 820 万元的融资款, 融资期限自 2014 年 5 月 21 日至 2014 年 11 月 17 日, 融资利息 4.2%。

2014 年 6 月 11 日, 珠海越亚与农业银行签署《出口贸易融资合同》(44060820140000370 号), 合同约定农业银行向珠海越亚提供出口商票融资, 融资期限为 2014 年 6 月 11 日至 2014 年 9 月 10 日。同日双方签订《权利质押合同》, 珠海越亚以 1,228,148.93 美元的应收账款出质, 被担保的债权本金为 100.00 万美元, 双方就上述质押签署了《应收账款质押登记协议》。

9. 与平安银行股份有限公司珠海分行签署的合同

2013 年 9 月 17 日, 珠海越亚与平安银行签署了《综合授信额度合同》(平银分营综字 20130801 第 001 号), 约定平安银行向珠海越亚提供人民币 10,000 万元的授信额度, 授信额度为循环额度, 授信期间自 2013 年 9 月 17 日到 2014 年 9 月 16 日。

同日, 双方签署了《进口 T/T 押汇总合同》(平银分营进融字 20130910 第 001 号), 对汇款结算方式下双方办理进口 T/T 押汇业务时双方权利、义务进行了具体约定。

(二) 重大采购合同

发行人签订的金额在 500 万元以上的重大采购合同如下:

1. 设备采购合同

序号	合同对方	签署日期	合同标的	合同金额
1	佳辉设备有限公司	2011-3-31	垂直连续电镀线	USD 1,150,000
2	佳辉设备有限公司	2012-2-8	垂直连续电镀线	USD 1,080,000
3	超淦企业国际有限公司	2012-6-19	垂直显影线	USD 1,520,000
4	超淦企业国际有限公司	2012-10-19	垂直褪膜线	USD 1,800,000
5	Gebr. Schmid GmbH+ Co	2012-10-26	非接触超粗化线、自动收板机、自动放板机	EUR 750,000
6	Gebr. Schmid GmbH+ Co	2012-10-26	非接触种子层蚀刻线、自动收板机、自动放板机	EUR 1,000,000
7	Orbotech Asia Limited	2012-3-27	镭射直接成像机、自动光学检测机	USD 4,208,000
8	ORBOTECH ASIA LTD	2013-6-25	镭射直接成像机	USD 2,048,332.00
9	ORBOTECH ASIA LTD	2013-7-8	镭射直接成像机	USD 4,096,664.00
10	佳辉设备有限公司	2014-1-7	垂直连续电镀线	USD 910,000.00

序号	合同对方	签署日期	合同标的	合同金额
11	ULVAC, Inc.	2014-2-17	In-Line Sputter	USD 2,700,000.00

2. 原材料采购框架协议

序号	合同对方	签署日期	合同标的及金额	合同有效期
1	珠海市剧毒物品专卖有限公司	2012-10-23	以采购订单为准	无期限，直至任一方提前一个月书面通知终止协议
2	深圳市柳鑫实业有限公司	2012-9-4	以采购订单为准	无期限，直至任一方提前一个月书面通知终止协议
3	日立化成电子材料（香港）有限公司	2012-4-6	以采购订单为准	无期限，直至任一方提前一个月书面通知终止协议
4	日立化成工业（东莞）有限公司	2012-3-26	以采购订单为准	无期限，直至任一方提前一个月书面通知终止协议
5	上村旭光化工机械（深圳）有限公司	2012-3-5	以采购订单为准	无期限，直至任一方提前一个月书面通知终止协议
6	东莞市登峰电子材料有限公司	2012-2-13	以采购订单为准	无期限，直至任一方提前一个月书面通知终止协议
7	东莞市广华化工有限公司	2012-2-10	以采购订单为准	无期限，直至任一方提前一个月书面通知终止协议
8	珠海开能环保科技有限公司	2011-11-22	以采购订单为准	无期限，直至任一方提前一个月书面通知终止协议
9	珠海镇东有限公司	2011-8-8	以采购订单为准	无期限，直至任一方提前一个月书面通知终止协议
10	珠海市庆龙化工有限公司	2013-6-27	以采购订单为准	无期限，直至任一方提前一个月书面通知终止协议

（三）重大销售合同

发行人签署了如下正在履行中的销售框架协议：

序号	合同对方	签署日期	合同标的及金额	合同有效期
1	ASE Korea Inc.	2012-10-19	以订单为准	自签署之日起 3 年
2	无锡中普微电子有限公司	2013-3-8	以订单为准	自签署之日起 3 年，到期后自动延期 1 年，除非合同任一方提前发出书面终止通知
3	惠州市正源微电子有限公司	2013-3-12	以订单为准	自签署之日起 3 年，到期后自动延期 1 年，除非合同任一方提前发出书面终止通知
4	Black Sand Technologies	2013-4-8	以订单为准	自签署之日起 1 年，到期后自动延期 1 年，除非合同任一方提前发出书面终止通知
5	RF Micro Devices, Inc.	2013-4-1	以订单为准	自签署之日起 3 年，到期后自动延期 1 年，除非合同任一方提前

序号	合同对方	签署日期	合同标的及金额	合同有效期
				发出书面终止通知

除上述销售框架协议外，截至本招股说明书签署之日，发行人不存在尚未执行完毕的，金额在 500 万元以上的重大销售合同。

（四）工程承包合同

2012 年 3 月 15 日，越亚有限与中国电子系统工程第四建设有限公司签署了《珠海越亚封装基板技术有限公司二楼扩建项目改造及机电安装总承包合同》，约定越亚有限将越亚有限二楼厂房的改造和机电安装工程发包给中国电子系统工程第四建设有限公司承包实施，合同工期分为两期，一期的工期为 2012 年 3 月 15 日至 2012 年 5 月 1 日，二期的工期为 2012 年 5 月 1 日至 2012 年 9 月 1 日，工程总价款为 6,290 万元，工程质量保修期为工程验收合格后一年，中国电子系统工程第四建设有限公司应向越亚有限提供履约担保，担保方式为 629 万元的银行保函。该工程合同尚有部分尾款未支付完毕。

2013 年 8 月 26 日，珠海越亚与珠海明源机电工程有限公司签署了《珠海越亚封装基板技术股份有限公司增容配电工程施工合同》，约定珠海越亚将珠海越亚增容配电工程发包给珠海明源机电工程有限公司，合同工期为 2013 年 8 月 29 日至 2013 年 10 月 31 日，工程总价款 490.00 万元。由于该工程尚未完成最终验收，尚有部分尾款未支付完毕。

（五）关联交易相关合同

1. 2013 年 4 月 1 日签订的《园区综合服务协议》，

关于该协议的情况，详见本招股说明书“第六章 同业竞争与关联交易”之“三、关联交易事项”之“（一）报告期内经常性关联交易”。

2. 2013 年 10 月 1 日签订的《园区综合服务协议》

关于该协议的情况，详见本招股说明书“第六章 同业竞争与关联交易”之“三、关联交易事项”之“（一）报告期内经常性关联交易”。

三、对外担保情况

截至本招股说明书签署日，本公司无任何对外担保情况。

四、重大诉讼或仲裁事项

截至本招股说明书签署日，本公司无重大诉讼或仲裁事项。

五、其他重要事项

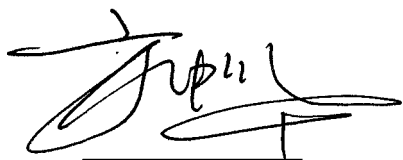
截至本招股说明书签署日，本公司无其他应披露而未披露的重要事项。

第十五章 董事、监事、高级管理人员及有关中介机构声明

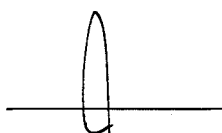
一、发行人全体董事、监事、高级管理人员声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

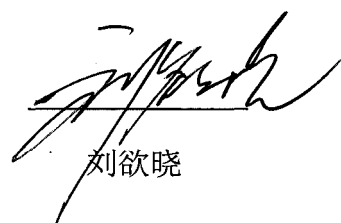
全体董事（签字）：



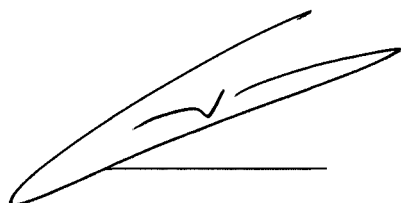
方中华



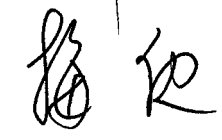
Yotam Stern



刘欲晓



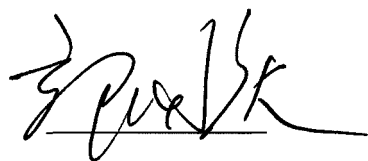
Rafi Amit



梅健



Yoon Sung Yong



郭国庆

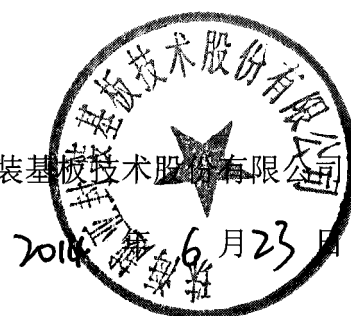


赵晋琳



赵大利

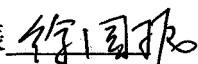
珠海越亚封装基板技术股份有限公司



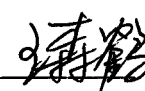
二、保荐人（主承销商）声明

本公司已对招股说明书及其摘要进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

法定代表人： 宫少林 

保荐代表人： 徐国振 

张 迎 

项目协办人： 王森鹤 

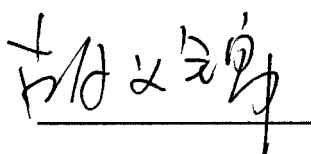


2014年 6 月23 日

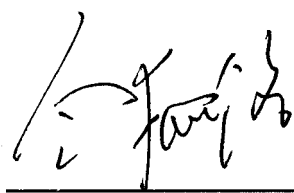
三、发行人律师声明

本所及经办律师已阅读招股说明书及其摘要，确认招股说明书及其摘要与本所出具的法律意见书和律师工作报告无矛盾之处。本所及经办律师对发行人在招股说明书及其摘要中引用的法律意见书和律师工作报告的内容无异议，确认招股说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

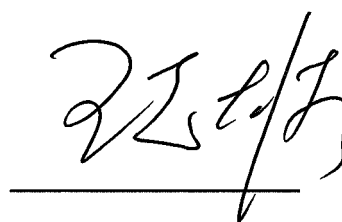
经办律师：



胡义锦



令狐铭



王志雄

律师事务所负责人：



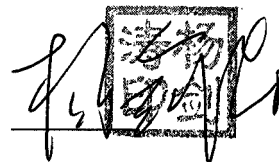
刘大力



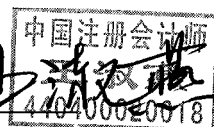
四、审计机构声明

本所及签字注册会计师已阅读招股说明书及其摘要,确认招股说明书及其摘要与本所出具的审计报告、内部控制鉴证报告及经本所核验的非经常性损益明细表无矛盾之处。本所及签字注册会计师对发行人在招股说明书及其摘要中引用的审计报告、内部控制鉴证报告及经本所核验的非经常性损益明细表的内容无异议,确认招股说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

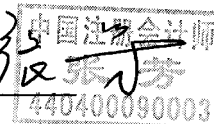
负 责 人: 杨剑涛



注册会计师: 王淑燕


中国注册会计师
440400020018

张 芳


中国注册会计师
440400090003

瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)

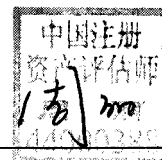


2014 年 6 月 23 日

五、资产评估机构声明

本机构及签字注册资产评估师已阅读招股说明书及其摘要，确认招股说明书及其摘要与本机构出具的资产评估报告无矛盾之处。本机构及签字注册资产评估师对发行人在招股说明书及其摘要中引用的资产评估报告的内容无异议，确认招股说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

经办注册资产评估师：



周丽

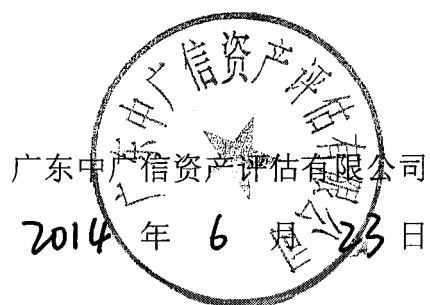


汤锦东

资产评估师事务所负责人：



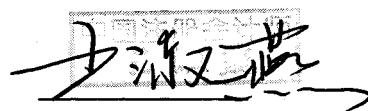
汤锦东



六、验资机构声明

本机构及签字注册会计师已阅读招股说明书及其摘要，确认招股说明书及其摘要与本机构出具的验资报告无矛盾之处。本机构及签字注册会计师对发行人在招股说明书及其摘要中引用的验资报告的内容无异议，确认招股说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

经办注册会计师：

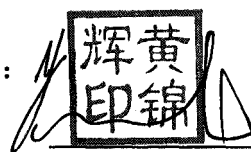


王淑燕



凌运良

会计师事务所负责人：



黄锦辉



七、验资复核机构声明

本机构及签字注册会计师已阅读招股说明书及其摘要，确认招股说明书及其摘要与本所出具的验资复核报告无矛盾之处。本机构及签字注册会计师对发行人在招股说明书及其摘要中引用的报告的内容无异议，确认招股说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述及重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

负 责 人： 杨剑涛



注册会计师： 王淑燕


中国注册会计师
440400020018

张 芳


中国注册会计师
440400090003

瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)



2014年6月23日

第十六章 备查文件

投资者可以查阅与本次公开发行有关的所有正式法律文件，该等文件也在指定网站上披露，具体如下：

- 1、发行保荐书、发行保荐工作报告；
- 2、财务报表及审计报告；
- 3、内部控制鉴证报告；
- 4、经注册会计师核验的非经常性损益明细表；
- 5、法律意见书及律师工作报告；
- 6、公司章程（草案）；
- 7、中国证监会核准本次发行的文件；
- 8、其他与本次发行有关的重要文件。

以上各种备查文件将陈放在公司和保荐人（主承销商）的办公地点，投资者在公司股票发行的承销期内可到下述地点查阅：

发行人：珠海越亚封装基板技术股份有限公司

住所：珠海市斗门区珠峰大道北 3209 号 FPC 厂房

法定代表人：方中华

联系人：陈春灵

电话：0756-5656005

传真：0756-5656510

保荐人（主承销商）：招商证券股份有限公司

住所：深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38—45 楼

法定代表人：宫少林

联系人：徐国振、张迎、王森鹤

电话：0755-82943666

传真：0755-82943121

投资者也可以于网站 <http://www.cninfo.com.cn> 查阅本招股说明书等电子文件。